

GESCHÄFTSBERICHT 2002

NEUE WEGE. NEUE ZIELE.



Never stop thinking.

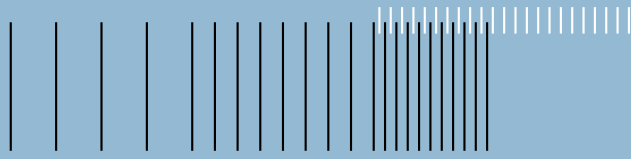
	1	Never stop thinking
	10	Brief an die Aktionäre
	14	Vorstand, Vision und Mission
<hr/>		
STRATEGIE	19	Unternehmensstrategie
	22	Kunden und Märkte
	26	Fertigung und Logistik
<hr/>		
NACHHALTIGKEIT	31	Innovationen
	40	Mitarbeiter
	43	Umweltschutz
<hr/>		
CHRONIK	47	Die IFX Aktie
	52	Chronik 2002
	58	Chronik 1952–2002
<hr/>		
GESCHÄFTSBEREICHE	63	Konzernentwicklung
	64	Drahtgebundene Kommunikation
	66	Mobile Kommunikation
	68	Sicherheits- und Chipkarten-ICs
	70	Automobil- und Industrieelektronik
	72	Speicherprodukte
	74	Umsatzentwicklung in den Quartalen
<hr/>		
FINANZBERICHT	77	Inhaltsverzeichnis Finanzbericht
	78/82	Bericht des Aufsichtsrats/Corporate Governance
	84	Konzernlagebericht
	120	Konzernabschluss
<hr/>		
	180	Mehrjahresübersicht 1998–2002
	182	Stichwortverzeichnis/Impressum
		Finanzkalender/Kontaktinformationen
		Finanzglossar/Technologieglossar (Umschlag innen)

» Zukunftsorientierte Aussagen

Der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte Aussagen. Diese sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der Infineon Technologies AG. Diese beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen.

Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen.

Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.



Infineon Kennzahlen

Geschäftsjahr (1. Oktober bis 30. September)	2001		2002		2002:2001	2002
	Mio. Euro (in % vom Umsatz)		Mio. Euro (in % vom Umsatz)		Veränd. in %	Mio. US-Dollar
Umsatz	5.671		5.207		-8 %	5.144
nach Regionen:						
Deutschland	1.745	(31 %)	1.372	(26 %)	-21 %	1.355
Europa (ohne D)	1.260	(22 %)	1.023	(20 %)	-19 %	1.011
NAFTA (inkl. USA)	1.262	(22 %)	1.211	(23 %)	-4 %	1.196
Asien/Pazifik (inkl. Japan)	1.309	(23 %)	1.512	(29 %)	+16 %	1.494
Andere	95	(2 %)	89	(2 %)	-6 %	88
nach Geschäftsbereichen:						
Drahtgebundene Kommunikation	766	(14 %)	386	(7,5 %)	-50 %	381
Sichere Mobile Lösungen ¹ , davon	1.548	(27 %)	1.295	(25 %)	-16 %	1.279
Mobile Kommunikation	960	(17 %)	874	(17 %)	-9 %	863
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	588	(10 %)	421	(8 %)	-28 %	416
Automobil- und Industrieelektronik	1.153	(20 %)	1.201	(23 %)	+4 %	1.186
Speicherprodukte	1.588	(28 %)	1.844	(35,5 %)	+16 %	1.822
Sonstige und Konzernfunktionen	616	(11 %)	481	(9 %)	-22 %	475
Bruttomarge vom Umsatz	767	(14 %)	601	(12 %)	-22 %	594
Forschungs- und Entwicklungsaufwand	1.189		1.060		-11 %	1.047
Betriebliches Ergebnis	-1.125		-1.072		+5 %	-1.059
Konzernfehlbetrag	-591		-1.021		-73 %	-1.009
EBIT (EBIT-Marge)	-1.024	(-18 %)	-1.142	(-22 %)	-12 %	-1.128
Konzernfehlbetrag je Aktie	EUR -0,92		EUR -1,47		-60 %	USD -1,45
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	211		237		+12 %	234
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	1.813		1.244		-31 %	1.229
Free-Cash-Flow ²	-1.994		-360		+82 %	-356
Abschreibungen	1.122		1.371		+22 %	1.355
Investitionen in Sachanlagen	2.282		643		-72 %	635
Brutto-Cash-Position ³	936		2.007		+114 %	1.983
Netto-Cash-Position (am 30.09.) ⁴	568		177		-69 %	175
Sachanlagen	5.233		4.491		-14 %	4.438
Bilanzsumme	9.743		10.918		+12 %	10.786
Summe Eigenkapital	6.900		6.158		-11 %	6.084
Eigenkapitalquote	71 %		56 %		-21 %	56 %
Verschuldungsgrad ⁵	5 %		30 %		+500 %	30 %
Eigenkapitalrendite ⁶	-9 %		-16 %		-78 %	-16 %
Gesamtkapitalrendite ⁷	-11 %		-11 %		0 %	-11 %
Mitarbeiter (am 30.09.)	33.813		30.423		-10 %	30.423

¹ Infineon hat mit Wirkung zum 1. November 2002 den neuen Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen gegründet. Dieser fasst die bisherigen Bereiche Mobile Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs zusammen.

² Mittelzu- bzw. -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit, bereinigt um die Verringerung bzw. Erhöhung des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit und um kurzfristig verfügbare Wertpapiere.

³ Brutto-Cash-Position = Zahlungsmittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens plus als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel.

⁴ Netto-Cash-Position = Brutto-Cash-Position minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

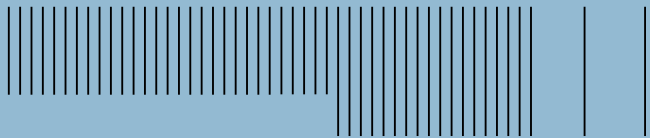
⁵ Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

⁶ Eigenkapitalrendite = Jahresfehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital.

⁷ Gesamtkapitalrendite = EBIT im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.

Infinion Geschäftsbereiche

	Drahtgebundene Kommunikation	Sichere Mobile Lösungen		Automobil- und Industrieelektronik	Speicherprodukte
		Mobile Kommunikation	Sicherheits- und Chipkarten-ICs		
Marktposition	<ul style="list-style-type: none"> Nr. 1 in Parallel Optical Links (Paroli) für Intraoffice-Anwendungen Nr. 1 in Breitbandzugang-10BaseS (VDSL) Nr. 1 in Fiber Optics Gigabit-Ethernet und Bidi Transceivern Nr. 1 in ISDN Nr. 2 in traditionellen Telekommunikationsanwendungen (SLIC, SLAC, T1/E1) Nr. 1 in 40G Optical Networking ICs 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. 1 unter den Anbietern digitaler Chip-Sätze für schnurlose Telefone Unter den Top 3 der Anbieter für GSM-ICs Nr. 1 der Lieferanten von diskreten HF-Halbleiter-Komponenten Führender Anbieter von Bluetooth Chips und Lösungen 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. 1 am Markt für Chipkarten-ICs (über 4 Mrd. Stück in den letzten 10 Jahren) Führende Position im Bereich Telekommunikation, Zahlungsverkehr, Identifikation, Biometrie, Plattform-sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. 2 am Markt für Halbleiter im Automobilbereich Nr. 1 am europäischen Markt für Halbleiter im Automobilbereich bei <ul style="list-style-type: none"> – Motormanagement mit Mikrocontrollern – Airbags und ABS mit SMART-Power-ICs Nr. 3 am Markt für industrielle Antriebe 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. 3 auf dem DRAM-Markt Führend in der Herstellung von 256-Mb-Chips und 512-Mb-Chips Nr. 1 in der 300-Millimeter-Produktion Bevorzugter Partner von Schlüsselkunden
Haupteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Breites Portfolio in Schlüsseltechnologien wie Mixed Signal- und Glasfaser-Technologie und Embedded DRAM Hervorragende Expertise bei Konvergenz von optischen Komponenten und ICs Führende Technologien für Transceiver Führende Prozesstechnologien (bipolar, BiCMOS, SiGe, GaAs, InP, Glas on Silicon) Eintritt in den Markt für 10/40 Gigabit Optische Line Cards 	<ul style="list-style-type: none"> Führend in HF-Prozess-technologien (bipolar, BiCMOS, SiGe) und in der Signalverarbeitung Komplette Produktpalette für mobile Anwendungen Weltweit kleinste Single-Chip Bluetooth Lösung Einzigartige Systemexpertise Design- und Software-Support für mobile Anwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> Führende Expertise in Sicherheitsanwendungen und Kryptographie Höchste Qualität bei Embedded EEPROM-Chips Innovationsführerschaft beim Module Packaging Innovationsführerschaft bei 32-Bit-High-Performance-Sicherheitscontrollern Führende Position bei Plattformsicherheit Großes Potenzial bei kontaktlosen Systemen 	<ul style="list-style-type: none"> Langfristige Beziehungen zu Branchenführern Große Bandbreite an Technologien (Power, Mikrocontroller, Sensoren) Führende Position in neuen Wachstumssegmenten des Automobilbereiches (X-by-Wire, 42-V-Technologie, Infotainment-Systeme) Führende Position bei industriellen Hochleistungsmärkten (z. B. CoolMOS, CoolSET, OptiMOS) 	<ul style="list-style-type: none"> Drei 200-Millimeter-Scheibenfertigungen auf ≤ 0,17 µm Zwei 300-Millimeter-Scheibenfertigungen auf 0,14 µm Allianzen mit IBM, Toshiba, AMD und DuPont Fertigungs- und Produktsynergien bei Nicht-DRAM-Produkten <ul style="list-style-type: none"> – Umfangreiche Einsparungen bei Fertigungs-, F&E- und Gemeinkosten – Effizienterer Ramp-up und flexible Kapazitätsausnutzung
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> ICs für optische Netzwerke Halbleiter für Telekommunikationsnetze und Breitbandzugangsnetze Optische Module 	<p>Komponenten & Kits:</p> <ul style="list-style-type: none"> Basisband-ICs Hochfrequenz-ICs Diskrete Halbleiter-Komponenten ICs für Mobilfunk-Basisstationen <p>Lösungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobilfunk-Plattformdesign Mobilfunk-Datenmodule Mobilfunk-Software-lösungen 	<p>Komponenten & Lösungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sicherheits-Speicher Sicherheitscontoller Fingerabdrucksensoren Sichere nichtflüchtige Massenspeicher inkl. MultimediaCard ICs Kontaktlose Systeme Plattform-Sicherheits-lösungen Sicherheitssoftware-Module 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungshalbleiter Leistungsmodule Mikrocontroller Sensoren Diskrete Halbleiter-Komponenten 	<ul style="list-style-type: none"> 64M-1G-DRAMs (SDRAM, DDR, RDRAM) Grafik-DRAMs Spezial-DRAMs für höchste Leistungsanforderungen Spezial-DRAMs für Low-Power und mobile Anwendungen
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> Breitbandzugangsnetze Hochgeschwindigkeits-Line Cards für optische Metro- und Weitverkehrs-Netze 	<ul style="list-style-type: none"> Mobiltelefone Schnurlose Telefone Wireless Local Area Networks Personal Area Networks (PAN) GPS-Geräte Mobile Anwendungen und Systeme Basisstationen für Mobilfunk 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation (SIM, Telefonkarten) Payment Identifikation (Ausweise, Gesundheitskarten, Item Management) Computing (Plattformsicherheit, Biometrie) Entertainment (Pay-TV, Content Protection) 	<ul style="list-style-type: none"> Automobilelektronik (Powertrain, Comfort Management, Safety Management, Infotainment) Industrielle Antriebe Automatisierungssysteme Energieversorgung Netzteile 	<ul style="list-style-type: none"> PCs und Notebooks PC-Aufrüstung Workstations Infrastruktur (Server und Netzwerke) PDAs SMART-Telefone Peripherie-Geräte
Schlüsselkunden	<ul style="list-style-type: none"> Alcatel Cisco Ericsson Fujitsu Huawei Lucent Marconi NEC Nokia Nortel Siemens 	<ul style="list-style-type: none"> Ericsson Matsushita Mitsubishi Motorola Nokia Sagem Samsung Siemens Solectron Sony Vtech 	<ul style="list-style-type: none"> Gemplus Giesecke & Devrient Oberthur Card Systems Schlumberger 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Delphi Denso Hella Motorola Siemens Industry Siemens VDO TRW Visteon 	<ul style="list-style-type: none"> Acer Cisco Dell Fujitsu HP/Compaq IBM Legend Sony Sun Western Digital



Im vergangenen Jahr **SPRACHEN** viele
von der größten Krise der Halbleiter-
Industrie seit ihrem Bestehen. Wir bei
Infineon haben diese Zeit **GENUTZT**, um
unser Unternehmen neu **ZU DEFINIEREN**.



Wir haben ehrgeizige ZIELE.

Infineon hat klare Vorstellungen, wie sich das Unternehmen weiter verändern wird. Wir haben genau definiert, was wir in den nächsten fünf Jahren erreichen wollen – und das ist eine ganze Menge. Unsere Mitarbeiter unterstützen die neuen Ziele, die sich auch in einer neuen Vision und Mission für Infineon ausdrücken.





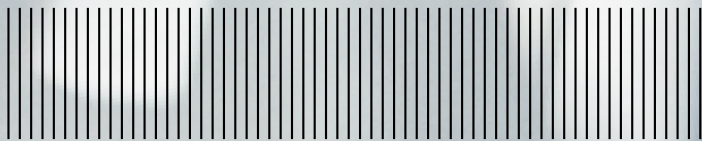
Wir vertrauen auf TALENT.

Bei uns können sich die Menschen entfalten. Schließlich sind es die Kreativität und das Engagement unserer Mitarbeiter, die Infineon weiter nach vorne bringen. Gerade in einer schwierigen Marktlage. Das Ergebnis sind zukunftsweisende Applikationen, die sich in erster Linie auf eines fokussieren: auf die Bedürfnisse des Menschen.



Wir ermöglichen INDIVIDUALITÄT.

Zukunft heißt, dass alle, die im 21. Jahrhundert angekommen sind, ihr Leben frei und individuell gestalten können. Wir bieten dafür Technologien an und machen die elektronischen Produkte marktfähig, die sich die Menschen wünschen. Und mit denen es ihnen gelingt, ihren persönlichen Stil zu entwickeln und zu bewahren.





Wir erhöhen das TEMPO.

Infineon wird noch schneller, effizienter und flexibler als je zuvor. Wir konzentrieren uns in Zukunft auf maßgeschneiderte Produkte und Lösungen, die den Erfolg unserer Kunden unterstützen. Denn technologische Innovationen werden für uns dann relevant, wenn wir damit in der Massenfertigung profitablen Mehrwert schaffen.



Brief an die Aktionäre



DR. ULRICH SCHUMACHER, Vorsitzender des Vorstands

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

eher im Stillen beging Infineon im Jahr 2002 das 50-jährige Jubiläum der Halbleiter-Industrie in Deutschland. In diesen fünf Jahrzehnten haben wir weit reichende Kompetenzen aufgebaut, uns weltweit Anerkennung erarbeitet und uns erfolgreich unter den Top 10-Unternehmen der Halbleiter-Industrie etabliert. Trotzdem stand uns im vergangenen Jahr nicht der Sinn nach Feierlichkeiten, denn wir wurden vor größere Herausforderungen gestellt, als wir sie am Ende des Jahres 2001 erwartet hatten. Die anhaltende weltweite Konjunkturkrise, der zum Teil erhebliche Rückgang der Nachfrage und die Verunsicherung auf den Finanzmärkten haben unser Geschäftsjahr 2002 geprägt und deutliche Spuren in der Halbleiter-Industrie hinterlassen.

Zwar hat die Nachfrage nach Halbleitern in den Monaten Juni bis September des Geschäftsjahres 2002 wieder leicht zugenommen, insgesamt blieben wir aber im Berichtsjahr hinter den Werten des Vorjahres zurück: Der Konzernumsatz sank von 5,7 auf 5,2 Mrd. Euro und der Verlust vor Zinsen, Ergebnisanteilen Dritter und Steuern beträgt 1,1 Mrd. Euro nach 1 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Nettoverlust je Aktie – im Vorjahr bei 92 Eurocent – beläuft sich für das Geschäftsjahr auf 1,47 Euro.

Für diese unbefriedigende Entwicklung gibt es zwei wesentliche Gründe: Zum einen hielt der extrem harte Preiskampf bei Speicherchips unvermindert an. So liegt der durchschnittliche Marktpreis für einen 128-Megabit-Chip weiterhin unter unseren Vollkosten, obwohl wir die Herstellungskosten um mehr als zwei Euro pro Chip und damit um etwa 35% reduzieren konnten. Zum anderen ging die Nachfrage aus der Kommunikationsindustrie nochmals stark zurück. Zum Beispiel reduzierten die angeschlagenen Telekommunikationsunternehmen ihre Investitionen im Jahresvergleich um mehr als 30%.

Diese schwierigen Rahmenbedingungen lenken von den Erfolgen ab, die wir im letzten Jahr erzielt haben. Nach den schlechten Ergebnissen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2002 haben wir uns im Jahresverlauf deutlich verbessert und konnten schließlich im vierten Quartal einen Umsatzzuwachs von über 33% gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal erzielen. Weiterhin haben wir in unseren Zielmärkten Anteile gewonnen: Bei Speicherchips sind wir heute die Nr. 3 weltweit, bei drahtgebundener und mobiler Kommunikation sind wir ebenfalls

unter den drei führenden Anbietern. Bei Automobilelektronik besetzen wir nun Platz 2 und sind europaweit Marktführer, und bei Sicherheits- und Chipkarten-ICs haben wir den Vorsprung nochmals ausgebaut und sind im vierten Jahr in Folge die unangefochtene Nummer eins.

Parallel dazu haben wir unsere technologische Führungsposition erneut gestärkt. Zwei Beispiele verdeutlichen dies. Zum einen haben wir das CoolMOS Chipset neu im Markt eingeführt, das 30 % Energieeinsparungen bei elektrischen Antrieben ermöglicht. Damit ist uns ein wissenschaftlich-technischer Durchbruch gelungen, der im Januar 2002 mit dem Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft gewürdigt wurde. Zum anderen setzen wir durch unsere überlegene Fertigungs-Technologie Maßstäbe für den Wettbewerb: Mit der Chip-Produktion auf Siliziumscheiben mit 300 Millimeter Durchmesser erreichen wir einen erheblichen Produktivitätszuwachs und reduzieren unsere Kosten deutlich. Seit Dezember 2002 fertigen wir kostengünstiger als mit der 200-Millimeter-Technologie. Infineon beherrscht heute als einziges Unternehmen die Volumenproduktion von Speicherchips auf 300-Millimeter-Wafern. Damit sind wir unserem Ermessen nach weltweiter Technologie- und Kostenführer.

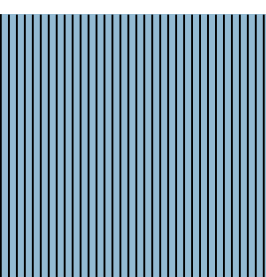
In dieser schwierigen Phase ist es darüber hinaus gelungen, konzernweit noch weitere Kosten zu verringern. So haben wir das im Vorjahr angekündigte Kostensenkungsprogramm Impact konsequent umgesetzt: Wir haben 2,5 Mrd. Euro eingespart und damit einen entscheidenden Beitrag zur Liquiditätssicherung geleistet. Infineon verfügte damit am Ende des Geschäftsjahres 2002 über eine Brutto-Cash-Position von 2 Mrd. Euro. Das bedeutet: Wir sind ein stabiles, solide finanziertes und auf die Zukunft gut vorbereitetes Unternehmen. Außerdem läuft mit Impact² ein Folgeprogramm, das alle wesentlichen Geschäftsvorgänge auf den Prüfstand stellt und das darauf abzielt, unsere Strukturen und Prozesse nachhaltig zu verbessern. Im Ergebnis soll Infineon dadurch noch schlanker und flexibler und somit schneller und schlagkräftiger werden.

Mit diesen Maßnahmen und unseren führenden Technologien werden wir gestärkt aus der Branchenkrise hervorgehen und die Zukunft der Halbleiter-Industrie aktiv mitgestalten. Dies soll sich nicht zuletzt auch auf unseren Aktienkurs positiv auswirken, über den Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sicherlich genauso enttäuscht sind wie wir. Unser Aktienkurs ist aber auch ein Spiegelbild der allgemeinen Lage auf dem Kapitalmarkt, der von einer anhaltenden Talfahrt geprägt ist. Hier brauchen wir alle Geduld und Optimismus.

Ein Unternehmen wie Infineon, das in einer Branche mit starken Marktschwankungen tätig ist, muss ständig seine Märkte beobachten und seine Strategien überprüfen. Wir haben systematisch die grundlegenden Veränderungen unserer Absatzmärkte, der zugrunde liegenden Wertschöpfungsketten und die Zukunftspotenziale unseres Know-hows analysiert.

Darauf aufbauend haben wir unsere Unternehmensstrategie neu ausgerichtet und in der Agenda 5-to-1 die langfristigen Erfolgsziele zusammengefasst.

- In den nächsten 5 Jahren wollen wir
- zu den Top 4-Halbleiter-Unternehmen gehören, indem wir unseren Anteil am Weltmarkt für Halbleiter auf rund 6 % verdoppeln,
- in jedem unserer Geschäftssegmente mindestens eine Top 3-Marktposition erreichen,
- bei der Ertragskraft jedes einzelnen Geschäftsbereiches eine Top 2-Position einnehmen
- und das Halbleiter-Unternehmen Nr. 1 im Lösungsgeschäft werden.



Unsere überarbeitete Strategie baut auf den Erfahrungen und Erfolgen der letzten Jahre auf. Die mit ihr verbundenen Ziele sind durchaus ehrgeizig, aber realistisch. Marktstudien zeigen, dass wir im ersten Halbjahr 2002 erstmals auf Platz sechs der Rangliste der großen Halbleiter-Hersteller weltweit vorgerückt sind. Wir sind optimistisch, dass wir auch im Jahresvergleich unseren Rang verbessern können.

Besonders werden wir uns auf den Ausbau unserer Marktanteile in den Wachstumsmärkten China, Japan und USA konzentrieren. Damit wollen wir unsere ehrgeizigen Wachstums- und Ertragsziele erreichen und den Unternehmenswert wieder deutlich steigern. Selbstverständlich wollen wir unsere starke Position in Europa und Asien dabei erhalten. Zusätzlich werden wir weitere Unternehmen nur dann erwerben, wenn sie unser Technologieportfolio bereichern. Ein entscheidender Eckpfeiler unserer Strategie bleiben Partnerschaften mit Marktführern wie Cisco, Ericsson, IBM, Nokia, Sony und Toshiba dort, wo es zu kostenintensiv und risikoreich ist, in der Produktentwicklung alleine voranzuschreiten. Analog dazu haben wir auf der Fertigungsseite richtungsweisende Allianzen mit Firmen wie UMC, Nanya, AMD und DuPont Photomasks geschlossen. Damit teilen wir in unserer kapitalintensiven Branche Kosten für Entwicklung und Fertigung, vermindern deutlich unser Investitionsrisiko und sichern langfristig unsere Technologieführerschaft.

Zentrales Element der Infineon Strategie ist unsere Entwicklung hin zum Systemlösungsanbieter Nummer eins. Was heißt das und wie wollen wir das erreichen? In der Halbleiter-Industrie wird es künftig nicht mehr ausreichen, nur einzelne Chips oder Komponenten anzubieten. Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kunden künftig maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die ein Paket aus Halbleiter-Produkt, Software, Beratung und Service beinhalten und die ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen.

Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel aus der Automobilindustrie darstellen: Moderne Kraftfahrzeuge sind zunehmend mit ihrer Außenwelt vernetzt. Sensoren nehmen Abstände zu anderen Verkehrsteilnehmern wahr; Motordefekte werden nicht nur an den Fahrer, sondern über Funk an ein Call Center oder an eine Werkstatt übermittelt und, wenn möglich, drahtlos sofort behoben; mittels GPS und Navigationssystem kann der Fahrer außerdem zur nächstgelegenen Servicestation gelenkt werden. Telekommunikation, Mechanik, Sensorik und Navigation wachsen immer enger zusammen. Und die Basis für das intelligent vernetzte Auto der Zukunft sind Halbleiter-Lösungen.

Die Fähigkeit, ein attraktives, integriertes Paket aus Mikrochip, Software, Beratung und Service zu liefern, nennen wir Lösungskompetenz. Schon heute sind wir Vorreiter auf diesem Gebiet und bieten unter anderem komplette Chipsets inklusive Software für Mobiltelefone an. Auf diesen Erfahrungen bauen wir auf. Wir werden unser umfassendes Know-how aus allen Geschäftsbereichen stärker vernetzen und für unsere Kunden maßgeschneiderte Systeme aus einer Hand entwickeln. Damit sichern wir uns langfristig profitables Wachstum.

Ich möchte noch auf das Thema Corporate Governance eingehen, also die Art und Weise, wie Unternehmen geleitet und überwacht werden. Ein paar wenige, aber öffentlichkeitswirksame Vorgänge im In- und Ausland, die mit nichts zu entschuldigen sind, haben in den letzten Monaten das Vertrauen von Anlegern und Investoren in börsennotierte Unternehmen

untergraben. Die von der deutschen Bundesregierung eingesetzte Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat im Februar 2002 ihren Abschlussbericht vorgelegt und einen Verhaltenskodex ausgearbeitet, der im November 2002 an die aktuelle Gesetzgebung angepasst wurde. Unser Unternehmen wurde bisher schon nach den meisten in diesem Kodex verankerten Regeln und den Gesetzen des US-amerikanischen Kapitalmarktes geführt. Wir haben dennoch unverzüglich die zusätzlichen Empfehlungen umgesetzt und einen eigenen, über die Regelungen der Kommission noch hinausgehenden Infineon Kodex verabschiedet. Außerdem haben wir einen Corporate Governance-Beauftragten berufen, der unmittelbar an Vorstand und Aufsichtsrat über Einhaltung und Fortentwicklung unseres umfassenden Regelwerkes berichtet. Dies verstehen wir als beispielhafte Basis für eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Konzernebenen im Sinne langfristig orientierter Investoren und Kunden.

Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die sich mit großem Engagement für die Ziele von Infineon einsetzen und auch in den anhaltend schwierigen Zeiten am Erfolg unseres Unternehmens arbeiten.

Wie sich Infineon im nächsten Geschäftsjahr entwickeln wird, können wir nur vorsichtig einschätzen. Denn der Marktausblick für das erste Halbjahr unseres Geschäftsjahres 2003 zeigt keine nachhaltige Verbesserung der Nachfrage und auch der Preisdruck in den meisten Marktsegmenten wird nicht nachlassen. Aber ich bin überzeugt, dass wir mit den genannten Maßnahmen für unser Unternehmen alle wesentlichen Weichen gestellt haben, um wieder Profitabilität und Wachstum zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Unternehmen auf diesem Weg weiterhin begleiten und unterstützen.

Ihr



Dr. Ulrich Schumacher
Vorsitzender des Vorstands

Wir schaffen Halbleiter-Lösungen, die den **Technology Lifestyle** des Menschen im 21. Jahrhundert ermöglichen.

Unsere Vision

Um im Lösungsgeschäft die Nummer eins zu sein

Die neue Vision und die neue Mission von Infineon Technologies zeigen unseren Mitarbeitern, Kunden und nicht zuletzt den Investoren, was unser Unternehmen von anderen unterscheidet. Sie wurden im Sommer 2002 formuliert und bestimmen fortan unser Denken und Handeln weltweit.

Profitable elektronische Systemlösungen für den Technology Lifestyle

Infineon Technologies bietet einen maßgeschneiderten Mix von Produkten und Dienstleistungen, basierend auf den Wünschen unserer Kunden sowie der Verbraucher. Dafür verknüpfen wir unsere Kernkompetenzen weltweit mit dem Know-how von Partnerfirmen. Mit der optimalen Kombination der notwendigen Ressourcen bauen wir unser Lösungsgeschäft profitabel aus, stärken nachhaltig die Performance unserer Kunden und damit auch den Shareholder Value von Infineon.

Unsere Mission

Ein Unternehmen, das nachhaltig Werte schafft

Wir generieren und optimieren Mehrwert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter:

- ▮ Wir entwerfen, produzieren und verkaufen die modernsten Halbleiter-Lösungen und -Dienstleistungen, indem wir die Branchenführerschaft bei Innovation und Kundenorientierung erreichen.
- ▮ Wir bauen auf unsere Kernkompetenzen und Innovationskraft. Wir wollen unseren Kunden branchenweit das umfassendste Portfolio an Kommunikationsprodukten und Automobil-Lösungen anbieten, einschließlich Breitband- und Zugangstechnologie, sicherer Lösungen für den Mobilfunk und Speicherprodukte.
- ▮ Wir schaffen in Zukunft auch Mehrwert, indem wir die traditionellen Grenzen der Industrie überwinden. Wir bieten Integrationsmöglichkeiten für Halbleiter, Biowissenschaften, Dienstleistungen und Miniaturisierung.
- ▮ Weltweit gewinnen wir die größten Talente und binden diese an uns, indem wir ihnen ein spannendes und kreatives Arbeitsumfeld, eine einmalige Unternehmenskultur und Honorierung der weltweiten Spitzenklasse bieten.

**DIE MITGLIEDER DES
VORSTANDS DER
INFINEON TECHNOLOGIES AG**

v.l.n.r.

PETER J. FISCHL

- ▮ Jahrgang 1946
- ▮ Chief Financial Officer (cfo) und Arbeitsdirektor

PETER BAUER

- ▮ Jahrgang 1960
- ▮ Chief Sales & Marketing Officer (cmo)

DR.-ING.

ULRICH SCHUMACHER

- ▮ Jahrgang 1958
- ▮ Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender des Vorstands

DR.-ING.

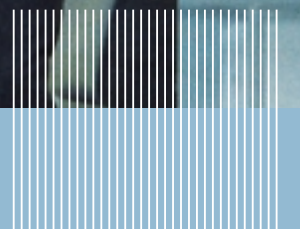
ANDREAS VON ZITZEWITZ

- ▮ Jahrgang 1960
- ▮ Chief Operating Officer (COO)

DR. RER. NAT.

SÖNKE MEHRGARDT

- ▮ Jahrgang 1948
- ▮ Chief Technology Officer (CTO)



Wussten Sie schon, dass ...

- ... Chips von Infineon in jedem dritten Airbag weltweit für Sicherheit sorgen und in jedem fünften Neufahrzeug das Antiblockiersystem (ABS) steuern?
- ... 30 % Energieeinsparungen bei Haushaltsgeräten durch innovative Leistungs-Halbleiter von Infineon möglich werden?
- ... jedes zweite GSM-Handy weltweit mit Infineon Bauteilen bestückt ist?
- ... jede zweite der mehr als zwei Milliarden im Jahr 2001 ausgelieferten Chipkarten einen Sicherheits-IC von Infineon enthält?
- ... weltweit jeder sechste neue PC und jeder fünfte neue Server mit einem Infineon Arbeitsspeicher ausgestattet ist?
- ... Infineon im Geschäftsjahr 2002 rund 1.500 neue Patente angemeldet hat und jetzt weltweit insgesamt über 30.300 Schutzrechte verfügt?

**Für meine Kinder gibt's nur beste Qualität.
Mit unseren Lösungen lässt sie sich sogar nachweisen.**

Unsere heutige Küche hat allen viel zu bieten. Selbstverständlich ist dabei stets Qualität das beste Rezept. Schließlich schmeckt es ja gleich viel besser, wenn man genau weiß, was man isst. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, so liefert Infineon Technologies hier doch mit einer zukunftsweisenden Lösung einen wichtigen Beitrag. Sie ermöglicht eine optimierte Kontrolle und Überwachung des Prozesses in der Lebensmittelherstellung. Das fängt mit einem kleinen Chip an, der z.B. ein Schwein oder Rind ein ganzes Leben lang begleitet. Mit der entsprechenden Softwarelösung und Einlesegeräten werden nun alle wichtigen Daten über Zucht, Fütterung und Impfungen erfasst. Zudem lässt sich mittels GPS der komplette Transportweg – vom Hof bis zum Supermarkt – des Tieres überwachen. Mit dem Ergebnis, dass es von Anfang an zuverlässige Angaben über die Herkunft, die sachgemäße Lagerung und die richtige Verarbeitung des Fleisches gibt. Damit am Ende die Kleinen wirklich nur das Beste kriegen.



STRATEGIE: Wir gehen konsequent neue Wege.

KUNDEN: Wir bieten komplette High-Tech-Lösungen.

MÄRKTE: Wir verfolgen neue ehrgeizige Ziele.

FERTIGUNG: Wir bleiben Technologie- und Kostenführer.

LOGISTIK: Wir erhöhen kostengünstig unsere Flexibilität.



WISSEN, was man WIRKLICH will.

Neue Wege beschreiten, neue Ziele erreichen – zurück zu Profitabilität und überproportionalem Wachstum

- In fünf Jahren zu den Top 4 der Halbleiterwelt aufrücken
- Ressourcen und Investitionen auf Wachstumssegmente ausrichten
- Ziele mit internem Wachstum, Akquisitionen und Partnern erreichen
- Systematisch über Marktsegmente hinweg Geschäftsideen umsetzen

Profitables Wachstum, Ausbau des Lösungsgeschäfts, verstärkte Globalisierung und niedrigste Kosten bei hoher Flexibilität – vier Schlagworte, die die neuen und aktualisierten Unternehmensziele von Infineon Technologies beschreiben. Wir geben damit Antwort auf aktuelle Herausforderungen und die Chancen der nächsten Jahre: auf den in der Halbleiter-Industrie anhaltenden Preisdruck, auf die fortschreitende Konsolidierung der Branche, auf sich verändernde Kundenerwartungen und auf die weiterhin gültige, langfristige Wachstumsdynamik des Halbleiter-Marktes. Die weiterentwickelte Unternehmensstrategie knüpft nahtlos an die Wachstumserfolge der letzten Jahre an und beschreibt den Weg, wie Infineon langfristig profitabel und schneller als der Markt wachsen kann.

„Die Menschen sind anspruchsvoller, sie sind emanzipierter und selbstbewusster geworden. Sie lassen sich nicht länger irgendetwas vorsetzen, sie fragen nach Qualität, Wert und nach Möglichkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung und Teilhabe ausleben zu können.“



DAGMAR DECKSTEIN,
Redakteurin der Süddeutschen Zeitung
und Buchautorin

Technology Lifestyle-Lösungen bestimmen die Zukunft unserer Märkte

Zentrales Element unserer Strategie ist die Fokussierung unseres Produkt- und Dienstleistungsspektrums auf technologisch geprägte Lösungen für das moderne Leben. In der Vergangenheit war nicht nur bei uns häufig das technisch Machbare Maßstab beim Entwickeln von Halbleiter-Komponenten. Künftig bestimmen die individuellen Bedürfnisse des Menschen verstärkt die neuen Technologietrends. Gefragt sind Lösungen mit hohem individuellem Nutzen, die in vielen Bereichen den Tagesablauf vereinfachen und die Lebensqualität verbessern.

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Sie liegen in der mobilen Kommunikation genauso wie in der Sicherheit von Personen und Daten oder auch dem Gesundheitswesen. Zum Beispiel werden mobile Multimediageräte immer bedeutender, mit deren Hilfe man unabhängig von Zeit und Ort auf Informationen zugreifen und sich nach Lust und Laune unterhalten lassen kann. Technische Sicherheitslösungen schaffen kontaktlose Zugangsmöglichkeiten und verbessern damit den Schutz der Privatsphäre. Oder mikroelektronische Sensoren, die zentrale Körperfunktionen kontrollieren, im Verbund mit Computern aus der Ferne überwachen

Die Infineon Strategie

wird umschrieben mit der

Vision und der Mission,

der strategischen

Positionierung sowie den

daraus abgeleiteten Zielen

für die nächsten fünf

Jahre: der Agenda 5-to-1

und bei Bedarf automatisch Hilfsmaßnahmen einleiten. Ein weiteres Beispiel für eine umfassende technische Lösung, die schon in naher Zukunft Standard sein wird, ist die Telematik in Fahrzeugen. Elektronische Funktionen im Auto werden dabei innerhalb des Chassis und auch mit der Außenwelt zunehmend vernetzt: Information, Kommunikation, Navigation, Sicherheit und Motorsteuerung wachsen enger zusammen. Die automatische Abstandskontrolle zu anderen Verkehrsteilnehmern gehört dann ebenso zum Fahreralltag wie das elektronische Bezahlen von Mautgebühren oder die Ferndiagnose von Fahrzeugdefekten.

Auf dem Weg zur Nummer eins der Lösungsanbieter

Die technologische Basis derartiger Anwendungen bilden Halbleiter. Und je komplexer die elektronischen Systeme sind, desto wichtiger werden technologische Komplettlösungen. Lösungen, die hoch spezialisiertes Know-how voraussetzen und nach erfolgreichem Schnittstellenmanagement verlangen. Infineon nimmt diese Herausforderung an und wird sich weiter vom reinen Produkt- zum Lösungsanbieter entwickeln. Unser Angebotspektrum wird in Zukunft also neben dem eigentlichen Halbleiter-Produkt immer mehr auch die dazu passende Software einschließlich des entsprechenden Anwendungs-Know-hows, die Integration von Fremdkomponenten sowie kompetente Beratung umfassen. Und das alles maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Endverbraucher und damit von noch größerem Wert für unsere direkten Kunden.

Damit wollen wir auch die traditionellen Grenzen der Halbleiter-Industrie überwinden und die technologischen Trends von morgen entscheidend mitbestimmen. Vom kundenorientierten Lösungsgeschäft versprechen wir uns einen deutlichen, profitablen Wachstumsschub. Wir streben an, das Halbleiter-Unternehmen Nummer eins im Lösungsgeschäft zu werden.

Unsere Wachstumsstrategie basiert vor allem auf organischem Wachstum. Unser umfassendes System-Know-how und unser breites Technologieportfolio sind dafür gute Voraussetzungen. Aber auch unsere Technologie- und Kostenführerschaft, die wir uns in vielen Bereichen erarbeitet haben, ist eine wichtige Grundlage für den Ausbau unserer Marktanteile. Damit verfügen wir über einen entscheidenden Vorsprung in unserer Branche, den wir uns langfristig sichern werden.

Wir konzentrieren unsere Ressourcen und Investitionen künftig konsequent auf die identifizierten Wachstumssegmente, optimieren unser Produktportfolio dahingehend und führen unsere Technologien im Lösungsgeschäft zusammen. Parallel dazu werden wir neue Geschäftsfelder aufbauen und in neue Technologien wie zum Beispiel die Biotechnologie und die Nanotechnologie diversifizieren.

Halbleiter-Lösungen, die
den Alltag erleichtern

Konzentration auf
profitables Wachstum
und flexible Netzwerke
in den Weltmärkten

MATTHIAS HORX,
Zukunftsforscher



„Wissen ist immer an Menschen gebunden, an die Interaktion zwischen lebenden Wesen. Die machtvollen Tools, die wir auf dem Sektor der Kommunikation geschaffen haben, können wir nur nutzen, wenn wir sie einpassen und einfeilen in den Kontext unserer Kultur unseres Wesens. Das wird die eigentliche, die wirkliche Informationsrevolution sein. Sie fängt jetzt erst an.“

Partnerschaften mit Schlüsselkunden und Marktführern sowie strategische Akquisitionen realisieren wir weiterhin dort, wo wir damit Wachstumschancen besser nutzen können, als es uns im Alleingang möglich wäre. Flexible Netzwerke, beispielsweise bei Forschung und Entwicklung, ermöglichen es uns, flexibler, schneller, kostengünstiger und mit geteiltem Risiko in unserem dynamischen Marktumfeld zu agieren.

Die Infineon Strategie des nachhaltigen Wachstums drückt sich auch in den Zielen auf den Weltmärkten aus: Unser Ziel ist es, führender Lösungsanbieter in den größten Wachstumsmärkten China und USA zu werden, unsere Marktposition in Japan auszubauen und unsere hervorragende Stellung in Europa und Asien zu stärken. Wo der Markt es erfordert, werden wir unsere Organisation dezentralisieren und unsere regionale Präsenz ausbauen, um noch näher bei unseren Kunden zu sein.

Um unsere ehrgeizigen Profitabilitätsziele zu erreichen, stellen wir immer wieder alle Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse auf den Prüfstand. Mit systematischem Benchmarking orientieren wir uns dabei an den weltweit besten Unternehmen unterschiedlichster Branchen, um im Infineon-Konzern nachhaltig die Qualität zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Parallel dazu werden wir den Wissenstransfer über alle Geschäftsbereiche hinweg ausbauen, unternehmerisches Handeln systematisch fördern und unternehmerische Ideen in neue Geschäftsmodelle umsetzen.

Infineon wird den skizzierten Weg konsequent gehen, um innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einem der vier führenden Halbleiter-Unternehmen der Welt aufzusteigen.

Ständige Verbesserung
durch Benchmarking

Individuelle Bedürfnisse der Verbraucher berücksichtigen und veränderte Erwartungen unserer Kunden erfüllen

- Verständnis schaffen für maßgeschneiderte „Technology Lifestyle-Lösungen“
- Kundenbasis auf Marktführer in den Wertschöpfungsketten ausrichten
- Strategische Partnerschaften mit Kunden und Technologieführern ausbauen
- Industriestandards setzen und in den Zielsegmenten Systemführer werden

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts rücken die individuellen Bedürfnisse der Menschen in Bezug auf Kommunikation und Information, Privatsphäre, Arbeitsumgebung sowie Gesundheit noch stärker in den Mittelpunkt. Das Ziel, diese Bedürfnisse zu befriedigen, ist der Ausgangspunkt für neue Technologielösungen. Und das verändert die Erwartungen, die unsere direkten Kunden an Infineon haben, und damit auch unser Denken und Handeln. Wir unterstützen den Massenindividualismus und konzentrieren uns verstärkt auf maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige und einfach zu bedienende elektronische Komplettlösungen – profitabel produziert und kombiniert mit Wert steigernden Serviceleistungen.

STAN DAVIS,
Zukunftsforscher und Autor



„Alles wird elektronisch miteinander verbunden: Produkte, Menschen, Unternehmen, Länder, einfach alles. Zumindest für das laufende Jahrzehnt werden Geschwindigkeit, Vernetzung und immaterielle Werte weiterhin die entscheidenden Komponenten darstellen, um die herum Geschäftsleben und Wirtschaft zu gestalten sind.“

Halbleiter bilden die Basis für intelligente Systemlösungen

Wir leben in einem Zeitalter der technologischen Vernetzung und der funktionalen Integration: Ehemals getrennte Anwendungen werden zunehmend in einem Gerät zusammengeführt, ob in der Unterhaltungselektronik, im Automobil oder am Arbeitsplatz. Vom Taschencomputer aus telefonieren, mit dem Fernseher ins Internet, Bezahlen per Mobiltelefon, automatische Stauinformation im Auto – unlängst waren das Zukunftsvisionen, heute sind sie Realität. Und neue Trends kündigen sich an: Kühlschränke sollen automatisch Lebensmittel nachbestellen und intelligente Kleidungsstücke werden Waschmaschinen über die optimale Temperatur und Schleuderdrehzahl informieren.

Die technologische Basis dafür bilden Halbleiter: Sie speichern Daten, verarbeiten diese, kommunizieren mit anderen Bauelementen. Je komplexer die Systeme werden, desto wichtiger werden Lösungen, die unterschiedlichste Halbleiter und deren Funktionen intelligent und flexibel vernetzen. Dabei sind vor allem Fähigkeiten zur Integration sowie erfolgreiches Management der Schnittstellen gefragt.

Systemlösungen von Infineon werden künftig das Halbleiter-Produkt, die dazu passende Software einschließlich des notwendigen Anwendungs-Know-hows, Beratungsleistungen und bei Bedarf Fremdkomponenten von Partnerfirmen zusammenfassen. Neben umfassender Fachkenntnis setzt eine derartige Systemlösungs-Kompetenz immer mehr voraus, dass Halbleiter-Firmen ihr Wissen um die tatsächlichen Bedürfnisse der Endkunden verbreitern. Das bedeutet, dass wir selbst genauer wissen müssen, was die Verbraucher von neuen Fahrzeug- und Mobilfunkgenerationen, von neuen Computern und Telefonnetzwerken erwarten. Welchen individuellen Lebensstil sollen neue Technologien unterstützen? Welchen Lebensstil sollen sie gar erst ermöglichen? Indem wir uns damit eingehender vertraut machen, können wir uns von Anfang an auf die Entwicklung bedarfsgerechter und damit höherwertiger Halbleiter-Lösungen konzentrieren. Davon sollen insbesondere unsere direkten Kunden profitieren. Ihnen können wir zum Markterfolg verhelfen, indem wir zeitgerechte Komplettlösungen anbieten, die sie beim schnellen Umsetzen der Verbraucherwünsche in profitable marktfähige Produkte benötigen.

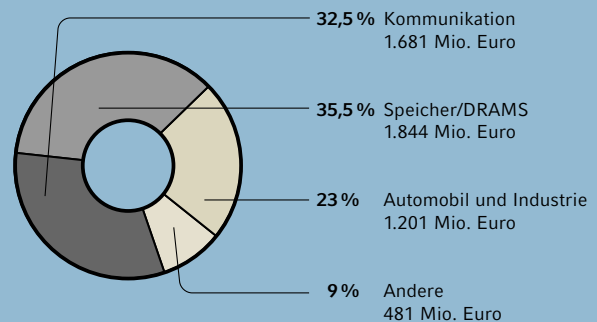
Veränderte Wertschöpfungsketten erfordern komplexeres System-Know-how

Einen wichtigen Vorsprung im Lösungsgeschäft verschaffen uns vielfältige Erfahrungen, die wir bereits auf diesem Gebiet gemacht haben. Beispielsweise bieten wir schon heute komplette Chip-Sätze für Mobiltelefone an. Diese bilden den gesamten technischen Kern eines Mobiltelefons und schließen Designempfehlungen und die Software mit ein. Insgesamt verfügen wir im Vergleich zum Wettbewerb über eine breitere Produktpalette: Wir entwickeln und produzieren Speicherchips, Logikchips für die mobile, drahtgebundene und sichere Kommunikation, Halbleiter für die Automobil- und Industrieelektronik und sind Vorreiter bei neuartigen Halbleiter-Produkten wie Bio-Chips. Auf dieser Basis wollen wir weiterhin neue Industriestandards setzen und in neuen Zielmärkten Systemführer werden.

Die aktuelle Entwicklung der Wertschöpfungsketten spricht ebenfalls für den Ausbau unseres Lösungsgeschäfts: Unsere Kunden lagern zunehmend die Entwicklung und Fertigung ganzer Baugruppen aus. Je mehr wir einzelne Komponenten zu elektronischen Systemen zusammenfassen, desto attraktiver werden wir für diese Kunden. Wichtig ist hierbei die enge Zusammenarbeit mit Schlüsselkunden wie Cisco, Ericsson, IBM, Matsushita, Nokia, Siemens, Sony und Toshiba. Durch strategische Kooperationen bilden wir Partnernetzwerke, um gemeinsam Innovationen voranzubringen und den Mehrwert für uns und für unsere Partner zu maximieren. Unser Ziel ist es, weltweit zum führenden Anbieter von Systemlösungen zu werden. Ein zentraler Bestandteil dieser Lösungen ist die entsprechende Software. Hier werden wir in Zukunft deutlich mehr investieren. So bauen wir momentan in der indischen Hochtechnologie-Metropole Bangalore sowie an Standorten in China unsere neuen Entwicklungszentren für Software und Applikationen aus.

Infineon setzt Bedürfnisse der Endverbraucher in Systemlösungen um

Umsatz 2002 nach Märkten
Gesamt: 5.207 Mio. Euro



Ausbau der Partnernetzwerke fördert Systemlösungs-Kompetenz

Neue Wachstumsstrategie wird weltweit an regionale Marktpotenziale angepasst und konsequent umgesetzt

- Starke Präsenz in Europa und Asien/Pazifik weiter festigen
- Marktanteil in China, den USA und Japan rasch vergrößern
- Organisation dezentralisieren und regionale Präsenz stärken
- Mit Dienstleistungen und Lösungsgeschäft Mehrwert generieren

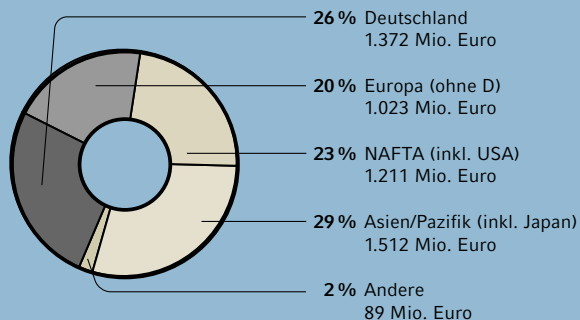
Wie müssen wir uns regional aufstellen, damit Infineon profitabler und schneller wachsen kann als der Gesamtmarkt? Um diese Frage zu beantworten, haben wir das Entwicklungspotenzial der unterschiedlichen Weltregionen sowie unseren eigenen Status in den einzelnen Technologiemarkten eingehend analysiert. Daraus haben wir eine neue, regional angepasste Wachstumsstrategie abgeleitet: Wir werden unsere Stellung in den Märkten China, Japan und Nordamerika ausbauen sowie unsere führende Position in Europa und Asien festigen.

Europa und Asien:
starke Basis für
globales Wachstum

Im erweiterten europäischen Markt sehen wir auch in Zukunft einen Garant für starke Umsatzzahlen: Als Europas Nr. 2 erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 hier etwa 46 % seines Gesamtumsatzes. Genauso haben wir mit einem Umsatzanteil von 29 % in Asien/Pazifik eine führende Marktposition erreicht. In diesen beiden Regionen wollen wir einerseits mit dem Ausbau bisheriger und andererseits mit dem Aufbau neuer strategischer Kundenbeziehungen zusätzliche Umsatzpotenziale schaffen und die Ziele der Agenda 5-to-1 erreichen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die Position von Infineon in den Wachstumsmärkten China, Japan und Nordamerika nachhaltig zu stärken.

Umsatz 2002 nach Regionen

Gesamt: 5.207 Mio. Euro



China entwickelt sich immer mehr zum weltweit entscheidenden Zentrum für die Produktion und den Absatz elektronischer Geräte und damit zu einem lukrativen Markt für Halbleiter-Hersteller. Unsere Prognosen gehen von einer Verdopplung des chinesischen Absatzvolumens für Halbleiter-Produkte von gut 15 Mrd. Euro im Jahr 2002 auf 31 Mrd. Euro im Jahr 2006 aus. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von knapp 20 % könnte sich China noch in diesem Jahrzehnt zum weltweit größten Absatzmarkt für Halbleiter-Produkte entwickeln. Das größte Umsatzpotenzial sehen wir in den Marktsegmenten Speicherchips, mobile Kommunikation und Chipkarten. Hier erwarten wir in den kommenden fünf Jahren sogar ein jährliches Wachstum von über 30 %. Dieses Potenzial wollen wir optimal ausschöpfen – und wir befinden uns bereits auf dem besten Weg: Entgegen der weltweiten Marktschwäche konnten wir unseren Umsatz in China in 2002 um 21 % steigern.

Im Rahmen der Agenda 5-to-1 wollen wir in China in 2002 von Platz 7 unter die Top 5 der Halbleiter-Unternehmen vorrücken. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf intensive Partnerschaften mit lokalen Marktteilnehmern und den Ausbau unserer Designkompetenz vor Ort. Dafür bauen wir in Shanghai ein neues Hauptquartier auf und verstärken die bisherige

Mannschaft auch bei Management, Vertrieb sowie Marketing. Damit schaffen wir nicht nur gute Voraussetzungen, um das Potenzial des nationalen Marktes auszuschöpfen, sondern auch, um langfristig von China aus kostengünstig andere internationale Märkte bedienen zu können.

Obwohl derzeit knapp ein Viertel der weltweiten Halbleiter-Verkäufe auf den japanischen Markt entfallen, trägt das Japangeschäft bisher nur einen geringen Prozentsatz zum Umsatz von Infineon bei. Hauptgrund dafür ist, dass die japanischen Elektronikgiganten elektronische Bauelemente bisher fast ausschließlich von den eigenen Tochtergesellschaften bezogen haben. Doch zunehmend verfolgen auch diese Weltkonzerne global ausgerichtete Einkaufsstrategien mit mehreren Lieferanten. Dadurch steigen unsere Erfolgchancen. Diese ergreifen wir, indem wir uns in Japan auf die Einführung einer passenden Auswahl unserer Produkte konzentrieren und parallel vor Ort das Vertriebsteam und unsere technischen Dienstleistungen ausbauen.

Unsere Japan-Strategie beinhaltet einen weiteren, vielleicht sogar den entscheidenden Eckpfeiler, um die neue Vision von Infineon zu verwirklichen: nämlich „Halbleiter-Lösungen zu schaffen, die den Technology Lifestyle des Menschen im 21. Jahrhundert ermöglichen“. Denn die japanische Bevölkerung ist bekanntlich seit Jahrzehnten Trendsetter bei elektronischen High-Tech-Geräten. Nirgendwo sonst haben Mobiltelefone, Taschencomputer und digitale Unterhaltungsgeräte einen derart hohen Stellenwert im Leben der Menschen. Und nirgendwo sonst sind die Ansprüche der Konsumenten so hoch. Jüngstes Beispiel ist der Vorsprung in der Mobilfunk-Technologie der dritten Generation, die in Japan bereits im Mai 2001 eingeführt wurde. Auch die in Deutschland im Jahr 2002 eingeführten i-mode-Handys sind im Inselstaat seit Jahren etabliert. Und noch im Jahr 2000 kamen 81 % aller Nutzer von mobilen Internetdiensten aus Japan. Neben dem erheblichen Absatzpotenzial bietet uns der japanische Markt also auch die Gelegenheit, Produkte, Software und Dienstleistungen am Puls des elektronischen Zeitalters zu entwickeln und damit das Lösungsgeschäft von Infineon zielgruppenorientiert auszubauen.

Nordamerika ist nach Asien der zweitgrößte Markt für Halbleiter. Unser Ziel ist es, die weiterhin vorhandene Wachstumsdynamik zu nutzen und den Marktanteil von Infineon in Nordamerika von 2,1 % im Jahr 2001 auf 5 % im Jahr 2005 zu erhöhen. Erreichen wollen wir dies, indem wir die Beziehungen zu unseren Kunden ausbauen und das Geschäft auf die attraktivsten Produktsegmente ausrichten. Vor allem bei Logikchips für die Kommunikations- und die Automobilindustrie sowie bei Speicherchips sehen wir gute Wachstumchancen. Diese Produkte wollen wir analog zu unserer Konzernstrategie verstärkt in Systemlösungen integrieren und maßgeschneidert anbieten, angepasst an die Bedürfnisse des amerikanischen Marktes. Das setzt voraus, dass wir noch intensiver mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihnen verstärkt beratend zur Seite stehen. Deshalb bauen wir unsere technische Kompetenz in Nordamerika deutlich aus und investieren erheblich in die Weiterbildung unserer Kundenbetreuer und Servicemitarbeiter. Mit diesen Maßnahmen reagieren wir auf eine Entwicklung, die wir besonders deutlich in Nordamerika erleben: Häufig reicht innovatives Chip-Design alleine nicht mehr aus; kontinuierliche Beratung und kompetenter Service werden immer mehr zum elementaren Unterscheidungsmerkmal.

China: Potenzial

ausschöpfen und unter

die Top 5-Hersteller

vorrücken

Japan: Elektronik-

giganten öffnen sich für

ausländische Zulieferer

Nordamerika:

Marktanteil von 2,1 %

auf 5 % erhöhen

Flexibler, schneller und effizienter – veränderte Rahmenbedingungen erfordern neue Produktionskonzepte

- Wandel der High-Tech-Industrie zum Wertschöpfungs-Netzwerk
- Wie bei Speicherchips auch in der Logikproduktion beste Leistungen erzielen
- Neue Allianzen mit AMD, DuPont, Nanya, UMC und Winbond

Mit größtmöglicher Flexibilität bei niedrigsten Kosten beste Qualität produzieren – die Herausforderung für Halbleiter-Hersteller besteht darin, sich in diesem Spannungsfeld optimal zu positionieren. Zunehmender Kostendruck und veränderte Kundenbedürfnisse bestimmen die Rahmenbedingungen und führen dazu, dass sich die Wertschöpfungskette in der Halbleiter-Industrie weiter aufgliedert. Dabei kann der hohe Investitionsbedarf in unserer Branche von immer weniger Unternehmen alleine gedeckt werden. Mehr und mehr Firmen beschränken sich deshalb verstärkt auf ihren Kernbereich oder einzelne Marktsegmente. Diesen Trend haben wir frühzeitig erkannt und unsere Strategie an den veränderten Rahmenbedingungen ausgerichtet: Wir setzen in der Fertigung auf strategische Partnerschaften, bauen unseren Vorsprung in den Kerntechnologien weiter aus und optimieren ständig unsere eigenen Ressourcen.

Infineon bildet
Produktionsnetzwerke,
um größtmögliche
Fertigungsflexibilität bei
niedrigsten Kosten zu
erreichen

Um die Kosten zu minimieren und gleichzeitig die Produktionskapazitäten an die starken Nachfrageschwankungen anzupassen, intensivieren wir den Ausbau unserer Kooperationen mit Zulieferern und Produktionspartnern. So kreieren wir ein flexibles Herstellernetzwerk entlang der Wertschöpfungskette.

Unsere Fertigungsstrategie stützt sich dabei auf drei Säulen:

- Eigenfertigung,
- gemeinsame Fertigung mit Partnern und
- Fremdfertigung.

Ohne unsere Fixkosten zu steigern, können wir so in Boomphasen den höheren Bedarf der Kunden befriedigen, indem wir einen größeren Teil der Produktion an Fremdfertiger auslagern. Zeichnet sich eine Marktschwäche ab, werden die vorhandenen Aufträge wo möglich in eigenen Produktionsstätten abgewickelt. Dadurch stellen wir über Marktzyklen hinweg eine gleichmäßigere Auslastung unserer Kapazitäten sicher – ein entscheidender Vorteil im Spannungsfeld der kapitalintensiven Halbleiter-Industrie. Weiterhin spielen in unserer Strategie Partnerschaften mit anderen Halbleiter-Firmen eine wichtige Rolle. Dabei stellen wir den Partnern führende Produktionstechnologien zur Verfügung und erhalten im Gegenzug variablen Zugriff auf zusätzliche Kapazitäten. Wir profitieren vom Fertigungs-Know-how des meist spezialisierten Partners und können die Auslastung aller im Verbund arbeitenden Werke flexibel disponieren.

Ein Beispiel für diese Säule der Fertigungsstrategie ist das gemeinsam mit dem Auftragsfertiger United Microelectronics Corporation (UMC) gegründete Joint Venture UMCi in Singapur: Auf Basis der von Infineon bei Speicherchips erfolgreich eingeführten 300-Millimeter-Technologie werden wir mit UMC in Singapur ab 2004 Logikchips produzieren. Ein weiteres Modell ist unsere Entwicklungskooperation mit UMC und Advanced Micro Devices (AMD). Diese Allianz entwickelt eine einheitliche Plattform zur hochvolumigen Produktion noch kleinerer Logik-

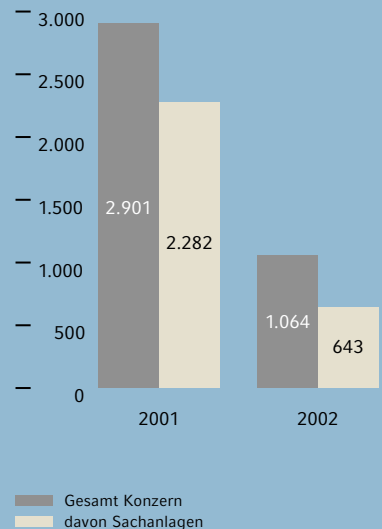
chips, die von jedem Partner in der eigenen Fertigung genutzt werden kann. Dabei teilen wir uns die hohen Kosten und reduzieren deutlich die Zeitspanne von der Produktentwicklung bis zur Serienfertigung.

Um unsere Kapazitäten noch bedarfsgerechter einsetzen zu können, nutzen wir die vorhandenen Synergien zwischen Speicher- und Logikproduktion. Bereits heute sind 80 % unserer Fertigungsanlagen für beide Chip-Varianten einsetzbar. Das verschafft uns den Vorteil, dass wir flexibler als der Wettbewerb auf Nachfrageschwankungen in den einzelnen Marktsegmenten reagieren können.

Technologie- und Kostenführer bei 300-Millimeter-Technologie und DRAMs

Wer im Massengeschäft mit DRAM-Chips langfristig erfolgreich sein will, muss technologisch hochwertige Produkte zu niedrigsten Preisen anbieten. Unser erklärtes und bereits erreichtes Ziel ist deshalb, die kleinsten DRAMs auf den größten Siliziumscheiben zu produzieren. Denn je kleiner die Chipstrukturen, desto höher ist die Leistungsfähigkeit der Produkte und desto geringer sind die Herstellungskosten. Und je größer der Siliziumwafer, auf dem in einem Durchlauf entsprechend mehr Chips gefertigt werden können, desto niedriger sind die Stückkosten. Im Vergleich zur Produktion auf herkömmlichen 200-Millimeter-Scheiben werden wir mit der Fertigung von DRAMs auf 300-Millimeter-Wafern die Stückkosten um weitere 30 % senken.

Investitionsvolumen
(in Mio. Euro)



„Wer den Neuen Verbraucher nicht versteht, wer nicht erkennt, wie radikal anders nicht nur sein Konsumverhalten, sondern auch sein Seelenleben ausgeprägt ist, der wird mit seinen (einst erfolgreichen) Marketingstrategien scheitern, wird auf Misstrauen und Desinteresse stoßen und seine Umsätze rasch schwinden sehen.“



DAVID LEWIS,
Buchautor und auf Konsumentenforschung spezialisierter Berater

Mit unserem neuen Werk in Dresden nahm im Dezember 2001 die erste 300-Millimeter-Fabrik der DRAM-Welt die Volumenproduktion auf. Anfang 2002 hat außerdem unser taiwanesisches Gemeinschaftsunternehmen ProMOS die 300-Millimeter-Produktion hochgefahren. Zusätzlich wollen wir mit Nanya als neuem Partner unseres Entwicklungs- und Produktionsnetzwerkes in Taiwan unser drittes 300-Millimeter-Werk bauen; dieses wird voraussichtlich Mitte 2004 den Betrieb aufnehmen. Weitere Partnerschaften existieren mit Winbond Electronics, ebenfalls ein taiwanesischer Auftragsfertiger, und SMIC, dem zur Zeit führenden Halbleiter-Hersteller in China. So haben wir für die derzeit günstigste Art der DRAM-Fertigung ein leistungsfähiges Kooperationsnetzwerk geschaffen, bevor einige unserer Wettbewerber überhaupt im Besitz dieser Technologie sind. Das Resultat: Wir glauben, dass Infineon unangefochtener Technologie- und Kostenführer bei Speicherchips ist.

Um diese Position nachhaltig zu stärken, verkleinern wir kontinuierlich die Chipstrukturen. Bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2003 waren 70 % unserer DRAM-Kapazitäten auf 140-Nanometer-Strukturen umgestellt – die kleinsten Strukturen, die zurzeit weltweit in der Volumenproduktion von Speicherchips verwendet werden. Kombiniert mit der Produktion

Fertigung auf 300-Millimeter-Wafern und 140 Nanometer breiten Leiterbahnen verringert DRAM-Kosten um 50 %

Weitere Informationen zu
Kooperationen und
Joint Ventures bietet der
Lagebericht auf S. 90 ff.

auf 300-Millimeter-Wafern können wir so die Herstellungskosten von DRAMs um insgesamt 50% senken.

Und die Technologiespirale dreht sich weiter: Gemeinsam mit Nanya entwickeln wir in Dresden Technologien, um die Chipstrukturen auf 90 Nanometer und kleiner schrumpfen zu lassen. Um die neuen Produktivitätsziele zu erreichen, haben wir außerdem am selben Standort mit AMD und DuPont Photomasks eine Allianz zur Entwicklung und Herstellung von Fotomasken gegründet. Unser Joint Venture Advanced Photomask Technologies wird uns mit High-End-Lithografiemasken beliefern, die zur Umsetzung der kleinsten Chipstrukturen notwendig sind.

Wir bleiben also Taktgeber bei Erfolg versprechenden Zukunftslösungen und bauen unseren Standort Dresden als internationales High-Tech-Zentrum der Halbleiter-Industrie weiter aus.

DANIEL DETTLING,
Gründer von BerlinPolis, dem
deutschen „Think Tank“ der
nächsten Generation



„Neue Technologien sind ein wichtiges
Selfempowerment-Instrument. Der
Selbstunternehmer der Wissensgesellschaft
braucht dazu benutzerfreundliche
Technologien, die den Menschen wieder in
den Mittelpunkt stellen und nicht die Technik.“

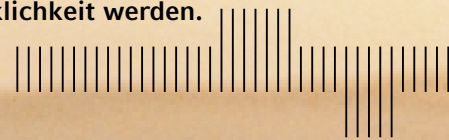
Optimierte Fertigungslogistik beschleunigt kostengünstige Produktion

Gerade in den Boomjahren 1999 und 2000 war es aufgrund der großen Nachfrage unserer Kunden erforderlich, die Fertigungskapazitäten so rasch wie möglich auszubauen. In der darauf folgenden Marktflaute haben wir mit dem Kostensenkungs- und Restrukturierungsprogramm Impact sowie dem aktuellen Effizienzsteigerungs-Programm Impact² die Fertigungsabläufe systematisch optimiert. Dabei erzielten wir im Geschäftsjahr 2002 beachtliche Erfolge: So wurde die Durchlaufzeit der Siliziumscheiben durch die Fertigung, die rund zwei Monate in Anspruch nehmen kann, gegenüber 2001 im Durchschnitt um 20% reduziert. Auch bei der Einführung neuer Produkte in den Fertigungsablauf sowie beim Entwickeln und Implementieren neuer Fertigungsprozesse sind wir erheblich schneller geworden.

Wir minimieren zudem konsequent die Durchlaufzeiten von der Planung einzelner Fertigungsschritte über den Eingang konkreter Bestellungen bis zur Auslieferung der Halbleiter. So können wir unsere Kunden flexibler und zügiger bedienen.

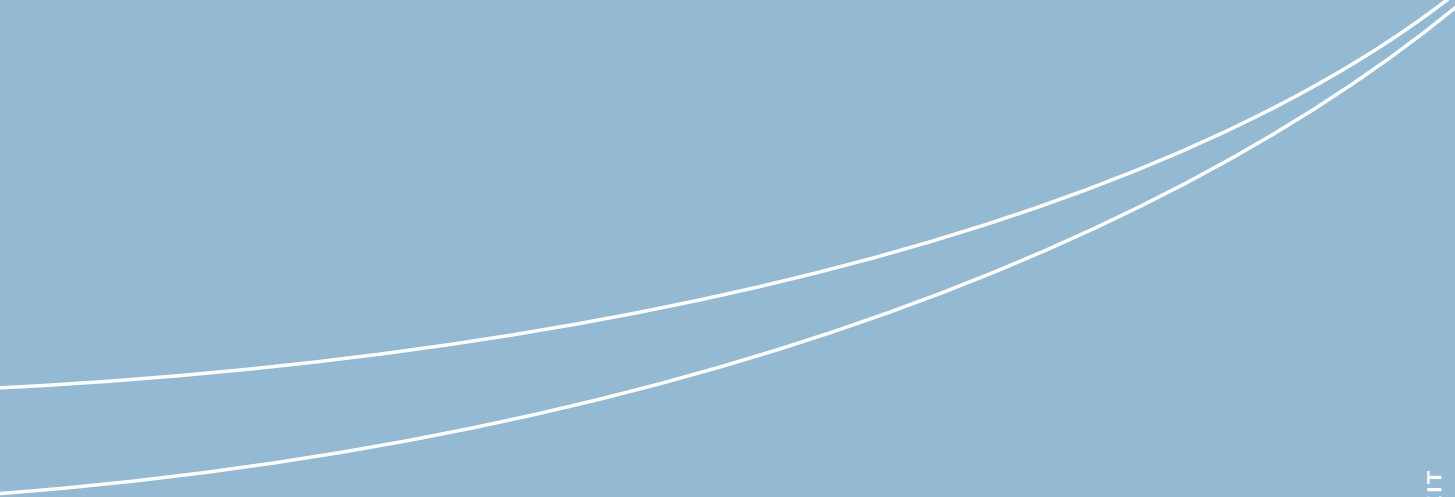
Das Leben an jedem Ort der Welt genießen. Unsere Lösungen geben Ihnen die Freiheit dazu.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Leben zu genießen. Ein guter Grund für uns, Lösungen zu entwickeln, die den Menschen dazu die nötige Freiheit geben. Lösungen wie unsere „intelligente“ Kleidung. Unserer Forschungsabteilung ist es gelungen, Chips und kleine Sensoren in Textilien zu integrieren. In den Stoff eingewebte feine Leiterbahnen sorgen dabei für die elektronischen Verbindungen. So genannte Thermogeneratoren erzeugen aus der Körperwärme den entsprechenden Strom – so dass Batterien teilweise unnötig werden. Wo immer man sich gerade aufhält, das Wichtigste steckt bequem in der Kleidung: vom MP3-Player bis zur Digitaluhr. Das Leben genießen heißt auch, sich sicher zu fühlen – besonders wenn man auf sich allein gestellt ist. Daher bietet unsere Lösung für den Fall der Fälle die nötige Sicherheit – in Form z. B. eines GSM/GPS-Chips im Anorak, der den Rettungskräften im Notfall schnell den Weg zeigt. Man sieht: Den Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt und sie können schon in naher Zukunft Wirklichkeit werden.



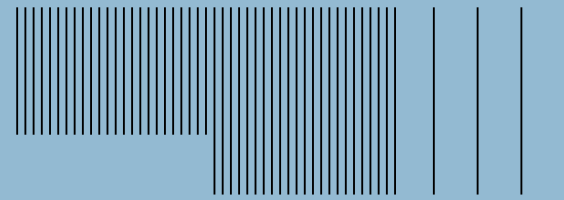
||||| NACHHALTIGKEIT





||| || NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGKEIT: Wir gehen mit Ressourcen schonend um.
INNOVATIONEN: Wir schauen weit über den Tellerrand hinaus.
MITARBEITER: Wir bieten maßgeschneiderte Karriereleitern.
GESUNDHEIT: Wir schützen unsere Mitarbeiter und Nachbarn.
UMWELTSCHUTZ: Wir reduzieren die Schadstoffemissionen.



SEHEN,
was neue CHANCEN eröffnet.



Bis in die Grenzbereiche der Physik

- Kosten- und Technologieführerschaft weiter ausgebaut
- Preisgekrönt: Infineon erhält Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft
- Innovationspionier: Leiterbahnen aus einem einzigen Molekül, intelligente Kleidung, Labor auf einem Chip und vieles mehr
- Forschung im Netzwerk: kooperativ und erfolgreich

Der Halbleiter-Markt zählt zu den dynamischsten und wachstumsstärksten Märkten überhaupt. In kurzen Zeitabständen bedarf es immer neuer Produkte und Lösungen. Damit wird die Innovation zum Erfolgsfaktor schlechthin, ja geradezu zum Lebenselixier des Technologieunternehmens. Dass Infineon die Klaviatur der Innovation meisterhaft beherrscht, beweist nicht zuletzt der Markterfolg des Konzerns: Er gehört zu den drei größten Anbietern in den Segmenten Speicherprodukte, drahtgebundene sowie mobile Kommunikation, ist unangefochten Weltmarktführer bei integrierten Schaltkreisen für Sicherheits- und Chipkarten und hält den zweitgrößten Weltmarktanteil bei Halbleitern für die Automobilindustrie.

„Der Markt verlangt immer mehr maßgeschneiderte Güter und Dienstleistungen, die im individuellen Dialog mit dem Kunden entwickelt werden. Denn die neuen Kunden wollen nicht nur Produkte, die sie ästhetisch befriedigen und zu ihrem Selbstverständnis und zu ihrer Selbstinszenierung passen. Sie wollen auch persönliche Bedienung, Beratung und Anregung.“



CHRISTIAN LUTZ,
Zukunftsforscher, Buchautor
und ehemaliger Leiter des
Gottlieb Duttweiler Instituts

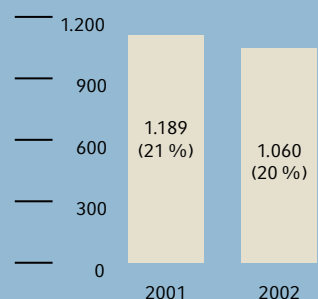
Die Innovationskraft von Infineon wird immer wieder preisgekrönt

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2002 beispielsweise mit dem Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft, der als der deutsche Technologie-Oscar schlechthin gilt. Infineon erhielt die Auszeichnung für eine Halbleiter-Familie, die verschiedenste Geräte dazu bringt, bis zu 30 % Energie einzusparen – ohne Bedienkomfort und Geräteleistung im Geringsten einzuschränken (siehe unten). Daneben erhielt Infineon den Sesames Award für die beste technologische Innovation der Chipkarten-Branche. Ausgezeichnet wurde damit ein Chipkarten-Controller, der bald mit dem Kartenchaos im Portmonee aufräumen könnte: Er kann die Daten von Personalausweis, Bank- und Kreditkarte, Monatskarte für Bus und Bahn sowie Kundenkarte vom Kaufhaus auf einer einzigen Chipkarte vereinen und vor unerlaubtem Zugriff schützen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind die Synergien, die sich zwischen den Geschäftsbereichen erschließen. Beispielsweise, wenn die Automobilelektronik um Elemente der mobilen Kommunikation erweitert wird. Oder wenn intelligenter Kleidung neben dem MP3-Player auch das satellitengestützte Positionierungssystem GPS eingewebt wird. Und alle Geschäftsbereiche ziehen gleichermaßen Nutzen aus den immer weiter verbesserten und günstigeren Herstellungs-

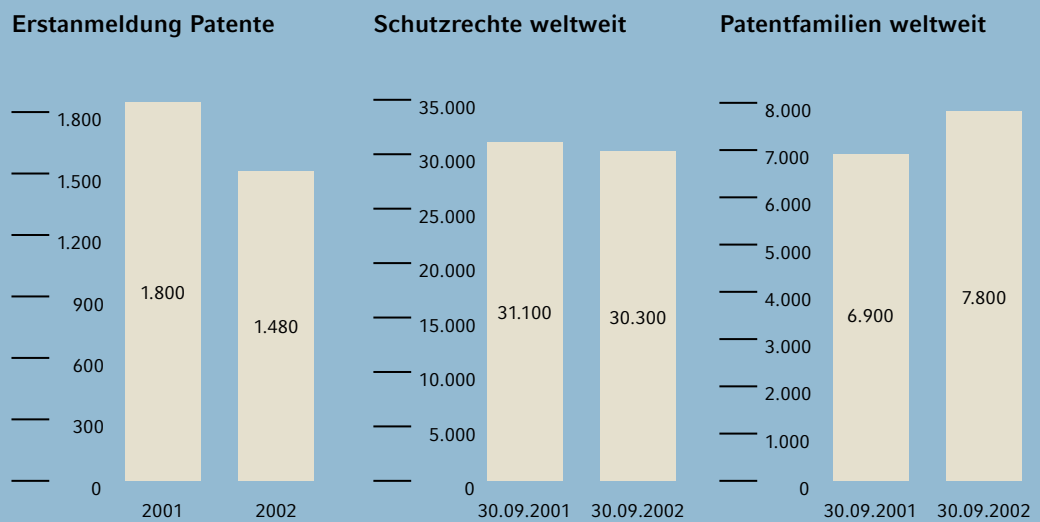
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

in Mio. Euro (% vom Umsatz)



methoden für Halbleiter. Diese Synergien sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil: Infineon tritt am Markt nicht mit isolierten Einzelleistungen auf, sondern kann ganze Systemlösungen anbieten. Dieses Lösungsgeschäft weiter auszubauen, die Wertschöpfungskette zu verlängern, ist ein wesentlicher Teil der Konzernstrategie – und deshalb auch Kern der neu formulierten Vision für Infineon.

Anzahl Erstanmeldungen von Patenten, Schutzrechten und Patentfamilien weltweit*



* Im Rahmen der Erstanmeldung einer Erfindung wird diese das erste Mal bei einem Patentamt in einem Land hinterlegt. Wenn das Amt das Patent erteilt, wird daraus ein Schutzrecht. Soweit nötig, wird diese Erfindung bzw. das zugrunde liegende Schutzrecht zusätzlich in anderen Ländern angemeldet bzw. beantragt. Alle weltweit erhaltenen Schutzrechte, die eine Erfindung betreffen, bilden zusammen die Patentfamilie zu dieser Erfindung.

Forschung und
Entwicklung haben
bei Infineon
höchsten Stellenwert

Infineon übernimmt immer wieder die Rolle des Pioniers, der das Entwicklungstempo vorgibt. Und das umso mehr in Zeiten eines schwachen Halbleiter-Marktes: Zwar hat sich Infineon mit dem Impact-Programm auch von einigen weniger aussichtsreichen Forschungsprojekten getrennt, um die Gesamtkosten zu senken. Doch um sich rechtzeitig für den nächsten Aufschwung zu rüsten, um schließlich gestärkt aus der Marktschwäche hervorzugehen, misst der Konzern Forschung und Entwicklung nach wie vor allerhöchsten Stellenwert bei. Das gilt zum einen für jene anwendungsorientierte Forschung, die direkt in absatzstarke Produkte mündet. Zum anderen widmet sich Infineon intensiv der Grundlagenforschung, die erst nach Jahren intensiver Laborarbeit Früchte tragen kann. Denn auch darin liegt ein Schlüssel zum Erfolg: Um seine Spitzenposition am Markt nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen, muss Infineon die Grenzen des physikalisch Machbaren immer weiter ausloten.

Über das Ende des Siliziumzeitalters hinaus

Die Kapazität und Komplexität von Mikrochips verdoppelt sich im 18-Monate-Takt. Sagt das Moore'sche Gesetz, und seit 37 Jahren erfüllt sich die gewagte Voraussage in verblüffender Regelmäßigkeit. Den Infineon Forschern ist das Moore'sche Gesetz geradezu eine Verpflichtung – erst recht, wenn die heutige Chip-Technik an ihre physikalischen Grenzen stößt: Es naht das Ende des Siliziumzeitalters. Noch mindestens zehn Jahre, so schätzt man heute, lassen sich die herkömmlichen Methoden weiter verfeinern. Dann werden die Möglichkeiten der optischen Lithografie erschöpft sein, mit der heute die Chipstrukturen auf das Trägermaterial aufgebracht werden. Bei Speicherchips etwa sind die kleinsten produzierten Strukturen heute 140 Nanometer breit, das entspricht etwa 700 Atomen; ab dem Jahr 2003 stellen wir auf 110 Nanometer um. In der Technologieentwicklung arbeiten wir nun an Konzepten für 90 und 70 Nanometer breite Strukturen, wobei die 90er-Variante schon ab 2004 eingesetzt wird. Doch wenn die Strukturen langfristig noch kleiner werden, sind die Wellenlängen des Lichts als Werkzeug nicht mehr filigran genug. Hinzu kommt: Je dünner die metallischen Leiterbahnen, desto höher ihr Widerstand; ab einem bestimmten Punkt wird der Chip einfach zu heiß. Damit die Chips also weiterhin kleiner und dabei leistungsfähiger werden, bedarf es nichts weniger als gewaltiger Technologiesprünge.

„Der fundamentale Wandel der Lebens- und Arbeitswelt fördert eine neue Art von Mobilität, die den Einzelnen zur gestaltenden Kraft in einer Welt der permanenten Veränderung macht.“



GUNDULA ENGLICH,
Buchautorin und
Filmproduzentin

Kohlenstoff: der Draht aus einem Molekül

Infineon Forschern ist es jetzt gelungen, weit über den Tellerrand des Siliziumzeitalters hinauszublicken: Sie haben erfolgreich mit dem dünnsten aller vorstellbaren Drähte experimentiert. Er besteht nur aus einem einzigen Molekül, einem Röhrchen aus Kohlenstoffatomen. Diese so genannten carbon nanotubes gehören nach den bekannten Formen Diamant und Grafit zur dritten Kohlenstoffmodifikation der Fullerene, die erst Anfang der 90er Jahre entdeckt wurde. Die Atome bilden dabei gleichmäßige Sechsecke, die allerdings nicht wie beim Grafit Plättchen formen, sondern perfekte, nahtlose Röhrchen. Und die besitzen ideale physikalische Eigenschaften: Sie haben eine doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Diamant, dem besten bisher bekannten Wärmeleiter. Sie halten Stromdichten von bis zu 10^{10} Ampere pro Quadratzentimeter aus, während Kupfer bei etwa 107 Ampere pro Quadratzentimeter schmilzt. Und sie setzen das Ohm'sche Gesetz außer Kraft – der elektrische Widerstand wird zur Konstante, die von der Länge fast unabhängig ist.

Kupfer-Leiterbahnen
werden Stück für Stück
durch carbon nanotubes
ersetzt

Auf dem Weg dahin, diese theoretisch günstigen Eigenschaften in praktische Anwendungen umzusetzen, haben Infineon Forscher mit ihrer Grundlagenforschung einen spektakulären Durchbruch erreicht: Sie haben es als Erste weltweit geschafft, carbon nanotubes auf Wafern, den in der Chip-Herstellung üblichen Siliziumgrundplatten, gezielt wachsen zu lassen. Dabei werden die Siliziumscheiben perforiert und mit einer metallischen Schicht unterlegt. Vom Metall aus können die Kohlenstoff-Fäden dann in den Löchern wachsen und sie ausfüllen. Wird das Ganze von oben mit einer zweiten metallischen Schicht bedeckt, sind es die Kohlenstoffröhrchen, die beide Ebenen als so genannte Vias verbinden. In ihrer konventionellen, metallischen Form stellen Vias neuralgische Punkte von Chips dar: Bei großen Stromdichten können sie sich so stark erhitzen, dass sie sich verformen und den Halbleiter untauglich machen. Bestehen sie jedoch aus carbon nanotubes, halten sie deutlich mehr aus – sowohl höchste Stromdichten als auch mechanische Einflüsse. Kohlenstoff-Vias könnten die erste praktikable Anwendung einer neuen Technologiegeneration werden. Den Prozess dazu haben die Infineon Forscher einem katalytischen Abscheidungsverfahren entlehnt, das in der Mikroelektronik üblich ist. Das Verfahren nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und ist sowohl von den Materialien als auch der Temperatur her mit herkömmlichen Verfahren in der Halbleiter-Herstellung kompatibel – im Unterschied zu Laserverdampfung oder Lichtbogenentladung, die bis dato die einzig bekannten Wege waren, um Nanotubes zu gewinnen.

Noch sind Anwendungen von carbon nanotubes Zukunftsmusik; heute rechnet man damit, dass frühestens im Jahr 2005 die ersten Mikrochips mit Kohlenstoff-Leitern auf den Markt kommen. Es könnte allerdings sein, dass die Vias dann nur der vergleichsweise bescheidene Anfang sein werden. Denkbar ist, dass die Kupfer-Leiterbahnen Stück für Stück durch carbon nanotubes ersetzt werden. Und theoretisch können Kohlenstoff-Röhren auch als Transistoren eingesetzt werden, denn sie sind auch halbleitend dotierbar. Doch damit nicht genug: Mit carbon nanotubes denken die Infineon Visionäre buchstäblich in neuen Dimensionen – im Unterschied zur heutigen zweidimensionalen Mikroelektronik ist mit Kohlenstoff der dreidimensionale Chip denkbar. Bis dahin aber ist es ein weiter Weg und viel Grundlagenforschung ist zu leisten. Vielleicht wird es in zehn Jahren so weit sein, dass mit Beginn des Kohlenstoffzeitalters das Ende der Siliziumära eingeläutet wird. Infineon wäre dann jedenfalls ganz vorne mit dabei.

Nachricht an die Branche: Dünne Drähte lohnen sich

Doch solange Silizium der Grundstoff des Informationszeitalters bleibt, werden die physikalischen Grenzen der Technologie weiter ausgelotet. Beispielsweise, was die Kupferleitungen in den Chips angeht: Wie oben beschrieben sind heute schon 110 Nanometer dünne Leiterbahnen möglich. Lange Zeit galt es in der Branche als ein Rätsel, auf welches Maß sich der Durchmesser noch reduzieren lässt, ohne die elektrische Zuverlässigkeit einzuschränken. Denn der Widerstand steigt, je dünner die Leiterbahn ist. Damit entsteht auch mehr Abwärme und die Gefahr, dass die Kupferfädchen regelrecht durchbrennen. Hinzu kommt das Phänomen der Elektromigration. Dahinter verbergen sich Alterserscheinungen, die für extrem kleine Strukturen typisch sind: Wärme und hohe Ströme führen dazu, dass das Material aus den Leitungen abgetragen wird, in der Folge fallen die Schaltungen aus. Infineon hat indes mit seiner Grundlagenforschung gezeigt: 70 und sogar 40 Nanometer, also weniger als ein Drittel heutiger Strukturbreiten, sind immer noch im Rahmen des Machbaren.

Die winzigen Leiter, deren Masseneinsatz in der Branche für die Jahre 2010 bis 2013 angepeilt wird, halten sogar ganz erhebliche Stromdichten von 80 bis 100 Millionen Ampere pro Quadratzentimeter aus. Möglich ist das, da es den Infineon Wissenschaftlern gelungen ist, die Wärme besonders effektiv an eine nicht leitende Schicht abzugeben, an ein so genanntes Intermetall-Dielektrikum, das die Leiterbahn umgibt. Was die Elektromigration betrifft, so liegen die extrem dünnen Leiterbahnen bei einer simulierten Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren – ein hervorragendes Ergebnis, das sich mit dem von heutigen Schaltungen durchaus messen kann. Damit sendet Infineon ein wichtiges Signal an die gesamte Halbleiter-Branche: Es lohnt sich durchaus, auf immer kleinere Strukturbreiten hinzuarbeiten und in die dazu notwendigen Technologien zu investieren.

Frequenz-Weltrekorde mit Si: Teurere Werkstoffe GaAs und InP ersetzbar

Und Infineon hat weitere Neuigkeiten für die Branche: Bisher galt es als unmöglich, Bauteile für sehr hohe Frequenzen, wie sie vor allem für Handys gebraucht werden, auf Siliziumbasis herzustellen. Damit die Geräte schnell arbeiten, basieren Hochfrequenz-Halbleiter heute meist auf Galliumarsenid (GaAs) oder Indiumphosphid (InP), deren Elektronenmobilität sehr viel höher als die von Silizium (Si) ist. Allerdings sind diese Werkstoffe nicht unproblematisch: GaAs und InP sind zum einen teuer, zum anderen sind sie potenziell umweltgefährdend und schwer zu entsorgen. Infineon Forschern ist es gelungen, mit siliziumbasierten Bauteilen neue Frequenzrekorde aufzustellen. Sie haben die Schaltungstechniken so weit verfeinert, dass die Si-Bauteile eine echte Alternative zu denen mit GaAs oder InP darstellen. Mit ersten Produkten, die von diesen Forschungsergebnissen profitieren, wird bereits 2003 gerechnet.

Chip-Sandwich: ein neuer Weg aus der Verdrahtungskrise

Auch dem Fernziel einer dreidimensionalen Mikroelektronik haben sich die Infineon Forscher schon einmal mit herkömmlichen Chips genähert: Sie haben erfolgreich zweistöckige Chip-Gebäude aus einem Logikchip und einem Speichermodul zusammengelötet. Dieses „Chip-Sandwich“ löst gleich mehrere Probleme der Halbleiter-Industrie: Die Kommunikationstechnik beispielsweise wird zunehmend komplexer und bedarf einer immer größeren Zahl von Leitungen, die auf begrenztem Raum untergebracht werden müssen. Hinzu kommt: Je länger die Wege und damit die Leitungen zwischen den Chips, die üblicherweise nebeneinander angeordnet sind, desto höher der Widerstand, desto wärmer wird das Gerät. Auch die Signale brauchen recht lange, um von Chip zu Chip zu gelangen, die Schaltung wird langsam. Angesichts dieser „Verdrahtungskrise“ sind etwa Anwendungen in der Kommunikationstechnik, die mit hohen Frequenzen arbeiten, relativ teuer. Dem setzen die Infineon Forscher nun eine elegante Lösung entgegen:

Mit der so genannten Face-to-face-Technologie werden ein Logik- und ein Speicherchip übereinander gelötet, wobei ihre Oberseiten einander zugewandt sind, sich also sozusagen anschauen. Die beiden Kontaktflächen werden jeweils mit einer hauchdünnen Kupferschicht überzogen, auf die dann nur drei Mikrometer (0,003 Millimeter) dünn das Lötzinn aufgetragen wird. 270 °C reichen als Löttemperatur aus. Alle verbindenden Leiterbahnen verlaufen innerhalb einer Zwischenschicht, außen entlang geführte Leitungen sind nicht nötig. Und weil die kurzen Leitungen zwischen den Chips wenig Widerstand hervorrufen, bewahren die Halbleiter auch im Betrieb einen kühlen Kopf; mobile Geräte werden damit nicht mehr so heiß. Bis zu einhundertmal mehr Leitungen als bei bisherigen Lösungen können so auf vergleichbarem Platz untergebracht werden.

Stromdichten von 80 bis
100 Millionen Ampere pro
Quadratzentimeter

Gefahren für die Umwelt
weiter verringert

Mit der Face-to-face-
Technologie wachsen
Logik- und Speicher-
elemente zusammen

Geeignet ist das Sandwich für fast alle Anwendungen von der mobilen Kommunikation bis hin zu Systemen für Industrie und Automobil. Und es passt auch in alle gängigen Gehäuse – die beiden Chipteile werden aus besonders flachen Siliziumscheiben gewonnen; das Sandwich wird nicht höher als ein normaler Chip. Im Vergleich zu den herkömmlichen, nebeneinander angeordneten Halbleitern spart diese Konstruktion also etwa die Hälfte des Platzes – womit sie komplexere Bauelemente auf kleinerer Fläche erlaubt und bestehende Produkte um bis zu 30 % verbilligen kann. Und auch das Umstellen der Produktion ist kostengünstig: Für das Sandwich wurden in Dresden die gleichen Maschinen genutzt, mit denen auch andere Infineon Halbleiter hergestellt werden. Eine erste Anwendung könnte schon im nächsten Jahr mit einem Chipkarten-Controller auf den Markt kommen. Bei Chips für die smarten Karten ist das Sandwich eine nahe liegende Lösung, denn auf einer festgelegten Grundfläche müssen Logik- und Speicherfunktionen untergebracht werden. Bislang verfügen Chipkarten über einen Speicher von 32 Kilobyte. Beim neuen Face-to-face-Chip, der bereits als Prototyp vorliegt, sind es 160 Kilobyte. Damit können nicht nur mehr Daten untergebracht werden, es gibt sogar Platz genug für ein komplexes offenes Betriebssystem, etwa für eine Linux-Variante.

PETER GLOTZ,
Direktor des Instituts für
Medien- und
Kommunikationsmanagement
der Universität
St. Gallen



„Die elektronischen Informations-, Kommunikations- und Medientechnologien tragen durchaus zu einer Verbesserung des Verhältnisses von Mensch und Biosphäre bei. Die Beschleunigung von Produktionsprozessen und ihre Effizienzsteigerung entlasten oft genug die Natur.“

Computer zum Anziehen: Zukunftsmarkt intelligente Kleidung

Elektronische Geräte zum Kleidungsstück werden zu lassen – das erscheint als logischer Schritt in einer technologischen Entwicklungskette, in der die Elektronik unaufhaltsam miniaturisiert wird. Infineon hat jetzt erstmals eine Jacke mit einem winzigen Audiomodul vorgestellt, dem auch Waschen und Bügeln nichts anhaben können. Integriert ist ein MP3-Player, ein Gerät zur Texterkennung und ein Musiksynthesizer. Das Audiomodul ist nur drei Millimeter dick, bei Seitenlängen von jeweils 2,5 Zentimetern. In der Kleidung fällt es also weder auf noch schränkt es den Tragekomfort ein. Wer eine solche Jacke trägt, kann ein Mikrofon und Kopfhörer ebenso daran anstöpseln wie Speicherkarten, Tastaturen, Displays, Sensoren und Aktoren. Auch Sender können eingewebt werden, Mobilfunktechnik oder GPS-Satellitenempfänger. Auswechselbar sind die Batterien und natürlich auch die Speicherkarten, damit neue Musiktitel oder Software aufgespielt werden können.

Für unsere Techniker indes bestand die größte Herausforderung darin, die Textilien mit der Elektronik zu verbinden. Denn während die Stoffstrukturen sich im Millimeterbereich bewegen, sind die elektronischen Leiterbahnen nur Mikrometerklein. Mit der Audiojacke haben Infineon Techniker das Problem gelöst: Das Chipmodul wird innerhalb einer hermetisch verschlossenen Kapsel fest mit hauchdünnen silberummantelten Kupferdrähten ver-

bunden, die, in den Jackenstoff verwoben, Signale und Daten transportieren. Und damit wird das intelligente Kleidungsstück wirklich alltagstauglich – es ist wasch- und bügelfest. Die Soundjacke ist dabei nur ein erstes Beispiel, ein winziger Ausschnitt dessen, was technologisch machbar ist. So könnten Jeansklamotten via GPS die Eltern darüber auf dem Laufenden halten, wo sich ihre Sprösslinge gerade aufhalten, Funktionskleidung alarmiert bei Notfällen den nächsten Rettungsdienst, Windjacken verfügen über eine integrierte Klimaanlage, elektronische Etiketten verhindern den Waschstart, wenn der Wollpullover im falschen Waschgang landet, der Jogginganzug misst Puls und Schrittfrequenz und erstellt ganze Trainingspläne – und so weiter und so fort.

Mikroelektronik zum Anziehen ist ein interessanter Zukunftsmarkt. Mehr als 80 % der Erwachsenen in Deutschland, so hat eine Umfrage des Bekleidungsphysiologischen Instituts Hohenstein ergeben, würden sich darauf einlassen. In etwa zehn Jahren könnte es Massen Anwendungen geben. Wenn es so weit ist, muss die Kleidung mit rund 10 Euro Mehrkosten nicht unbedingt viel teurer als herkömmliche Garderobe sein. Ein baldiger Durchbruch ist im medizinischen Sektor denkbar, der einen interessanten Markt darstellt: Zum einen reagiert der medizinisch-sportliche Bereich weniger preissensitiv als der Konsumgütermarkt. Zum anderen steigt mit einer tendenziell alternden Bevölkerung auch die Nachfrage nach Pflege im weitesten Sinne. Beispielsweise nach „Personal Health Monitoring“, der personenbezogenen Überwachung der Gesundheit, wobei unscheinbare Sensoren Puls, Temperatur oder andere Körperfunktionen messen. Die Patienten müssten gar nichts davon bemerken, ihre Lebensqualität stiege. Ebenso könnte ein Sensor bei Risikopatienten dann den Notarzt alarmieren, wenn das Herz Probleme macht. Gleiches könnten Sensoren leisten, die bei Stürzen reagieren. Im Krankenhaus könnten Sensoren in Schlafanzügen die Körperfunktionen überwachen – die Patienten bräuchten dafür nicht mehr verkabelt zu werden.

Der Strom für die intelligente Kleidung kommt bisher von Batteriemodulen. Bisher, denn derzeit wird an integrierten Thermogeneratoren geforscht, die aus dem Temperaturunterschied zwischen Kleidung und Körper Strom erzeugen sollen. Infineon hat bereits einen Generator auf Siliziumbasis entwickelt, der medizinischen Sensoren ausreichend Strom liefern würde.

Innovationspreis: Energie sparen ohne Verzicht

Ende 2001 hat Infineon den Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft gewonnen. Ausgezeichnet wurde damit eine Familie von Leistungshalbleitern namens CoolMOS und IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), die zweifellos eine Karriere vor sich hat: Mit ihrer Hilfe werden Geräte und Maschinen bis zu 30 % weniger Energie benötigen. In Zukunft werden sie milliardenfach zur Grundausstattung von Autos und Haushaltsgeräten, von Mobiltelefonen, Industriemotoren und Personalcomputern gehören. Dahinter stecken Transistoren, die hohe Ströme punktgenau steuern können.

Bei Autos beispielsweise wird alles ständig auf Einsparungsreserven ausgelotet, von den Fensterhebern über die Bremsen bis hin zu den Steuerungen für Motor und Getriebe und zur Klimaanlage. Auch im Haushalt werden die vielfältigen Winzlinge Großes leisten: Schon heute steuern sie in Waschmaschinen der Marken Miele und Bosch-Siemens die Motoren-drehzahl; in Zukunft werden sie jedoch vom Aufheizen bis zur Kontrolle der Wassermenge alles im Griff haben, beim Schleudern sollen sie überdies für ein knitterfreies Waschergeb-

Die Halbleiter werden verkapselt und so wasch- und bügelfest gemacht

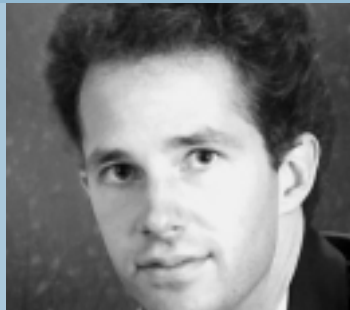
Wearable Electronics: Massenmarkt in 10 Jahren möglich

Milliardenmarkt für Infineon Module

nis sorgen. Kühlschränke, die mit der neuen Technik ausgestattet sind, werden weniger Strom aufnehmen. Und Hi-Fi-Geräte oder Computer benötigen im Standby-Betrieb so gut wie keine Energie mehr. Industriemotoren, die heute die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland ausmachen, fressen mit IGB-Transistoren nur noch halb so viel Strom.

Mit den neuen Leistungshalbleitern, die Infineon einen Technologievorsprung von rund 15 Monaten sichern, entsteht eine ganz neue Wettbewerbsdimension: Es ist nicht mehr allein die Geschwindigkeit, die einen leistungsfähigen Chip ausmacht. Denn die IGBT- und CoolMOS Halbleiter machen Geräte möglich, die sich bei gleicher Leistung einfacher bedienen lassen und dabei gleichzeitig umweltfreundlicher werden – also Energie sparen ohne Verzicht, ohne den Komfort im geringsten einzuschränken.

JÖRG ZOBEL,
Berater und Buchautor von
„Mobile Business und
M-Commerce“



„Mobile Datenübertragung wird unser Leben verändern. Sie vergrößert die Aktionsreichweite und kontextspezifische Informationsmacht für den Einzelnen. So wird der Traum vom allwissenden Mann im Ohr früher oder später Wirklichkeit.“

**Mit Dünnscheibentechnik
das Gesetz von Feuer und
Wasser durchbrochen**

Nach einer Beispielrechnung ließe sich mit den sinnvoll eingesetzten Halbleiter-Bauelementen allein in den USA Energie im Wert von jährlich 80 bis 100 Mrd. Dollar einsparen. Was die kleinen Bauteile zu all dem befähigt, ist eine komplexe Kette technologischer Durchbrüche. Eine wesentliche Grundlage ist die Dünnscheibentechnik, mit der Infineon weltweit eine Spitzenposition erobert hat: Die Wafer – also die Siliziumgrundplatten, auf die die Halbleiter-Strukturen in einem komplizierten, mehrere hundert Schritte umfassenden und mehrwöchigen Prozess aufgetragen werden – sind nur 70 Mikrometer dünn. Mit dem CoolMOS Prinzip ist es den Infineon Entwicklern gelungen, hervorragendes Leiten und perfektes Isolieren im gleichen Bauelement zu vereinen – Eigenschaften, die sich eigentlich wie Feuer und Wasser widersprechen. Damit entsteht ein Strom, der sich durch eine besonders hohe Schaltfrequenz auszeichnet. Energieflüsse lassen sich damit außerordentlich präzise regeln. Und weil es kaum Widerstand gibt, fällt nur sehr wenig Abwärme ab. So werden schwere Energiefresser wie Transformatoren oder Gleichrichter überflüssig. Ein Schicksal, das auch die heute üblichen Ladegeräte mit ihrer aufwändigen Kühlung ereilen wird: Die künftigen elektronischen Wandler werden sich kaum mehr erwärmen – Ladegeräte für Mobiltelefone finden so in einem normalen Elektrostecker Platz. Und auch die Stromversorgung für PCs oder Notebooks wird mit den neuen Bauteilen überdacht werden. Infineon erwartet in diesen Marktsegmenten ein überdurchschnittlich hohes Wachstum.

Das vollelektronische Labor: Bio-Chip ersetzt Reagenzgläser

Der Biotechnologie widmet sich Infineon erst seit kurzem. Das aber gleich mit durchschlagendem Erfolg: Bio-Chip heißt eine Innovation, die der klinischen Diagnostik eine Revolution bescheren könnte. Denn die Arbeit, für die man bislang 128 Reagenzgläser braucht, schafft

ein einziger Chip in einem Bruchteil der Zeit. Und er ist obendrein vielseitig: Er kann Infektionskrankheiten identifizieren und herausfinden, ob ein Patient ein Medikament verträgt oder nicht. Bio-Chips können in der Krebsfrüherkennung eingesetzt werden, Immunreaktionen testen und latenten Erbkrankheiten auf die Spur kommen. Und in der Gerichtsmedizin helfen sie, Straftäter mit Hilfe von Gen-Datenbanken dingfest zu machen. Nur einen halben Quadratzentimeter groß ist der Chip, und darauf passen 128 Reaktionsmulden, die entweder für Einzeltests oder für Paralleluntersuchungen genutzt werden können. Dabei werden den Proben Enzyme beigegeben und diese spalten eine weitere Substanz, die ebenfalls beigegeben wird, in ihre elektrisch aktiven Bestandteile auf. In der Folge entstehen minimale Ströme, die von hoch empfindlichen Goldelektroden eingefangen werden. Sensoren leiten den Strom dann weiter an die Auswerteelektronik, und diese wiederum kann anhand des zeitlichen Verlaufs des Stromflusses ausrechnen, wie sich die gesuchte Substanz zusammensetzt.

Dieses vollelektronische Verfahren ist ungleich robuster und einfacher anzuwenden als das der herkömmlichen optischen Bio-Chips: Bei letzterem werden die Proben mit einem fluoreszierenden Farbstoff versetzt und danach bestrahlt; Licht wird in einer bestimmten Wellenlänge emittiert und mit einer Spezialkamera ausgelesen. Die entstehenden Farbmuster geben geschultem Personal Aufschluss darüber, wie sich die Substanz zusammensetzt. Infineon hat in diesem Jahr einen Bio-Chip auf den Markt gebracht, der mit dieser aufwändigeren optischen Analysearbeit arbeitet. Doch vorausgesetzt, dass er in etwa einem Jahr alle Praxistests bestanden haben wird, gehört die Zukunft dem vollelektronischen Bio-Chip der zweiten Generation. Besonders Krankenhäuser dürften davon profitieren: Günstiger, besser und schneller schafft der Bio-Chip die Laborarbeit.

Für seine bahnbrechende Lösung benutzt Infineon als weltweit erstes Halbleiter-Unternehmen Standard-Chiptechnik: Zu Bio-Chips abgewandelt werden normale CMOS-Halbleiter, wie sie ganz ähnlich beispielsweise in Mobiltelefonen vorkommen. Die größte Herausforderung bestand dabei darin, die Goldelektroden so zu konzipieren, dass sie nicht mit der Schaltung in Konflikt geraten – und das ist den Infineon Forschern gelungen. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesforschungsministerium im Rahmen des Programms SIBANAT, an dem neben Infineon auch das Unternehmen Eppendorf, das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie, die November AG und die Siemens AG beteiligt waren. Ein hervorragendes Beispiel für eine erfolgreiche Forschungspartnerschaft von Infineon.

Hinzu kommen viele weitere Kooperationen mit den ganz Großen und kleineren Firmen der Branche sowie weltweit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die über Spezialkompetenzen verfügen. Denn bahnbrechende Technologien entstehen heute nur noch selten im Alleingang, ein ausgeprägtes Innovationsnetzwerk ist für Infineon ein Schlüssel zum Erfolg.

Besonders wichtig ist jedoch auch der Nachwuchs: Infineon sucht auf der ganzen Welt nach Talenten und arbeitet eng mit Universitäten zusammen. Der Konzern bietet Studenten und Absolventen anspruchsvolle Aufgaben, auch und gerade in Forschung und Entwicklung. Näheres, beispielsweise auch eine Datenbank für Praktika und Diplomarbeiten, finden Interessenten auf der Webseite www.infineon.com/careers.

**Günstigere und
schnellere Suche
nach Erbkrankheiten**

**Informationen über
weitere FuE-Kooperati-
onen im Lagebericht
auf Seite 90 ff.**

Neue Personalstrategie unterstützt Unternehmensziele

- Zahl der Mitarbeiter von 33.813 auf 30.423 gefallen
- Stellenabbau soweit möglich sozial verträglich umgesetzt
- 20.000 Verbesserungsvorschläge sparen 80 Millionen Euro ein

Impact: Infolge der
Branchenkrise fielen
weltweit rund 5.000
Arbeitsplätze weg

Die schwierige Lage am Halbleiter-Markt spiegelt sich bei uns auch in den Beschäftigtenzahlen: Am 30. Juni 2001 – und damit vor Beginn des Kostensenkungsprogramms Impact – arbeiteten konzernweit 34.761 Mitarbeiter. Bis zum Ende des Vorjahres sank die Zahl auf 33.813 und ging im Laufe des Berichtsjahres 2002 bis auf 29.633 Beschäftigte zurück. Mit dem Kauf der Halbleitersparte von Ericsson kamen wieder rund 600 sowie durch andere Erstkonsolidierungen und den Aufbau neuer Abteilungen weitere 200 Mitarbeiter hinzu; damit erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten bis zum Stichtag 30. September 2002 wieder auf 30.423.

WILHELM BAUER,
Leiter des Kompetenzzentrums
„New Work“ am Fraunhofer-
Institut für Arbeitswirtschaft



„Moderne Technik ermöglicht, dass der Wissensarbeiter der Zukunft zu jeder Zeit und an fast allen Orten am Wertschöpfungsprozess partizipieren kann. Das Büro wächst über seine Grenzen hinaus. Damit ergeben sich auch vollkommen neue Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsprozesse, der Bürogebäude und der Technik.“

Der mit der Branchenkrise einhergehenden negativen Umsatz- und Ertragsentwicklung setzten wir ab Juli 2001 das umfassende Kostensenkungs- und Restrukturierungsprogramm Impact entgegen. So konnte das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2002 2,5 Mrd. Euro einsparen und weiterhin eine solide Finanzierungsbasis aufrechterhalten. Erreicht wurde dies auch durch Stellenkürzungen.

Bei der Konzernmutter in Deutschland waren von Impact 1.750 Mitarbeiter betroffen. Bei den Tochtergesellschaften im In- und Ausland wurden rund 3.250 Arbeitsplätze abgebaut. Betrieblich bedingte Kündigungen konnten weitgehend vermieden werden, in den meisten Fällen wurde ein einvernehmliches Ausscheiden vereinbart. Bei weiteren Betroffenen, die direkt bei der Konzernmutter angestellt waren, greifen Interessenausgleich und Sozialplan – ein Ergebnis konstruktiver Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat.

Wo immer aus Unternehmenssicht möglich, haben wir Alternativen genutzt, um weitere Stellenkürzungen zu vermeiden und Arbeitsplätze langfristig zu sichern: An den Standorten Regensburg, München-Perlach und Berlin wurde Kurzarbeit eingeführt, in einzelnen Bereichen wurde die Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden reduziert. Hinzu kam das Angebot, Modelle

der Altersteilzeit, Teilzeitarbeit oder Arbeitszeitflexibilisierung verstärkt zu nutzen. Ebenso konnten Mitarbeiter auf ein Time-Out-Programm zurückgreifen, um sich bei reduziertem Gehalt befristet freustellen zu lassen.

Im Rahmen des neuen Impact²-Programms zur nachhaltigen Effizienzsteigerung nehmen wir auch die Personalarbeit genauer unter die Lupe. Jetzt gilt es umso mehr, die Personalpolitik konsequent an die speziellen Anforderungen unseres Technologieumfelds anzupassen. Wir vergleichen derzeit alle Hauptprozesse – von der Personalstrategie über die Einstellungspolitik und die Personalentwicklung bis hin zu den Vergütungsmodellen – mit den Abläufen und Vorgehensweisen bei ähnlich strukturierten, weltweit tätigen Großunternehmen.

Erste Neuerungen wurden bereits herausgearbeitet:

- Um die notwendigen Veränderungsprozesse sowie neue, innovative Managementmethoden durchzusetzen, werden Mitarbeiter für frei gewordene oder neu zu besetzende Schlüsselfunktionen verstärkt auch extern rekrutiert; ein spezielles Programm erleichtert neuen Mitarbeitern die Integration in das vorhandene Infineon Netzwerk.
- Weiter verfeinern wir das System der Zielvereinbarung und -kontrolle – ein Führungsinstrument, das noch mehr die Leistungsbereitschaft fördern soll und sich vor allem auf die individuelle Vergütung auswirkt.
- Eine andere Neuerung betrifft das Topmanagement: Sämtliche Aspekte der auf die Führungskräfte der oberen Leitungsebene fokussierten Personalarbeit werden künftig zentral betreut und koordiniert.
- Ferner arbeiten wir an neuen international einsetzbaren Vergütungsmodellen, um die individuelle Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter flexibler zu entgelten: Es sollen besondere Anreize für hervorragende Leistungen bereitgehalten werden, wobei monetäre und nicht-monetäre Elemente zu regional angepassten Paketen geschnürt werden.

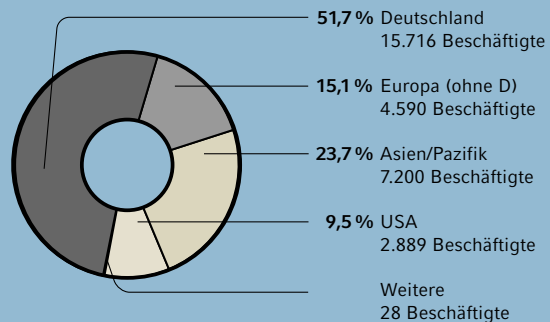
Zu den Spar- und Effizienzsteigerungsprogrammen Impact und Impact² haben unsere Mitarbeiter auch über die eigentlichen Grenzen ihrer Aufgabengebiete hinaus viel beigetragen: Zum Beispiel haben mehr als ein Drittel der Infineon Beschäftigten weltweit im Berichtszeitraum 1. Oktober 2001 bis 30. September 2002 Verbesserungsvorschläge eingereicht, die nicht ihren unmittelbaren Arbeitsbereich betreffen. Auf der Basis von mehr als 20.000 Vorschlägen, die realisiert wurden, können mehr als 80 Millionen Euro eingespart werden. Das ist eine Steigerung von 55 % gegenüber dem Vorjahreswert.

Unser besonderes Augenmerk gilt bei der Personalentwicklung Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen – oder jenen, die dafür künftig in Frage kommen. Bereits bewährt haben sich die beiden Karrierepfade, die wir für unterschiedliche Bedürfnisse anwenden: einerseits die Managementlaufbahn und andererseits die Fachlaufbahn.

Personalpolitik wird
konsequenter an globales
Technologieumfeld
angepasst

Mitarbeiter in den Regionen am 30.09.2002

Gesamt: 30.423 Beschäftigte



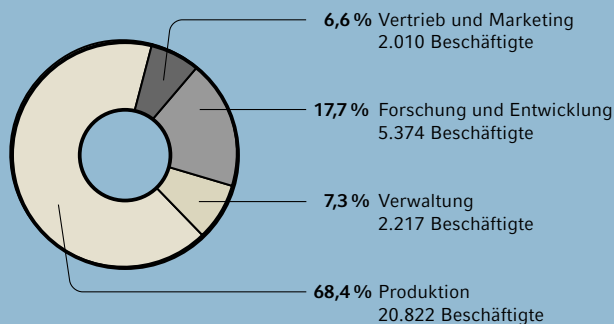
Bereits 2.700
Technologieexperten
auf maßgeschneiderter
Karriereleiter

Für letztere wurde im Vorjahr die so genannte „Technical Ladder“ entwickelt. Damit haben wir auch für Fachexperten eine mehrstufige Karriereleiter geschaffen. Mit der Technical Ladder kann Infineon den Interessen der Mitarbeiter besser gerecht werden, die sich durch herausragendes Fachwissen beweisen. Im Berichtsjahr wurden weltweit bereits 2.700 Fachexperten für dieses Karriereprogramm ausgewählt.

Die Managementlaufbahn richtet sich an jene Mitarbeiter, die aus heutiger Sicht das Potenzial für eine Funktion im Topmanagement mitbringen. Auf ihre persönliche Eignung als so genannte High Potentials werden sie zuvor in einem Assessment Center geprüft. Derzeit bereiten wir etwa 650 Mitarbeiter auf mögliche Schlüsselrollen im Konzern vor. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, am Entwicklungsprogramm für Global Manager teilzunehmen, bei dem wir mit dem Babson College zusammenarbeiten, einer renommierten Management- schule im US-amerikanischen Boston, Massachusetts.

Mitarbeiter nach Funktionen am 30.09.2002

Gesamt: 30.423 Beschäftigte



In der Infineon University
begegnen sich Mitarbeiter

Als unternehmensweite Dialog- und Lernplattform haben wir im Geschäftsjahr 2002 die Infineon University gegründet. Sie wird sich über geographische und funktionale Grenzen hinweg strategischer Themen und Know-how-Felder annehmen. Ohne festen Lehrkörper werden wir je nach Bedarf eigene und externe Experten einladen; ein Pilotprogramm widmet sich beispielsweise dem Kernthema Produktentwicklung. Künftig befasst sich die Unternehmensuniversität mit einer ganzen Bandbreite von Themen – von Technologieentwicklung und Produktion über Finanzierung und Controlling bis hin zu Vertrieb und Marketing. Angeboten werden sowohl Seminare, auf denen Expertenwissen vermittelt wird, als auch Communities, bei denen Experten und Nachwuchskräfte untereinander ihr Fachwissen austauschen. Zu Schlüsselthemen werden zudem Großveranstaltungen abgehalten. In jedem Fall können die Teilnehmer neue und tiefere Kontakte knüpfen und so die konzernweiten Netzwerke auf globaler Ebene verstärken. Die erste Großveranstaltung der Infineon University war eine Topmanagement-Konferenz Mitte September 2002, auf der sich 350 weltweit aktive Infineon Manager intensiv mit den Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten der neuen Unternehmensprogramme Agenda 5-to-1 und Impact² befasst haben.

Mit Nachwuchs-
programmen werden
Hochbegabte früh an
Infineon gebunden

Um talentierte Studenten, Diplomanden und Doktoranden sowie sehr gute Absolventen frühzeitig kennen zu lernen, bieten wir zielgruppenspezifische Nachwuchsprogramme an. Beispielsweise können sich diese jungen Menschen bei uns bewerben, um nebenberuflich erste Arbeitserfahrungen zu sammeln und dabei möglicherweise den Grundstein für eine Karriere bei Infineon zu legen. Besonders begabte Hochschüler fördern wir mit einem „Student MemberChip“-Programm. Neu ist außerdem eine Variante, die angehende Doktoranden unter anderem mit einer internetbasierten Kommunikationsplattform sowie Weiterbildungsveranstaltungen anspricht. Zudem haben wir das „International Graduate Program“ etabliert, das sich an Akademiker mit dem Potenzial zu einer internationalen Karriere richtet.

Spitzentechnologie hilft Mensch und Umwelt

- Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft wahrnehmen
- Umweltverträglichkeit von Fertigung und Produkten weiter gesteigert
- Mitarbeiter ausgezeichnet für Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir stehen zu unserer Verantwortung für die Umwelt, für unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft. Unser Engagement bezieht sich nicht nur auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern wird als ständiger Verbesserungsprozess verstanden, der in unseren regulären Betriebsablauf integriert ist: Kontinuierlich werden unsere Mitarbeiter in Umweltfragen weitergebildet; fortlaufend verbessern wir Produktionsanlagen und -methoden; und wir nehmen neue Produkte schon in der Entwicklungsphase dahingehend unter die Lupe, wie sie möglichst umweltverträglich produziert werden können. Unser starkes Engagement für die Umwelt und damit auch für die Gesellschaft wird auch von unabhängigen Dritten bestätigt: Das Umweltmanagement-System von Infineon ist an den meisten Standorten nach dem internationalen Standard ISO 14001 zertifiziert, weitere Standorte bereiten sich auf eine baldige Zertifizierung vor.

Die runden Siliziumwafer, auf denen die Chips entstehen, stellen an sich keine Gefahr für die Umwelt oder den Menschen dar. Jedoch sind bis zu 600 chemische und physikalische Prozess-Schritte notwendig, damit die Chipstrukturen auf diesen Scheiben entstehen. Für die Chip-Herstellung und die Weiterverarbeitung zu fertigen Halbleiter-Bauelementen werden etwa 400 zumeist flüssige oder gasförmige Chemikalien eingesetzt. Als Halbleiter-Hersteller können wir also nicht auf Chemikalien verzichten. Deshalb gehen wir verantwortungsbewusst mit diesen Substanzen um. Voraussetzung dafür ist, dass wir die Eigenschaften dieser Stoffe genau kennen. Nur so ist es möglich, Risiken einzuschätzen und vor allem zu vermeiden. Um dieses Wissen zu systematisieren, bauen unsere für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit zuständigen Abteilungen eine weltweit verfügbare Chemikaliendatenbank auf. Darin sind sämtliche Chemikalien aufgelistet, die bei Infineon zum Einsatz kommen. In der Datenbank werden diese auch hinsichtlich ihrer Gefahreigenschaften beschrieben.

Produktionstechnisch lässt es sich nicht immer vermeiden, dass die Abluft aus der in Reinräumen ablaufenden Halbleiter-Produktion verunreinigt ist. Jedoch werden Verunreinigungen, die Umwelt und Menschen schaden könnten, aus der Abluft gefiltert. Das gilt auch bei Gasen, die den Treibhauseffekt und damit die Erderwärmung beschleunigen. Dazu zählen u. a. die so genannten perfluorierten Verbindungen (PFC), die in der Halbleiter-Fertigung als Ätzgase eingesetzt werden. Die europäische Halbleiter-Industrie hat sich freiwillig verpflichtet, bis zum Jahr 2010 – gemessen am Jahr 1995 – 10% weniger PFCs zu emittieren, berechnet in CO₂-Äquivalenten. Geht man von einem Volumenwachstum der Halbleiter-Industrie von jährlich 15% aus, so muss die Emission effektiv um etwa 90% verringert werden.

Damit die Gesundheit unserer Mitarbeiter nicht durch Gefahrstoffe beeinträchtigt wird, führen wir die meisten Fertigungsprozesse in geschlossenen Systemen durch. Mitarbeiter, die dennoch in Kontakt mit solchen Stoffen kommen könnten, werden dauerhaft arbeitsmedizinisch betreut und im Rahmen eines Biomonitorings untersucht. Der Vorteil der regelmäßig stattfindenden Untersuchungen ist, dass die Auswertung biologischer Proben von Urin und Blut bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem der Exponierte gesund ist, Daten über

Verantwortungsvoller

Umgang mit Chemikalien

Aktiver Klimaschutz

durch Reduktion von

Schadstoffemissionen

Risiken für Menschen

erkennen, bevor sie die

Gesundheit beeinträchtigen

potenzielle Gesundheitsrisiken liefert. Dadurch können wir frühzeitig geeignete Gegenmaßnahmen zum Schutze der Gesundheit unserer Mitarbeiter ergreifen.

300-Millimeter- Technologie spart Ressourcen

Unser Ziel ist es, möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Etwa, indem der Einsatz vieler Rohstoffe verringert oder sogar eingespart wird – wovon Umwelt und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Ein aktuelles Musterbeispiel ist die 300-Millimeter-Technologie: Im Vergleich zu 200-Millimeter-Wafern werden mehr als doppelt so viele Chips auf einer Siliziumscheibe produziert. Das erhöht die Produktivität, senkt die Kosten – und schont die Umwelt. Dabei können wir den Verbrauch an Gasen um über 10 % senken, bei Chemikalien werden sogar mehr als 20 % eingespart.

Auch bei den Bestandteilen der Halbleiter-Bauelemente setzen wir auf ökologisch vorbildliche Lösungen: So ist es unseren Entwicklern gelungen, Hochfrequenz-Bauteile, etwa für Handys, auf Siliziumbasis herzustellen. Bislang konnten solche Halbleiter nur mit Galliumarsenid und Indiumphosphid hergestellt werden, die potenziell umweltgefährdend und daher entsprechend zu entsorgen sind. Damit elektrische und elektronische Altgeräte einfacher entsorgt werden können, arbeiten wir daran, dass im Jahr 2004 die Mehrzahl unserer Halbleiter-Lösungen blei- und halogenfrei ausgeliefert wird. Zudem sorgen wir mit unseren Halbleiter-Lösungen dafür, dass viele Endprodukte umweltfreundlicher werden. Beispielsweise verringern Mikrocontroller von Infineon den Benzinverbrauch von Fahrzeugen deutlich; unsere modernsten Speicherchips sorgen dafür, dass Computer weniger Strom benötigen; und für unsere neuen Leistungshalbleiter, mit denen verschiedene Elektrogeräte rund 30 % weniger Strom verbrauchen, erhielt Infineon im Berichtsjahr sogar den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft.

Jährlicher Award für Mitarbeiter

Als Anreiz für die Mitarbeiter hat Infineon im Jahr 2002 erstmals den ESH-Award ausgeschrieben. Mit diesem Preis werden wir künftig jedes Jahr nachhaltige Einzel- oder Teamleistungen auszeichnen. Die relativ große Zahl der Bewerbungen und die hohe Qualität der Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie unsere Mitarbeiter durch großes Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes beitragen.

Die ersten drei Gewinner wurden aus 31 Bewerbungen von acht Standorten ausgewählt und im November 2002 prämiert:

- Ein Team hat in einer Rekordzeit von acht Monaten den Verbrauch von Frischwasser an seinem Montagestandort um ein Drittel gesenkt und gleichzeitig die gesamte Abwassermenge um 72 % verringert.
- An einem anderen Montagestandort ist es einem Team gelungen, den Gesamtwasserverbrauch in den letzten drei Geschäftsjahren um vier Fünftel zu reduzieren.
- In einem erfolgreichen weltweiten Projekt konnten die für einen Ätzprozess benötigten Chemikalien stark reduziert und gleichzeitig Investitionen für Produktionsanlagen in Millionenhöhe eingespart werden.

Zusätzliche Informationen zum Thema Umweltschutz enthält der erste Umweltbericht der Infineon Technologies AG, der Anfang 2003 publiziert wird und auf Anfrage erhältlich ist.



**Die Welt für uns und unsere Kinder
sicherer und bequemer machen.
Wir haben die richtigen Lösungen dafür.**




So viel steht fest: Das Thema Sicherheit spielt in unserer heutigen Zeit eine wichtige Rolle. Immer und überall. Infineon Technologies stellt sich dieser Herausforderung und hat dafür eine wirklich innovative Lösung entwickelt: den Fingerabdruck-Sensor (FingerTIP™). Er lässt sich in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens einsetzen – in Zukunft beispielsweise bei der TV-Fernbedienung, mit der Kinder wirklich nur das sehen können, was sie dürfen. Oder schon heute bei Notebooks, PCs und Handys, denn mit Hilfe des FingerTIP™ lassen sich die Geräte ausschließlich von der zugriffsberechtigten Person aktivieren – ein Passwort ist bei dieser Lösung nicht mehr nötig. Wer schon mal sein Passwort vergessen hat, weiß, wie viel Zeit und Kosten das zum Beispiel in der Arbeitswelt ersparen kann. Mit Hilfe des FingerTIP™ wird das Leben aber nicht nur sicherer, sondern zusätzlich komfortabler. So gibt es bereits Autos, die ihre jeweiligen Fahrer über den FingerTIP™ erkennen und z. B. Sitz, Spiegel und Radiosender entsprechend für ihn einstellen. So kommen alle mit unseren Innovationen sicherer und bequemer durchs Leben.



VERSTEHEN, was WAR und was WIRD.



I III I CHRONIK



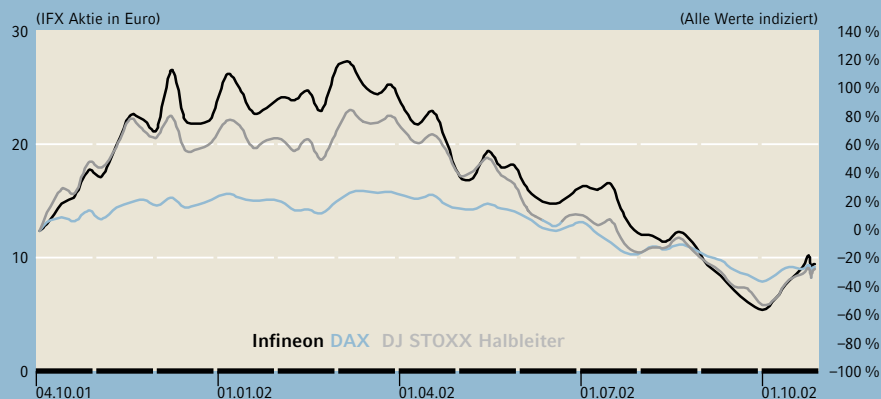
BÖRSEN: Die Kapitalmärkte spüren weltweit das Konjunkturtief.
IFX AKTIE: Der Infineon Kurs folgt dem Trend der Technologiewerte.
AKTIONÄRE: Streubesitz und Handelsvolumen erreichen neue Höhen.
CHRONIK 2002: Von Know-how über Leistung zu Auszeichnungen.
50 JAHRE: Halbleiter bestimmen schon lange den Technology Lifestyle.

Der IFX Aktienkurs: Spiegel eines schwachen Marktes

- DJ STOXX Halbleiter-Index verliert im Berichtsjahr 46 % – Infineon rund 56 %
- Handelsvolumen mehr als verdoppelt: täglich über 6,9 Mio. Aktien
- Streubesitz der Infineon Aktien steigt auf bis zu 88 %
- IR-Arbeit von Infineon unter Top 3 der europäischen Technologiewerte

An der Börse zeigt sich die Schwäche des Halbleitermarktes besonders deutlich: Chip-Aktien haben im vergangenen Jahr erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Sowohl im Verhältnis zum gesamten Aktienmarkt als auch zum Technologiesektor haben sich diese schlechter entwickelt. Während beispielsweise der europäische Technologieindex Dow Jones (DJ) STOXX Technology mit 42 % und der europäische Blue-Chip-Index DJ STOXX 50 mit 29 % im Minus lagen, büßte der Index DJ STOXX Semiconductor im Jahresverlauf mit 46 % fast die Hälfte seines Wertes ein.

Relative Entwicklung von IFX Aktie, DAX und DJ STOXX Halbleiter-Index seit Beginn des Geschäftsjahres 2002



Eine Entwicklung, der sich die Infineon Aktie mit einem Minus von 56 % nicht entziehen konnte. Dabei ergaben sich im Jahresverlauf durchaus unterschiedliche Szenarien. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2002 – vom 1. Oktober bis zum 6. Dezember 2001 – hat sich der Wert der Infineon Aktie mehr als verdoppelt, und damit hat sie weit besser als die vergleichbaren Indizes abgeschnitten. Die Gründe dafür waren zum einen die allgemeine Erholung der Märkte, zum anderen, dass unsere Geschäftsjahreszahlen 2001 trotz schlechter Ergebnisse besser als vom Kapitalmarkt erwartet ausfielen und schließlich, dass sich in den Bereichen Speicherprodukte und Mobile Kommunikation eine leichte Erholung abzeichnete.

Bis Anfang März 2002 entwickelte sich die Infineon Aktie besser als der DAX; am 4. März erreichte sie ihren Jahres-Höchstkurs von 29,30 Euro. Ursachen für diese Entwicklung waren sowohl der deutliche, wenn auch vorübergehende Anstieg der Preise für Speicherchips als auch eine Erholung unserer Geschäftsbereiche Automobil- und Industrieelektronik, Mobile Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs.

Speicherchip-Aktien
verlieren überdurch-
schnittlich an Wert

Etwa mit Beginn des zweiten Geschäftshalbjahres – also ab April 2002 – verschlechterten sich die makroökonomischen Rahmendaten in Europa und den USA weiter, ebenso erholte sich der Technologiesektor nicht wie allgemein erhofft. Vom folgenden Abwärtstrend an den Aktienmärkten waren die Halbleiter-Werte besonders stark betroffen, wobei die Infineon Aktie gegenüber anderen Chip-Aktien überdurchschnittlich an Wert verlor. Der Hauptgrund war erhöhter Verkaufsdruck bei den Aktien aufgrund der wieder stark gefallenen Preise für Speicherchips. Am Geschäftsjahresende, dem 30. September 2002, rutschte die Infineon Aktie tagsüber auf ein Allzeittief von 5,36 Euro.

Kursdaten der Infineon Aktie

Geschäftsjahr (zum 30.09.)	2001	2002
Europa (Xetra – in Euro)		
Höchstkurs	58,25	29,30
Tiefstkurs	11,52	5,36
Jahresschlusskurs (Ende September)	13,50	5,61
Durchschnittlich gehandelte Aktien (pro Tag) (davon in Xetra)	3.121.172 (91%)	6.562.893 (95%)
USA (NYSE – in US-Dollar)		
Höchstkurs	50,06	25,89
Tiefstkurs	10,80	5,42
Jahresschlusskurs (Ende September)	12,39	5,70
Durchschnittlich gehandelte ADS (pro Tag)	229.424	378.856

Langfristig hat sich die Infineon Aktie bislang enttäuschend entwickelt. Seit dem Börsengang am 13. März 2000 verlor sie gegenüber ihrem Ausgabepreis 84 %, wobei sie immer noch besser als die vergleichbaren Indizes abschneidet. Hinzu kommt, dass der Börsengang von Infineon zeitlich mit dem Allzeithoch der Weltbörsen zusammenfiel – seither befanden sich die Kurse in einem allgemeinen Abwärtstrend.

Entwicklung IFX Aktie und Indizes

Zeitraum (bis zum 30.09.2002)	seit IPO am 13.03.2000	seit Oktober 2000	seit Oktober 2001
Europa			
Infineon (Xetra)	-84 %*	-90 %	-56 %
DJ STOXX Semiconductor	-88 %	-83 %	-46 %
DJ STOXX Technology	-87 %	-83 %	-42 %
DJ STOXX 50	-54 %	-52 %	-29 %
DAX	-64 %	-60 %	-35 %
USA			
Infineon (NYSE)	-83 %*	-88 %	-51 %
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	-82 %	-71 %	-34 %

* Basiert auf dem Ausgabepreis von 35 Euro bzw. 33,92 US-Dollar.

Was die Börsenkaptalisierung angeht, lag Infineon zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September 2002 bei 4,0 Mrd. Euro, nach 20,3 Mrd. Euro zum Jahreshoch am 4. März. Gegenüber dem Stichtag im Vorjahr entspricht der Jahresendwert einem Rückgang von 57 %. Darin drücken sich vor allem die Kursverluste von 56 % aus. Daneben sind die ausstehenden Aktien um 4 % angestiegen, wobei sich die Aktienzahl fast ausschließlich durch den Erwerb der Mikroelektroniksparte von Ericsson erhöht hat.

Deutlicher Rückgang der Börsenkaptalisierung

Grundkapital, Anzahl Aktien und Marktkaptalisierung Infineon Technologies AG

Stichtag	30.09.2001	30.09.2002	Entwicklung
Grundkapital	EUR 1.385 Mio.	EUR 1.442 Mio.	+4,1 %
Ausstehende Aktien (im Jahresdurchschnitt)	693 Mio. (641 Mio.)	721 Mio. (695 Mio.)	+4,0 % (+8,4 %)
Marktkaptalisierung (Zeitwert in US-Dollar)	EUR 9,4 Mrd. (USD 8,6 Mrd.)	EUR 4,0 Mrd. (USD 4,1 Mrd.)	-57,5 % (-52,3 %)

Die Infineon Aktie notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB, WKN 623100), zudem wird sie unter dem Kürzel „IFX“ in Form von American Depositary Shares (ADS) an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. Optionen auf IFX Aktien werden an der europäischen Terminbörse EUREX und der amerikanischen Terminbörse CBOE (Chicago Board Options Exchange) geführt. Mit insgesamt über 6,5 Millionen Stück hat sich der Durchschnitt der täglich in Deutschland gehandelten IFX Aktien in Xetra, auf dem Frankfurter Parkett und den anderen Regionalbörsen im Geschäftsjahr 2002 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Mit 379.000 im Tagesdurchschnitt gehandelten ADS-Anteilen betrug der Anstieg an der NYSE etwa 65%. (Siehe auch oben aufgeführte Tabelle „Kursdaten der Infineon Aktie“.)

Infineon gehört zu zahlreichen regionalen und globalen Indizes und ist damit Teil einer Vielzahl von Fondsprodukten der Bankenwelt. Basis hierbei sind neben dem DAX 30 und dem Dow Jones German Titans 30 auch der Dow Jones STOXX Semiconductor Index, der FTSE Euro 100, der MSCI Germany und der S&P Europe 350.

Die Deutsche Börse AG hat am 31. Oktober 2002 beschlossen, eine neue Indexsystematik für den deutschen Aktienmarkt einzuführen. Das neue Modell setzt auf der zuvor vom Börsenrat beschlossenen Neusegmentierung des deutschen Aktienmarkts auf, die mit den zwei Segmenten Prime Standard und General Standard unterschiedlich hohe Anforderungen an die Berichterstattung vorsieht. Nach dem Zeitplan der Börse vom November 2002 soll die neue Indexwelt zum 24. März 2003 umgesetzt werden. Die neue Indexsystematik bedeutet gemäß den uns im Dezember 2002 vorliegenden Informationen für Infineon keine Veränderungen. Wir werden auch die höheren Transparenzanforderungen erfüllen und die Zulassung zum Prime Standard-Segment beantragen. Die IFX Aktie ist demnach weiterhin im DAX30 und den entsprechenden DAX-Branchenindizes vertreten. Umfassende Informationen über den aktuellen Stand der neuen Aktienmarkt-Segmentierung sind im Internet unter www.deutsche-boerse.com/listingcenter zu finden. Dort gibt es beispielsweise eine Liste mit der Zuordnung der Branchen zu den Classic- und Technology-Indexgruppen sowie ein Szenario der zukünftigen Auswahlindizes.

Für IFX Aktie keine Änderungen durch neue Indexsystematik in Deutschland

Streubesitz deutlich

erhöht auf 88,03 %

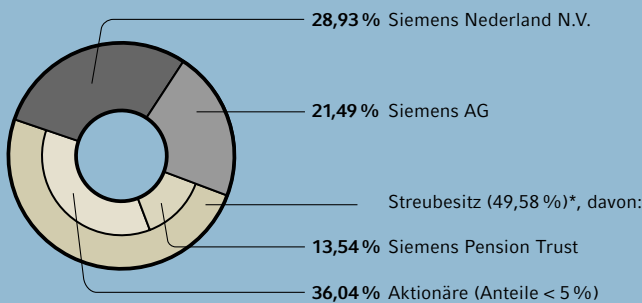
bzw. 60,29 %

Signifikant erhöht hat sich der Anteil der im Streubesitz befindlichen Infineon Aktien: Er stieg nach der Definition des britischen Indexanbieters FTSE von 49,58 % auf 88,03 %. Gründe dafür sind zum einen die um 28 Mio. Stück gewachsene Anzahl ausstehender Aktien; zum anderen hat der Großaktionär Siemens einige Millionen Anteile am Kapitalmarkt veräußert und 200 Millionen Aktien an die Treuhandgesellschaft First Union Trust übertragen. Dieser Anteil des First Union Trust wird von anderen Indexanbietern wie z.B. der Deutschen Börse und STOXX nicht zum Streubesitz gezählt; in den entsprechenden Indizes wird Infineon mit einem um 10,71 Prozentpunkte erhöhten Streubesitz von 60,29 % geführt.

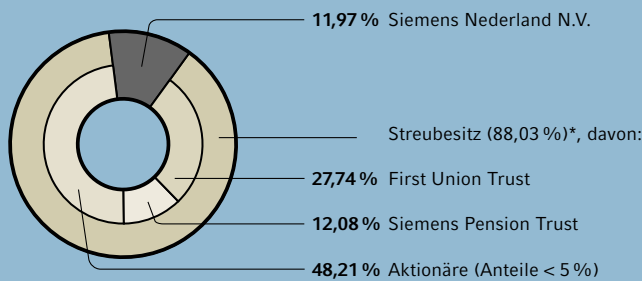
Da wir im Geschäftsjahr 2002 ein negatives Ergebnis von -1,47 Euro je Aktie (Vorjahr: -92 Eurocent) und somit keinen Gewinn erwirtschaftet haben, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen. Wie im Vorjahr angekündigt, wollen wir zukünftige Erträge dazu verwenden, den Konzern weiterzuentwickeln und strategisch zu erweitern, um so zur nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens beizutragen.

Aktionärsstruktur Infineon Technologies AG

Stichtag 30.09.2001



Stichtag 30.09.2002



* Streubesitz gemäß Definition von FTSE; z.B. die Deutsche Börse und STOXX berechnen den Infineon Streubesitz ohne die Anteile des First Union Trust.

Dialog mit Investoren und Multiplikatoren

Ein intensiver Dialog mit privaten wie institutionellen Investoren, mit Finanzanalysten und Journalisten ist uns gerade in der anhaltend schwierigen Lage der Chip-Industrie und angesichts unsicherer Börsen besonders wichtig. Die weiter intensivierte Investor Relations (IR)-Arbeit von Infineon konzentriert sich in dieser Phase darauf, unsere sichere finanzielle Situation sowie unsere nachhaltige Technologie- und Kostenführerschaft ausführlich darzustellen. Denn beides verschafft uns eine komfortable Ausgangssituation für den nächsten Aufschwung im Halbleiter-Markt. Neben den täglichen Gesprächen der IR-Manager mit Privatanlegern und Fondsmanagern sowie den Informationsmittlern des Kapitalmarktes trifft sich der Vorstand immer wieder persönlich mit vielen Analysten und Investoren aus Europa, den USA und Asien. Das Infineon Management präsentiert den Konzern darüber hinaus auf zahlreichen Technologiekonferenzen. Über Strategie, Produkte und Dienstleistungen der einzelnen Geschäftsbereiche informieren wir Interessierte auf zahlreichen Messen persönlich und umfassend.

Unser Online-Informationsangebot für die Finanzwelt haben wir im vergangenen Geschäftsjahr stark erweitert und übersichtlicher strukturiert. Über die Investor Information-Startseite im Internet (www.infineon.com/boerse) sind noch mehr aktuelle Meldungen, Links zu interessanten Presseinformationen und alle Ad-hoc-Meldungen von Infineon zu finden; ferner berichten wir hier über so genannte Directors' Dealings, also über meldepflichtige Börsengeschäfte von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats bzw. deren Angehöriger. Des Weiteren beschreiben wir auf unseren Internetseiten ausführlich, wie sich das Grundkapital und die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens entwickeln und in welchen Indizes die IFX Aktie vertreten ist; und aus einer Excel-Datei lassen sich immer aktuell sämtliche veröffentlichten Quartalsdaten entnehmen. Es ist außerdem möglich, die „Infineon Online News“ und den „Infineon Investor Newsletter“ zu abonnieren; beides Informationsbriefe über die aktuellen Entwicklungen, die in der Regel einmal pro Quartal per E-Mail bzw. per Post versandt werden.

Im neuen Geschäftsjahr ist geplant, den gesamten Internetauftritt von Infineon optisch neu zu gestalten. Ferner sind unverzüglich nach der Verabschiedung durch den Vorstand und Aufsichtsrat ausführliche Informationen über die Corporate Governance im Web abrufbar. Mit einer E-Mail an Investor.Relations@infineon.com oder per Telefon unter 089 234-26655 können überdies jederzeit Anfragen gestellt und Vorschläge zur weiteren Ausweitung der IR-Arbeit von Infineon gemacht werden.

3.701 Aktionäre besuchten am 22. Januar 2002 die zweite Publikums-Hauptversammlung der Infineon Technologies AG in der Münchner Olympiahalle. Das waren 810 Aktionäre bzw. 28% mehr als im Jahr zuvor. Jedoch waren damit nur 41,67% des stimmberechtigten Kapitals vertreten; im Vorjahr waren es 74,74%. Hauptgrund für diesen Rückgang ist, dass sich der First Union Trust verpflichtet hat, die Stimmrechte für seine 200 Millionen Infineon Aktien ruhen zu lassen, die im Vorjahr noch ins Gewicht fielen. Die nächste Hauptversammlung wird am 21. Januar 2003 wiederum in der Olympiahalle stattfinden. Erstmals können in diesem Jahr Aktionäre, die ihre Vollmacht und Weisung per Internet erteilen, diese bis in die Hauptversammlung hinein ändern. Wie in den vergangenen Jahren wird die Rede des Vorstandsvorsitzenden erneut im Internet unter www.infineon.com übertragen und ist dort auch später noch abrufbar.

Dass unsere Investor Relations-Arbeit bei den Zielgruppen Anklang findet, bestätigen zwei Untersuchungen: In der von dem Medienunternehmen Reuters herausgegebenen Rangliste „European Equities Investment Survey 2002“, für die zahlreiche Fondsmanager und Analysten befragt werden, belegte unser IR-Team hinter Nokia den zweiten Platz der europäischen Technologiewerte. Auch das verbesserte Informationsangebot im Internet fand öffentliche Anerkennung: Anfang November 2002 hat die Financial Times (FT) ein internationales Ranking von Online-IR-Auftritten der FT Top 500-Unternehmen veröffentlicht. Hierbei lag Infineon hinter Ericsson und Nokia unter den Top 3 der Technologiefirmen. Im Gesamt-Ranking erreichten wir Rang 33, im Vergleich deutscher Firmen Rang 7. Die Details dieser Studie sind auf der Website www.webranking.nu (Ranking Lists) verfügbar.

Ad-hoc-Informationen und
Directors' Dealings im
Internet verfügbar

3.701 Aktionäre
besuchten die
Hauptversammlung 2002

Infineon Investor
Relations-Arbeit
international anerkannt

Chronik des Geschäftsjahres 2002

-
- OKTOBER 2001**
- 18.10.** | Produktionsstart in 0,14 Mikrometern: Gegenüber den bisher üblichen 0,17-Mikrometer-Leiterbahnen schrumpfen die Chipstrukturen um 18 %. Infineon baut damit in Dresden den kleinsten 256-Megabit-Speicherchip der Branche. Die Kosten sinken um 30 %.
 - 29.10.** | Als „Beste technologische Innovation“ der Chipkarten-Branche erhält der 32-Bit-Chipkarten-Controller von Infineon den so genannten Sesames Award. Der Chip, ausgezeichnet auf der Messe „Cartes 2001“ in Paris, kann die Daten vieler Karten – u. a. Personalausweis, Bank- und Kreditkarte – auf einer einzigen vereinen und ist in Rechenleistung und Sicherheitsfunktionen unübertroffen.
 - 30.10.** | Das US-Verteidigungsministerium beauftragt Infineon, die neuen Ausweise der Behörde zu liefern. Die so genannte „Common Access Card“, die den Zugang zu Gebäuden und Computernetzwerken regelt, ist die weltweit einzige, die den strengen Sicherheitsanforderungen des Ministeriums genügt.
-
- NOVEMBER 2001**
- 13.11.** | Infineon kooperiert mit Sony, um die kontaktlose Chipkarte zu entwickeln, bei der die Daten per Funk übertragen werden. Das Projekt umfasst Systemlösungen einschließlich der dazugehörigen Lesegeräte und Infrastruktur. Anwendungen sind beispielsweise Tickets, Ausweise für Firmen oder Bankenkarten.
-
- DEZEMBER 2001**
- 5.12.** | Infineon steht endgültig auf eigenen Füßen: Wie angekündigt, gibt Siemens seine Stimmrechtsmehrheit an der einstigen Tochter ab. Einige Millionen Aktien werden über die Börse verkauft, weitere 200 Millionen Aktien gehen an den Treuhandfonds First Union Trust, der die Stimmrechte ruhen lassen wird.
 - 12.12.** | Als weltweit erstes Unternehmen startet Infineon in Dresden die Volumenproduktion auf 300-Millimeter-Wafern. Wafer sind die runden Siliziumgrundplatten, auf denen die Chips entstehen. Im Unterschied zur bisher üblichen 200-Millimeter-Technologie passen zweieinhalb Mal so viele Chips auf einen Wafer, wobei die Kosten um bis zu 30 % sinken.
-
- JANUAR 2002**
- 16.1.** | Stellenabbau: Infineon und der Gesamtbetriebsrat einigen sich auf Interessenausgleich und Sozialplan. Im Rahmen des Kostensenkungsprogramms Impact waren weltweit insgesamt 5.000 Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausgeschieden.
 - 16.1.** | Infineon erhält den Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft. Preisgekrönt werden damit zwei Halbleiter-Familien, die Ströme punktgenau steuern und damit den Stromverbrauch von Maschinen, Autos und Haushaltsgeräten um bis zu 30 % senken.

- 22.1.** | Rund 4.300 Besucher, davon rund 3.700 Aktionäre, finden sich zur Hauptversammlung in München ein. Die Aktionäre beschließen die Schaffung eines genehmigten Kapitals von 350 Mio. Euro. Zudem ermächtigen sie das Unternehmen, bis Januar 2007 Options- und Wandelschuldverschreibungen von bis zu 4 Mrd. Euro auszugeben. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wird Dr. Peter Mihatsch (61) als neuer Aufsichtsratsvorsitzender und damit als Nachfolger von Dr. Volker Jung gewählt.

FEBRUAR 2002

- 6.2.** | Infineon stellt Hochfrequenz-Bauteile, beispielsweise für Handys, aus kostengünstigem Silizium her. Mit neuen Frequenz-Weltrekorden schafft das Unternehmen damit eine Alternative zu den bisher genutzten Galliumarsenid- oder Indiumphosphid-Halbleitern, beide teurer und potenziell umweltgefährdend. Erste Produkte werden im Jahr 2003 erwartet.
- 18.2.** | Infineon stellt den weltweit ersten Analyse-Chip vor, der Biomoleküle vollelektronisch auswerten kann. In der Laborarbeit ersetzt der Bio-Chip 128 Reagenzgläser und kommt billiger, schneller und einfacher zum Ergebnis.
- 19.2.** | Mit dem Ziel, das mobile Internet zum Erfolg zu führen, präsentiert Infineon das Konzept „Wireless Solution Value Net“. Dabei werden die Mobilfunk-Kompetenzen von Infineon und ausgewählten Partnerunternehmen gebündelt, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und neue Business-Modelle umzusetzen.
- 20.2.** | Infineon stellt eine Reihe von Chips für die mobile Kommunikation vor. Etwa den Chip-Satz S-GOLD für den neuen UMTS-Standard, mit dem auch Hi-Fi-Sound und Videobilder per Handy übermittelt werden können. S-GOLD überträgt größere Datenmengen, ohne die Akkulaufzeiten spürbar zu beeinträchtigen. Präsentiert wird zudem ein Sicherheits-Chip, der Daten beispielsweise für mobiles Banking verschlüsselt. Außerdem stellt Infineon ein System vor, mit dem PDAs auch als Mobiltelefone des verbreiteten GSM/GPRS-Standards genutzt werden können.

MÄRZ 2002

- 6.3.** | Chips machen normale Kupfertelefonleitungen zum Daten-Highway: Infineon präsentiert drei Spezialhalbleiter, die ohne zusätzliche Verkabelung den schnellen Internetzugang möglich machen. Das Fachmagazin Elektronik wählt das System zum „Produkt des Jahres 2001“.
- 11.3.** | Auf ein Memorandum of Understanding verständigt sich Infineon mit der Winbond Electronics Corp.: Infineon will künftige Generationen seiner Speichertechnologie an den taiwanesischen Halbleiter-Hersteller lizenzieren. Im Gegenzug erhält Infineon das exklusive Abnahmerecht für die DRAM-Chips, die damit von Winbond hergestellt werden.

- 18.3. | Neue Lösung für die mobile Telekommunikation und Navigation im Auto: Infineon präsentiert ein Infotainment-System, das Internetzugang, Telekommunikation und Navigation ebenso wie den automatischen Notruf integriert und auch in neuen Kleinwagen-Serien ab Werk kostengünstig eingebaut werden kann.
- 25.3. | Glasfaser auf der Überholspur: Ein neuer Baustein von Infineon verdoppelt die Übertragungskapazitäten von Glasfaser-Strecken. Daneben hat das Unternehmen den Single-Fiber-Transceiver entwickelt, der die Zwei-Wege-Kommunikation auf nur einer Glasfaser erlaubt – bislang wird für jede Richtung je eine Faser gebraucht. Und ein spezielles Modul sorgt speziell in Großstadt-Glasfasernetzen dafür, dass große Datenmengen von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über maximal 10 Kilometer übertragen werden.
- 25.3. | Infineon baut den komplexesten Speicherchip der Industrie: Muster von Ein- und Zwei-Gigabyte-Speichermodulen werden vorgestellt, mit denen Systemhersteller die Speicherkapazität im Vergleich mit den üblichen 256-Megabit-Komponenten verdoppeln können, mit Vorteilen bei Speicherdichte, Ladezeiten, Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit.

APRIL 2002

- 4.4. | Infineon liefert Mikrocontroller-Chips für die neue Gesundheitskarte, die ab Juli 2002 landesweit in Taiwan ausgegeben wird. Bei diesem größten Projekt im Gesundheitswesen in Asien erhalten bis Ende 2003 22 Millionen Taiwaner ihre persönliche Gesundheitskarte.
- 11.4. | Mit der Berliner S-Bahn zum Zug und mit der Dresdner Tram nach Hause: Infineon arbeitet an einem technischen Standard, der das mit einem einzigen Fahrschein möglich macht. Das bundesweit einheitliche E-Ticket, das kontaktlos und elektromagnetisch mit einem speziellen Lesegerät kommuniziert, soll die Brücke zwischen den Tarifsystemen schlagen. Mitte 2003 wollen Infineon und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) eine Lösung vorstellen.
- 25.4. | Infineon ist das vierte Jahr in Folge Weltmarktführer bei Chips für Kartenanwendungen. 51 % aller im Jahr 2001 ausgelieferten Chipkarten enthalten nach einer Studie des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Gartner Dataquest einen Chip von Infineon, das sind 4 % mehr als im Jahr zuvor.
- 25.4. | Neue Liefervereinbarung mit MasterCard: Weltweit alle Partner- und Mitgliedsbanken von MasterCard können zu gleichen Konditionen Sicherheits-Chips für Kredit- und Bankenkarten von Infineon beziehen.
- 26.4. | Infineon präsentiert Basis-Technologien für intelligente Kleidung: Um Chips und elektronische Geräte in Kleidung zu integrieren, hat Infineon robuste und zuverlässige Lösungen gefunden. Prototypen funktionsfähiger und alltagstauglicher Mikroelektronik-Schaltungen in „smarten“ Textilien werden vorgestellt.

MAI 2002

- 2.5.** | Infineon will mit dem Speicherchip-Hersteller Nanya (Taiwan) kooperieren: Am Standort Dresden werden die beiden Partner zusammen daran forschen, die DRAM-Chipstrukturen von heute 130 auf 90 und 70 Nanometer zu reduzieren. Zudem planen die Unternehmen ein 50:50-Joint Venture für eine neue 300-Millimeter-Fabrik in Taiwan, wobei Infineon seine 300-Millimeter-Technologie an das Gemeinschaftsunternehmen lizenziert. Der verbindliche Vertrag hierzu wird am 13. November unterschrieben.
- 16.5.** | AMD, DuPont Photomasks und Infineon vereinbaren, in Dresden ein gemeinsames Zentrum zu errichten, um die lithografischen Masken der nächsten Generation zu entwickeln und zu produzieren. Masken übernehmen eine Schlüsselfunktion in der Chip-Herstellung. Mit dem Joint Venture wollen die Partner Kosten reduzieren und Entwicklungszyklen verkürzen.
- 28.5.** | Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der industriellen Produktion von Halbleitern in Deutschland wurde das Infineon Future Forum ins Leben gerufen, das an diesem Tag zum ersten Mal in der Flugwerft Schleißheim bei München stattfindet. Menschen aus unterschiedlichen Handlungsräumen treffen sich zu einem Austausch und zur Weiterentwicklung von Erfahrungen, Ansichten und Standpunkten.
- 31.5.** | Infineon Forscher reduzieren den Durchmesser von Chip-Leiterbahnen auf bis zu 40 Nanometer, ohne die elektrische Zuverlässigkeit einzuschränken. Damit ist bewiesen, dass diese Strukturbreiten nicht am Widerstand der Drähte scheitern müssen. Die 40-Nanometer-Technologie wird in der Massenproduktion voraussichtlich ab dem Jahr 2010 eingesetzt.

JUNI 2002

- 4.6.** | Infineon baut seine Spitzenstellung auf dem japanischen Breitband-Markt aus: An das Unternehmen Sumitomo Electric liefert Infineon Chip-Sätze für Zugangssysteme zu VDSL-Breitband-Netzwerken.
- 6.6.** | Möglicher Nachfolger für Silizium in der Chip-Herstellung: Infineon Forschern ist es gelungen, carbon nanotubes, winzige Röhren aus Kohlenstoff, auf Siliziumwafern wachsen zu lassen, die in der Mikroelektronik üblich sind. Damit lassen sich die interessanten Eigenschaften der Nanoröhren in bestehende Fertigungsprozesse einbinden und bessere integrierte Schaltkreise entwickeln.
- 10.6.** | Auftrag aus Hongkong: Zum neuen Personalausweis für die 6,8 Millionen Einwohner der Stadt wird ein Mikrocontroller-Chip von Infineon gehören, der neben persönlichen Daten die Merkmale des Fingerabdrucks enthält.
- 12.6.** | Infineon kooperiert mit Ericsson und übernimmt die Chip-Produktionssparte des schwedischen Telekommunikations-Ausrüsters. Infineon wird damit ein wichtiger Zulieferer von Ericsson. Zudem planen die Unternehmen, ihre Kooperation für Mobilfunklösungen zu erweitern.

- 13.6. | Bis Juni 2002 hat Infineon sieben Millionen Bluetooth Chips ausgeliefert, mit denen elektronische Geräte drahtlos per Funk miteinander kommunizieren können. Zudem stellt das Unternehmen den BlueMoon Universal vor, einen besonders kleinen, leistungsfähigen und Energie sparenden Bluetooth Single-Chip. Ab 2003 soll er in großen Stückzahlen produziert werden.
- 18.6. | Gemeinschaftsunternehmen von Infineon mit Agere Systems und Motorola: Die StarCore LLC soll künftig die Digitalsignalprozessor (DSP)-Technologie weiterentwickeln und vermarkten, die wesentlich für Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Kommunikationssysteme ist.
- 26.6. | Infineon hat zwei Milliarden Chipkarten-Module gefertigt. Während die erste Milliarde 1999 und damit sieben Jahre nach dem Fertigungsstart erreicht war, genügten für die zweite Milliarde weitere 30 Monate. Die Nachfrage nach Chipkarten steigt weiter an.

JULI 2002

- 1.7. | Rund 60 % weniger Platz auf der Hauptplatine beansprucht das 1-Gigabyte-Speichermodul, das Infineon als Produktionsmuster präsentiert. Zudem stellt das Unternehmen einen neuen Grafikspeicher vor, der 3-D-Applikationen verbessert und mit geringem Stromverbrauch für Notebooks geeignet ist.
- 5.7. | Mit Chips von Infineon zum Ein-Liter-Auto: Infineon Forscher arbeiten an Motor- und Getriebesteuerungen, die Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß der Autos optimieren. Infineon ist nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens Strategy Analytics weltweit die Nummer zwei unter den Chiplieferanten für Automobilelektronik und konnte seinen Marktanteil trotz des stagnierendem Marktes um 16,6 % ausbauen.
- 12.7. | Ausweg aus der Verdrahtungskrise: Infineon lötet einen Logik- und einen Speicherchip zum „Chip-Sandwich“ zusammen, so dass sich die Wege zwischen den Bauteilen verkürzen und bis zu 100 mehr Leiterbahnen möglich sind. Bisher waren die Bausteine nebeneinander angeordnet; hohe Frequenzen der Kommunikationstechnik sind damit sehr teuer. Das Chip-Sandwich spart 50 % des Platzes und führt zu 30 % geringeren Kosten.
- 15.7. | Infineon verknüpft herkömmliche Telekom-Systeme mit neuen digitalen Netzwerken. Möglich macht das ein neuer Multiservice-Kommunikationsprozessor.
- 30.7. | AMD, Infineon und UMC einigen sich darauf, eine einheitliche Technologie zu entwickeln, um Logikchips mit Strukturgrößen von 65 und 45 Nanometern auf 300-Millimeter-Wafern zu produzieren.

AUGUST 2002

- 5.8.** | Infineon nimmt die Volumenproduktion eines 256-Megabit-Chips auf, mit dem mobile Geräte halb so viel Energie verbrauchen wie mit üblichen Speicherbausteinen. Damit erhöhen sich die Akkulaufzeiten etwa von PDAs, Mobiltelefonen der neuen Generation und Digitalkameras, so dass neue Anwendungen möglich sind.
- 28.8.** | Nachdem Dr. Mihatsch sein Aufsichtsratsmandat aus beruflichen Gründen zum 31. Juli niedergelegt hat, wird Max Dietrich Kley zum neuen Mitglied bestellt und am 28. August einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von Infineon gewählt.

SEPTEMBER 2002

- 13.9.** | Für seine Kampagne zum Zukunftsthema „Wearable Electronics“, der intelligenten Kleidung, erhält Infineon den deutschen Public-Relations-Preis „Goldene Brücke“. Ein komplexes Hochtechnologie-Thema sei dabei anschaulich und mit großem Erfolg umgesetzt worden, so die Jury.
- 20.9.** | Die Agenda 5-to-1 wird als neues Unternehmensprogramm vorgestellt: Infineon definiert damit seine strategischen Ziele für die nächsten 5 Jahre. Demnach will das Unternehmen 2007 zu den 4 ersten Halbleiter-Herstellern der Welt gehören. Dabei ist weniger das technisch Machbare Maßstab der Entwicklung, Infineon konzentriert sich vielmehr auf technologische Lösungen für individuelle Bedürfnisse des Menschen.

Mit dem Notebook zum Mond – 50 Jahre Halbleiter-Geschichte bei Siemens und Infineon

- 1947 wird in den USA der Transistor entwickelt
- 1952 bringt Siemens diese Technologie nach Deutschland
- 1954 bis 2000: Der Chip-Markt wächst von 5 Mio. auf über 200 Mrd. US-Dollar
- 1999 wird Infineon gegründet und geht im März 2000 an die Börse
- Infineon gehört seit 5 Jahren zu den Top 10 weltweit

50 Jahre ist es her, dass Ernst von Siemens bekannt gab, ein separates Werk zur Produktion von Halbleiter-Transistoren bauen zu wollen. Damals war nicht abzusehen, welche Entwicklung er damit anstoßen würde. Fünf Jahre, nachdem in den USA der Transistor entwickelt wurde, und sechs Jahre, bevor der Ingenieur Jack Kilby die integrierte Schaltung (IC – Integrated Circuit) und damit den Mikrochip erfand, schlug die Geburtsstunde der Halbleiter-Industrie in Deutschland. Heute – ein halbes Jahrhundert später – blickt diese Branche wirtschaftlich wie technologisch auf eine unvergleichlich rasante Entwicklung zurück. Einer der Vordenker in diesem Fortschrittsprozess ist nach wie vor der einstige Siemens-Bereich. Dieser heißt heute allerdings Infineon Technologies – 1999 wurden wir aus dem Siemens Konzern ausgegründet und erfolgreich an die Börse gebracht. Und aus den anfänglich 30 Beschäftigten im Jahr 1952 sind über 30.000 Mitarbeiter geworden, von denen jeder sechste an weltweit 29 Standorten in den Bereichen Forschung und Entwicklung tätig ist.

Zwischen 1954 und 2000 wuchs der weltweite Jahresumsatz der gesamten Chip-Branche von 5 Mio. US-Dollar um das 40.000fache auf 200 Mrd. US-Dollar; nach einem drastischen Nachfrageeinbruch ging das Marktvolumen in den Jahren 2001 und 2002 auf etwa 140 Mrd. US-Dollar zurück. Doch egal, wie volatil sich die Märkte entwickeln: Pro Erdenbürger und Jahr werden inzwischen durchschnittlich 60 Millionen Transistoren produziert. Dabei funktionierte die Halbleiter-Industrie von Anfang an nach eigenen Regeln. Die wichtigste formulierte der Amerikaner Gordon Moore bereits 1965: Er sagte voraus, dass sich die Anzahl an Transistoren auf einem IC etwa alle 18 Monate verdoppelt. Damit besagt das nach ihm benannte Moore'sche Gesetz, dass beispielsweise die Leistungsfähigkeit ganz normaler Personalcomputer im gleichen Zeitraum ebenfalls zweimal so groß wird. Demnach ließe sich die gesamte Rechenleistung der ersten Mondlandung von 1969 heute mit einem handelsüblichen Notebook bewältigen. Für die Speicherleistung von einem Gigabyte, heute ein Modul in der Größe zweier Kreditkarten, wurde vor 30 Jahren die Fläche von 700 Quadratmetern und der Strombedarf eines ganzen Dorfes benötigt.

Ob zur Verkehrssteuerung, Telekommunikation, Informationsverarbeitung oder in der programmierbaren Kaffeemaschine, die immer kleineren und schnelleren aktiven Bauelemente sind inzwischen unverzichtbare Bestandteile des Alltags. Möglich ist das nur, weil die Preise nicht analog zur Leistungsstärke gestiegen sind – im Gegenteil. Keine andere Branche zeichnet sich durch eine ähnliche Preiserosion aus: So hätte man sich im Jahr 1972 noch für umgerechnet rund 80.000 Euro entweder ein Einfamilienhaus oder ein Speichervolumen von einem Megabit zulegen können. Heute entspricht der Gegenwert für diese Speichergröße ungefähr dem Preis eines einzelnen Kaugummis.

Immer mehr Leistung auf
immer kleineren Chips

1972 war ein Megabit
so teuer wie ein Haus

Einen kontinuierlichen Preisverfall in diesem Umfang können die Halbleiter-Firmen nur mit dauerhafter Produktivitätssteigerung auffangen, wobei Infineon immer wieder die Rolle des Vorreiters übernimmt.

Dabei hat sich das Prinzip der Chip-Herstellung selbst nie verändert: Mikrochips werden nach wie vor auf dünnen, runden Siliziumscheiben, den so genannten Wafern, gefertigt. Der Trend war und ist, immer kleinere Chips auf immer größeren Wafern herzustellen. Passten die Wafer Anfang der 70er Jahre mit 50 Millimeter Durchmesser bequem auf einen Handteller, produzierte Infineon in 2001 als weltweit erster DRAM-Hersteller auf pizzagroßen 300-Millimeter-Wafern. Zugleich werden die Chipstrukturen immer weiter verkleinert: Heute sind sie nur noch 140 Nanometer breit, das entspricht einem vierzehntausendstel Millimeter.

Ein Ende dieser Entwicklung ist noch lange nicht in Sicht – und das, obwohl praktisch seit den Anfängen der Halbleiter-Industrie immer wieder ihre Grenzen heraufbeschworen wurden. Derzeit stehen die Entwickler vor der Schallmauer von 100 Nanometern, womit nun tatsächlich schon einzelne Atome ins Blickfeld geraten.

Wohin der Weg führen könnte, zeigt ein Blick in die Natur: Der höchste uns bekannte „integrierte Schaltkreis“ ist die DNA mit einer genetischen Speicherkapazität von mehreren Milliarden Bit. Ein Gen, das einen Informationsumfang von etwa einem Bit hat, wird dabei mit rund 20 Atomen abgebildet. Sollte das Moore'sche Gesetz noch weitere 50 Jahre seine Gültigkeit behalten, könnte sich die Chip-Technologie dieser fantastischen Leistungsfähigkeit der Natur noch im 21. Jahrhundert nähern.

Einzelne Atome rücken
ins Blickfeld – größtes
Vorbild ist die DNA

Vom ersten deutschen Transistoren-Hersteller zum Technologie- und Kostenführer der Halbleiter-Industrie

1952

Fünf Jahre nach ihrer Erfindung beginnt Siemens im Münchner Röhrenwerk die erste Produktion von Transistoren in Deutschland. Es werden 30 Mitarbeiter beschäftigt.

1954

Silizium wird bei Siemens als Basismaterial für Halbleiter entdeckt und wird später das teure Germanium ersetzen.

1958

Erste integrierte Schaltungen: Mehrere Transistoren, Widerstände und Kondensatoren sind auf einem Germanium-Chip untergebracht. Zwischen 1960 und 1988 wächst die Zahl der Transistoren auf einem Chip von 10 auf 10.000.000 an.

1963

Der erste Integrierte Schaltkreis (IC) von Siemens geht in Produktion.

1973

Die Speicherkapazität von einem Megabit kostet etwa 80.000 Euro, zu diesem Zeitpunkt der Preis eines Einfamilienhauses. 1 Gigabyte Speicher, im Jahr 2002 ein Modul in der Größe zweier Kreditkarten, beansprucht eine Fläche von 700 m² und den Strombedarf eines Dorfes.

1982

Fertigungsanlauf für 64-Kilobit-Speicherprodukte bei Siemens.

1983

Das MEGA-Projekt wird gestartet: Damit erreicht die deutsche Industrie im Jahr 1988 bei 4-Megabit-Speicherchips den Weltstandard.

1985

Mitte der 80er Jahre werden die Bauteile eines Computerchips kleiner als ein Mikrometer. Damit lassen sich die Chipstrukturen nur noch per Elektronenmikroskop erkennen.

1988

Erste Muster für 4-Megabit-DRAMs von Siemens aus München. Von da an zahlreiche Entwicklungs- und Fertigungskooperationen für immer leistungsfähigere Chips.

1995

Siemens nimmt in Dresden die Produktion von 16-, 64- und später auch 256-Megabit-DRAMs auf.

1999

Aus dem Siemens Geschäftsbereich Halbleiter geht Infineon Technologies hervor.

2000


Infineon geht am 13. März 2000 an die Börse. Die Aktie wird parallel in Frankfurt und New York notiert.

2001

Weltpremiere bei Infineon: Volumenproduktion auf 300-Millimeter-Wafern beginnt in Dresden.

2002

Infineon hat in fünf Jahrzehnten weit reichende Kompetenzen aufgebaut und sich seit fünf Jahren unter den Top 10-Unternehmen der Halbleiter-Industrie positioniert. Das neue Ziel: Um bis zum Jahr 2007 zu den Top 4 zu gehören, soll der Weltmarktanteil nochmals auf rund 6 % verdoppelt werden.



Das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden. Mit unseren Lösungen wird flexibles Home Office möglich.

Wer träumt nicht davon, dort zu arbeiten, wo es am schönsten ist. In den eigenen vier Wänden zum Beispiel. Mit unserer flexiblen Home Office-Lösung wird dieser Traum wahr. Sichere und schnelle Datenverbindungen – Virtual Private Networks (VPN) – schaffen die Basis für einen geschützten Hochgeschwindigkeits-Datentransfer zwischen Zuhause und Büro. So ist man nicht nur flexibler in seiner Tagesgestaltung. Man hat auch mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben – z. B. für den Partner und die Familie. Der Datenzugriff selbst kann übrigens überall im Haus drahtlos über Wireless LAN bereitgestellt werden. Das erhöht die Flexibilität um einiges. Homebanking lässt sich in Zukunft bequem von der Terrasse aus erledigen. E-Mails können im ganzen Haus abgerufen und beantwortet werden. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, lassen sich auch zahlreiche Multimediageräte über drahtlose oder drahtgebundene Netze ansteuern. Wie die Stereoanlage, die Radiosender via Internet empfängt – Sender und Lautstärke werden per Notebook eingestellt. So wird das Zuhause wirklich zum schönsten Arbeitsplatz.

ENTWICKELN, was alle WEITERBRINGT.



||| ||| GESCHÄFTSBEREICHE

DRAHTGEBUNDENE KOMMUNIKATION: Wir sind unter den Top 3.
MOBILE KOMMUNIKATION: Wir gehören auch hier zu den Top 3.
SICHERHEITS- UND CHIPKARTEN-ICs: Wir bleiben die Nummer eins.
AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK: Wir sind die Nummer zwei.
SPEICHERPRODUKTE: Wir rücken vor auf Rang 3 weltweit.

Auf solider finanzieller Basis durch das Konjunkturtal

- Nachfrage- und Preiseinbruch führt zu Umsatzrückgang auf 5,21 Mrd. Euro
- EBIT-Ergebnis infolge starken Preisdrucks bei –1,14 Mrd. Euro
- Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiterhin über 20 % vom Umsatz
- Impact: Kostenposition deutlich verbessert
- Weiterhin starke Cash-Position von 2 Mrd. Euro; Free-Cash-Flow verbessert

Die anhaltende weltweite Konjunkturschwäche, die erheblich zurückgegangene Verbrauchernachfrage und die massiven Verluste auf den Finanzmärkten haben das abgelaufene Geschäftsjahr 2002 geprägt. In diesem Konjunkturmilieu ging die Nachfrage unserer direkten Kunden nochmals zurück und der Preisdruck, der entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis hat, hielt in fast allen Marktsegmenten weiter an. Insbesondere gilt das bei Speicherprodukten sowie Kommunikations- und Chipkarten-ICs. Demgegenüber konnten wir im Geschäft mit Automobil- und Industrieelektronik unseren bisher höchsten Jahresumsatz erzielen.

Der Konzern-Jahresumsatz ging in diesem Marktumfeld jedoch um 8 % zurück auf 5,21 Mrd. Euro gegenüber 5,67 Mrd. Euro im Vorjahr. Das EBIT-Ergebnis von Infineon lag bei –1,14 Mrd. Euro, gegenüber –1,02 Mrd. Euro im Vorjahr – ein Rückgang um 11 %. Der Nettoverlust betrug im Konzern 1.021 Mio. Euro gegenüber 591 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001. Im Berichtsjahr 2002 sind darin Steuerrückstellungen in Höhe von 275 Mio. Euro enthalten.

Insgesamt haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,06 Mrd. Euro bzw. 20 % vom Umsatz in die Forschung und Entwicklung investiert, um unsere Innovationskraft und unsere Position als Technologieführer zu festigen; im Vorjahr waren es 1,19 Mrd. Euro. Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten lagen bei 643 Mio. Euro bzw. 12 % vom Umsatz gegenüber 786 Mio. Euro im Vorjahr.

Der Rückgang dieser Kostenblöcke ist auf die erfolgreiche Umsetzung des Kostensenkungsprogramms Impact zurückzuführen. Damit konnten wir seit Juni 2001 insgesamt Cash-wirksame Einsparungen von 2,5 Mrd. Euro realisieren und unsere finanzielle Situation wesentlich verbessern: Den Free-Cash-Flow – also den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit, bereinigt um Wertpapiere des Umlaufvermögens – verbesserten wir deutlich von –1,99 Mrd. Euro auf –360 Mio. Euro. Dabei erhöhte sich der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr von 211 Mio. Euro auf 237 Mio. Euro. Die Brutto-Cash-Position des Konzerns – zur Ermittlung werden Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel zusammengerechnet – verdoppelten wir bis Ende September 2002 auf rund 2 Mrd. Euro gegenüber 936 Mio. Euro zwölf Monate zuvor.

Detaillierte Informationen

über die operativen

Ergebnisse und die

Finanzlage folgen im

Lagebericht ab S. 85

Der Ausblick des

Infineon Vorstands

folgt auf S. 110 ff.

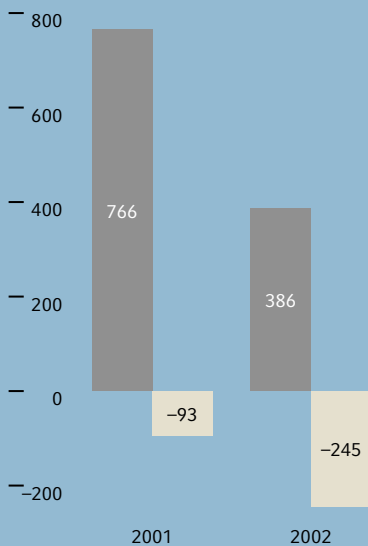
Die Zukunft liegt in Breitband- und Metro-Netzen

- Investitionen der Telekom-Firmen gehen weiter zurück
- Nachfrageeinbruch führt zu Umsatzrückgang auf 386 Mio. Euro
- Hoher Preisdruck, fallende Margen: EBIT-Verlust liegt bei -245 Mio. Euro
- Neue Produkte eingeführt und Marktanteile in fast allen Segmenten erhöht
- Budget für Forschung und Entwicklung fokussiert auf Breitband- und innerstädtische Netzwerk-Lösungen

Schwere Krise der
Telekom-Branche
beeinflusst Ergebnis

Unser Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation ist tätig im Bereich Halbleiter- und Glasfaserkomponenten zur Übertragung von Sprache, Daten und Videosignalen. Wir bieten unseren Kunden Produkte für den traditionellen Zugang und neue, schnellere Breitband-Zugänge zu lokalen Netzbetreibern (Carrier Access) sowie für innerstädtische Netze (MAN) und Weitverkehrs-Netze (WAN).

Drahtgebundene Kommunikation (in Mio. Euro)



■ Umsatz
■ EBIT

Größerer Marktanteil bei
Zugangstechnologie und
Glasfaseroptik

Das Geschäftsjahr 2002 war stark beeinflusst von der anhaltenden schweren Krise der gesamten Telekommunikationsbranche. Dabei gingen die weltweiten Ausgaben für Telekommunikationsausrüstung schon im Jahr 2001 um 36 % zurück. Dieses ungünstige Geschäftsumfeld spiegelt sich bei unseren Kunden wider in Milliardenverlusten, weit reichenden Restrukturierungen und teilweise sogar im Zusammenbruch großer Telekommunikationskonzerne. Der wirtschaftliche Abschwung führte zur Stornierung von geplanten Produktplattformen sowie zu starken Kürzungen bei Investitionen, bremste aber auch die weitere Verbreitung von Breitband-Technologien.

In diesem Marktumfeld ging der Jahresumsatz unseres Geschäftsbereichs um 50 % zurück auf 386 Mio. Euro nach 766 Mio. Euro im Vorjahr. Der EBIT-Verlust erhöhte sich parallel auf -245 Mio. Euro gegenüber -93 Mio. Euro im Vorjahr. Entscheidend für das Jahresergebnis war, dass die Nachfrage nach unseren Netzzugangs- und optischen Netzwerk-Komponenten insgesamt um 50 % sowie bei Glasfaser-Modulen um 30 % einbrach.

Trotz allem konnten wir in dieser Konjunkturphase unsere Position gegenüber den wichtigsten Wettbewerbern verbessern. So haben wir in unseren Marktsegmenten erfolgreich neue Produkte eingeführt und teilweise sogar unsere Marktanteile ausgebaut. Unser Anteil am Chip-Weltmarkt für drahtgebundene Kommunikationslösungen liegt nun bei 6,9%. Dabei stehen wir auf Platz drei der Halbleiterzulieferer im Segment Carrier Access – hierzu gehören die Sprachverarbeitung, Digital- und Analogmodems, ISDN, Kabel und DSL-Lösungen. Bei zukunftsorientierten Technologien wie 10Base/VDSL und einigen traditionellen Technologien wie ISDN und T/E sind wir sogar der weltweit führende Anbieter.

Unsere intensive Forschung und Entwicklung hat sich auch im Berichtsjahr in einer Vielzahl von innovativen Produkten niedergeschlagen, mit denen wir oftmals ganzen Technologien zum Durchbruch verhelfen. Dazu gehören ein schnellerer Internet-Zugriff über DSL, Ethernet-Verbindungen über bestehende Telefonleitungen oder Hochgeschwindigkeits-Netzwerkknoten mit 10 und 40 Gigabit Datendurchsatz. Mit unserem neu entwickelten Chip-Satz „VDSL-A, VDSL-V und 10BaseS“ lassen sich beispielsweise vorhandene Kupferdrahtleitungen in Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Datennetzwerke verwandeln – sowohl für den Geschäfts-

als auch Privatgebrauch. Für diese Entwicklung wurden wir sogar mit dem begehrten Preis „Produkt des Jahres“ der Fachzeitschrift Elektronik ausgezeichnet.

Mit der erfolgreichen Markteinführung von VDSL/10BaseS-Lösungen erreichten wir in der Region Asien/Pazifik vom Start weg eine dominante Marktposition: Mehr als 70 große Anbieter setzen dort unsere Lösung ein, darunter Huawei Technologies, ZyXEL, Sumitomo Electric, Allied Telesis K.K und Telson. Weiterhin haben wir einen neuen integrierten ADSL-Transceiver-Chip-Satz im Markt platziert, der von Schlüsselkunden wie dem europäischen Alcatel-Konzern eingesetzt wird. Mit diesem Chip-Satz können unsere Kunden ADSL-Linecards mit höherer Dichte herstellen, die dem Internetsurfer einen schnelleren und günstigeren Netzzugriff ermöglichen. Mit der US-Firma Cisco haben wir eine strategische Partnerschaft für die Entwicklung einer 10-Gigabit-Produktlinie geschlossen, um die nächste Generation innerstädtischer Netzwerke zu unterstützen.

Die Anbieter von Telekommunikations-Dienstleistungen bauen trotz der Marktkrise ihre Infrastrukturen weiter aus. Allerdings begrenzen sie ihre Kapitalausgaben und Betriebskosten noch mehr, indem sie soweit wie möglich die Leistungsfähigkeit vorhandener Kupferleitungen erweitern. Für uns liegt ein großes Marktpotenzial darin, wenn immer mehr Kunden der Telekom-Unternehmen Breitband-Zugänge verlangen, so dass dafür auch die noch immer vorhandenen engen „Flaschenhalse“ der innerstädtischen Netzwerke erweitert werden sollen.

Die Ansprüche an diese Netzwerke sind gewaltig, denn die immer größeren Sprach- und Datenmengen müssen sicher über große Entfernungen und die Systeme verschiedenster Lieferanten übertragen werden. Und auch die Zahl der Multimedia-Dienste nimmt weiter zu: schnelle Internet-Zugänge, Video-on-Demand oder Multichannel-Video, Multiplayer-Spiele sowie TV-, Computer- und Sprachdienste. All diese Anwendungen werden gleichzeitig durch dieselben Netze geschleust, erreichen den einzelnen Anwender über eine einzige Set-Top-Box und müssen effizient im Haus oder der Wohnung verteilt werden. Erst dann wird optimales „Home Networking“ gemäß den Bedürfnissen des anspruchsvollen Endkunden möglich, der parallel auf eine Vielzahl von Diensten zugreifen will.

Schon in den vergangenen Jahren haben wir bereits den Großteil unseres Budgets für Forschung und Entwicklung auf die langfristig wachstumsstarken Segmente fokussiert. Mit diesem großen Marktpotenzial im Hintergrund werden wir unser umfassendes Portfolio mit Technologien und Systemlösungen für den Breitband-Zugang und innerstädtische Netzwerke weiter ausbauen.

„Produkt des Jahres“

kommt von Infineon

Neue Multimedia-Dienste

erhöhen Marktpotenzial

FuE konzentriert auf neue

Netzwerk-Lösungen

Das Ziel heißt: im Jahr 2005 die Nummer zwei sein im Halbleitermarkt für mobile Kommunikationslösungen

- Halbleitergeschäft von Ericsson übernommen
- Neue Lösungen für Basisstationen, WLAN-Netzwerke und Bluetooth
- Umsatzrückgang um 9 % auf 874 Mio. Euro
- EBIT-Verlust um 54 % auf –82 Mio. Euro verringert
- Kundenbasis in Nordamerika und Asien wird erweitert

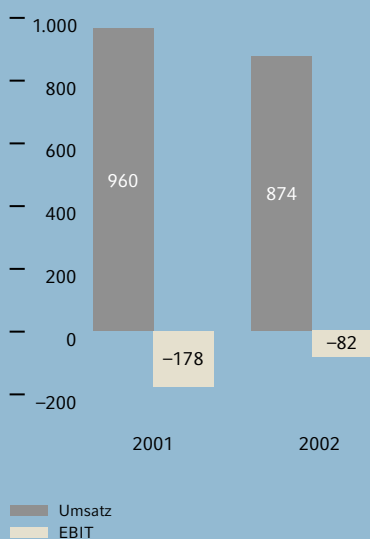
Im Chip-Markt für mobile Kommunikation gehört Infineon zu den führenden Lösungsanbietern. Wir sind einer der wenigen Hersteller am Markt, deren Angebot nahezu die gesamte Palette drahtloser Kommunikation abdeckt: von Mobilfunk über Bluetooth bis zu Wireless LAN. So stellen wir zum Beispiel alle Hochfrequenz- und Basisband-Halbleiter her, die für Handys notwendig sind. Der anhaltenden Nachfrageschwäche und dem Preisdruck im Markt konnten wir uns nicht entziehen. In nahezu allen Segmenten blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen der Marktbeobachter zurück. Vor allem in Europa, unserem wichtigsten Markt, machen sich der verzögerte Aufbau der UMTS-Netze sowie die Kaufzurückhaltung der Verbraucher bei Auftragsingang und Ergebnismargen weiter bemerkbar.

Gegenüber dem Vorjahr sank unser Umsatz deshalb um 9 % auf 874 Mio. Euro. Das Ergebnis konnten wir dennoch deutlich verbessern: Der EBIT-Verlust verringerte sich von –178 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2000/2001 auf jetzt –82 Mio. Euro. In diesem Ergebnis sind – bedingt durch die Akquisition von Ericsson Microelectronics – Sondereffekte in Höhe von –39 Mio. Euro enthalten. Ohne diese Sondereffekte erreichte der Geschäftsbereich Mobile Kommunikation seit dem dritten Quartal des Berichtsjahres (April bis September 2002) wieder ein positives EBIT. Dieses verbesserte Ergebnis haben wir zum einen durch umfangreiche Maßnahmen im Rahmen unserer Impact-Programme erzielt, mit denen wir Kosten gesenkt und die Effizienz unserer Prozesse und Strukturen optimiert haben. Zum anderen war die Einführung neuer Produkte und Lösungen äußerst erfolgreich.

Unsere Systemplattformen für GSM- und GPRS-Handys, die alle benötigten Halbleiter inklusive Software umfassen, sind von den Teilmärkten gut angenommen worden, insbesondere in Asien. Bis heute wurden über eine Million dieser Chip-Sätze verkauft. Das Geschäft mit Bluetooth Chips hat sich ebenfalls positiv entwickelt: Der Absatz stieg von 750.000 Stück im letzten Jahr auf zehn Millionen. Im ersten Kalenderhalbjahr 2002 lag unser Marktanteil bei Bluetooth Produkten bei circa einem Drittel. Nach intensiver Forschungsarbeit haben wir dieses Jahr mit dem BlueMoon Universal die nächste Generation der Bluetooth Einchip-Lösungen eingeführt, mit der wir unsere Stellung im Bluetooth Markt weiter ausbauen werden. Bei der dritten Mobilfunkgeneration (3G), dem großen Zukunftsthema der mobilen Kommunikation, konnten wir mit neu vorgestellten Produkten unsere Position ebenfalls festigen.

Neben Kosten senkenden Maßnahmen und erfolgreichen Produkteinführungen bestimmte der Abschluss von zwei weit reichenden Kooperationsverträgen mit Ericsson sowie Agere und Motorola das abgelaufene Geschäftsjahr.

Mobile Kommunikation (in Mio. Euro)



Bluetooth Absatz von
0,75 Mio. auf 10 Mio.
Stück erhöht

Im Rahmen der langfristigen Partnerschaft mit Ericsson, die im Juni 2002 unterzeichnet wurde, haben wir das Kerngeschäft der Halbleitertochter Ericsson Microelectronics übernommen, die zu den größten Herstellern von Mikrochips für Mobilfunk-Basisstationen, Wireless LAN-Netzwerke und Bluetooth Anwendungen gehört. Das Abkommen beinhaltet zusätzlich eine Entwicklungskooperation mit Ericsson für heutige und zukünftige Mobilfunklösungen der Generationen 2.5G und 3G. Gleichzeitig gewinnen wir mit Ericsson einen wichtigen Abnehmer unserer Produkte und Lösungen für Handys und Netzwerk-Infrastruktur.

Im neu gegründeten Joint Venture StarCore LLC bündeln seit Mitte des Jahres mit Agere, Motorola und Infineon drei Schwergewichte des Logikchip-Marktes ihre Kompetenz bei Entwicklung und Vertrieb von digitalen Signalprozessoren (DSP). Diese Halbleiter ermöglichen zum Beispiel die Übermittlung digitaler Musik- und Videodateien über Mobilfunk. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir einen Standard für DSP und werden ihn am Markt etablieren. Dabei unterscheidet sich unsere Vorgehensweise fundamental vom Wettbewerb: Mit StarCore setzen wir auf ein für andere Firmen offenes Geschäftsmodell. Das heißt, wir werden neue, gemeinsam entwickelte Technologien an Kunden lizenzieren, die diese genauso wie Agere, Motorola und Infineon zur Herstellung eigener Produkte verwenden.

Mit beiden Partnerschaften ergänzen wir unsere Produktpalette und vertiefen unser Technologie-Know-how auf Märkten, die in Zukunft deutlich wachsen werden. Zum Beispiel wird mit der weiteren Verbreitung von GPRS sowie dem Start von UMTS die Nachfrage nach DSP deutlich erhöht. Und auch die Übernahme von Ericsson Microelectronics, die wir mit Aktien finanziert haben, wird sich schnell auszahlen. Mit dem erweiterten Know-how festigen wir unsere Stellung als zuverlässiger Lieferant der weltweiten Elektronik- und Telekommunikationsfirmen, die nicht mehr nur in Massen einzelne Halbleiter-Produkte kaufen, sondern immer mehr gesamte Kommunikationslösungen von einem Partner anfordern. Diese Lösungskompetenz werden wir weiterentwickeln, indem wir die Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen und Kundenkreisen von Infineon ausbauen, zum Beispiel mit der Automobil- und Industrieelektronik, um neue Telematik- sowie Infotainment-Systeme zu entwickeln. Außerdem wird der Bereich Mobile Kommunikation im neuen Geschäftsjahr mit den Segmenten Sicherheits- und Chipkarten-ICs im neuen Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen zusammengeführt.

Dass wir in der zweiten Jahreshälfte trotz der schwierigen Marktsituation wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt sind, zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und gut vorankommen. Die ehrgeizigen Ziele der Agenda 5-to-1 werden wir erreichen, indem wir uns noch stärker in den Regionen Asien und Nordamerika engagieren, die höhere Wachstumsraten versprechen als der europäische Markt. Und wir werden das Lösungsgeschäft weiter vorantreiben. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Kurs zu Umsatzwachstum und positiven Renditen zurückfinden werden.

Die Ziele, an denen wir uns messen lassen, lauten: Bis 2005 wollen wir zweitgrößter Halbleiter-Hersteller im Bereich Mobile Kommunikation sein und wieder eine so gute EBIT-Marge erwirtschaften wie vor der Branchenkrise.

Partnerschaften für
Spitzentechnologie

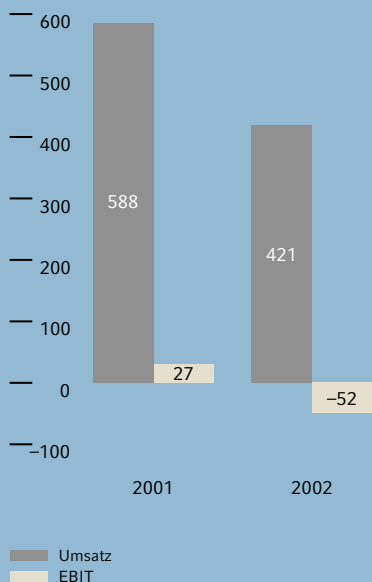
Strategische
Kooperationen ergänzen
Lösungsportfolio

EBIT-Marge soll
weiter verbessert werden

Als langjähriger Marktführer wird Position bei vertrauenswürdigen Sicherheitslösungen weiter ausgebaut

- Im vierten Jahr in Folge weltweit Nummer eins im Chipkarten-IC-Markt
- Umsatzrückgang um 28 % auf 421 Mio. Euro; SIM-Nachfrage gesunken
- EBIT aufgrund hohen Preisdrucks bei -52 Mio. Euro
- Infineon Sicherheitstechnologie in bedeutenden Projekten eingesetzt
- Erneut Sesames Award für die beste technologische Innovation gewonnen

Sicherheits- und Chipkarten-ICs
(in Mio. Euro)



Als Marktführer im Segment Chipkarten-ICs sind wir Experten in Sachen digitale Sicherheit. Unsere Produkte machen viele Aspekte des modernen Lebens aber nicht nur sicherer, sondern auch bequemer. Sie werden in Bereichen wie Telekommunikation, Banken-, Ausweis- und Gesundheitswesen, E- und M-Commerce oder Transport und Verkehr eingesetzt.

Bereits im vierten Jahr in Folge ist Infineon die Nummer eins auf dem Chipkarten-IC-Markt weltweit. Wir konnten diese Position noch einmal stärken und unseren Marktanteil – gemessen nach Stückzahlen – auf 51 % erhöhen. Das Marktforschungsinstitut Frost & Sullivan erkennt unsere Spitzenposition in der Entwicklung und im Marketing von Chips für Kartenanwendungen an und hat Infineon dafür mit dem „Market Engineering Leadership Award 2002“ ausgezeichnet.

Generell hat sich der Markt für Chipkarten-ICs im vergangenen Geschäftsjahr negativ entwickelt. Die hohen Lagerbestände unserer Kunden sorgten für einen enormen Preisdruck. Damit blieb der Umsatz in diesem Geschäftsfeld deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Im Geschäftsbereich insgesamt sank der Umsatz von 588 Mio. Euro auf 421 Mio. Euro. Das EBIT-Ergebnis belief sich auf -52 Mio. Euro. Mittelfristig sehen wir jedoch eine Erholung des Markts für Sicherheits- und Chipkarten-ICs, die im neuen Geschäftsjahr wieder zu steigenden Umsätzen führen wird. Kein Unternehmen hat unserer Meinung nach eine derartig gute Ausgangsposition wie Infineon, die Nachfrage der Kunden nach Hardware-basierten Sicherheitslösungen zu bedienen. Um das bei Infineon vorhandene Lösungs-Know-how noch stärker zu vernetzen, wird das Geschäft mit Sicherheits- und Chipkarten-ICs künftig vereint mit den mobilen Kommunikationslösungen im neuen Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen weitergeführt.

Unsere Sicherheitslösungen sind weltweit gefragt

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Marktstellung in den größten weltweiten Wachstumsmärkten Asien und USA nachhaltig verbessert und eine Reihe von bedeutenden Aufträgen gewonnen: Unsere Sicherheitscontroller sind das Kernelement von Chipkarten, mit denen das US-Verteidigungsministerium seine Mitarbeiter ausstatten wird. Die Regierung von Hongkong setzt bei der Einführung eines neuen Chipkarten-Ausweises ebenfalls auf die ausgezeichnete Technologie von Infineon. 22 Millionen Taiwaner werden bis Ende 2003 mit einem neuen Gesundheitspass ausgestattet – Infineon ist in diesem Projekt wichtiger Lieferant für Sicherheitscontroller. Zudem sind wir mit unserer Sicherheitstechnologie weltweit in allen entscheidenden Referenzprojekten vertreten, welche die Einführung einer so genannten Chipkarten-ID vorbereiten; gemeint sind Ausweise, die als Chipkarten herausgegeben werden.

Durch die vielfältigen Möglichkeiten des Internets und der mobilen Kommunikation können individuelle Arbeits- und Freizeitwelten komfortabler und flexibler gestaltet werden als je zuvor. Damit wächst jedoch auch die Gefahr, dass persönliche Daten missbraucht werden. Es gilt also, die Sicherheitslücken in unseren virtuellen Welten zu schließen und vertrauenswürdige Lösungen zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist unser Trusted Platform Module (TPM), die weltweit erste Sicherheitsschaltung für alle gängigen Rechnerplattformen. Sie entspricht den Vorgaben der Trusted Computing Platform Alliance, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Kommunikation und Interaktion im Internet durch neue Sicherheitsmodule sicherer zu gestalten. Das TPM schafft eine elementare Voraussetzung für vertrauenswürdigen (engl.: trusted) und somit erfolgreichen E- und M-Commerce. Ausgehend von der PC-Plattform wird diese Technologie schnell Anwendungen in anderen Bereichen finden. Ob für Mobiltelefon oder PDA – gerade neue Anwendungen für mobile Kommunikationstechnik wie Wireless LAN und UMTS werden sich langfristig nur durchsetzen können, wenn sie auf einer vertrauenswürdigen Kommunikationsplattform aufgebaut sind.

Dank unserer Produkte wird das Leben auch außerhalb der virtuellen Welten sicherer und bequemer: Mit Sony entwickeln wir derzeit die kontaktlose Chipkarte, deren Informationen ohne physischen Kontakt zu einem Lesegerät übertragen werden. Denkbar sind zum Beispiel elektronische Tickets für öffentliche Transportmittel oder Firmen-IDs, welche die Zugangserlaubnis ihres Trägers im Vorübergehen überprüfen. Der für diese Chipkarte entwickelte Mikrocontroller hat uns im November 2002 anlässlich der Messe Cartes 2002 in Paris erneut den Sesames Award für die beste technologische Innovation im Jahr 2002 eingebracht.

Unser Gemeinschaftsunternehmen Ingentix hat sich äußerst erfolgreich auf dem Markt der Speicherprodukte für MultiMediaCards etabliert. Wir haben im Rahmen eines Projektes mit den Unternehmen Hitachi, Matsushita, ScanDisk und Toshiba die Sicherheitsstandards für Flash-Speicherkarten erheblich erweitert. Diese Multimedia-Karten speichern heute Bilder, Ton und Text in Mobiltelefonen, Digitalkameras, PDAs oder PCs.

Weitere Marktsegmente mit einem besonders hohen zukünftigen Wachstumspotenzial sind Identifikation und Zahlungsverkehr: Hier stehen zum einen große Projekte für elektronische Ausweise, Bürgerkarten und Gesundheitspässe an. Außerdem werden Kreditkarten in Zukunft mit einem Sicherheitscontroller versehen sein, um das Sicherheitsniveau dieses Zahlungsmittels deutlich zu erhöhen. Als Marktführer stellen wir uns den neuen Herausforderungen und wollen diesen Markt auch in Zukunft als Technologie- und Innovationsführer im Sinne der Bedürfnisse unserer Kunden prägen.

**Vertrauenswürdige
Technologien für
das moderne Leben**

**Lukrativer
Karten-Markt für
Identifikation und
Zahlungsverkehr**

Der Halbleiter-Markt für Fahrzeuge und Industrieprodukte bleibt der stabilste der Branche

- Umsatzerlöse auf Rekordhöhe von 1,2 Mrd. Euro gesteigert
- Positives EBIT von 111 Mio. Euro 22% unter Vorjahreswert
- Automotive hat Marktanteil trotz Konjunkturschwäche auf rund 8% erhöht
- Industrieprodukte gewinnen Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft
- Infineon Lösungen für Fahrzeuge prägen schon heute den Technology Lifestyle

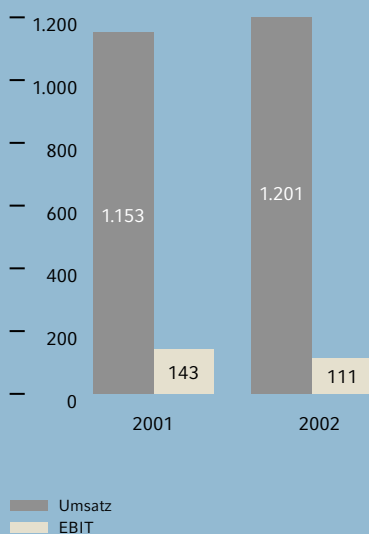
Schon heute Halbleiter im Wert von etwa 200 Euro in jedem Neuwagen

Halbleiter sind aus modernen Autos nicht mehr wegzudenken. Eine Vielzahl von Chips steuern von Klimaanlage, Sitzeinstellung und Airbag zahlreiche Funktionen bis hin zu Motor und Getriebe. Der Markt für solche Bauelemente ist der stabilste der Halbleiter-Branche: Einmal unterliegt die Automobilproduktion selbst in wirtschaftlich schwachen Zeiten nur geringen Schwankungen, zum zweiten steigt die Elektronikausstattung pro Auto immer weiter an. So liegt der Wert der Halbleiter im Auto heute im Durchschnitt bei 200 Euro, Tendenz weiter steigend. Und damit stiegen die Umsätze weiter, obwohl die Fahrzeugproduktion im deutschen Markt, dem wichtigsten für Infineon, um rund 4% zurückging. Laut einer Marktstudie belegen wir bei Halbleitern für Automobile jetzt uneingeschränkt den zweiten Rang weltweit, in Europa ist Infineon die Nummer eins.

Bis zu 30% weniger Energieverbrauch

Der Bereich Industrieelektronik ist für Stromversorgung zuständig – im Kleinen wie im Großen: Hochleistungselektronik sorgt einerseits in Umspannwerken, ICE-Zügen, Windkraftanlagen und Industrieantrieben dafür, dass hohe Leistungen zuverlässig gesteuert werden. Dabei werden zunehmend halbleiterbasierte Lösungen eingesetzt; der Markt wächst kontinuierlich. Zum anderen steuern Halbleiter die Energiezufuhr für Mother Boards in Personalcomputern und in mobilen Geräten, beispielsweise in Netzteilen für Laptops. In beiden Bereichen sind wir als Technologieführer preisgekrönt: Der Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft ging im Geschäftsjahr 2002 an Infineon für die beiden Leistungshalbleiterfamilien CoolMOS und IGBT; das sind Transistoren, die hohe Ströme punktgenau steuern können. Sie werden in Zukunft milliardenfach in Autos und Haushaltsgeräten, Mobiltelefonen, Industriemotoren und PCs eingesetzt, die dann bis zu 30% weniger Energie verbrauchen.

Automobil- und Industrieelektronik (in Mio. Euro)



Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs stiegen im Berichtsjahr 2002 auf das Rekordniveau von 1,2 Mrd. Euro. Das EBIT-Ergebnis ist bedingt durch den enormen Preisdruck auf 111 Mio. Euro gesunken. Zusätzlich zu den erfolgreichen Impact-Maßnahmen konnte der Bereich seine Kosten durch die Produktionsumstellung auf kleinere Strukturgrößen sowie den erhöhten Einsatz größerer Waferscheiben senken. Im Bereich Industrieelektronik wurde das Werk im oberpfälzischen Pretzfeld planmäßig geschlossen, während die Kapazitäten im ungarischen Cegled ausgebaut wurden.

Zahlreiche Ausschreibungen, so genannte Design-Wins, konnten wir in diesen Marktsegmenten auch im vergangenen Geschäftsjahr für uns entscheiden. Wichtige Kunden hat das Unternehmen in den USA und in Japan gewonnen. Entscheidend war dabei neben der Technologie- und Kostenführerschaft, dass der Bereich zunehmend Systemlösungen anbietet.

Der Geschäftsbereich hat seine Marktanteile weiter ausgebaut – bei Automobilanwendungen etwa stieg unser Weltmarktanteil von 7,3 auf rund 8 %, während der Markt selbst um 2,1 % zurückging. Auch in der Industrieelektronik kamen trotz eines konjunkturell schwachen Investitionsgütermarktes Marktanteile hinzu. Damit haben wir in allen drei technologischen Segmenten – Leistungshalbleiter, Sensorik und Mikrocontroller – eine hervorragende Ausgangsposition für den Zeitpunkt geschaffen, wenn der Weltmarkt wieder anzieht.

Das Segment Leistungshalbleiter hat uns nicht nur den Innovationspreis eingebracht, sondern war auch wirtschaftlich erfolgreich. Bei Stromwandlern für Mother Boards etwa stieg unser Weltmarktanteil auf 22 %. Die so genannten DC/DC-Bauteile werden dabei dem zunehmend höheren Strombedarf von Computerprozessoren gerecht – bei einem hervorragenden Wirkungsgrad und geringer Wärmeentwicklung.

In den Geschäftsbereich integriert und neu organisiert wurde im Berichtsjahr das Segment Sensorik: Infineon konzentriert sich hier auf Magnetfeld-, Druck- und Temperatursensoren für automobiler Anwendungen und sichert sich so den Zugang zu einem wichtigen Wachstumsmarkt. Beispielsweise wird in den USA ab dem Jahr 2003 gesetzlich vorgeschrieben, dass der Reifendruck kontinuierlich überwacht werden muss. Dabei warnen elektronische Systeme den Fahrer, wenn der Druck abfällt; die Fahrsicherheit steigt deutlich.

Im dritten Segment Mikrocontroller ist es gelungen, den neu entwickelten 32-Bit-TriCore erfolgreich bei den Automobilherstellern zu platzieren. Der TriCore ermöglicht etwa modernste Direkteinspritzung und neuartige Konzepte für Getriebesteuerungen und Motormanagement. Gegenüber der bisherigen 16-Bit-Technologie steigt die Rechenleistung um das Zehnfache, womit sich die Systemkosten optimieren lassen. Wichtig sind die hoch integrierten Bauelemente zudem für das automobiler Informations- und Unterhaltungsprogramm. Denn eine entscheidende Voraussetzung für kostengünstige Infotainment-Systeme im Auto ist die Kombination zahlreicher Schnittstellen auf winziger Fläche, vom Navigationsgerät über das Mobiltelefon und den PDA bis hin zu CD-/DVD-Laufwerken sowie Radios mit Internet-Zugang.

Technology Lifestyle of the Individual – für die neue Vision von Infineon liegt gerade in der Automobilelektronik ein hohes Potenzial: Das Auto prägt immer stärker den individuellen Lebensstil und wird als „mobiles Wohnzimmer“ personenbezogen ausgestattet. Dabei wird Elektronik immer wichtiger für das Fahrzeugdesign – mit Sicherheits- ebenso wie mit Komfortfunktionen und bedienerfreundlichen Mensch-Maschine-Schnittstellen.

Segmente Leistungs-
halbleiter, Sensorik und
Mikrocontroller in guter
Ausgangsposition

Infineon Lösungen
machen das Auto zum
mobilen Wohnzimmer

Technologie- und Kostenführerschaft sichern, um die Marktkonsolidierung mit voranzutreiben

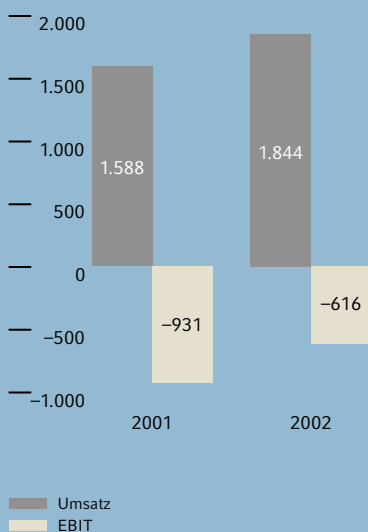
- Mit weiter steigenden Marktanteilen jetzt Nr. drei im DRAM-Markt
- Umsatz um 16 % auf 1,84 Mrd. Euro erhöht trotz Preisverfall am Jahresende
- EBIT-Jahresverlust verringert um 315 Mio. Euro auf –616 Mio. Euro
- Erhöhte Kapazitäten und verbesserte Produktivität in wachsendem Markt
- Weltweites DRAM-Produktionsnetzwerk mit Winbond und Nanya erweitert

Im Geschäftsbereich Speicherprodukte haben wir unsere weltweite Marktposition im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter ausgebaut. Wir haben uns nachhaltig als Technologie- und Kostenführer bei Speicherchips etabliert und die Voraussetzungen dafür geschaffen, um als Gewinner aus der Konsolidierungsphase des DRAM-Marktes hervorzugehen. So haben wir unsere Produktionsprozesse kontinuierlich optimiert, wichtige Entwicklungsprojekte umgesetzt und neue Produkte im Markt eingeführt. Dabei verfolgen wir konsequent unsere drei Dauerziele: die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und so die Margen zu erhöhen. Dass wir das alles erfolgreich umsetzen, bestätigt eine Untersuchung des Marktforschungsinstitutes iSupply: Bis Ende Juni 2002 haben wir unseren Weltmarktanteil bei Speicherchips auf 13,7 % ausgebaut und sind nun der drittgrößte DRAM-Hersteller.

Durchschnittspreise für Speicherchips um 30 % per Megabit gefallen

Entscheidend für den Ausbau unseres Marktanteils im Geschäftsjahr 2002 war, dass wir die verkauften Stückzahlen in Megabits gerechnet um mehr als 60 % steigern konnten, während der Markt in Megabits gerechnet um etwa 55 % gewachsen ist. Dabei sind unsere Umsatzerlöse im Speicherbereich gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf über 1,84 Mrd. Euro gestiegen. Während die Nachfrage im Berichtsjahr weiter anstieg, fiel der Durchschnittspreis für Speicherchips im Jahresvergleich nochmals um 30 % per Megabit. Teilweise lag dieser bis zu zwei Euro unter unseren Vollkosten. Trotz des anhaltend schwierigen und zyklischen Marktumfeldes konnten wir durch die weiter gesteigerten Umsätze, geringere Bestandsabschreibungen sowie deutliche Kostensenkungen im Rahmen von Impact den EBIT-Verlust des Geschäftsbereichs gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel auf –616 Mio. Euro verbessern.

Speicherprodukte
(in Mio. Euro)



Mit dem erfolgreichen Hochlauf der neuen 300-Millimeter-Produktionstechnologie in einer neuen Fabrik in Dresden haben wir im Geschäftsjahr 2002 Maßstäbe gesetzt: Infineon ist weltweit der erste Hersteller, der DRAMs in hohen Volumina auf 300 Millimeter breiten Siliziumscheiben produziert. Gleichzeitig haben wir die Produktivität der bisherigen 200-Millimeter-Fabriken erhöht, so dass wir die Kapazität unserer Chipfertigung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 40 % steigern konnten. Zudem haben wir unsere Fertigungstechnologien weiter verbessert. Ende September 2002 waren bereits mehr als 70 % unserer Produktion von 0,17 auf 0,14 Mikrometer breite Chipstrukturen umgestellt. Wir haben außerdem mit der Einführung der 0,11-Mikrometer-Technologie begonnen. Parallel dazu entwickeln wir bereits die nächste Generation, die 90-Nanometer-Technologie.

Durch das Erhöhen der 300-Millimeter-Kapazitäten und das weitere Verkleinern der Chipstrukturen bauen wir unsere Technologie- und Kostenführerschaft weiter aus und sichern uns langfristig strategische Vorteile gegenüber dem Wettbewerb.

Auch mit im vergangenen Geschäftsjahr neu eingeführten Produkten zielen wir auf Märkte mit höheren Margen: Als Folge der Einführung eines neuen Double Data Rate (DDR)-Chip-Satzes durch den Marktführer Intel nahm Mitte 2002 die Nachfrage unserer Kunden nach den im Vergleich zu Standard-DRAM-Produkten leistungsstärkeren DDR-Speicherchips stark zu. Wir werden bis zum Ende des Jahres 2002 mehr als 80 % unserer Fertigung auf die DDR-Variante umgestellt haben. Neben dem 128-Megabit-Chip haben wir mit neuen 256-Megabit- und 512-Megabit-Chips zwei ertragreiche DDR-DRAM-Produkte im Programm: Zum einen fertigen wir diese kostengünstig mit unserer modernen 0,14-Mikrometer-Technologie und gleichzeitig erzielen wir aufgrund ihrer hohen Speicherdichte gute Preise auf dem Weltmarkt.

Die Produktpalette unserer Spezial-DRAMs haben wir zusätzlich zu den Grafik-RAMs entscheidend erweitert: Unsere Mobile-RAMs mit den Speicherdichten 128 und 256 Megabit wurden aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs vor allem von PDA-Herstellern schnell akzeptiert. Gemeinsam mit dem US-Unternehmen Cisco haben wir zudem den 256-Megabit-RLDRAM (Reduced Latency DRAM) speziell für schnelle Netzwerk- und Cache-Applikationen entwickelt.

Zudem konnten wir unsere Markt- und Kostenposition durch neu geschlossene Partnerschaften bei Produktion sowie Forschung und Entwicklung weiter ausbauen: Hierzu gehören die kombinierte Lizenz- und Abnahmekooperation mit Winbond Electronics sowie die Zusammenarbeit mit Advanced Micro Devices (AMD) und DuPont Photomasks beim Entwickeln und Fertigen von Lithografiemasken. Ferner planen wir mit Nanya Technology die langfristige Zusammenarbeit bei Technologieentwicklung und 300-Millimeter-Fertigung. Auf Basis weiterer Kooperationen mit Cypress und Micron Technology zum Entwickeln eines Cellular-RAM sowie mit der Firma EMS im Bereich Spezial-Speicherchips werden wir uns noch breiter im Weltmarkt aufstellen.

Mit diesen und künftigen Partnerschaften und einer noch stärkeren Diversifikation unserer Produktpalette auch bei nichtflüchtigen Speicherchips werden wir unsere Position in wachstums- und margenstarken Segmenten weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, als umfassender Hersteller von Standard- und Spezial-Speicherprodukten unseren Weltmarktanteil bis zum Jahr 2005 auf über 20 % zu steigern.

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir mit Hilfe erfolgreicher Kooperationen und dem konsequenten Weiterführen unserer Fertigungsstrategie langfristig unsere Technologie- und Kostenführerschaft sichern. Wir sind auf dem besten Weg: Sobald wir die nächste Produktionstechnologie für 0,11 Mikrometer breite Chipstrukturen eingeführt haben sowie den Ausstoß der auf 300-Millimeter-Wafer produzierten DRAMs weiter erhöhen, werden wir die Gesamtzahl verkaufter Speicherchips in absehbarer Zeit nochmals um mehr als 70 % steigern. Gleichzeitig können damit weitere Kostensenkungen von bis zu 40 % realisiert werden.

Ertragreiche Double-Data-Rate-Chips erfolgreich im Markt eingeführt

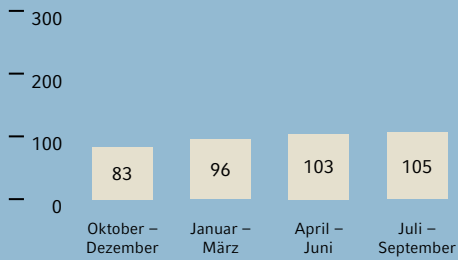
Weltweit zahlreiche neue Kooperationen

Bis 2005 soll der Weltmarkt-Anteil auf über 20 % gesteigert werden

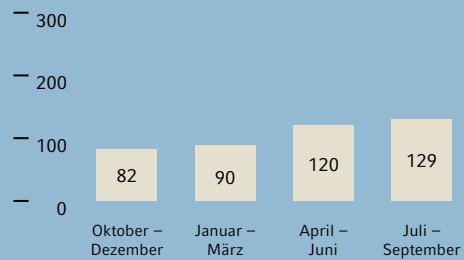
Umsatzentwicklung in den Quartalen

Geschäftsjahr 2002 – in Mio. Euro

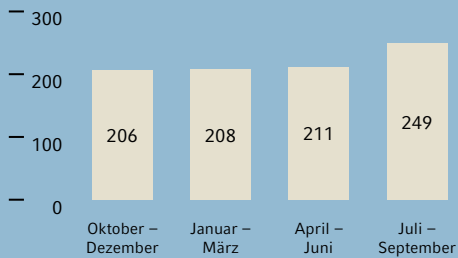
Drahtgebundene Kommunikation



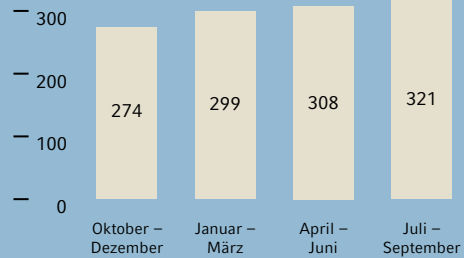
Sicherheits- und Chipkarten-ICs



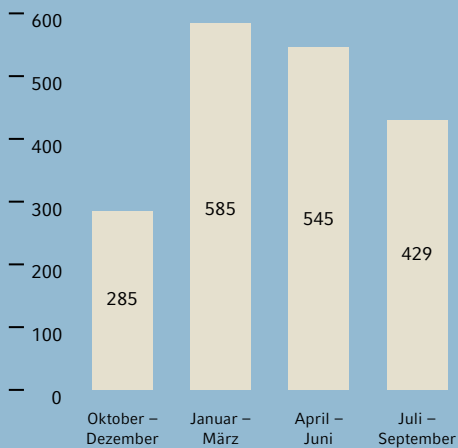
Mobile Kommunikation



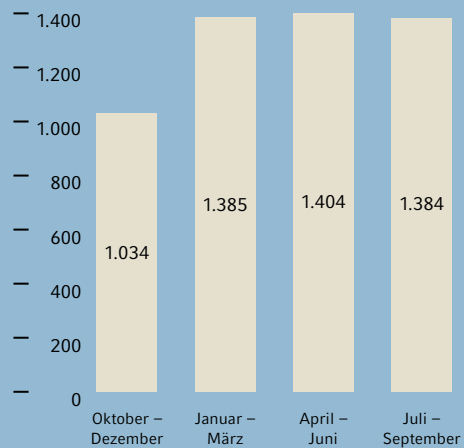
Automobil- und Industrieelektronik



Speicherprodukte



Infineon-Konzern

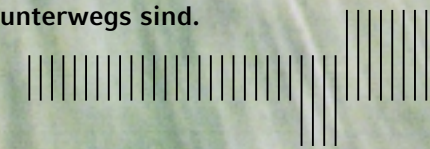


Basis für die Diagramme sind untestierte konsolidierte Quartalszahlen gemäß der Unternehmensstruktur am Ende des Geschäftsjahres 2002. Abweichungen der Summen durch Rundungsdifferenzen sind möglich. Beim „Infineon-Konzern“ sind neben den Geschäftsbereichen die Sonstigen Bereiche sowie die Konzernfunktionen berücksichtigt.



Ihr Kind soll sich im Auto genauso sicher fühlen wie zu Hause. Dafür haben wir überzeugende Lösungen entwickelt.

Mit Sicherheit fährt es sich am besten – gerade wenn man seine Kinder dabei hat. Ein guter Grund für Infineon Technologies, Autohersteller bei der Entwicklung sicherer Fahrzeuge mit zukunftsweisenden Lösungen zu unterstützen. Eine davon basiert auf unserem Mikrocontroller und steuert die elektronischen Überwachungssysteme im Auto. Sie überprüfen regelmäßig die Funktionen u. a. von Motor, Bremsen und Reifendruck. Sie überwachen aber auch die Airbags, ABS und ESP. Kommt es hier zu Störungen oder Ausfällen, wird der Fahrer durch das Überwachungssystem gewarnt. Um nicht nur sicher, sondern auch entspannt unterwegs zu sein, bietet Infineon Technologies mit dem „Infotainment-Konzept“ eine überzeugende Lösung, die Sie bequem und ohne Umwege an Ihr Ziel navigiert. Für ein beruhigendes Gefühl sorgt zudem unser FingerTIP™ Sensor. Er identifiziert den Fahrer beim Einsteigen und weist dessen gespeicherte Daten wie Name, Blutgruppe, Allergien etc. eindeutig zu. Im Notfall könnten diese dann von der Rettungszentrale abgerufen werden. So haben Sie immer die nötige Sicherheit, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind.





ZEIGEN, was
man WIRKLICH kann.

AUFSICHTSRAT: Neuer Vorsitzender seit August 2002.

CORPORATE GOVERNANCE: Infineon mit eigenem Kodex.

LAGEBERICHT: Branchenkrise führt zu Umsatz- und EBIT-Rückgang.

ANHANG: Ausführliche Erläuterung der Konzernrechnungslegung.

KALENDER: Hauptversammlung am 21. Januar 2003 in München.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS	78	
<hr/>		
MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS	81	
<hr/>		
CORPORATE GOVERNANCE	82	
<hr/>		
KONZERNLAGEBERICHT	85	Signifikante Entwicklungen während des Geschäftsjahrs 2002
	94	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
	104	Darstellung der Finanzlage
	109	Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
	110	Ausblick
	112	Mitarbeiter und Campeon
	113	Risiken und Chancen
	116	Infineon Technologies AG
<hr/>		
BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER	119	
<hr/>		
KONZERNABSCHLUSS	120	Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnungen
	121	Konzern-Bilanzen
	122	Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen
	124	Konzern-Kapitalflussrechnungen
<hr/>		
ANHANG	126	Anhangsangaben
ZUM KONZERNABSCHLUSS	171	Vorstand und Aufsichtsrat
	179	Wesentliche Beteiligungen
<hr/>		



MAX DIETRICH KLEY, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionäre!

Im vergangenen, für das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Investoren schwierigen Geschäftsjahr fand ein besonders intensiver Dialog zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat statt. Dabei hat der Vorstand den Aufsichtsrat im Rahmen der Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Investitions- und Finanzplanung informiert. Darüber hinaus erhielt der Aufsichtsrat ausführliche schriftliche Quartalsberichte. Zwischen den Sitzungen wurde der Aufsichtsratsvorsitzende laufend über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen unterrichtet.

Schwierige Situation im Halbleitermarkt prägt Aufsichtsratsarbeit

Die schwierige Situation auf dem Halbleitermarkt mit einer anhaltenden Nachfrageschwäche prägt natürlich auch die Arbeit des Aufsichtsrats. In fast allen Marktsegmenten von Infineon, insbesondere aber bei Speicherchips, standen die Preise weiterhin unter starkem Druck. Als Reaktion auf die Branchenkrise leitete der Vorstand schon im Juli 2001 das mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Kostensenkungsprogramm Impact ein. Hauptziel war es, die Liquidität des Unternehmens rasch und nachhaltig zu sichern. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand über den erfolgreichen Fortgang dieses Programms ebenso informiert wie über die Ziele des Nachfolgeprogramms Impact². Mit dessen Umsetzung optimiert das Unternehmen weiter seine Strukturen und Prozesse, um die Wettbewerbsfähigkeit aller Geschäftsbereiche fortlaufend zu verbessern und langfristig abzusichern. Der Aufsichtsrat unterstützt die Maßnahmen und hat den Vorstand darin bestärkt, den Konzern weiterhin umfassend und zügig an das dynamische Marktumfeld anzupassen.

Als Antwort auf die veränderten Marktbedingungen hat Infineon seine Unternehmensstrategie fortentwickelt und mit der „Agenda 5-to-1“ die Ziele für die nächsten Jahre definiert. Der Aufsichtsrat diskutierte die Neuausrichtung hin zum Lösungsanbieter ausführlich und befürwortet die Strategie, die konsequent umgesetzt werden soll. Das vorrangigste Ziel muss aber sein, wieder die Gewinnschwelle zu erreichen. Wir werden Infineon auf dem

eingeschlagenen Weg aktiv begleiten und das Erreichen der gesetzten Ziele überwachen. Über die Entwicklung der im Berichtsjahr akquirierten Unternehmen, einschließlich deren Integration, ließ sich der Aufsichtsrat ebenfalls berichten. Weiterhin wurde das Projekt Campeon, die Errichtung einer neuen Konzernzentrale für Infineon, in verschiedenen Sitzungen eingehend erörtert und befürwortet. Campeon ist auf die Bedürfnisse eines auf die Kreativität seiner Mitarbeiter besonders angewiesenen innovativen Technologieunternehmens zugeschnitten und soll so das Arbeitsumfeld und die Kommunikation der Mitarbeiter untereinander nachhaltig verbessern.

Insgesamt fanden 10 Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse statt

Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Beschlüsse durch den Aufsichtsrat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst. Der Präsidialausschuss trat im Berichtsjahr einmal zusammen. Weiterhin hat er Beschlüsse zu Satzungsänderungen im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. Der Investitions- und Finanzausschuss hat im Berichtsjahr viermal getagt; außerdem hat er Beschlüsse zu zustimmungspflichtigen Geschäften im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. Schwerpunkte der Sitzungen des Ausschusses waren die Vorprüfung des Jahresabschlusses, die Erörterung des Prüfungsberichtes mit dem Wirtschaftsprüfer, die laufende Prüfung der Investitionsplanung und die Prüfung zustimmungspflichtiger Geschäfte, insbesondere die Akquisition der Ericsson Microelectronics AB.

Der gemäß Paragraph 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss musste nicht einberufen werden.

Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt

Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat folgende Unterlagen geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: den Jahresabschluss der Infineon Technologies AG zum 30. September 2002, den nach den Vorschriften der US-GAAP unter Anwendung der Befreiungsvorschrift des Paragraphen 292a HGB aufgestellten Konzernabschluss zum 30. September 2002 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Infineon Technologies AG und des Infineon Konzerns.

Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen ebenfalls selbst geprüft. Die Berichte der KPMG über die Prüfung der Abschlüsse lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Die Unterlagen und Prüfberichte wurden zunächst in der Sitzung des Investitions- und Finanzausschusses am 6. November 2002 sowie in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 3. Dezember 2002 in Anwesenheit des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Wir hatten keine Einwände und stimmen dem Ergebnis der Prüfung durch die KPMG zu. Entsprechend hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Dem vom Vorstand aufgestellten Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde vom Abschlussprüfer ebenso der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt, wonach die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, die Leistung der Gesellschaft bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften nicht unangemessen hoch war oder eventuelle Nachteile ausgeglichen worden sind und bei den im Bericht aufgeführten

Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Der Aufsichtsrat hat den Bericht selbst geprüft. Wir erheben nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung keine Einwendungen gegen die Schlusserklärung des Vorstands und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfer zu.

Besetzung des Aufsichtsrats verändert – neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Dr. Eberhard Rauch legte sein Aufsichtsrats-Mandat zum 31. Dezember 2001 nieder. Zum Ablauf der Hauptversammlung am 22. Januar 2002 legten die Herren Dr. Volker Jung, Heinz-Joachim Neubürger und Prof. Dr. Claus Weyrich ihre Mandate nieder. In der Hauptversammlung wurden auf Vorschlag des Aufsichtsrats die Herren Dr. Stefan Jentzsch, Karl Heinz Midunsky, Dr. Peter Mihatsch und Dr. Martin Winterkorn für die restliche Amtszeit der aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieder zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre gewählt. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Dr. Peter Mihatsch einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Frau Sibylle Wankel legte zum 31. Mai 2002 ihr Mandat nieder. Zu ihrem Nachfolger als Mitglied des Aufsichtsrats und Vertreter der Arbeitnehmer wurde zum 1. Juli 2002 Herr Wolfgang Müller gerichtlich bestellt.

Herr Dr. Peter Mihatsch hat sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Infineon Technologies AG mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2002 niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 16. August 2002 ist an seiner Stelle Herr Max Dietrich Kley zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt und durch Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren am 28. August 2002 einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.

Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre engagierte und verantwortungsvolle Tätigkeit in diesem Gremium.

München, im Dezember 2002
Für den Aufsichtsrat



Max Dietrich Kley
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Anteilseignervertreter

- **Max Dietrich Kley**
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft
- **Dr. h. c. Martin Kohlhausen**
Stellvertretender Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank AG
- **Dr. Joachim Faber**
Mitglied des Vorstands der Allianz AG
- **Dr. Stefan Jentsch**
Mitglied des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG
- **Karl Heinz Midunsky**
Corporate Vice President und Treasurer der Siemens AG
- **Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge**
Ordinarius der Technischen Universität München
- **Dr. Martin Winterkorn**
Vorsitzender des Vorstands der Audi AG
- **Dr.-Ing. Klaus Wucherer**
Mitglied des Vorstands der Siemens AG

Arbeitnehmervertreter

- **Alfred Eibl**
Stellvertretender Vorsitzender
Mitglied des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße
- **Ender Beyhan**
Mitglied des Gesamtbetriebsrats
Mitglied des Betriebsrats München-Perlach
- **Johann Dechant**
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West
- **Heinz Hawreliuk**
Leiter der Abteilung Unternehmensmitbestimmung der IG Metall
- **Klaus Luschtinetz**
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
Vorsitzender des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße
- **Wolfgang Müller**
Gewerkschaftssekretär IG Metall-Bezirksleitung Bayern
- **Michael Ruth**
Kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs Sichere Mobile Lösungen
- **Gerd Schmidt**
Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West

Corporate Governance – unser ganzheitliches Konzept

- Infineon-Kodex auf Geschäftsumfeld zugeschnitten
- Ganzheitliches Konzept zur Umsetzung der neuen Vision und Mission
- Corporate Governance-Beauftragter berichtet direkt an Vorstand und Aufsichtsrat

Corporate Governance – das sind Standards guter und verantwortlicher Unternehmensführung. Über das Corporate Governance-System von Infineon informieren wir ausführlich auf unseren Internetseiten www.infineon.com und in der Hauptversammlung am 21. Januar 2003. Unser Corporate Governance-System umfasst das gesamte Unternehmen und ist an unserem Geschäftsmodell ausgerichtet: Infineon entwirft, produziert und verkauft modernste Halbleiterlösungen und -dienstleistungen, mit denen wir die Branchenführerschaft bei Innovation und Kundenorientierung erreichen wollen. Oberstes Gebot ist dabei die Kundenorientierung, um Mehrwert zu produzieren, von dem neben unseren Kunden ebenso unsere Aktionäre und Mitarbeiter profitieren sollen.

Alle unternehmerischen Werte, Prozesse und Ziele unterliegen dem Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat von Infineon verstehen unter Corporate Governance ein ganzheitliches Konzept, das alle unternehmerischen Werte, Prozesse und Ziele einschließt, die unserer Mission dienen. Dazu zählen die Standards des internen Controllings ebenso wie die Leitlinien für das unternehmerische Verhalten im Wettbewerb, die „Business Conduct Guidelines“. Integriert sind zudem die Leitlinien, die die Organisations- und Aufsichtspflichten des Unternehmens betreffen. Wir haben einen Corporate Governance-Beauftragten berufen, der direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Ein wesentliches Element des Konzepts ist ein speziell auf die Anforderungen unseres Geschäftsumfeldes konzipierter Infineon-Corporate Governance-Kodex.

Infineon hält deutsche und amerikanische Regeln ein

Infineon hält bereits alle Empfehlungen der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance-Kodex“ ein, ebenso die Vorgaben des US-amerikanischen Kapitalmarktrechtes. Infineon hat sich zusätzliche Ziele gesteckt – mit weiterführenden Leitlinien guter Unternehmensleitung und -überwachung:

- Wir informieren unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit umfassend und offen über das Unternehmen, wobei wir unsere Spitzenstellung bei der Berichterstattung halten und ausbauen wollen.
- Wir wollen die Aktionäre bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere in der Hauptversammlung, soweit wie möglich unterstützen. Dafür setzen wir das Internet ein.
- Wir wollen die Zusammenarbeit und Beratung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat noch weiter stärken. Wir sind einerseits zutiefst davon überzeugt, dass das deutsche System der Trennung von Unternehmensleitung und -kontrolle beste Voraussetzungen für gute Corporate Governance bietet. Andererseits erreichen wir unsere Ziele nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Beratung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Deshalb werden wir das positive Klima offener Gespräche im gegenseitigen Respekt weiter fördern.
- Die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden ist nur mit fähigen und engagierten Menschen möglich. Vorstand und Aufsichtsrat sehen es als gemeinsame Aufgabe an, die größten Talente für das Unternehmen zu gewinnen und zu halten.

Ständige Überprüfung des Regelwerks

Vorstand und Aufsichtsrat sowie Führungskräfte sorgen dafür, dass unser Corporate Governance-Regelwerk aktiv im Unternehmen gelebt wird. Wir werden es auch ständig überprüfen und weiterentwickeln. Damit wollen wir die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben – und zu den Unternehmen mit der besten Corporate Governance gehören.

Wichtiger Hinweis:

Dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (Lagebericht) sollte im Zusammenhang mit den Konzernfinanzdaten und den Konzernanhangsangaben, die an anderer Stelle stehen, gelesen werden. Die geprüften Konzernabschlüsse basieren auf einer Reihe von Annahmen, die detaillierter in den Konzernanhangsangaben 1 (Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung) und 2 (Bilanzierung und Bewertung) dargestellt sind.

Da die Infineon Technologies AG („Infineon“ oder die „Gesellschaft“) Teil des konzernweiten Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Marketingnetzwerks ist, wird der Lagebericht der Infineon Technologies AG mit dem des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

Dieser Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Planungen, Annahmen und Schätzungen beruhen. Zukunftsaussagen sind immer nur für den Zeitpunkt gültig, an dem sie gemacht werden. Infineon übernimmt keine Verpflichtung, diese beim Auftreten neuer Informationen zu überarbeiten. Zukunftsaussagen unterliegen immer Risiken und Unsicherheiten. Wir möchten Sie diesbezüglich deutlich darauf hinweisen, dass eine Reihe von Faktoren die tatsächlichen Ergebnisse dahingehend beeinflussen können, dass diese von den prognostizierten wesentlich abweichen. Einige dieser Faktoren sind im Abschnitt „Risiken und Chancen“ und in weiteren Bereichen in diesem Bericht beschrieben.

Grafiken und Schaubilder, einschließlich der Kommentierung, dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil dieses Lageberichts.

Die Infineon Technologies Aktiengesellschaft entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie in Chipkarten, eingesetzt. Unser Leistungsspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Lösungen für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Unsere Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika. Das Geschäftsjahr von Infineon endet zum 30. September.

Signifikante Entwicklungen während des Geschäftsjahrs 2002

Überblick

Infineon bewegte sich im Jahr 2002 in einem schwierigen Marktumfeld, das durch eine schwache Weltwirtschaft, einen deutlich anhaltenden Abschwung des Halbleitermarkts und starken Preisdruck in fast allen unseren Segmenten, insbesondere bei Speicherprodukten, gekennzeichnet war. Nachstehend folgt ein kurzer Überblick über wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2002:

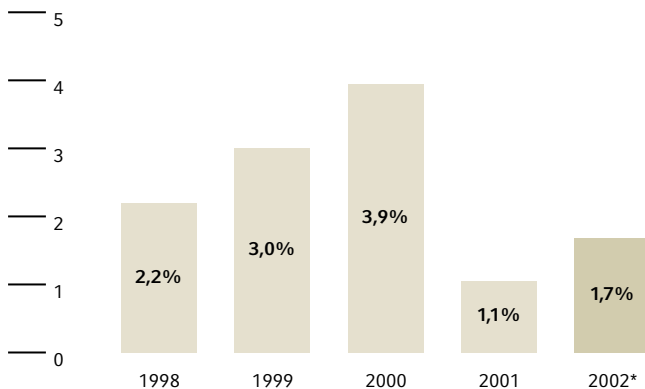
- Rückgang bei Umsatz und EBIT, Verbesserung bei Speicherprodukten
- Infineon gewinnt Marktanteile
- deutliche Verbesserung der Liquidität
- erfolgreiche Umsetzung des Kostensenkungsprogramms „Impact“
- Start des Prozessoptimierungsprojekts „Impact2“
- Rationalisierung des Einkaufs
- kontinuierliche Investitionen in die Entwicklung innovativer Produkte
- weitere Vereinbarungen zu strategischen F&E-Partnerschaften
- Erwerb von Ericsson Microelectronics stärkt Mobilfunkgeschäft
- neue strategische Allianzen
- Optimierung des Beteiligungsportfolios durch Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten
- kontinuierliche Verbesserung der Fertigung

Ungünstige Weltwirtschaftsbedingungen

Nach dem weit gefassten Abwärtstrend der Weltwirtschaft im Kalenderjahr 2001 und den tragischen Geschehnissen am 11. September 2001 wies die US-Wirtschaft im ersten Quartal dieses Kalenderjahrs ein überraschend hohes Wachstum auf, so dass sich zunächst Optimismus über die Stärke des Konjunkturaufschwungs verbreitete. Ökonomische Frühindikatoren gaben in den ersten Monaten des Jahres Anlass, von einem Anhalten dieses Aufschwungs auszugehen. Auf Grund der engen globalen Verflechtungen hatte das deutliche Anspringen der US-Konjunktur auch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den anderen Regionen zur Folge, insbesondere im asiatischen und pazifischen Raum. Das Konjunkturwachstum in den USA ließ jedoch im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres nach, die anfängliche Euphorie war verflogen und wurde von Konjunkturpessimismus und der Angst vor einem „double dip“ verdrängt. Die Weltwirtschaft war während des Jahres

Weltwirtschaftswachstum

in %



Stand: Oktober 2000

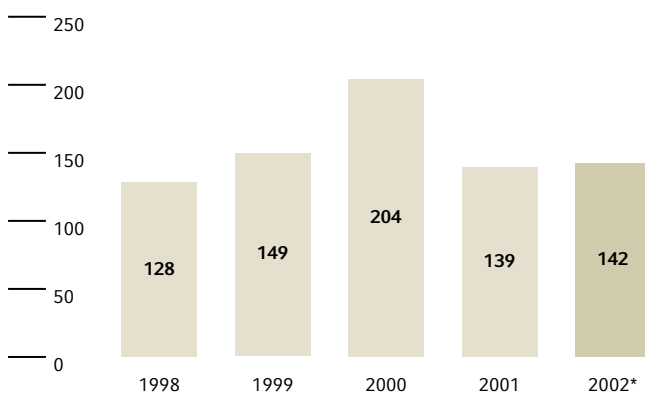
* geschätzt

Quelle: Internationaler Währungsfonds

Das Weltwirtschaftswachstum kann auch 2002 noch keine entscheidenden Wachstumsimpulse für den Halbleitermarkt geben.

Halbleitermarkt

in Mrd. US-Dollar



Stand: Oktober 2000

* geschätzt

Quelle: WSTS

Nach dem schwersten Einbruch des Halbleitermarkts in 2001 befinden sich Nachfrage und Preise weiterhin auf tiefem Niveau.

durch eine Flaute der Absatzmärkte für Telekommunikationsprodukte und PCs gekennzeichnet, die mit erheblichen Investitionsrückgängen, insbesondere in der Telekommunikationsbranche, einherging; auch das Zinsniveau gab nicht ausreichend Impulse zur Verbesserung der Situation. Das für 2002 vom Internationalen Währungsfonds erwartete Weltwirtschaftswachstum fällt mit 1,7%, nach 1,1% in 2001, wieder zu gering aus, um entscheidende Wachstumsimpulse für den Halbleitermarkt geben zu können.

Weiterhin schwierige Bedingungen und starker Preisdruck auf dem Halbleitermarkt

Im Kalenderjahr 2001 hat die Halbleiterbranche nach Angaben der WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) mit 32% gegenüber dem Kalenderjahr 2001 den schwersten Einbruch in ihrer Geschichte erfahren. Im Kalenderjahr 2002 befinden sich Nachfrage und Preise auf einem anhaltend tiefen Niveau. So fiel beispielsweise der Preis für 128-Megabit-DRAM-Bausteine von 15,00 US-Dollar im September 2000 auf 1,45 US-Dollar im September 2001. Gegen Ende des Kalenderjahrs 2001 stiegen die Preise an; erreichten ihren Höhepunkt im März 2002, um bis September 2002 wieder auf 1,61 US-Dollar zurückzugehen. Ende Oktober 2002 sagte die WSTS ein verhaltenes Wachstum von nur 2,3% für das Kalenderjahr 2002 voraus. Vor allem der Bereich der Nicht-Speicherprodukte (Logikchips, analoge, diskrete und optische Komponenten), der 81% des Gesamtmarkts entspricht, soll im Vergleich zu 2001 nur um etwa 1% zunehmen.

Die verbleibenden 19% des Halbleitermarkts werden abgedeckt durch den Bereich der Speicherprodukte, der DRAMs, SRAMs und nichtflüchtige Speicher (z. B. Flash-Memories) umfasst. Für dieses Segment sagt die WSTS ein Wachstum von circa 10% gegenüber dem Vorjahr vorher. Der geringe Anstieg der Nachfrage in 2002 wurde durch den Preisrückgang in den meisten Segmenten größtenteils kompensiert.

Rückgang bei Umsatz und EBIT, Verbesserung bei Speicherprodukten

Die anhaltend schwierigen Marktbedingungen im Geschäftsjahr 2002 schlagen sich in Umsatz und Ergebnis nieder. Unsere wesentlichen Finanzkennzahlen lauten wie folgt:

- Wir erzielten im Berichtsjahr 2002 Umsatzerlöse in Höhe von 5.207 Mio. Euro, was einem Rückgang um 8% entspricht (Vorjahr: 5.671 Mio. Euro).
- Unser Konzernjahresfehlbetrag beläuft sich im Geschäftsjahr 2002 auf 1.021 Mio. Euro, inklusive 275 Mio. Euro zusätzlicher Wertberichtigungen auf aktivierte latente Steuern im Vergleich zu 591 Mio. Euro im Vorjahr.
- Dies entspricht einem unverwässerten und verwässerten Verlust je Aktie von 1,47 Euro gegenüber 0,92 Euro im Geschäftsjahr 2001.
- Das Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern (EBIT) beläuft sich auf minus 1.142 Mio. Euro (Vorjahr: minus 1.024 Mio. Euro).
- Der operative Cash-Flow verbesserte sich auf 237 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 gegenüber 211 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001.

Eine detailliertere Erläuterung unserer Finanzdaten erfolgt im Abschnitt „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“.

Infineon gewinnt Marktanteile

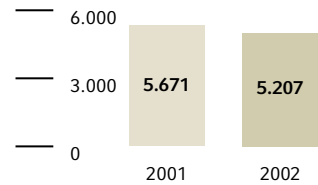
Trotz der schwierigen Situation, in der sich der Halbleitermarkt und damit die Halbleiterindustrie befindet, konnte Infineon seinen Anteil auf dem Weltmarkt erhöhen, obwohl die Umsätze in 2002 zurückgingen. Gemäß IC Insights, einem führenden US-amerikanischen Marktforschungsinstitut, konnte sich Infineon vom 8. Rang in 2001 auf den 6. Platz der weltweit umsatzstärksten Halbleiterhersteller im ersten Kalenderhalbjahr 2002 vorarbeiten.

Deutliche Verbesserung der Liquidität

Im Geschäftsjahr 2002 konnten wir unsere Liquidität durch mehrere Finanzierungsmaßnahmen sowie das Kostensenkungsprogramm Impact deutlich verbessern. Zunächst wurde eine syndizierte Kreditlinie über 450 Mio. Euro für die Erweiterung unserer Fertigungsstätte in Dresden abgeschlossen. Des Weiteren haben wir im Januar 2002 eine Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro begeben. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, wird mit nominal 4,25% verzinst und kann während der ersten drei Jahre nicht von Infineon gekündigt werden. Den Erlös aus der Emission werden wir zur Finanzierung unserer langfristigen Geschäftsstrategie verwenden.

Umsatzerlöse

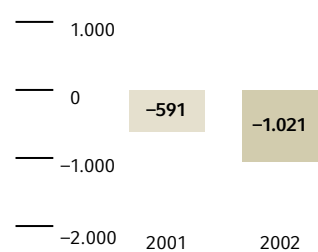
in Mio. Euro



Trotz rückläufiger Umsatzerlöse konnte Infineon im ersten Kalenderhalbjahr 2002 Marktanteile hinzugewinnen.

Konzernjahresfehlbetrag

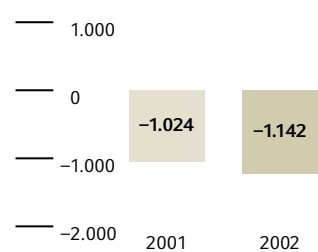
in Mio. Euro



Der Konzernjahresfehlbetrag in 2002 war belastet mit Wertberichtigungen auf aktivierte latente Steuern in Höhe von 275 Mio. Euro.

EBIT

in Mio. Euro



Die anhaltend schwierigen Marktbedingungen im Geschäftsjahr 2002 schlagen sich deutlich im EBIT nieder.

Erfolgreiche Umsetzung des Kostensenkungsprogramms „Impact“

Angesichts der anhaltenden Schwäche des Technologiesektors, sinkender Nachfrage und starken Preisdrucks führten wir im Juli 2001 ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm – „Impact“ – ein. Dieses Programm war dazu bestimmt, die Beschaffungs- und Logistikprozesse zu rationalisieren sowie die IT-, Overhead- und Herstellungskosten zu senken. Die Ziele waren, die Betriebskosten im Geschäftsjahr 2002 um mehr als 1 Mrd. Euro und die cash-wirksamen Ausgaben um 1,5 Mrd. Euro zu senken, bei gleichzeitiger Reduzierung des Mitarbeiterstamms um 15%. Das Kostensenkungsprogramm war ein voller Erfolg. Deutliche Ausgabenreduzierungen konnten erreicht werden durch:

- Reduzierung der Gemeinkosten,
- Effizienzverbesserung in der Beschaffung,
- Optimierung unserer Logistikprozesse,
- Reduzierung der Investitionen zur Verbesserung der Finanzsituation, wobei der Zugang zu führender Produktionstechnologie durch strategische Partnerschaften erhalten bleibt,
- Verbesserung der operativen Produktivität sowie
- Fokussierung der F&E-Aufwendungen.

Die Verkleinerung unseres Mitarbeiterstamms wurde im Geschäftsjahr 2002 abgeschlossen. Durch das Kostensenkungsprogramm entstanden uns im Geschäftsjahr 2001 Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 117 Mio. Euro, im Geschäftsjahr 2002 fielen durch weiter gehende Maßnahmen nochmals Aufwendungen in Höhe von 16 Mio. Euro an.

Start des Prozessoptimierungsprogramms „Impact²“

Das im Geschäftsjahr 2002 neu gestartete Prozessoptimierungsprogramm „Impact²“ zielt darauf ab, unser Unternehmen noch schneller, effizienter und flexibler zu machen. Hierbei wird die Grundlage geschaffen werden, uns in unserem harten Wettbewerbsumfeld als Innovations- und Kostenführer aufzustellen und damit zu den besten und erfolgreichsten Halbleiterunternehmen zu gehören.

Rationalisierung des Einkaufs

Der Geschäftsverlauf und das Kostenreduzierungsprogramm Impact hatten erheblichen Einfluss auf unser Einkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2002.

Dieses belief sich im Berichtsjahr auf 2,6 Mrd. Euro und lag damit um ca. 23% unter dem Wert des Vorjahrs und entspricht ca. 50% unseres Umsatzes. Gesunkene Bezüge von Materialien (minus 17% gegenüber Vorjahr) und reduzierter Einkauf von Produkten bei Auftragsfertigungen (minus 32% gegenüber Vorjahr) waren die wesentlichen Gründe für diesen Rückgang.

Im Geschäftsjahr 2002 konnten wir deutliche Einsparungen durch die Konzentration auf einige wesentliche Zulieferer und konzernweite Zusammenfassung von Aufträgen realisieren. Der Einsatz von gebrauchten statt neuen technischen Anlagen, wo angebracht, und die Vereinfachung von technischen Anforderungen brachten weitere Einsparungen. Durch diese Maßnahmen konnten erhebliche Kostensenkungen erzielt werden.

Weiterhin führten wir interne Benchmark-Untersuchungen unserer Einkaufsprozesse sowohl gegenüber Mitbewerbern als auch gegenüber anderen Branchen durch. Als Ergebnis dieser Untersuchungen haben wir unsere Einkaufsprozesse teilweise umgestellt und implementieren weitere Verbesserungen, insbesondere bei Zukäufen von Verwaltungsdienstleistungen. Auch zukünftig werden wir Benchmark-Untersuchungen durchführen, um zusätzliche Verbesserungen und Einsparungen zu identifizieren und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu gewährleisten.

Kontinuierliche Investitionen in die Entwicklung innovativer Produkte

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E), einschließlich der Aufwendungen für erworbene, nicht abgeschlossene Forschung und Entwicklung in Höhe von 37 Mio. Euro, beliefen sich im Geschäftsjahr 2002 auf insgesamt 1.060 Mio. Euro. Als Teil unseres Impact-Programms richten sich unsere Bestrebungen hauptsächlich auf die Entwicklung neuer innovativer Produkte für unsere Kerngeschäftsbereiche. Größere Erfolge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu verzeichnen waren, sind unter anderem:

- neue Chips für Telematik und Steuerungen in Autos,
- neue auf 32-Bit-Controllern basierende Chipkarten- und Sicherheitsprodukte,
- Chips für optische 10-Gbit/s- und 40-Gbit/s-Netzwerke,
- eine neue Generation von Produkten für mobile Übertragungstechniken wie Bluetooth, GPRS- und 3G-Lösungen sowie
- fortschrittliche Speicherprodukte wie 256-Megabit Mobile-RAM in 140 Nanometern, 256-Megabit RDRAM in 170-Nanometer-embedded-DRAM-Technologie, konzeptionelles Design von CellularRAM und 128-SGRAM in 140 Nanometern mit DDR II-Funktionalität.

Die beträchtlichen Investitionen in Produktionstechnologien zur Halbleiterfertigung sowie von Bibliotheken, Werkzeugen, Software und Methodiken, die wir für die Entwicklung von Spitzenprodukten benötigen, behielten wir auch im vergangenen Geschäftsjahr bei.

Nahezu 5.400 Mitarbeiter werden in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit unseres Unternehmens eingesetzt. Der Großteil beschäftigt sich unmittelbar mit der Produktentwicklung in unseren fünf Geschäftsbereichen. Daneben ist ein zentraler F&E-Bereich verantwortlich für die Entwicklung von Basistechnologien, die von allen anderen Geschäftsbereichen genutzt werden. Das Prozesstechnologie-Entwicklungsteam ist ein gutes Beispiel und zeigt, wie Synergien maximiert werden können. Zusätzlich unterhalten wir eine hoch qualifizierte Forschungsabteilung, die für Grundlagenforschung in Zukunftsthemen verantwortlich ist.

Unsere Forschungsgruppe hat im Geschäftsjahr 2002 weltweit Aufmerksamkeit durch den Weltrekord der bisher höchsten Signalfrequenz mit einer Standardtechnologie sowie weitere herausragende Ergebnisse, wie auf dem Gebiet der Nanotube-Technologie, auf sich gezogen.

Im Rahmen unseres Kostensenkungsprogramms Impact haben wir eine umfassende Analyse des gesamten Portfolios unserer Entwicklungsprojekte durchgeführt. Anhand dieser Ergebnisse wurden unsere Anstrengungen auf die erfolgversprechendsten Entwicklungsprojekte konzentriert und in einigen Fällen bestimmte Projekte und Technologien aufgegeben, wie etwa Ardent. Darüber hinaus optimierten wir unsere Entwicklungsprozesse, um unsere Entwicklungszyklen weiter zu verkürzen und die Qualität nochmals zu steigern.

Weitere Vereinbarungen zu strategischen F&E-Partnerschaften

Unsere strategischen F&E-Partnerschaften mit anderen führenden Halbleiter- und Technologieunternehmen haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter intensiviert. Diese Partnerschaften dienen dazu, unseren Wettbewerbsvorteil durch effektivere Entwicklung neuer Technologien, schnellere Marktreife der Produkte sowie eine Teilung von Risiken und Kosten zu gewährleisten. So sind wir beispielsweise für die Entwicklung neuer Herstellungstechnologien für System-on-Chip-Produkte auf 300-Millimeter-Wafern eine Partnerschaft mit United Microelectronics Corporation („UMC“), Taiwan, und Advanced Micro Devices Inc. („AMD“), USA, eingegangen. Für die Entwicklung von neuen DRAM-Technologien stehen wir kurz vor dem Abschluss einer Allianz mit Nanya Technology Corporation („Nanya“), Taiwan (siehe auch unter Ereignisse nach dem Bilanzstichtag).

Erwerb von Ericsson Microelectronics stärkt Mobilfunkgeschäft

Am 9. September 2002 vollzogen wir die Akquisition der Ericsson Microelectronics AB („MIC“) für 327 Mio. Euro. Mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, ist MIC sowohl ein strategischer Zulieferer für Ericsson bei Bluetooth-Lösungen sowie Hochfrequenz-Bauteilen für Mobiltelefone und drahtlose Infrastruktur als auch ein Hersteller von Hochfrequenz-Mikroelektronikbauteilen für Mobilfunkapplikationen, High-End-Leistungsverstärker, Bluetooth-Bauteile und Breitband-Kommunikationsprodukte. Im Zusammenhang mit dieser Akquisition erwarb Infineon Vermögensgegenstände von Ericssons Mikroelektronikgeschäft einschließlich nicht abgeschlossener F&E-Projekte in Höhe von 37 Mio. Euro. Ferner vereinbarten wir eine strategische Liefervereinbarung mit Ericsson über Mobilfunklösungen für eine Laufzeit von zwei Jahren. Infineon glaubt, durch die Akquisition von MIC seine Marktposition als führender Anbieter von Bluetooth-ICs weiter stärken zu können. Durch die Kombination der starken Position von MIC mit unserer Leistungsfähigkeit beim Design und bei der Produktion können wir optimierte, kostengünstige Komponenten anbieten sowie die Einführungszeiten von neuen Produkten wesentlich verkürzen.

Neue strategische Allianzen

Winbond: DRAM-Technologien

Im Geschäftsjahr 2002 lizenzierten wir unsere hoch entwickelte DRAM-Trench-Technologie an Winbond Electronics Corp. („Winbond“), Hsinchu, Taiwan, und werden das exklusive Abnahmerecht für die ab dem Jahr 2003 von Winbond mit dieser Technologie hergestellten Standard-Speicherchips erhalten. Wir vereinbarten zusätzlich ein festgelegtes Abnahmevermögen von DRAM-Produkten und die Belieferung eines Großkunden von Winbond.

Nanya: 300-Millimeter-Chip-Produktion

Im Mai 2002 unterzeichneten wir ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MoU) mit Nanya über eine Zusammenarbeit bei Standard-DRAM-Speicherchips. Im Rahmen dieser Abmachung werden wir die zukunftsweisenden 0,09-Mikrometer- und 0,07-Mikrometer-Fertigungstechnologien auf 300-Millimeter-Wafern gemeinsam entwickeln und dabei die Entwicklungskosten teilen. Zudem haben wir mit Nanya vereinbart, ein Joint Venture für die Fertigung von DRAM-Chips zu gründen und ein neues gemeinsames 300-Millimeter-Werk in Taiwan zu bauen. Der Start der Produktion auf den ersten 300-Millimeter-Wafern ist für das Ende des Kalenderjahrs 2003 vorgesehen. In der ersten Ausbaustufe soll die Fertigung im zweiten Kalenderhalbjahr 2004 eine Kapazität von rund 20.000 Waferstarts pro Monat erzielen, von denen uns die Hälfte zusteht (siehe auch unter Ereignisse nach dem Bilanzstichtag).

AMD, DuPont: Advanced Mask Technology Center

Im Mai 2002 gaben Infineon, AMD sowie DuPont Photomasks Inc. („DuPont“), USA, die Absicht bekannt, gemeinsam die Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG („AMTC“) zu errichten und zu betreiben. AMTC wird eine Anlage für fortgeschrittene Fotomasken in Dresden aufbauen, um die nächste Generation von Halbleitern mit erweiterter Funktionalität bei kleinerem Ausmaß zu entwickeln. Die Fertigstellung des Maskenzentrums wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2003 abgeschlossen sein. In dem Maskenzentrum werden lithographische Masken der nächsten Generationen, mit denen Siliziumscheiben (Wafer) belichtet werden, entwickelt und in Pilotstückzahlen hergestellt. Ebenso schlossen wir mit DuPont eine Liefervereinbarung über 10 Jahre ab, welche das Produktionsvolumen der Dresdner Fertigung berücksichtigt.

Agere, Motorola: StarCore-DSP-Technologien

Im Oktober 2002 gründeten wir in Kooperation mit Agere Systems Inc. („Agere“), USA, und Motorola Inc. („Motorola“), USA, das Gemeinschaftsunternehmen StarCore, LLC („StarCore“). Diese neue Gesellschaft wird leicht skalierbare Digitalsignalprozessor-Cores (DSP-Cores), basierend auf der etablierten StarCore®-DSP-Architektur, für den Einsatz in zahlreichen Kommunikations- und Unterhaltungselektronikprodukten, z. B. Mobilfunktelefonen, entwickeln und vermarkten. StarCore hat ihren Hauptsitz in Austin, Texas, USA, und eine Niederlassung in Tel Aviv, Israel. Hauptkunden werden zunächst Agere, Infineon und Motorola sein. Daneben wird StarCore seine Produkte künftig anderen Halbleiter- und Kommunikationssystemherstellern weltweit zur Verfügung stellen. Das neue Unternehmen wird voraussichtlich den Betrieb im Geschäftsjahr 2003 aufnehmen.

Das Resultat der oben beschriebenen vier neuen Allianzen ist, dass wir einen wesentlich höheren Zugriff auf Produktionskapazitäten von DRAM-Speichern und ähnlichen Produkten gemäß dem neuesten Stand der Technik sowie auf zukünftige Technologieentwicklung haben werden, während der Bedarf an Investitionen und Kosten in Verbindung mit Kapazitäten und Entwicklungsaktivitäten verringert wird.

Optimierung des Beteiligungsportfolios durch Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten

Um uns verstärkt auf unser Kerngeschäft zu fokussieren, bewerten wir fortwährend unser Produktportfolio neu und haben im Geschäftsjahr 2002 bestimmte Aktivitäten veräußert, die nicht zum Kerngeschäft zählen. Dabei haben wir insgesamt Erlöse in Höhe von 96 Mio. Euro und einen Gewinn von 41 Mio. Euro vor Steuern erzielt, welcher in „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesen wird.

Im Dezember 2001 schlossen wir den Verkauf unseres Infrarotkomponenten-Geschäfts, welches früher Bestandteil der sonstigen Geschäftsbereiche war, an Vishay Intertechnology Inc., Hillboro, Oregon, USA, mit einem Netto-Gewinn vor Steuern in Höhe von 39 Mio. Euro ab.

Im Juli 2002 veräußerten wir für einen vorläufigen Erlös von 50 Mio. Euro unser Gallium-Arsenid-Geschäft, welches früher Bestandteil des Bereichs Mobile Kommunikation war, an TriQuint Semiconductor Inc., USA. Der vorläufige Erlös kann, basierend auf gewissen Eventualitäten unter Berücksichtigung der durch den Käufer bis zum 30. September 2004 erzielten Umsatzerlöse mit Gallium-Arsenid-Produkten, angepasst werden. Der angepasste Kaufpreis bewegt sich zwischen 45 Mio. Euro und 124 Mio. Euro. Jegliche Kaufpreisanpassung wird einmalig nach Eintreten der Bedingungen erfolgswirksam vereinnahmt. Wir vereinbarten weiterhin mit dem Käufer, für ein Jahr Service- und Fertigungsleistungen zu übernehmen.

Kontinuierliche Verbesserung der Fertigung

Wie die gesamte Halbleiterindustrie mussten auch wir im Geschäftsjahr 2001 und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2002 einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Logikchips verzeichnen, der zu Unterauslastung in unseren Nicht-Speicherfertigungen führte. Während der verminderten Auslastung wurden die Fertigungskosten durch Schichtreduzierungen, Maschinenstilllegungen und generelle Kostensenkungsmaßnahmen konsequent reduziert. Darüber hinaus wurde ein Teil der Überkapazitäten gezielt für Entwicklungsprojekte und Projekte zur Erhöhung der Fertigungsflexibilität zwischen den Werken genutzt. Gestiegene Nachfrage führte in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2002 zu einer Normalisierung der Auslastung unserer Produktionsstätten. In unseren Speicherwerken war die vorhandene Kapazität im Geschäftsjahr 2002 hingegen durchweg voll produktiv genutzt.

Zur Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit führten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr einige Schlüsselprojekte durch. So wurden die 300-Millimeter-Speicherfertigungen in unserem Werk in Dresden und bei unserem Joint Venture ProMOS in Taiwan im ersten bzw. zweiten Quartal des Geschäftsjahrs auf Basis der 0,14-Mikrometer-Technologie qualifiziert; der Hochlauf bis zur vollen Kapazität wird für beide Anlagen bis Ende des Geschäftsjahrs 2003 erwartet.

Wir haben kürzlich jedoch die Aktionärsvereinbarung über ProMOS gekündigt und könnten dadurch den Zugang zu den Fertigungskapazitäten dieser Produktionsanlage verlieren.

Abhängig von der Marktentwicklung werden wir im Geschäftsjahr 2003 den Bau unserer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Richmond, USA, fortführen. Ebenfalls für das Geschäftsjahr 2003 planen wir, unsere Speicherproduktion sowohl auf 200-Millimeter- als auch auf 300-Millimeter-Wafern sukzessive auf die 0,11-Mikrometer-Technologie umzustellen. Darüber hinaus erwarten wir, dass unsere Fertigungsallianzen mit Winbond und Nanya im Geschäftsjahr 2003 operativ wirksam werden.

Die 300-Millimeter-Logikchip-Fertigung unseres Joint Ventures UMCi in Singapur wird gemeinsam mit UMC errichtet, an dem wir 30% der Kapazität erhalten werden. Wir erwarten den Produktionsstart mit der Prozessqualifikation der 0,13-Mikrometer-Technologie im Kalenderjahr 2004.

Investitionen/Desinvestitionen in Mio. Euro*



* ohne Wertpapiere

** inkl. Verkauf Opto-JV

Deutlich reduzierte Investitionen in Sachanlagen fokussiert auf Fertigungsoptimierung und dem Ausbau des technologischen Vorsprungs bei der 300-Millimeter-Technologie.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen und Regionen sowie das EBIT nach Geschäftsbereichen (Segmentdaten):

(in Mio. Euro, außer Prozentsätze)

	Geschäftsjahr zum 30. September ¹					
	2000		2001		2002	
Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen²	%		%		%	
Drahtgebundene Kommunikation	661	9	766	14	386	7
Mobile Kommunikation	1.191	16	960	17	874	17
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	375	5	588	10	421	8
Automobil- und Industrieelektronik	923	13	1.153	20	1.201	23
Speicherprodukte	3.473	48	1.588	28	1.844	35
Sonstige Geschäftsbereiche	570	8	560	10	434	8
Konzernfunktionen	90	1	56	1	47	1
Gesamt	7.283	100	5.671	100	5.207	100
Umsatzerlöse nach Regionen	%		%		%	
Deutschland	1.612	22	1.745	31	1.372	26
Übriges Europa	1.647	23	1.260	22	1.023	20
USA	1.814	25	1.262	22	1.211	23
Asien/Pazifik	2.100	29	1.309	23	1.512	29
Andere	110	1	95	2	89	2
Gesamt	7.283	100	5.671	100	5.207	100
EBIT^{2,3}						
Drahtgebundene Kommunikation	48		-93		-245	
Mobile Kommunikation	258		-178		-82	
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	49		27		-52	
Automobil- und Industrieelektronik	71		143		111	
Speicherprodukte	1.336		-931		-616	
Sonstige Geschäftsbereiche	28		188		6	
Konzernfunktionen ⁴	-120		-180		-264	
Gesamt	1.670		-1.024		-1.142	

Anmerkungen

¹ Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

² Zum 1. Oktober 2001 haben wir einige unserer Geschäftsbereiche reorganisiert, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Die Bereichsergebnisse der Jahre 2000 und 2001 wurden entsprechend umgestellt, so dass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahres entsprechen und die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen ermöglichen.

³ EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wird als das Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile und Steuern definiert.

⁴ Im Geschäftsjahr 2001 beinhalten die Konzernfunktionen nicht zugeordnete Leerkosten in Höhe von 27 Mio. Euro, Umstrukturierungsaufwendungen in Höhe von 117 Mio. Euro und zentrale Informationstechnologiekosten in Höhe von 71 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2002 beinhalten die Konzernfunktionen nicht zugeordnete Leerkosten in Höhe von 211 Mio. Euro, Umstrukturierungsaufwendungen in Höhe von 16 Mio. Euro und zentrale Informationstechnologiekosten in Höhe von 36 Mio. Euro.

Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Ergebnispositionen der Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Umsatz¹:

	Geschäftsjahr zum 30. September ²		
	2000	2001	2002
Umsatzerlöse	100,0%	100,0%	100,0%
Umsatzkosten	-56,4	-86,5	-88,5
Bruttoergebnis vom Umsatz	43,6	13,5	11,5
Forschungs- und Entwicklungskosten	-14,1	-21,0	-20,4
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-9,2	-13,9	-12,3
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-2,1	-0,3
Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), Saldo	0,0	3,5	0,9
Betriebsergebnis	20,3	-19,8	-20,6
Zinsergebnis, saldiert mit Zuschüssen	1,0	0,0	-0,5
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	1,4	0,4	-0,9
Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	0,7	0,2	0,3
Sonstige Erträge, Saldo	0,5	1,1	-0,8
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	0,0	0,1	0,1
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23,9	-18,0	-22,3
(Aufwendungen) Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8,4	7,6	2,7
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	15,5%	-10,4%	-19,6%

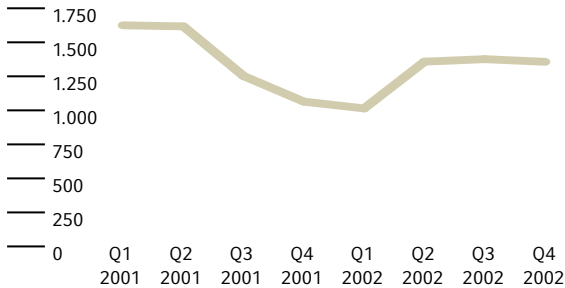
Anmerkungen

¹ Alle Angaben in %.

² Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

Umsatz nach Quartalen

in Mio. Euro



Die Umsatzerlöse konnten im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 kontinuierlich gesteigert werden, gingen jedoch im vierten Quartal auf Grund der gesunkenen Speicherpreise wieder zurück.

Vergleich der Geschäftsjahre 2002 und 2001

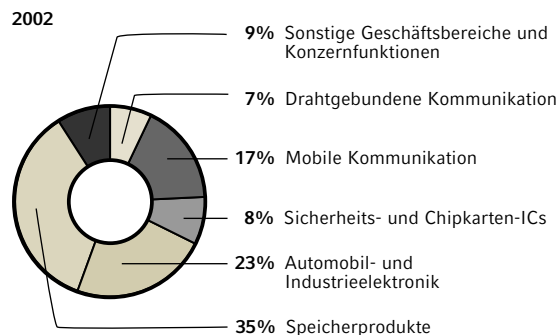
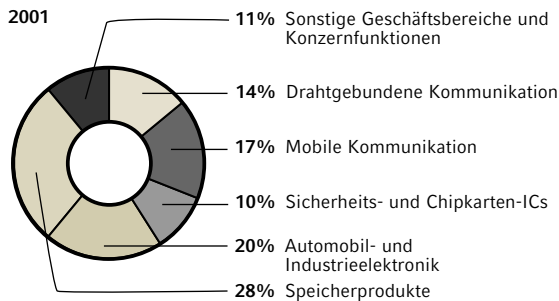
Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Geschäftsjahr 2001 um 8% von 5.671 Mio. Euro auf 5.207 Mio. Euro. Die niedrigeren Umsatzerlöse in den Geschäftsbereichen Drahtgebundene Kommunikation, Mobile Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs wurden verursacht durch den dramatischen Rückgang der Investitionen von global operierenden Telekommunikationsanbietern, Nachfrageschwäche und großen Preisdruck. Durch höhere Umsätze in den Bereichen Speicherprodukte und Automobil- und Industrieelektronik konnte der Rückgang zumindest teilweise ausgeglichen werden. Im Geschäftsjahr 2002 stellten Speicherprodukte 35% unseres Gesamtumsatzes dar, gegenüber 28% im Vorjahr. Während der ersten drei Quartale im Geschäftsjahr 2002 stiegen die Speicher-Umsatzerlöse kontinuierlich, sanken im vierten Quartal jedoch auf Grund des Rückgangs der Preise für Speicherprodukte wieder.

Nachfolgend wird der Vergleich der Umsatzerlöse der Geschäftsjahre 2002 und 2001 in den verschiedenen Geschäftsbereichen beschrieben:

Umsatzerlöse nach Segmenten

in %



Dem deutlichen Umsatzrückgang bei Drahtgebundene Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs stehen deutliche Steigerungen bei Speicherprodukten gegenüber.

I Drahtgebundene Kommunikation – Die Umsatzerlöse im Bereich Drahtgebundene Kommunikation verringerten sich um nahezu 50% von 766 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 auf 386 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002. Die Umsätze fielen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2001. Nach einer Talsohle im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2002 konnte in den nachfolgenden Quartalen ein stetiges Wachstum erreicht werden.

Der Umsatzrückgang im Jahresvergleich wurde hauptsächlich durch einen dramatischen Abschwung des Absatzmarkts für Glasfaser-Technologien sowie in traditionellen Telekommunikationssegmenten wie ISDN, analoger Technologie, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen und unternehmensinternem Telefonverkehr hervorgerufen. Als Folge des außergewöhnlichen Aufschwungs der Telekommunikationsbranche im Kalenderjahr 2000 waren im abgelaufenen Geschäftsjahr – insbesondere in Europa und den USA – Markteinbrüche zu beobachten. Der Absatzmarkt für Glasfaser-Technologien erfuhr einen stärkeren Einbruch als der traditionelle Telekommunikationsmarkt, unsere Umsatzerlöse im Glasfaser-Bereich gingen um etwa 30% zurück. Diese dramatischen Umsatzeinbrüche in den traditionellen Marktsegmenten wurden jedoch durch die erhöhte Marktdurchdringung unserer VDSL/10BaseS- und xDSL-Technologien – insbesondere auf den Absatzmärkten im asiatischen und pazifischen Raum – teilweise ausgeglichen.

Mobile Kommunikation – Die Umsatzerlöse des Bereichs Mobile Kommunikation reduzierten sich im Geschäftsjahr 2002 um insgesamt 9% von 960 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 auf 874 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002, hauptsächlich auf Grund niedrigerer Preise, vor allem bei Basisband-Produkten.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2001 sanken die Umsätze immer weiter ab, nachdem die Nachfrage nach Mobiltelefonen zurückging und auf Grund hoher Lagerbestände in den Vertriebskanälen. Der Tiefststand war im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2001 erreicht. Seitdem stiegen die Umsatzerlöse wieder von Quartal zu Quartal. Diese Steigerung ist überwiegend auf ein erhöhtes Volumen, im Wesentlichen für diskrete und Bluetooth-Produkte, zurückzuführen. Dies konnte jedoch nicht die Effekte der auf Grund des starken Preisdrucks im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Durchschnittspreise ausgleichen.

Sicherheits- und Chipkarten-ICs – Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Sicherheits- und Chipkarten-ICs sanken um 28% von 588 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 auf 421 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002. Ein im Vergleich zum Vorjahr niedrigeres Preisniveau, insbesondere bei ICs für SIM-Karten, sowie ein durch die allgemeine Marktschwäche resultierender Rückgang der verkauften Stückzahlen verursachten diese Entwicklung. Unabhängig davon war es jedoch über das Geschäftsjahr hinweg möglich, die Umsatzerlöse kontinuierlich quartalsweise zu steigern. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch verstärkte Umsätze mit Anwendungen für Bank- und Sicherheitskarten erreicht, dennoch bleibt der Wettbewerb weiterhin intensiv.

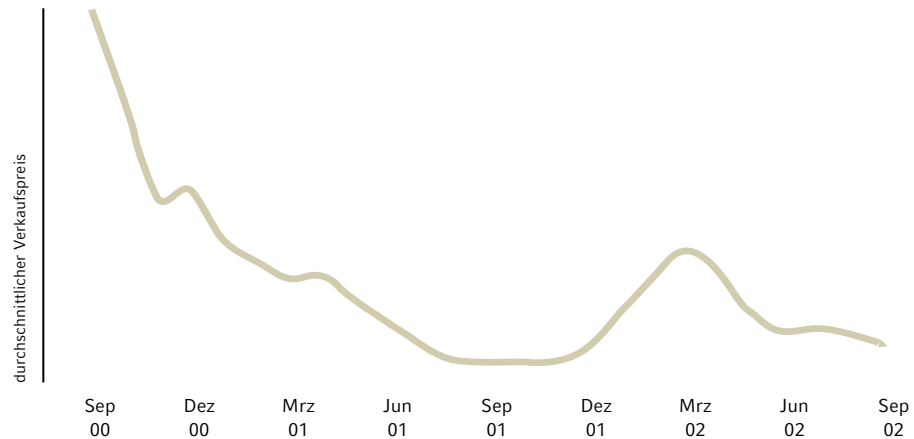
Automobil- und Industrieelektronik – Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik konnte seine Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 4% von 1.153 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 auf 1.201 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 steigern. Der Umsatz konnte auf Quartalsbasis kontinuierlich im Geschäftsjahr gesteigert werden. Die Umsatz-erhöhung war überwiegend auf höheres Volumen, hauptsächlich für Leistungshalbleiter, zurückzuführen, teilweise kompensiert durch niedrigere Preise, im Wesentlichen bei Automobilanwendungen. Dieser Anstieg konnte trotz der weltweit gesunkenen Automobilproduktion auf Grund von Geschäftsausweitung in Asien mit Leistungshalbleiterlösungen und Leistungs-ICs realisiert werden.

Besonders hervorzuheben sind dabei deutliche Marktanteilsgewinne bei Automobilanwendungen (Position 2 weltweit; Position 1 in Europa), bei Hochleistungshalbleitern (IGBT-Module: 23% Marktanteil) sowie bei Power-Management-Lösungen. Hier konnten wir unsere Erfolge bei CoolMOS- und OptiMOS-Produkten fortsetzen.

Speicherprodukte – Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Speicherprodukte stiegen um 16% von 1.588 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 auf 1.844 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002. Das Volumen an verkauften Megabit im Geschäftsjahr 2002 erhöhte sich deutlich, während die Durchschnittspreise für DRAM über das Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr weiter fielen.

Das Absatzvolumen in Megabit erhöhte sich im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 erheblich, da die 256-Megabit-DRAM-Serienproduktion die 128-Megabit-Produktion überstieg und bereits 512-Megabit-Produkte auf dem Markt eingeführt wurden.

DRAM-Preisentwicklung



Diese Grafik dient der Veranschaulichung der Volatilität der Speicherpreise.

Diese Grafik ist Bestandteil des Lageberichts.

Die Preise für Speicherbausteine stiegen zunächst im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2002 auf mehr als das Doppelte, fielen in der zweiten Hälfte wieder deutlich ab, blieben jedoch am Ende des Geschäftsjahrs leicht über dem Niveau, das zu Beginn des Geschäftsjahrs herrschte. Gegen Ende des Geschäftsjahrs überstiegen für einige unserer Produkte die vollen Herstellkosten die Verkaufspreise. Die Preisunterschiede zwischen 128-Megabit- und 256-Megabit-DRAM, zwischen SDRAM- und DDR DRAM-Bausteinen sowie zwischen Termin- und Spot-Märkten schwankten im Jahresverlauf. Zum Geschäftsjahresende zeigten 128-Megabit- und 256-Megabit-Produkte pro Megabit nur geringe Preisdifferenzen, DDR DRAM-Produkte jedoch einen deutlichen Preisvorteil gegenüber SDRAM-Produkten. Wir sind weiterhin bestrebt, unser Angebot von DDR DRAM und SDRAM zu optimieren, um diese Preisdifferenzen auszunutzen, und werden unseren Fokus verstärkt auf High-End-Produkte wie 512-Megabit- und Spezial-DRAM-Bausteine legen. Hauptsächlich auf Grund höherer abgesetzter Stückzahlen reduzierte sich der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megabit im Geschäftsjahr 2002 um rund 30%.

Die Umsatzerlöse bei Festplatten-Controllern gingen im Vergleich zum Vorjahr auf Grund von Verzögerungen bei der Entwicklung und Einführung neuer Produkte weiter zurück.

Daneben wies der Geschäftsbereich Speicherprodukte Lizenzeinnahmen in Höhe von 147 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002 aus (Vorjahr 88 Mio. Euro).

Sonstige Geschäftsbereiche – Die Umsatzerlöse der Sonstigen Geschäftsbereiche sanken im Vergleich zum Vorjahr um 23% von 560 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 auf 434 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2002. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Verkauf unseres Infrarotkomponenten-Geschäfts im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2002 zurückzuführen. Unser Optoelektronik-Geschäft erwirtschaftete in den Geschäftsjahren 2001 und 2002 Umsätze in Höhe von 324 Mio. Euro und 316 Mio. Euro. Wir führen derzeit Gespräche mit OSRAM GmbH („OSRAM“) über den Rückzug aus unserem Optoelektronik-Geschäft Ende März 2003. Nach einem möglichen Ausstieg würde Infineon von OSRAM erworbene optoelektronische Produkte nicht mehr verkaufen.

Umsätze nach Region und Kunden

Bei einer Umsatzaufgliederung nach Regionen verzeichnet Europa mit 46% den größten Anteil im Geschäftsjahr 2002 im Vergleich zu 53% im Geschäftsjahr 2001. 54% des Gesamtumsatzes wurden außerhalb Europas erwirtschaftet (Vorjahr: 47%). Dies ist im Wesentlichen durch höhere Umsätze mit Speicherprodukten in den USA und im asiatischen und pazifischen Raum begründet.

Nur auf einen Kunden, den Siemens-Konzern, entfielen in den Geschäftsjahren 2001 und 2002 mehr als 5% der Umsatzerlöse des Unternehmens. Der Umsatz mit Siemens beinhaltet sowohl Direktverkäufe an den Siemens-Konzern in Höhe von 14% in 2001 bzw. 13% in 2002 als auch Verkäufe an die Siemens-Vertriebsorganisation zum Weiterverkauf an Drittkunden in Höhe von 2% bzw. 1% in den beiden Jahren. Die Umsätze an den Siemens-Konzern werden hauptsächlich durch die Geschäftsbereiche Mobile Kommunikation und Automobil- und Industrieelektronik getätigt.

Umsatzkosten

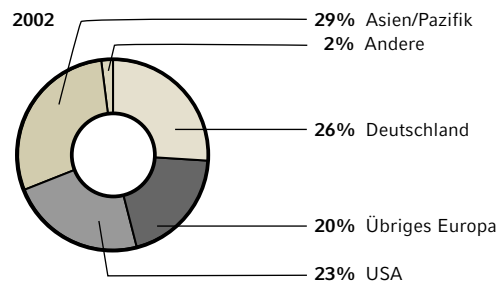
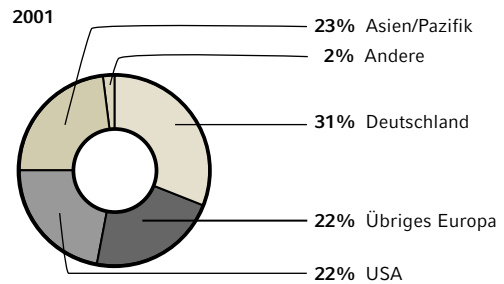
Die Umsatzkosten sanken im Geschäftsjahr 2002 um 6% auf 4.606 Mio. Euro (Vorjahr: 4.904 Mio. Euro).

Die Umsatzkosten im Verhältnis zum Umsatz verbesserten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2002 gegenüber den negativen Bruttomargen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2001, gingen aber in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2002 auf Grund des Preisdrucks bei Speicherprodukten wieder zurück. Im Geschäftsjahr 2001 haben wir in Folge des starken Preisverfalls und durch Auftragsstornierungen Bestandsabwertungen in Höhe von 358 Mio. Euro vorgenommen. Die Kosten für nicht genutzte Fertigungskapazitäten der Nicht-Speicherfertigungen haben eine Verbesserung der Bruttomarge in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2002 negativ beeinflusst. Dieser Trend kehrte sich durch das gestiegene Volumen der Kommunikationssegmente in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs um.

Im Vergleich der Geschäftsjahre 2001 und 2002 stiegen die Umsatzkosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen von 86% auf 88%. Das Bruttoergebnis vom Umsatz lag dementsprechend im Geschäftsjahr 2002 bei 12% (Vorjahr: 14%). Durch unsere Anstrengungen im Rahmen des Kosteneinsparungsprogramms Impact wurde der Rückgang der Umsatzerlöse durch Einsparungen und Produktivitätssteigerungen teilweise ausgeglichen.

Umsatzerlöse nach Regionen

in %



Durch die höheren Umsatzerlöse mit Speicherprodukten verschoben sich die Umsatzanteile in die Regionen USA und Asien/Pazifik.

Als prozentualer Anteil am Umsatz spiegeln sich in den Umsatzkosten der einzelnen Geschäftsbereiche folgende Entwicklungen wider:

I Drahtgebundene Kommunikation – ein relativer Anstieg der Umsatzkosten von 55% des Umsatzes im Geschäftsjahr 2001 auf 71%. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf einen deutlichen Rückgang des Absatzvolumens wegen des industrieweiten Nachfragerückgangs auf Grund gekürzter Investitionen von weltweit tätigen Telekommunikationsanbietern zurückzuführen. Durch diese Umsatzverminderung entstand eine geringere Fixkostendeckung, insbesondere bei unseren Standorten für Glasfaser-Anwendungen.

Die Umsatzkosten wurden durch eine strukturelle Änderung der Nachfrage gegenüber dem Vorjahr negativ beeinflusst. Dies ist zurückzuführen auf den dramatischen Nachfragerückgang bei traditionellen Telekommunikations- und Datenübertragungsprodukten, die einen hohen Deckungsbeitrag aufweisen, das Auslaufen eingeführter Produkte mit relativ geringen Produktionskosten sowie die Einführung neuer Produkte mit hohen Anlaufkosten.

I Mobile Kommunikation – eine relative Verringerung der Umsatzkosten auf 67% des Umsatzes von 79% im Geschäftsjahr 2001. Die Verbesserung resultiert aus Veränderungen im Produktmix, etwa der Einführung von profitableren Basisband-Produkten, und Ausbeutesteigerungen. Die Bruttomarge war im Geschäftsjahr 2001 von Bestandsabwertungen negativ beeinflusst.

I Sicherheits- und Chipkarten-ICs – ein relativer Anstieg von 66% im Geschäftsjahr 2001 auf 75% im Geschäftsjahr 2002. Die Bruttomarge wurde durch Leerkosten wegen niedriger Nachfrage und starken Preisdrucks, speziell bei SIM-Karten-ICs, negativ beeinflusst.

I Automobil- und Industrieelektronik – ein relativer Anstieg der Umsatzkosten auf 67% des Umsatzes im Vergleich zu 64% im Geschäftsjahr 2001. Obwohl der Umsatz eine Rekordmarke erreichte, wurde im Geschäftsjahr 2002 wegen starken Wettbewerbspreisdruks eine geringere Bruttomarge erzielt.

I Speicherprodukte – eine relative Verringerung der Umsatzkosten auf 106% im Vergleich zu 126% im Geschäftsjahr 2001. Dies ist hauptsächlich auf höhere Fertigungsproduktivität und Kostenreduzierungen, aber auch ein höheres Absatzvolumen zurückzuführen. Der Anstieg wurde teilweise ausgeglichen durch die rückläufigen Preise, insbesondere im vierten Quartal des Berichtsjahrs 2002. Im Geschäftsjahr 2001 war die Bruttomarge durch Wertberichtigungen auf Vorräte negativ beeinflusst.

Die Umsatzkosten der Konzernfunktionen stiegen im Geschäftsjahr 2002 von 84 Mio. Euro auf 272 Mio. Euro, was im Wesentlichen aus den im Vergleich zum Vorjahr höheren nicht zugeordneten Leerkosten resultiert.

Infineon weist die Kosten für die Materialbezüge von den Gemeinschaftsfertigungen ProMOS und ALTIS, und im Vorjahr auch von OSRAM Opto, unter den Umsatzkosten aus. Die Bezüge von diesen Fertigungen und von assoziierten und verbundenen Unternehmen beliefen sich im Berichtsjahr 2002 auf 686 Mio. Euro (Vorjahr: 1.040 Mio. Euro).

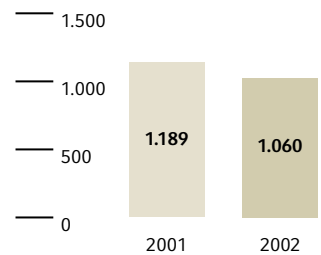
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

Im Berichtsjahr sanken die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um 11% auf 1.060 Mio. Euro (Vorjahr: 1.189 Mio. Euro). Dies ist auf einen allgemeinen Rückgang der Aufwendungen für F&E im Rahmen des Kostensenkungsprogramms Impact zurückzuführen. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung umfassen vor allem entwicklungs-spezifische Aufwendungen für Schlüsselmarkte und beinhalten im Wesentlichen Kosten für Personal, Lizenzgebühren, Laboreinrichtungen und Software. Weitere Aufwendungen fielen für die Entwicklung universell in den Produkten einsetzbarer Prozesskerne und Bibliotheken mit Grundsaltungen an. Die Aufwendungen für erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte unserer diesjährigen Akquisitionen betragen 37 Mio. Euro (Vorjahr: 69 Mio. Euro). Im Vergleich zu den Umsatzerlösen sanken die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung von 21% im Geschäftsjahr 2001 auf 20% im Berichtsjahr. Der Rückgang wurde durch folgende Entwicklungen verursacht:

- **Drahtgebundene Kommunikation** – ein relativer Anstieg der F&E-Kosten auf 60% des Umsatzes im Vergleich zu 40% im Geschäftsjahr 2001. Dies ist hauptsächlich auf den im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Umsatz zurückzuführen. In absoluten Zahlen hingegen waren die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Geschäftsjahr 2002 im Vergleich zum Vorjahr erheblich geringer. Im Geschäftsjahr 2001 wurden erworbene, nicht abgeschlossene F&E-Projekte in Höhe von 69 Mio. Euro im Aufwand gezeigt, die auf Grund der Akquisitionen von Ardent und Catamaran angefallen waren. Im Geschäftsjahr 2002 sind solche Abschreibungen nicht angefallen. Die F&E-Kosten verliefen in den Geschäftsjahren vergleichbar, wenn sie um erworbene, noch nicht abgeschlossene F&E-Aufwendungen bereinigt werden.
- **Mobile Kommunikation** – ein relativer Anstieg der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 30% des Umsatzes im Vergleich zu 27% im Geschäftsjahr 2001. Der Anstieg resultiert aus niedrigeren Umsatzerlösen und Abschreibungen auf erworbene, nicht abgeschlossene F&E-Projekte im Rahmen der Akquisition von MIC im Geschäftsjahr 2002 in Höhe von 37 Mio. Euro. Bereinigt um die Aufwendungen für erworbene, nicht abgeschlossene F&E-Projekte gingen die F&E-Aufwendungen absolut zurück.
- **Sicherheits- und Chipkarten-ICs** – die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr mit 19% auf 24% relativ an. Der Rückgang der absoluten F&E-Kosten wurde vom Rückgang der Umsatzerlöse überkompensiert. Zu der Kostenentwicklung trugen eine Portfoliobereinigung und Restrukturierungsmaßnahmen bei.
- **Automobil- und Industrieelektronik** – ein relativer Anstieg auf 13% im Geschäftsjahr 2002 im Vergleich zu 12% im Geschäftsjahr 2001.
- **Speicherprodukte** – eine relative Verringerung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 16% des Umsatzes im Vergleich zu 20% im Geschäftsjahr 2001. Sie war begründet durch die Kostenreduzierung bei höheren Umsatzerlösen sowie einen absoluten Rückgang dieser Kosten im Bereich der Festplatten-Controller.

Die von der öffentlichen Hand erhaltenen Fördergelder für Forschungs- und Entwicklungsprojekte beliefen sich im Geschäftsjahr 2002 auf 59 Mio. Euro (Vorjahr: 71 Mio. Euro).

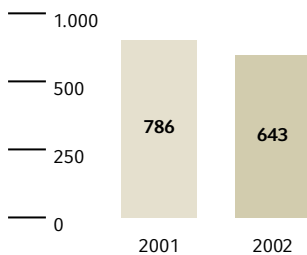
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Mio. Euro



Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung konnten im Geschäftsjahr 2002 durch das Kostensenkungsprogramm Impact reduziert werden.

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten

in Mio. Euro



Unser Kosteneinsparungsprogramm Impact zeigt besonders bei den Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten Wirkung.

Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten

Diese Aufwendungen umfassen neben den Vertriebskosten auch die allgemeinen Verwaltungskosten und enthalten in beiden Jahren Gemein-, Personal-, Beratungs- und sonstige Verwaltungskosten. Die Vertriebskosten und die allgemeinen Verwaltungskosten sanken im Berichtsjahr um 18% auf 643 Mio. Euro (Vorjahr: 786 Mio. Euro). Der relative Anteil dieser Kosten an den Umsatzerlösen sank von 14% im Geschäftsjahr 2001 auf 12% im Berichtsjahr und reflektiert im Wesentlichen die erfolgreiche Umsetzung des Kostensenkungsprogramms Impact und den Rückgang der Umsatzerlöse.

Die Vertriebskosten verminderten sich im Berichtsjahr um 24% auf 341 Mio. Euro (Vorjahr: 451 Mio. Euro), relativ zum Umsatz betrachtet entspricht dies einer Verringerung auf 7% (Vorjahr: 8%). Dies verdeutlicht die Auswirkungen der Kostenreduzierungsbemühungen seit Beginn des Geschäftsjahrs, inklusive Mitarbeiterabbau und Optimierung der Vertriebs- und Marketingfunktionen und Prozesse.

Die allgemeinen Verwaltungskosten reduzierten sich um 10% auf 302 Mio. Euro oder 6% vom Umsatz im Berichtsjahr gegenüber 335 Mio. Euro und ebenfalls 6% vom Umsatz im Vorjahr. Durch weitere Verbesserungen der Prozesse und die konsequente Umsetzung des Impact-Programms inkl. Mitarbeiterabbau und reduzierter IT-Kosten sind die allgemeinen Verwaltungskosten sowohl absolut als auch relativ gesunken. Als Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe in Dresden im Sommer 2002 wurden 2 Mio. Euro gespendet.

Restrukturierung

Im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2001 verabschiedeten wir ein Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm (Impact). Im Zusammenhang mit dem Impact-Projekt fielen im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2001 Umstrukturierungsaufwendungen in Höhe von 117 Mio. Euro an.

Der Mitarbeiterstamm wurde im Geschäftsjahr 2002 wie angekündigt reduziert. Im Geschäftsjahr 2002 ergriffen wir weitere Maßnahmen, um Impact abzuschließen. Dabei fielen zusätzliche Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 16 Mio. Euro für nicht abkündbare Verpflichtungen an.

Sonstige betriebliche Erträge, Saldo

Der Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 46 Mio. Euro enthält überwiegend die Vorsteuergewinne aus dem Verkauf des restlichen Infrarotkomponenten-Geschäfts in Höhe von 39 Mio. Euro und des Gallium-Arsenid-Geschäfts in Höhe von 2 Mio. Euro. Im Vorjahr betragen die sonstigen betrieblichen Erträge 200 Mio. Euro und enthielten im Wesentlichen die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf des Image & Video-Geschäfts in Höhe von 202 Mio. Euro und des Infrarotkomponenten-Geschäfts in Höhe von 26 Mio. Euro.

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Als Resultat der zuvor genannten Faktoren entstand im Berichtsjahr 2002 ein EBIT-Verlust in Höhe von 1.142 Mio. Euro (Vorjahr: EBIT-Verlust von 1.024 Mio. Euro).

Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Das anteilige Ergebnis von assoziierten Unternehmen wird überwiegend im Geschäftsbereich Speicherprodukte ausgewiesen. Der anteilige Verlust beträgt im Berichtsjahr 47 Mio. Euro gegenüber einem Gewinn von 25 Mio. Euro im Vorjahr. Die anteiligen Verluste aus dem Joint Venture ProMOS belaufen sich wegen der ungünstigen Marktbedingungen für DRAM-Produkte im Berichtsjahr auf 53 Mio. Euro. Im Vorjahr konnte hier noch ein Gewinn von 17 Mio. Euro erzielt werden.

Zinsergebnis

Der Netto-Zinsaufwand stieg im Berichtsjahr auf 25 Mio. Euro (Vorjahr: 1 Mio. Euro). Dies beinhaltet im Wesentlichen Zinsen auf unsere Wandelanleihe und Finanzierungskosten unserer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden, teilweise ausgeglichen durch Zins-einnahmen aus unseren Zahlungsmitteln und Wertpapieren in Höhe von 12 Mio. Euro.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für das Berichtsjahr weisen wir Erträge für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 139 Mio. Euro gegenüber einem Ertrag von 428 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 aus. Dies entspricht einer positiven Steuerquote von 12% (Vorjahr: 42%). Die Veränderung der Steuerquote ist im Wesentlichen auf die Wertberichtigung auf aktivierte latente Steuern in Höhe von 275 Mio. Euro zurückzuführen.

Wir haben unsere aktivierten latenten Steuern auf die Notwendigkeit einer Wertberichtigung hin überprüft. Die Überprüfung verlangt von unserem Management unter anderem eine Beurteilung von Erträgen aus verfügbaren Steuerstrategien und künftigem zu versteuerndem Einkommen sowie anderen positiven oder negativen Faktoren. Die tatsächliche Realisierung von aktivierten latenten Steuern hängt von der Möglichkeit der Gesellschaft ab, entsprechendes zu versteuerndes zukünftiges Einkommen zu generieren, um Verlustvorträge oder Steuervergünstigungen vor ihrem Verfall nutzen zu können. Da wir zum 30. September 2002 in bestimmten Steuerländern über einen Dreijahreszeitraum einen kumulierten Verlust ausgewiesen haben, wird der Einfluss von geplantem zu versteuerndem Einkommen nach den Vorschriften des Statement of Financial Accounting Standards („SFAS“) Nr. 109 für diese Bewertung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt für diese Steuerländer dementsprechend nur auf Grund der Erträge, die durch verfügbare Steuerstrategien und die Umkehr von zeitlichen Unterschieden in zukünftigen Perioden erlöst werden können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Überprüfung haben wir zum 30. September 2002 die Wertberichtigung auf die aktivierten latenten Steuern um 275 Mio. Euro erhöht und damit auf einen Betrag gebracht, der wahrscheinlich in Zukunft realisiert werden kann.

Wir überprüfen unsere aktivierten latenten Steuern regelmäßig. Die Möglichkeit, aktivierte latente Steuern zu realisieren, ist abhängig von der Generierung von zukünftigem zu versteuerndem Einkommen, das mit steuerlichen Verlustvorträgen oder Steuerfreibeträgen verrechnet werden kann, bevor diese verfallen. Auf Grund der jüngst entstandenen steuerlichen Verluste erwarten wir im Berichtsjahr 2003 eine geringere Aktivierungsrate von latenten Steuern als in der Vergangenheit. Dies wird so lange anhalten, bis die Verlustvorträge in den entsprechenden Steuerländern durch zu versteuernde Erlöse genutzt worden sind.

Die Bundesregierung hat kürzlich Steuergesetzänderungen vorgeschlagen, die eine reduzierte Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen vorsehen. Grundsätzlich verfallen die deutschen steuerlichen Verlustvorträge nicht, aber nach dem derzeitigen Gesetzesvorschlag (Stand: 21. Oktober 2002) sollen steuerliche Verlustvorträge nach sieben Jahren verfallen. Entsprechend US-GAAP werden wir die Effekte solcher Änderungen zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Gesetzes berücksichtigen. Wir kennen derzeit weder den genauen Inhalt noch den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung und können deshalb keine Aussage über eventuelle Auswirkungen treffen.

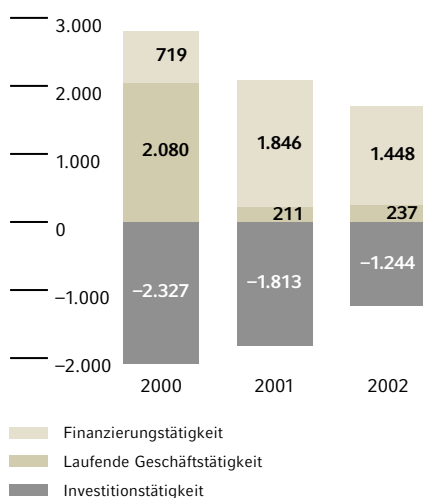
Darstellung der Finanzlage

Cash-Flow

(in Mio. Euro)

	Geschäftsjahr zum 30. September		
	2000	2001	2002
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.080	211	237
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.327	-1.813	-1.244
Mittelzufluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	719	1.846	1.448
Zahlungsmittel zum Periodenende	511	757	1.199

Mittelzuflüsse/Mittelabflüsse in Mio. Euro



Der Cash-Flow zeigt Herkunft und Verwendung der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihm kommt damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu.

Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit sind jeweils zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit ausgehend vom Konzernjahresergebnis indirekt abgeleitet. Die im Rahmen der indirekten Ermittlung berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäft sind um Effekte aus der Währungsumrechnung und Konsolidierungskreis-Änderungen bereinigt. Sie können deshalb nicht mit den entsprechenden Veränderungen auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit stiegen im Geschäftsjahr 2002 auf 237 Mio. Euro gegenüber 211 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001. Wesentliche Veränderungen nicht zahlungswirksamer Positionen gegenüber dem Vorjahr sind der Anstieg der Abschreibungen um 249 Mio. Euro und der Rückgang der latenten Steuern um 216 Mio. Euro wegen der zusätzlichen Wertberichtigung in Höhe von 275 Mio. Euro. Wesentliche Veränderungen in den operativen Forderungen und Verbindlichkeiten beinhalten den Anstieg der Forderungen aus

Mittelzuflüsse aus Finanzierungs- und laufender Geschäftstätigkeit verbesserten die Liquiditätssituation.

Lieferungen und Leistungen um 127 Mio. Euro, ausgeglichen vom Anstieg langfristiger Verbindlichkeiten netto in Höhe von 181 Mio. Euro.

Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit reduzierten sich im Geschäftsjahr 2002 auf 1.244 Mio. Euro (Vorjahr: 1.813 Mio. Euro), im Wesentlichen durch geringere Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 643 Mio. Euro (Vorjahr: 2.282 Mio. Euro). Dies war überwiegend bedingt durch die Fertigstellung der 300-Millimeter-Produktionsstätte in Dresden, und Investitionen in frei verfügbare Wertpapiere in Höhe von 709 Mio. Euro (Vorjahr: 82 Mio. Euro). Des Weiteren investierten wir 127 Mio. Euro (Vorjahr: 296 Mio. Euro) in Beteiligungen und immaterielle Vermögensgegenstände. Mittelzuflüsse aus der Investitionstätigkeit gab es im Zusammenhang mit dem Verkauf von nicht strategischen Geschäftseinheiten in Höhe von 96 Mio. Euro (Vorjahr: 346 Mio. Euro) und den zunächst einbehaltenen 50 Mio. Euro im Zuge des Erwerbs der MIC.

Die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit betragen im Geschäftsjahr 1.448 Mio. Euro (Vorjahr: 1.846 Mio. Euro). Der Gesellschaft flossen aus einem Darlehen für die 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden 450 Mio. Euro und mit der Begebung einer Wandelanleihe im Februar 2002 netto 981 Mio. Euro zu. Im Geschäftsjahr 2001 flossen Infineon im Zuge unserer Kapitalerhöhung 1.475 Mio. Euro zu.

Der Bestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich zum 30. September 2002 auf 1.199 Mio. Euro (Vorjahr: 757 Mio. Euro).

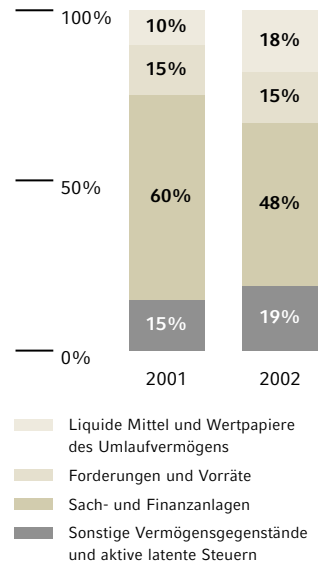
Darstellung der Vermögenslage

Das bilanzierte Gesamtvermögen von Infineon erhöhte sich zum 30. September 2002 um 12% auf 10.918 Mio. Euro (Vorjahr: 9.743 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens stiegen auf 1.937 Mio. Euro (Vorjahr: 850 Mio. Euro). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Einzahlungen aus unserer Wandelanleihe und des Darlehens für unsere 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden, teilweise ausgeglichen durch Auszahlungen für Investitionen, zurückzuführen. Das Anlagevermögen ging um 2% auf 6.727 Mio. Euro (Vorjahr: 6.867 Mio. Euro) zurück, bedingt durch den Rückgang bei Sachanlagen, da die Abschreibungen die Neuinvestitionen um 677 Mio. Euro überstiegen. Der Rückgang wurde teilweise durch die Aktivierung latenter Steuern und gestiegene sonstige Vermögensgegenstände aus dem Kauf der MIC ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 67% auf 4.760 Mio. Euro (Vorjahr: 2.843 Mio. Euro). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich um 1.461 Mio. Euro auf 1.710 Mio. Euro, im Wesentlichen durch die Begebung unserer Wandelanleihe und das Darlehen für unsere 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 80% auf 609 Mio. Euro, hauptsächlich auf Grund abgegrenzter Zulagen. Der nicht mit Einlagen abgedeckte Anteil unserer Pensionspläne stieg zum Ende des Geschäftsjahrs auf 103 Mio. Euro (Vorjahr: 70 Mio. Euro), überwiegend durch geringere Renditen am Finanzmarkt. Sollten diese Trends anhalten, können sich unsere Nachschussverpflichtungen für diese Pläne erhöhen. Im Geschäftsjahr 2002 übersteigen die Beiträge in unsere Pensionspläne jedoch den Rückgang der Marktwerte ihrer Vermögensgegenstände.

Bilanzstruktur Aktiva

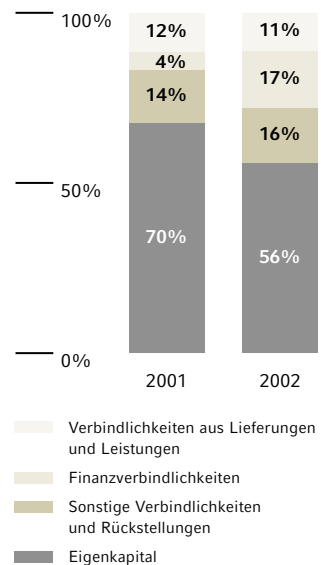
in %



Rückgang bei Sachanlagen, da die planmäßigen Abschreibungen die Neuinvestitionen deutlich übertrafen.

Bilanzstruktur Passiva

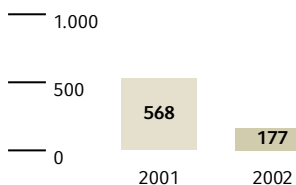
in %



Die Finanzverbindlichkeiten sind durch die Begabe der Wandelanleihe und das Darlehen für den Ausbau Dresden deutlich gestiegen.

Net Cash

in Mio. Euro



Trotz der schwierigen Marktsituation konnte durch konsequentes Cash-Management eine positive Net Cash-Position gehalten werden.

Das Eigenkapital des Konzerns reduzierte sich im Geschäftsjahr um 11% auf 6.158 Mio. Euro (Vorjahr: 6.900 Mio. Euro). Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Zufluss aus der Kapitalerhöhung im Rahmen des Kaufs von MIC in Höhe von 325 Mio. Euro im September 2002 und dem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von minus 1.021 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2002 beträgt 56% (Vorjahr: 71%).

Kapitalbedarf

Net Cash – der Saldo aus Finanzforderungen (Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheiten hinterlegte Zahlungsmittel) und Finanzverbindlichkeiten (kurz- und langfristige) – reduzierte sich um 391 Mio. Euro auf 177 Mio. Euro zum 30. September 2002 (Vorjahr: 568 Mio. Euro).

Netto-Zahlungsmittelbestand zum 30. September 2002

(in Mio. Euro)

	Gesamt	Zahlung fällig in					
		weniger als 1 Jahr	1–2 Jahre	2–3 Jahre	3–4 Jahre	4–5 Jahre	5 Jahre und länger
Zahlungsmittel	1.199	1.199	–	–	–	–	–
Wertpapiere des Umlaufvermögens	738	738	–	–	–	–	–
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	70	–	70	–	–	–	–
Brutto-Zahlungsmittelbestand	2.007	1.937	70	–	–	–	–
Abzüglich:							
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.705	–	92	497	46	1.000	70
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	5	–	2	2	1	–	–
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	120	120	–	–	–	–	–
Gesamte Finanzverbindlichkeiten	1.830	120	94	499	47	1.000	70
Netto-Zahlungsmittelbestand	177	1.817	–24	–499	–47	–1.000	–70

Zum 30. September 2002 weisen wir Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 120 Mio. Euro aus, die innerhalb eines Jahres fällig werden. Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, diese Finanzverbindlichkeiten aus vorhandenen Zahlungsmitteln, Mittelzuflüssen aus laufender Geschäftstätigkeit und Anleihen sowie durch die Prolongation der Finanzverbindlichkeiten im üblichen Geschäftsgang zurückzahlen zu können.

Am 6. Februar 2002 begaben wir (als Bürgin) durch unsere Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V., Rotterdam, Niederlande (als Emittentin), eine nachrangige Wandelschuldverschreibung in Höhe von 1.000 Mio. Euro im Rahmen eines garantierten Angebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese auf Anforderung in unsere Aktien umwandeln, wobei der Wandelpreis 35,43 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung können wir für einen Teil oder alle Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 4,25% und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Nach drei Jahren können wir die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls unsere Aktie 115% des Ausübungspreises an 30 Tagen in Folge übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt.

Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten^{1,2,3} zum 30. September 2002

(in Mio. Euro)

	Gesamt	Zahlung fällig in						
		weniger						5 Jahre
		als 1 Jahr	1–2 Jahre	2–3 Jahre	3–4 Jahre	4–5 Jahre	und länger	
Zahlungen aus Operating Lease	376	83	78	67	46	18	84	
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	843	449	155	107	22	13	97	
Andere langfristige Verpflichtungen	436	146	145	145	–	–	–	
Vertragliche Verpflichtungen	1.655	678	378	319	68	31	181	
Garantien	398	19	19	19	332	–	9	
Eventualverbindlichkeiten	398	19	19	19	332	–	9	

Anmerkungen

Oben stehende Tabelle sollte im Zusammenhang mit Anhang Nr. 31 zu unserem Konzernabschluss des Geschäftsjahrs 2002 gelesen werden.

¹ Die Umrechnung von US-Dollar in Euro erfolgt mit dem Wechselkurs 1 Euro = 0,9879 US-Dollar, dem Mittagkurs vom 30. September 2002.

² Oben stehende Tabelle enthält gewisse Rückzahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die zeitlich nicht fixiert sind, abhängen und welche deren wahrscheinliche Fälligkeiten im jeweiligen Fall durch das Management geschätzt wurden. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

³ Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvorbehaltvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2002 nicht quantifizierbar sind.

In obiger Tabelle ist enthalten:

- Im Laufe der nächsten zwei Jahre werden wir Technologien und Bareinlagen in einer Höhe von insgesamt 405 Mio. US-Dollar in das Joint Venture UMCi einbringen müssen.
- Im Zuge unserer Gründung haben wir die Siemens AG von den Risiken einer geringen Anzahl ehemals von Siemens für den Halbleiterbereich geleisteten Garantie- und Finanzverpflichtungen wirtschaftlich freigestellt. Hierbei handelt es sich um einzelne Vertragsverhältnisse, die uns zwar betreffen, jedoch wegen gesetzlicher, technischer Gründe oder aus Praktikabilitätsgründen nicht auf uns übertragen werden konnten. Zum 30. September 2002 ist darin auch eine Rückhaftungserklärung im Zusammenhang mit bereits erhaltenen Fördermitteln der öffentlichen Hand in Höhe von 313 Mio. Euro enthalten.
- Die Siemens AG hat eine Zahlungsgarantie in Höhe von bis zu 61 Mio. US-Dollar für ProMOS gegeben. Diesbezüglich gaben wir Siemens gegenüber eine Rückgarantie.

Nicht enthalten in obiger Tabelle sind Verpflichtungen über die nächsten drei Jahre bis zum 30. September 2005 in einer Höhe von 550 Mio. Euro, die wir auf Grund einer Vereinbarung mit Nanya über die gemeinsame Entwicklung von fortgeschrittener DRAM-Technologie und die Errichtung einer 300-Millimeter-Fertigung in Taiwan eingegangen sind.

Wir haben verschiedene, voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart. Diese Kreditlinien (einschließlich der unten beschriebenen angepassten revolvingenden Mehrwährungskreditlinie über 750 Mio. Euro und der Kreditlinie über 450 Mio. Euro) haben eine Höhe von 2.183 Mio. Euro, von denen 1.340 Mio. Euro zum 30. September 2002 verfügbar waren. Die Kreditlinien bestehen aus den folgenden vier Gruppen:

Kreditlinien

(in Mio. Euro)

Laufzeit	Zusage durch Finanzinstitut	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Zum 30. September 2002		
			Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
kurzfristig	feste Zusage	Betriebskapital, Garantien, Cash Pooling	911	96	815
kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital	152	–	152
langfristig	feste Zusage	Betriebskapital	384	11	373
langfristig ¹	feste Zusage	Projektfinanzierungen	736	736	–
			2.183	843	1.340

Anmerkung

¹ Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Für den Ausbau der Fertigungsstätte am Standort Dresden haben wir ein Konsortialdarlehen in Höhe von 450 Mio. Euro in Anspruch genommen. Diese Kreditlinie ist teilweise von der Bundesrepublik Deutschland und einer anderen öffentlichen Körperschaft gesichert. Die Kreditlinie enthält bestimmte Restriktionen bezüglich der Bilanzrelationen, sieht jährliche Zinszahlungen vor und ist am 30. September 2005 rückzahlbar.

Zum 30. September 2002 vereinbarten wir eine neue revolvingende Mehrwährungskreditlinie bei einem Konsortium von Finanzinstituten, um unsere bisherige Kreditlinie zu ersetzen. Die geänderte Kreditlinie beträgt 750 Mio. Euro und ist in zwei gleiche Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche über 375 Mio. Euro läuft bis September 2003, die zweite Tranche über 375 Mio. Euro bis September 2005. Die Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen. Zum 30. September 2002 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Zum 30. September 2002 halten wir die geforderten Bilanzrelationen in Bezug auf die entsprechenden Kreditlinien ein.

Investitionsaufwendungen

(in Mio. Euro)

	2000	Geschäftsjahr		
		2001	2002	geplant 2003
Speicherprodukte	935	1.380	470	630
Nicht-Speicherprodukte	636	902	173	350
Gesamt	1.571	2.282	643	980

Zur Verbesserung von Produktivität und Technologie beabsichtigen wir, im Geschäftsjahr 2003 etwa 980 Mio. Euro zu investieren. Auf Grund der Länge des Zeitraums zwischen der Bestellung und der Lieferung von Anlagen sind üblicherweise erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. Etwa 64% der erwarteten Investitionen sollen auf die Front-End- und die Back-End-Fertigungsprozesse des Geschäftsbereichs Speicherprodukte entfallen. 36% der geplanten Investitionen werden für die Logik-Fertigungsstätten ausgegeben.

Nach unserer Planung soll die Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens und des übrigen Finanzmittelbedarfs einerseits aus Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, Fördermitteln der öffentlichen Hand und – abhängig von Marktbedingungen – durch die Aufnahme von Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente erfolgen. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Wir können weiterhin nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, die zusätzlich benötigten Finanzmittel für Forschung und Entwicklung zur Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens oder für andere Investitionen überhaupt bzw. zu günstigen Konditionen beschaffen zu können.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 4. Oktober 2002 gaben wir bekannt, dass wir unseren Aktionärsvertrag mit Mosel Vitelic, Inc. („MVI“) über das Gemeinschaftsunternehmen ProMOS auf Grund schwer wiegender Verletzungen des Aktionärsvertrags durch MVI zum 1. Januar 2003 gekündigt haben. Wir haben weder das im Aktionärsvertrag vereinbarte Recht zur Ausübung einer Call-Option zum Kauf der von MVI gehaltenen ProMOS-Aktien noch das einer Put-Option, die MVI verpflichtet, die von uns gehaltenen Anteile an ProMOS zu erwerben, in Anspruch genommen. Die Kapazitäts- und Liefervereinbarung, die sowohl das Recht als auch die Pflicht zur Abnahme von Produkten von ProMOS für beide Anteilseigner beinhaltet, erlischt mit der Beendigung des Aktionärsvertrags. Wir überprüfen verschiedene Handlungsalternativen, darunter die Verhandlung einer neuen Liefervereinbarung mit ProMOS, welche gemäß dem Gesellschaftervertrag von ProMOS für die Genehmigung eine Dreiviertelmehrheit im Aufsichtsrat und damit die Zustimmung der Vertreter von MVI benötigt. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eine solche Vereinbarung getroffen oder vom ProMOS- Aufsichtsrat genehmigt wird. Die Materialbezüge von ProMOS für die Geschäftsjahre 2001 und 2002 beliefen sich auf 137 Mio. Euro bzw. 182 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2002 weisen wir Lizenzeinnahmen von ProMOS in Höhe von 95 Mio. Euro aus. Am 30. September 2002 war die Beteiligung an ProMOS, saldiert mit abgegrenzten Lizenzeinnahmen in Höhe von 60 Mio. Euro, mit 196 Mio. Euro in den Finanzanlagen bilanziert. Die Forderungen gegenüber MVI waren alle kurzfristig und betragen zum 30. September 2002 87 Mio. Euro.

Wir entschieden die Zusammenlegung der Geschäftsbereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs zu einem Geschäftsbereich unter dem Namen Sichere Mobile Lösungen und werden die Zusammenlegung mit Wirkung zum 1. Oktober 2002 darstellen.

Am 13. November 2002 schlossen wir mit Nanya eine Reihe von Abkommen über eine strategische Kooperation zur Entwicklung von DRAM-Speicherprodukten und die Errichtung und den Betrieb einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Taiwan.

Gemäß den Vereinbarungen werden wir gemeinsam mit Nanya fortschrittliche 0,09-Mikrometer- und 0,07-Mikrometer-Technologie entwickeln. Wir erwarten, dass die Entwicklung bis zum 30. April 2005 abgeschlossen ist, die Kosten hierfür werden zu zwei Dritteln von uns und zu einem Drittel von Nanya getragen. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungstätigkeiten haben wir es Nanya gestattet, unsere 0,11-Mikrometer-Technologie in Lizenz im Rahmen ihrer bestehenden Produktion einzusetzen. Nanya hat sich verpflichtet, uns – hauptsächlich im Geschäftsjahr 2003 – 95 Mio. US-Dollar zu zahlen.

Die neue 300-Millimeter-Fertigungsstätte wird die im Rahmen der oben genannten Vereinbarung entwickelte Technologie einsetzen um DRAM-Produkte herzustellen und soll in zwei Stufen errichtet werden. Die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe ist für die zweite Hälfte des Kalenderjahrs 2004 geplant. Die Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe wird für das Geschäftsjahr 2006 erwartet. Beide Partner an diesem Joint Venture haben sich verpflichtet, jeweils die Hälfte der Produktion dieser Fertigungsstätte zu Preisen, die teilweise auf Marktpreisen basieren, abzunehmen.

Das Finanzierungsvolumen für die Errichtung der gemeinsamen 300-Millimeter-Fertigungsstätte beträgt rund 2,2 Mrd. Euro. Von diesem Betrag wird bis zum Ende des Kalenderjahres 2005 jeder der beiden Partner 550 Mio. Euro einbringen, wobei wir erwarten, dass 110 Mio. Euro bis zum 30. September 2003 benötigt werden. Die verbleibenden 1,1 Mrd. Euro plant das Joint Venture extern zu finanzieren. Der Zeitrahmen der Errichtung und die entsprechenden Kapitalaufnahmen können an die vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Das beabsichtigte Gemeinschaftsunternehmen muss durch die Kartellbehörden genehmigt werden; die Zustimmung wird bis Ende des laufenden Kalenderjahrs erwartet.

Ausblick

Mit der Fortsetzung des Abschwungs der weltweiten Halbleiterindustrie im Geschäftsjahr 2002 bleiben die Marktbedingungen weiterhin ungünstig und volatil. Obgleich wir eine Verbesserung der Marktlage nach Ende des Geschäftsjahrs beobachtet haben, insbesondere bei Nachfrage und Preisen im Segment Speicherprodukte, nehmen wir nicht an, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt eine nachhaltige Verbesserung der Marktlage darstellt.

Die Marktprognosen für die erste Hälfte des Geschäftsjahrs 2003 zeigen keine eindeutigen Anzeichen für einen nachhaltigen Anstieg der Nachfrage, und wir erwarten, dass der Preisdruck in den meisten Geschäftsbereichen des Unternehmens während der kommenden Monate anhalten wird. Für unsere einzelnen Segmente bedeutet das:

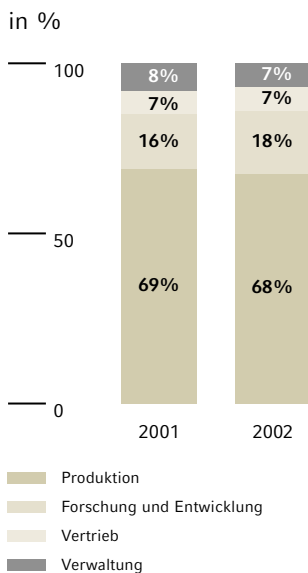
- Das Marktumfeld für Telekommunikationsinfrastruktur wird voraussichtlich auch weiter schwierig bleiben, da die globalen Netzbetreiber auch weiterhin nur in geringem Umfang Investitionen tätigen werden. Im Bereich Breitband-Zugangslösungen (ADSL/VDSL) erwarten wir jedoch – insbesondere in Japan und anderen Teilen Asiens – ein moderates Wachstum für das laufende Geschäftsjahr.

- Im Markt für Mobiltelefone sehen wir eine Stabilisierung der Nachfrage, die im Wesentlichen auf die Einführung der aktuellen Generation von GSM-/GPRS-Geräten zurückzuführen ist. Der starke Preisdruck hält jedoch auch weiter an.
- Wir erwarten einen positiven Trend im Markt für Sicherheits- und Chipkarten-ICs im Geschäftsjahr 2003 bei anhaltendem Preisdruck. Wir erwarten Wachstum hauptsächlich bei Zahlungs- und Identifikationsanwendungen.
- Die weltweite Automobilproduktion wird sich voraussichtlich im Jahr 2003 stabilisieren. Trotz des zunehmenden Preisdrucks erwarten wir ein moderates Wachstum in unserem Automobil- und Industrieelektronik-Segment im Geschäftsjahr 2003. Zu den Gründen gehören die weitere Zunahme des Elektronikanteils in allen Automobilanwendungen, unsere strategische Kundenbasis und unsere starke Führungsposition bei neuen Anwendungen wie Telematik und Infotainment sowie höhere Standards in den Bereichen Sicherheit, Karosserie und Komfort.
- Bedingt durch den starken Preisdruck in unserem Segment Speicherprodukte werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Kosten für unsere DRAM-Produktion zu senken, die Bandbreite unserer angebotenen DRAM-Produkte zu erhöhen und unseren Produktmix der Speicherprodukte zu verbessern. Wir streben an, unsere Kostenposition in der DRAM-Fertigung durch Nutzung unseres bedeutenden technologischen Vorsprungs in der 300-Millimeter-Fertigung, den wir gegenüber vielen unserer Konkurrenten haben, zu stärken, um weiter steigende Produktivität zu erreichen. Wir planen, unsere verfügbare Kapazität durch den Ausbau unserer wichtigen strategischen Kooperationen mit UMC und Winbond sowie durch das erwartete weit reichende Produktionsbündnis mit Nanya zu erhöhen, was unseren Kapitalbedarf verringern wird. Indem wir die nächste Speichertechnologie-Generation auf Basis unseres 300-Millimeter-Know-hows gemeinsam entwickeln, erwarten wir unsere Entwicklungskosten zu verringern und unseren technologischen Vorsprung auszubauen.

Angesichts der schlechten Vorhersehbarkeit der Halbleiterindustrie ist es extrem schwierig, Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2003 zu prognostizieren. Für das Kalenderjahr 2003 sagt die WSTS jedoch einen Anstieg der weltweiten Umsätze mit Halbleiterprodukten um 16,6% voraus. Wir glauben, dass eine erfolgreiche Implementierung unseres Impact²-Programms unsere operationale Produktivität durch die weitere Optimierung unserer Geschäftsprozesse und unsere Finanzkraft im Geschäftsjahr 2003 verbessern kann. Wir werden unser starkes Produkt- und Technologieportfolio, unser System-Know-how und unsere strategischen Partnerschaften nutzen, um zur Profitabilität zurückzukehren. Wir glauben, dass wir mit der Kombination unserer 300-Millimeter-Technologie und unseren strategischen Allianzen weitere Marktanteile gewinnen können und unter den Ersten sein werden, die nach der Erholung des Halbleitermarkts profitabel wachsen werden.

Unser ambitioniertes strategisches Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren zu einem der Top 4-Halbleiterunternehmen zu gehören und unseren weltweiten Marktanteil auf 6% zu verdoppeln. Wir erwarten im Wesentlichen, durch organisches Wachstum, unterstützt durch Kooperationen und strategische Akquisitionen, zu wachsen. Wir sind der Ansicht, dass die Ausweitung unseres Geschäfts mit Komplettlösungen in den nächsten Jahren ein wichtiger Bestandteil der Implementierung unserer Strategie sein wird.

Mitarbeiter nach Funktionen in %



Auch nach erfolgreicher Umsetzung des Impact-Kostenreduzierungsprogramms weiterhin hoher Mitarbeiterereinsatz in Forschung und Entwicklung.

Mitarbeiter

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung unserer Belegschaft nach Regionen und Funktionen jeweils zum 30. September der genannten Geschäftsjahre sowie die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl nach Regionen. Die Reduzierung der Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2002 spiegelt im Wesentlichen den Mitarbeiterabbau im Rahmen des Kostenreduzierungsprogramms Impact wider.

Anzahl der Mitarbeiter

Funktionen	Zum 30. September		
	2000	2001	2002
Funktionen			
Produktion	20.371	23.416	20.822
Forschung und Entwicklung	4.733	5.510	5.374
Vertrieb und Marketing	2.043	2.259	2.010
Verwaltung	2.019	2.628	2.217
Gesamt	29.166	33.813	30.423
Regionen			
Deutschland	14.247	16.814	15.716
Übriges Europa	3.409	5.007	4.590
USA	2.838	3.023	2.889
Asien/Pazifik	8.672	8.949	7.200
Übrige	-	20	28
Gesamt	29.166	33.813	30.423
	Durchschnitt über das Geschäftsjahr		
	2000	2001	2002
Regionen			
Deutschland	13.718	16.279	15.773
Europa	3.161	4.921	4.376
USA	2.747	3.101	2.818
Asien/Pazifik	8.064	9.095	7.189
Übrige	-	7	24
Gesamt	27.690	33.403	30.180

Campeon

Wir befinden uns derzeit am Ende der Entwurfs- und Planungsphase für die Errichtung einer neuen Konzernzentrale in der Nähe von München. Dazu verhandeln wir mit der MoTo Objekt CAMPEON GmbH & Co. KG („MoTo“) eine Finanzierungs- und Errichtungsvereinbarung. MoTo soll demnach die Finanzierung und Errichtung einer Konzernzentrale und eines Forschungs- und Entwicklungszentrums im Campus-Stil in einem Vorort von München übernehmen. Wir werden den Komplex im Rahmen einer Operating-Lease-Vereinbarung anmieten und gegen Ende 2004 beziehen können. Wir können nicht zusichern, dass dieses Projekt vollendet wird.

Risiken und Chancen

Das Halbleitergeschäft ist gekennzeichnet durch eine hohe Zyklizität und bietet daher sowohl große Chancen als auch Risiken. Obwohl die Chip-Branche in den letzten 20 Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate weit über den meisten Old-Economy-Branchen hatte, umfasst dieser Durchschnitt sowohl extrem starke Wachstums- als auch Rezessionsjahre. Ergänzt wird diese Risikolage durch den sehr hohen Investitionsbedarf zur Absicherung der Marktstellung sowie des außerordentlich schnellen technologischen Wandels. Der sich auch in 2002 fortsetzende Nachfrageeinbruch bei Produkten und Dienstleistungen des Technologiesektors – insbesondere bei Halbleitern – und der dadurch verursachte Druck auf die Aktienkurse der Technologiefirmen veranschaulichen das Ausmaß der Volatilität in der Halbleiterindustrie.

Das Risiko- und Chancenmanagementsystem von Infineon

Wir haben ein unternehmensweites Risiko- und Chancenmanagementsystem installiert, das uns in die Lage versetzt, sowohl die sich aus dem Markt heraus ergebenden Chancen als auch die mit ihrer Umsetzung verbundenen Risiken zu identifizieren bzw. zu antizipieren. Dieses System, das alle Bereiche umfasst, ist vom Abschlussprüfer geprüft worden. Dieser Ansatz und die zugehörige Berichterstattung geben der Unternehmensleitung die Möglichkeit, schnell und effektiv zu handeln. Das Risiko- und Chancenmanagementsystem ist umfassend in unserem Intranet dokumentiert und damit für unsere Mitarbeiter weltweit zugänglich.

Dieses System, für das ein US-Patent beantragt wurde, ist ein Schlüsselement unserer Betriebsaktivitäten. Das System basiert auf einem individuellen Monitoring, unterstützt durch entsprechende Managementprozesse, und ist in unsere Kernaktivitäten integriert. Es beginnt bei der strategischen Planung und setzt sich über die Fertigung und den Vertrieb einschließlich des Forderungsmanagements fort. Als eine Erweiterung des Planungsprozesses in den Geschäftsbereichen, der Vertriebsorganisation, dem Fertigungs-Cluster und den Zentralbereichen dient das Risiko- und Chancenmanagementsystem zur Identifikation und Bewertung möglicher Abweichungen von erwarteten Entwicklungen. Neben der Identifikation und Bewertung von wesentlichen Entwicklungen, die unser Geschäft beeinflussen können, wird das System auch herangezogen, um Aktivitäten zu priorisieren und zu implementieren, um Chancen besser zu nutzen und Risiken zu reduzieren.

Die Geschäftseinheiten erstellen auf monatlicher Basis Risiken- und Chancenberichte, die den Kern des Risiko- und Chancenmanagementsystems darstellen. Die Berichte werden von den Chief Operating Decision Makers bewertet und sind Teil des monatlichen Berichtsprozesses. Im Zusammenhang mit Markt- und Wettbewerberanalysen sowie Benchmark-Untersuchungen werden diese Berichte vom Topmanagement als Entscheidungsgrundlage herangezogen.

Wir haben eine Anzahl von Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen der aus den jeweiligen Betriebstätigkeiten resultierenden Hauptrisiken umgesetzt. Anstrengungen zur Implementierung von Maßnahmen zur Risikoreduktion sind ein integraler Bestandteil des Infineon-Risiko- und Chancenmanagementsystems. Allerdings können nicht alle der oben erwähnten Risiken gleichmäßig mit internen Maßnahmen adressiert werden, da viele der identifizierten Risiken, wie z. B. Marktrisiken, externe Ursachen haben. Obgleich wir danach streben, wirksame Maßnahmen zur Behandlung von Risiken zu identifizieren und umzusetzen,

kann es vorkommen, dass einzelne Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt haben, zum einen, weil das Risiko außerhalb unseres originären Einflussbereichs liegt, und zum anderen, weil spezifische Maßnahmen nicht richtig konzipiert bzw. umgesetzt werden.

Gegen Produktrisiken haben wir ein Netz von Qualitätskontrollen eingerichtet, in das auch die wichtigsten Lieferanten einbezogen sind. Alle Standorte sind nach der Norm ISO 9000 bzw. QS 9000 zertifiziert.

Wir schützen uns mit Versicherungen weitgehend gegen Auswirkungen von Haftungsrisiken oder Schadensfällen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Steuerliche, wettbewerbs-, patent-, umwelt- und börsenrechtliche Regelungen können ebenso Unternehmensrisiken beinhalten. Die Gesellschaft lässt sich deshalb umfassend von internen und externen Fachleuten beraten.

Marktrisiken

Die folgenden Erläuterungen sollten auch im Zusammenhang mit Anhang Nr. 2, 29 und 30 des Konzernabschlusses gelesen werden.

Einzelrisiken

Das bedeutendste Risiko stellt für Infineon weiterhin die Speicherpreisentwicklung dar. Wir sehen ein Risiko für das Geschäftsjahr 2003 in gleicher Größenordnung wie im Geschäftsjahr 2002. Hier wirkt neben der anhaltenden Konjunktur- und Nachfrageschwäche auch die vorhandene Überkapazität auf dem DRAM-Sektor belastend. Durch einen weiteren Ausbau unserer Kostenpositionen und den Abschluss neuer strategischer Kooperationen versuchen wir, dieses Risiko abzumildern. Ein zusätzliches, für Halbleiterhersteller geschäftstypisches Risiko ist der Hochlauf unserer 0,11-Mikrometer-Technologie mit dem Risiko deutlicher Ausbeuteschwankungen.

Ein weiteres Hauptrisiko stellt die zukünftige Marktentwicklung für unsere Logikprodukte, insbesondere in den Bereichen Mobile Kommunikation, Drahtgebundene Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs, dar. Der erhebliche und andauernde Abschwung der Telekommunikationsbranche, der mit branchenübergreifenden Überkapazitäten sowie Finanzproblemen größerer Kunden einhergeht, macht es schwierig einzuschätzen, wann eine Geschäftsbelebung erfolgen wird.

Fremdwährungsmanagement

Die folgende Aufstellung zeigt die wesentlichen derivativen Finanzinstrumente zum 30. September 2002, die von den Veränderungen der Fremdwährungs-Wechselkurse beeinflusst werden. Für Fremdwährungs-Termin- und -Optionsgeschäfte hinsichtlich bestimmter Verkaufs- und Kauftransaktionen sowie der Zahlungsverpflichtung aus Verbindlichkeiten in Fremdwährungen zeigt die Tabelle nominale Beträge und die gewogenen Mittelwerte der vertraglich festgelegten Fremdwährungskurse. Die zum 30. September 2002 existierenden Fremdwährungs-Termin- und -Optionsgeschäfte hatten Laufzeiten von bis zu einem Jahr. Unser währungsübergreifender Zinsswap läuft 2005 aus, der Zinsswap läuft bis 2007. Wir handeln und spekulieren nicht mit derivativen Finanzinstrumenten.

Derivative Finanzinstrumente

	Kontraktsumme Kauf/(Verkauf) ¹	Durchschnittlicher vertraglicher Devisenterminkurs	Zeitwert 30. September 2002 ²
Fremdwährungs-Termingeschäfte			
US-Dollar	148	0,98049	–
US-Dollar	–313	0,95970	6
Japanische Yen	75	116,91435	–2
Singapur-Dollar	33	1,70970	–1
Britische Pfund	7	0,63364	–
Sonstige Währungen	52	–	–
Währungsübergreifender Zinsswap			
US-Dollar	616	n/a	106
Zinsswap	500	n/a	26
Termingeschäfte	150	n/a	–

Anmerkungen

¹ Euro-Äquivalent in Mio., Annahme für durchschnittliche vertragliche Devisenterminkurse.

² In Mio. Euro.

Unsere Geschäftspolitik zur Begrenzung von kurzfristigen Fremdwährungsrisiken ist es, mindestens 75% des erwarteten Netto-Risikos über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten im Voraus, je nach Art des Grundgeschäfts, für einen bedeutenden Anteil auch darüber hinaus, zu sichern. Ein Teil des Fremdwährungsrisikos bleibt auf Grund des Unterschieds zwischen tatsächlichen und erwarteten Beträgen bestehen. Wir berechnen dieses Netto-Risiko auf Basis des Kapitalflusses unter Berücksichtigung von Bilanzpositionen, eingegangenen oder vergebenen Aufträgen und allen anderen geplanten Einnahmen und Ausgaben.

Wir bilanzieren unsere derivativen Finanzinstrumente gemäß den Vorgaben des vom Financial Accounting Standards Board veröffentlichten SFAS Nr. 133 „Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften“. Gemäß SFAS Nr. 133 müssen derivative Finanzinstrumente zum Marktwert bilanziert werden. Differenzen auf Grund der Marktbewertung sind auszuweisen, abhängig davon, ob das Instrument Bestandteil eines Sicherungsgeschäfts ist und welche Art von Sicherungsgeschäft vorliegt. Unsere Sicherungsgeschäfte fallen nicht unter die Regelungen von SFAS Nr. 133. Auf Grund unserer Sicherungsstrategie werden alle derivativen Finanzinstrumente mit den Marktwerten in dem Konzernjahresabschluss erfasst. Die Wertveränderungen sind in den Konzern-Gewinn- und Verlust-Rechnungen ausgewiesen.

Im Berichtsjahr fielen Verluste aus Währungsgeschäften in Höhe von 16 Mio. Euro gegenüber Gewinnen von 34 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2001 an. Ein bedeutender Anteil unserer Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungs- sowie Forschungs- und Entwicklungskosten entsteht originär nicht in Euro, sondern vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen. Wechselkurschwankungen gegenüber dem Euro hatten einen negativen Effekt auf Kosten und Ergebnis im Geschäftsjahr 2002.

Wir halten Finanzanlagen an verschiedenen Unternehmen wie ProMOS und UMCi, die nicht in unserer funktionalen Währung Euro bilanzieren. Die Buchwerte dieser Finanzanlagen unterliegen deshalb Währungsrisiken. Im Geschäftsjahr 2002 waren die Buchwerte dieser Finanzanlagen auf Grund von Währungsschwankungen um 55 Mio. Euro gesunken. Ungünstige Wechselkursentwicklungen des Euro zum US-Dollar und des Euro zum neuen taiwanesischen Dollar sowie des Euro zu anderen Währungen können die Buchwerte unserer Finanzanlagen wesentlich beeinflussen.

Management des Zinsrisikos

Unsere Zinsrisikopositionen resultieren hauptsächlich aus Kreditaufnahmen. Im Berichtsjahr wurden die wesentlichen Kreditaufnahmen, außer unserer mit 4,25% festverzinslichen Wandelschuldanleihe, durch Vermögensgegenstände mit der gleichen Laufzeit und dem gleichen Zinssatz wirtschaftlich gesichert. Unser Zinsrisiko war somit auf die sonstigen Kreditaufnahmen mit geringer Höhe und kurzen Laufzeiten begrenzt. Der Buchwert dieser sonstigen Kreditaufnahmen entspricht in etwa ihrem Marktwert, da die Zinssätze denen entsprechen, die in dem relevanten Markt erzielt werden können. Am 30. September wurde unsere Wandelschuldanleihe mit 42,3% Abschlag zum Nominalwert gehandelt. Ein deutlicher Anstieg der Zinssätze könnte künftige Zinsaufwendungen erhöhen und dadurch zu erhöhten Kosten der Finanzierung für Investitionen führen. Wir versuchen, dieses Risiko durch Investitionen der verfügbaren Mittel in variabel verzinsliche Finanzanlagen zu verringern.

Materialpreissrisiken

Wir sind auf Grund unserer Abhängigkeit von verschiedenen Materialien Preisrisiken ausgesetzt. Wir versuchen, diese Risiken durch unsere Einkaufsstrategien und durch Einsatz geeigneter Instrumente zu minimieren. Wir setzen keine derivativen Finanzinstrumente zur Vermeidung von Restrisiken aus Preisschwankungen ein.

Preisrisiken waren weitestgehend ausgeglichen, und Versorgungsrisiken hatten keinen wesentlichen Einfluss auf unser Geschäft. Es traten auch keine Risiken auf Grund der weiteren Abkoppelung von den Siemens-Zulieferervereinbarungen auf.

Infineon Technologies AG

Die Infineon Technologies AG ist die Führungsgesellschaft des Infineon-Konzerns und führt die entsprechenden Leitungs- und Zentralfunktionen aus. Die Infineon Technologies AG übernimmt wesentliche übergreifende Aufgaben wie das konzernweite Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, strategische und produktionsorientierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die weltweite Unternehmens- und Marketingkommunikation und steuert die logistischen Prozesse im Konzern. Die Infineon Technologies AG verfügt über eigene Fertigungen in Berlin, München und Regensburg.

Die Infineon Technologies AG stellt ihren Jahresabschluss nach den Regeln des HGB auf. Der vollständige Abschluss wird separat veröffentlicht.

Die Umsatzerlöse der Infineon Technologies AG betragen im Berichtsjahr 6.765 Mio. Euro (Vorjahr: 6.697 Mio. Euro). Es wird ein Jahresfehlbetrag von 617 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: 435 Mio. Euro). Auf Grund der betriebsbedingten Abrechnungsstruktur im Infineon-Konzern mit der Infineon Technologies AG als Verrechnungs-Drehscheibe für die Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften weist die Muttergesellschaft höhere Umsätze aus als der Konzern.

Die Vermögens- und Finanzlage der Infineon Technologies AG ist geprägt durch den Anstieg der Finanzanlagen durch Einlagen bei Beteiligungsgesellschaften und eines entstandenen Gewinns aus der Verschmelzung von Beteiligungen, dem Anstieg der Wertpapiere und flüssigen Mittel aus erhaltenen Darlehen von verbundenen Unternehmen, teilweise ausgeglichen durch den Rückgang von Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Das Eigenkapital ist, bedingt durch Kapitalerhöhungen und den Bilanzverlust, auf 7.061 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 7.259 Mio. Euro). Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 64% (Vorjahr: 81%).

Dividende

Der Vorstand schlägt vor, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzverlust aus dem Geschäftsjahr 2002 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Zum 30. September 2002 hält die Siemens Nederland N.V., 86.292.363 Aktien (11,97% des Grundkapitals, Vorjahr 28,93%) und der Siemens Pension-Trust e.V. 87.052.632 Aktien (12,08% des Grundkapitals, Vorjahr: 13,54%) an der Infineon Technologies AG. Die Siemens AG kann dem Siemens Pension-Trust e.V. Weisungen zur Ausübung der Stimmrechte aus den Aktien erteilen. Am 5. Dezember 2001 hat uns die First Union Trust Company, National Association, USA, mitgeteilt, dass sie 200 Mio. Aktien an der Infineon Technologies AG von der Siemens-Gruppe erworben habe und diese treuhänderisch für die Siemens AG halte. Siemens kann keinerlei Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts aus diesen Aktien geben; auch hat sich die First Union Trust Company vertraglich verpflichtet, die Stimmrechte aus diesen Aktien nicht auszuüben. Insgesamt kann die Siemens AG damit nur noch die Ausübung der Stimmrechte aus circa einem Drittel unserer Aktien beeinflussen, aus denen voraussichtlich Stimmrechte ausgeübt werden.

Es besteht kein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen Infineon und der Siemens AG. Die Siemens AG und Siemens Nederland N.V. haben aber zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahrs 50,4% und der Siemens Pension-Trust e.V. 13,5% des Grundkapitals der Infineon Technologies AG gehalten. Daher hat der Vorstand der Infineon Technologies AG gemäß § 312 Aktiengesetz einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt, den so genannten Abhängigkeitsbericht, um umfassend zu informieren.

Im Abhängigkeitsbericht wird erklärt, dass die Infineon Technologies AG bei allen Rechtsgeschäften und allen Maßnahmen mit verbundenen Unternehmen nach den Umständen, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, zu dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt worden ist.

Der Abhängigkeitsbericht ist vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

München, im November 2002

Der Vorstand



Dr. Ulrich Schumacher, Vorsitzender



Peter Bauer



Peter J. Fischl



Dr. Sönke Mehrgardt



Dr. Andreas von Zitzewitz

An den Aufsichtsrat und die Aktionäre der Infineon Technologies AG

Wir haben die beigefügten Konzernbilanzen der Infineon Technologies AG, einschließlich ihrer Tochterunternehmen, zum 30. September 2001 und 2002, sowie die zugehörigen Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnungen, Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen und Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre (Konzernrechnungslegung) geprüft. Die Konzernrechnungslegung liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über die Konzernrechnungslegung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der US-amerikanischen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Konzernrechnungslegung frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben in der Konzernrechnungslegung auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Konzernrechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung stellt die oben genannte Konzernrechnungslegung die Vermögens- und Finanzlage des Infineon Konzerns zum 30. September 2001 und 2002 sowie die Ertragslage und die Zahlungsströme für die am 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles) in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

München, den 21. Oktober 2002, bis auf Nr. 32 des Anhangs,
die dem Stand vom 13. November 2002 entspricht.

KPMG DEUTSCHE TREUHAND-GESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Berger
Wirtschaftsprüfer

Feege
Wirtschaftsprüfer

Infineon Technologies AG

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnungen

für die am 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre

	Anhang Nr.	2000	2001	2002
Umsatzerlöse				
aus Lieferungen und Leistungen an Dritte		6.072	4.623	4.276
aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen		1.211	1.048	931
Umsatzerlöse gesamt		7.283	5.671	5.207
Umsatzkosten		4.111	4.904	4.606
Bruttoergebnis vom Umsatz		3.172	767	601
Forschungs- und Entwicklungskosten		1.025	1.189	1.060
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten		670	786	643
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	24	–	117	16
Sonstige betriebliche Erträge, Saldo		–2	–200	–46
Betriebsergebnis		1.479	–1.125	–1.072
Zinsergebnis, saldiert mit Zuschüssen		75	–1	–25
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften		101	25	–47
Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	12	53	11	18
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo		36	65	–41
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		–6	6	7
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.738	–1.019	–1.160
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	–612	428	139
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		1.126	–591	–1.021
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie (in Euro) – unverwässert und verwässert	6	1,83	–0,92	–1,47

Angaben in Mio. Euro, außer bei Angaben pro Aktie.
Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Infineon Technologies AG

Konzern-Bilanzen

zum 30. September 2001 und 2002

	Anhang Nr.	2001	2002
AKTIVA			
Umlaufvermögen:			
Zahlungsmittel		757	1.199
Wertpapiere des Umlaufvermögens	7	93	738
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	626	758
Vorräte	9	882	891
Aktive kurzfristige latente Steuern	20	39	82
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	10	479	523
Summe Umlaufvermögen		2.876	4.191
Sachanlagen	11	5.233	4.491
Finanzanlagen	12	655	708
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel		86	70
Aktive latente Steuern	20	412	787
Sonstige Vermögensgegenstände	13	481	671
Summe Aktiva		9.743	10.918
PASSIVA			
Kurzfristige Verbindlichkeiten:			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	18	119	120
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14	1.191	1.197
Rückstellungen	15	426	508
Passive kurzfristige latente Steuern	20	19	21
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	16	448	537
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		2.203	2.383
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, ohne kurzfristig fällige Bestandteile	18	249	1.710
Passive latente Steuern	20	53	58
Sonstige Verbindlichkeiten	17	338	609
Summe Verbindlichkeiten		2.843	4.760
Eigenkapital:			
Grundkapital	5	1.385	1.442
Zusätzlich eingezahltes Kapital (Kapitalrücklage)		5.247	5.569
Gewinnrücklagen		195	-826
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	27	73	-27
Summe Eigenkapital		6.900	6.158
Summe Passiva		9.743	10.918

Angaben in Mio. Euro.

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Infiniteon Technologies AG

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen

für die am 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre

	Ausgegebene Stückaktien	
	Anzahl	Betrag
Konzern-Bilanz zum 1. Oktober 1999	600.000.000	1.200
Konzernjahresüberschuss	-	-
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren		
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien		
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs, saldiert mit Kosten des Börsengangs	16.700.000	33
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung im Zuge einer Privatplatzierung	7.592.430	15
Kauf von Savan	1.209.077	3
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	-	-
Zuschreibung zu Finanzanlagen auf Grund einer Kapitalerhöhung eines assoziierten Unternehmens	-	-
Einlagen der Siemens AG	-	-
Konzern-Bilanz zum 30. September 2000	625.501.507	1.251
Konzernjahresfehlbetrag	-	-
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren		
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien		
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung, saldiert mit Kosten der Kapitalerhöhung	60.000.000	120
Kauf von Ardent	706.714	1
Kauf von Catamaran	5.730.866	12
Einlage in ein assoziiertes Unternehmen	443.488	1
Von Gemeinschaftsunternehmen gehaltene, auf den Namen lautende Stückaktien	-	-
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	-	-
Auszahlung von Dividenden	-	-
Veräußerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen an eine Siemens-Gesellschaft	-	-
Einlagen der Siemens AG	-	-
Konzern-Bilanz zum 30. September 2001	692.382.575	1.385
Konzernjahresfehlbetrag	-	-
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren		
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien		
Mitarbeiteraktien	355.460	1
Kauf von Catamaran	546.183	1
Kauf von MIC	27.500.000	55
Von Gemeinschaftsunternehmen gehaltene, auf den Namen lautende Stückaktien	-	-
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo	-	-
Einlagen der Siemens AG	-	-
Konzern-Bilanz zum 30. September 2002	720.784.218	1.442

Angaben in Mio. Euro, mit Ausnahme der Anzahl der Aktien.
Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Zusätzlich eingezahltes Kapital Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Kumulierte Fremdwährungs-Umrechnungsdifferenz	Zusätzliche Pensionsverbindlichkeiten	Nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren	Gesamt
2.390	67	1	-	-2	3.656
-	1.125	-	-	-	1.125
-	-	105	-	8	113
					1.238
529	-	-	-	-	562
244	-	-	-	-	259
46	-	-	-	-	49
-23	-	-	-	-	-23
51	-	-	-	-	51
14	-	-	-	-	14
3.251	1.192	106	-	6	5.806
-	-591	-	-	-	-591
-	-	-19	-12	-8	-39
					-630
1.355	-	-	-	-	1.475
38	-	-	-	-	39
240	-	-	-	-	252
20	-	-	-	-	21
-4	-	-	-	-	-4
-19	-	-	-	-	-19
-	-406	-	-	-	-406
392	-	-	-	-	392
-26	-	-	-	-	-26
5.247	195	87	-12	-2	6.900
-	-1.021	-	-	-	-1.021
-	-	-92	-8	-	-100
					-1.121
7	-	-	-	-	8
8	-	-	-	-	9
270	-	-	-	-	325
4	-	-	-	-	4
23	-	-	-	-	23
10	-	-	-	-	10
5.569	-826	-5	-20	-2	6.158

Infineon Technologies AG

Konzern-Kapitalflussrechnungen

für die am 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre

	2000	2001	2002
Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag)	1.126	-591	-1.021
Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresüberschusses/-fehlbetrages auf den Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:			
Planmäßige Abschreibungen	834	1.122	1.371
Erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	26	69	37
Auflösung der Abgrenzung von Personalaufwendungen	26	25	23
Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	17	19	-5
Wertberichtigungen auf Vorräte	40	358	-
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-20	-1	1
Gewinne aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten	-	-235	-39
Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Sachanlagen	-2	-	2
Anteiliger Fehlbetrag/Überschuss von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	-101	-25	47
Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	-54	-11	-18
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	6	-6	-7
Außerplanmäßige Abschreibungen	-	51	51
Passive Rechnungsabgrenzung	-	-26	-87
Latente Steuern	91	-494	-278
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:			
Zu-/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-629	673	-127
Zu-/Abnahme von Vorräten	-148	-394	-27
Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-84	-76	39
Ab-/Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442	50	45
Ab-/Zunahme von Rückstellungen	468	-322	86
Zunahme von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	130	36	-37
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten	-88	-11	181
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.080	211	237

	2000	2001	2002
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:			
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens	-452	-82	-709
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-	474	62
Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftsaktivitäten	-	346	96
Einzahlungen aus Unternehmenszusammenschlüssen	-	-	50
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an assoziierten und verbundenen Unternehmen	-301	-214	-88
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43	-82	-39
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.571	-2.282	-643
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	40	27	27
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.327	-1.813	-1.244
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:			
Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten	60	-14	4
Zu-/Abnahme der Finanzforderungen und -verbindlichkeiten	222	70	-40
Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten	13	128	1.482
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	-500	-21	-21
Einzahlungen aus Ausgabe von zurückgewährbaren Anteilen an assoziierten Unternehmen	169	-	-
Veränderung der als Sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden Mittel	-67	45	15
Einzahlungen aus Ausgabe von Aktien an Minderheitsgesellschafter	-	20	-
Einzahlungen aus Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien	821	1.475	8
Auszahlungen von Dividenden	-	-406	-
Verkauf von Beteiligungen an einem Gemeinschaftsunternehmen an Siemens	-	564	-
Kapitaleinlagen vom Siemens Konzern	1	-15	-
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	719	1.846	1.448
Währungsumrechnungseffekte auf Zahlungsmittel	9	2	1
Veränderung der Zahlungsmittel	481	246	442
Zahlungsmittel am Periodenanfang	30	511	757
Zahlungsmittel am Periodenende	511	757	1.199

Angaben in Mio. Euro.

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

(1) Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Infineon Technologies Aktiengesellschaft („Infineon“ oder die „Gesellschaft“) entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten, eingesetzt. Das Leistungsspektrum von Infineon umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Lösungen für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Infineons Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika. Das Geschäftsjahr von Infineon endet zum 30. September.

Gründung

Infineon wurde als eigenständiges Rechtssubjekt mit Wirkung zum 1. April 1999 gegründet („Gründung“). Im Zuge der Gründung erfolgte die Übertragung des nahezu vollständigen mit dem Halbleitergeschäft verbundenen Vermögens der Siemens AG („Siemens“) mit allen Beteiligungen, Betrieben und Geschäftsaktivitäten. Infineons Börsengang erfolgte am 13. März 2000. Die Gesellschaft wird an der New York Stock Exchange gehandelt und ist eines der dreißig Dax-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Grundlagen der Darstellung

Der Konzernabschluss wurde nach den in den USA geltenden Grundsätzen der Rechnungslegung („US-GAAP“) erstellt. Die Infineon Technologies AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Nach § 292a HGB braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt zu werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wie US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt Infineon die Befreiungsmöglichkeit des § 292a HGB in Anspruch.

Alle in diesem Jahresabschluss gezeigten Beträge sind in Mio. Euro („€“), außer wenn anders angegeben.

Im Konzernabschluss und Konzernanhang des Vorjahrs wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr zu gewährleisten. Das Konzernergebnis wird von diesen Umgliederungen nicht beeinflusst.

(2) Bilanzierung und Bewertung

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

Konsolidierungsgrundsätze

Der vorliegende Konzernabschluss umfasst, jeweils auf konsolidierter Basis, Infineon und deren wesentliche Tochtergesellschaften. Gesellschaften, an denen Infineon mit 20% oder mehr beteiligt ist, die jedoch nicht unter der einheitlichen Leitung von Infineon stehen („Assoziierte Unternehmen“), werden prinzipiell unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert (siehe Anhang Nr. 12). Das anteilige Jahresergebnis von den nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften wird im Allgemeinen um drei Monate zeitversetzt erfasst. Sonstige Beteiligungen, an denen Infineon einen Eigentumsanteil von weniger als 20% hält, werden zu Anschaffungskosten aufgenommen. Die Auswirkungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle zwischen den konsolidierten Gesellschaften sind im Konzernabschluss eliminiert.

Der Infineon-Konzern besteht neben der Infineon Technologies AG aus der folgenden Anzahl von Unternehmen:

	Konsolidierte Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gesamt
30. September 2001	44	9	53
Zugänge	4	2	6
Zusammenschlüsse	-3	-	-3
Abgänge	-1	-	-1
30. September 2002	44	11	55

Zusätzlich umfasst der Konzernabschluss 32 (2001: 33) Tochtergesellschaften und 9 (2001: 9) assoziierte Unternehmen, die nicht konsolidiert, sondern nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanziert werden, da diese keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Finanzanlagen“. Die Auswirkung dieser Unternehmen auf die Konzernbilanzsumme, die Konzernumsätze und das Konzernergebnis war in den Betrachtungsperioden geringer als 1%.

Berichtswährung und Währungsumrechnung

Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden ausländischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, werden grundsätzlich unter Anwendung der Stichtagskursmethode umgerechnet. Posten der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung werden dagegen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs des Geschäftsjahrs umgerechnet. Unterschiede aus der Umrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden, die aus zu Vorjahren abweichenden Wechselkursen resultieren, werden innerhalb des Postens „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ (Other Comprehensive Income/Loss) separat im Eigenkapital ausgewiesen.

Nachfolgend sind die bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten Wechselkurse für die wichtigsten Währungen aufgeführt:

Währung		Wechselkurs zum 30. September		Jahresdurchschnittskurs	
		2001	2002	2001	2002
		Euro	Euro	Euro	Euro
US-Dollar	1 USD =	1,0864	1,0208	1,1312	1,0910
Japanische Yen	100 JPY =	0,9112	0,8318	0,9573	0,8661
Britisches Pfund	1 GBP =	1,6015	1,5939	1,6269	1,6017
Singapur-Dollar	1 SGD =	0,6152	0,5722	0,6373	0,6029

Zahlungsmittel

Bargeld sowie alle Finanzmittel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten werden als liquide Mittel ausgewiesen.

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel beinhalten Geldanlagen, die im Rahmen der Finanzierung als Sicherheit hinterlegt sind.

Wertpapiere

Die Gesellschaft hält frei veräußerbare Wertpapiere („Available-for-Sale“-Papiere), die zu dem zuletzt gehandelten Marktpreis vor dem Bilanzstichtag bewertet sind. Kumulierte unrealisierte Gewinne und Verluste, nach Abzug von latenten Steuern, sind im Eigenkapital als „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste und voraussichtlich dauernde Wertminderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens werden in der Position „Sonstige Erträge und Aufwendungen“ erfasst. Im Veräußerungsfall wird für die Ermittlung realisierter Gewinne oder Verluste vor Steuern von den individuellen Anschaffungskosten der Wertpapiere ausgegangen.

Vorräte

Die Vorräte werden entweder zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis bewertet, wobei die Herstellungskosten vorwiegend zu Durchschnittswerten ermittelt werden. Die Herstellungskosten beinhalten die direkt zurechenbaren Material- und Lohnkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

Sachanlagen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bilanziert. Kosten für Ersatzteile, laufende Instandhaltung und Reparaturen werden bei Anfall aufwandswirksam erfasst. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder degressiven Methode ermittelt. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten Anzahlungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben.

Die Herstellungskosten bestimmter langlebiger Vermögensgegenstände enthalten aktivierte Finanzierungskosten, die über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben werden. Für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002 wurden Zinsen in Höhe von € 3, € 27 und € 0 aktiviert. Die den Abschreibungen zu Grunde gelegten Nutzungsdauern betragen bei:

	Jahre
Gebäuden	10–25
Technischen Anlagen und Maschinen	3–10
Sonstigen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1–10

Leasing

Infineon ist Leasingnehmer von Sachanlagen. Alle Leasinggeschäfte, bei denen Infineon in der Position des Leasingnehmers als wirtschaftlicher Eigentümer zu sehen ist, werden gemäß dem vom Financial Accounting Standards Board („FASB“) veröffentlichten Statement of Financial Accounting Standards („SFAS“) Nr. 13, „Rechnungslegung für Leasing“, als Finanzierungsleasing behandelt und bei Infineon als Sachanlagen bilanziert. Alle anderen Leasinggeschäfte werden als Operating-Leases behandelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Juli 2001 veröffentlichte das FASB das SFAS Nr. 141 „Geschäftszusammenschlüsse“. Seitdem wendet die Gesellschaft die Erwerbsmethode bei allen Unternehmenszusammenschlüssen an. Die Erwerbsmethode fordert, dass bei einem Unternehmenserwerb neben dem Geschäfts- und Firmenwert (Goodwill) die immateriellen Vermögensgegenstände getrennt erfasst und ausgewiesen werden.

Seit dem 1. Oktober 2001 wendet die Gesellschaft SFAS Nr. 142 „Geschäfts- und Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände“ an. Bei der Einführung des SFAS Nr. 142 bewertete die Gesellschaft ihre vorhandenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Firmenwerte, die bei früheren Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden gemäß SFAS Nr. 141 und gliederte Beträge von € 1, die zuvor dem Mitarbeiterstamm zugerechnet wurden, zu Geschäfts- und Firmenwert um, um den neuen Kriterien des SFAS Nr. 141 zu entsprechen. Bei Einführung des SFAS Nr. 142 bewertete die Gesellschaft die Nutzungsdauern und Restwerte aller erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände neu, was zu keinen wesentlichen Änderungen der Abschreibungsdauern führte. Die Gesellschaft stellte keine immateriellen Vermögensgegenstände mit unbegrenzter Nutzungsdauer fest. Gemäß SFAS Nr. 142 werden immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauern über ihre entsprechende Nutzungsdauer auf einen geschätzten Restwert abgeschrieben und nach den Maßgaben des SFAS Nr. 121 „Rechnungslegung bei außerplanmäßiger Wertminderung von langfristigen Anlagevermögen und bei der Veräußerung langfristigen Anlagevermögens“ auf außerplanmäßige Wertminderungen überprüft.

Im Zusammenhang mit der Einführung von SFAS Nr. 142 führte die Gesellschaft eine Überprüfung durch, ob Anhaltspunkte dafür bestanden, dass Geschäfts- und Firmenwerte zu diesem Zeitpunkt in ihrem Wert beeinträchtigt waren. Für diese Untersuchung ermittelte die Gesellschaft ihre relevanten Geschäftseinheiten und bestimmte für jede dieser Geschäftseinheiten den zurechenbaren Buchwert, indem sie die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten einschließlich des bestehenden Geschäfts- und Firmenwerts und der immateriellen Vermögensgegenstände den Geschäftseinheiten zum Zeitpunkt der Einführung zordnete. Die Gesellschaft bestimmte die Marktwerte jeder Geschäftseinheit zum Umstellungszeitpunkt und verglich diese mit den Buchwerten. Die Untersuchung wurde von der Gesellschaft am 31. März 2002 abgeschlossen. Soweit der Buchwert einer Geschäftseinheit den Marktwert nicht überstieg, lagen keine Anzeichen dafür vor, dass der Geschäfts- und Firmenwert der Geschäftseinheit zum Zeitpunkt des Erwerbs beeinträchtigt war.

Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen hauptsächlich aus erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen, die zum Kaufpreis bilanziert wurden, sowie aus Geschäfts- und Firmenwerten, die im Zusammenhang mit Unternehmensakquisitionen als der Teil des Kaufpreises, der den Marktwert des erworbenen Nettovermögens überstieg, entstanden. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über den erwarteten Nutzungszeitraum, der von drei bis zehn Jahren reicht, abgeschrieben. Bei Einführung des SFAS Nr. 142 wies die Gesellschaft nicht abgeschriebene Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von € 297 sowie nicht abgeschriebene immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von € 140 aus. Gemäß SFAS Nr. 142 werden Geschäfts- und Firmenwerte nicht weiter abgeschrieben, sondern nach den Vorgaben des SFAS Nr. 142 mindestens einmal jährlich auf eventuelle Wertminderungen geprüft. Die Gesellschaft beendete die jährlichen Überprüfungen im letzten Quartal des Geschäftsjahrs 2002, welche in einer Geschäftseinheit der Sonstigen Geschäftsbereiche eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 5 zur Folge hatten.

Vor der Anwendung des SFAS Nr. 142 wurden Geschäfts- und Firmenwerte über ihre erwarteten Nutzungsdauern abgeschrieben. In den Geschäftsjahren 2000 und 2001 betrug die Abschreibungen für Geschäfts- und Firmenwerte € 8 bzw. € 21. Wären die Bestimmungen der SFAS Nr. 141 und 142 für alle dargestellten Geschäftsjahre angewendet worden, d. h. das Ergebnis der Geschäftsjahre 2000 und 2001 wäre nicht um die Abschreibung von Geschäfts- und Firmenwerten reduziert worden, hätten der Jahresüberschuss (-fehlbetrag) und das Ergebnis pro Aktie den nachfolgend dargestellten Pro-forma-Beträgen entsprochen:

	2000	2001	2002
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)			
Wie ausgewiesen	1.126	-591	-1.021
Pro forma	1.134	-570	-1.021
Gewinn (Verlust) je Aktie (in Euro):			
Wie ausgewiesen – unverwässert und verwässert	1,83	-0,92	-1,47
Pro forma – unverwässert	1,85	-0,89	-1,47
Pro forma – verwässert	1,84	-0,89	-1,47

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Infineon überprüft Anlagegüter einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen, sobald Ereignisse oder Veränderungen eintreten, die darauf hindeuten, dass voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen könnten. Dabei wird der Restbuchwert mit den erwarteten künftigen Einnahmeüberschüssen, die von diesem Vermögensgegenstand generiert werden, verglichen. Eine außerplanmäßige Abschreibung wird insoweit vorgenommen, als nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Buchwert über dem Marktwert oder dem Barwert künftiger Einnahmeüberschüsse liegt. Die Beurteilung durch das Management erfordert wesentliche Annahmen, um diskontierte zukünftige Cash-Flows abschätzen zu können.

Finanzinstrumente

Infineon ist als weltweit operierendes Unternehmen den Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgesetzt. Zur Sicherung gegen Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Das FASB veröffentlichte SFAS Nr. 133 „Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften“, erweitert durch SFAS Nr. 137 und SFAS Nr. 138, die ab dem 1. Oktober 2000 durch die Gesellschaft angewendet werden. SFAS Nr. 133 und die Erweiterungsregelungen beinhalten Aussagen zur Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten einschließlich solcher, die Bestandteil anderer Verträge sind, sowie von Sicherungsgeschäften. Derivative Finanzinstrumente werden mit ihrem Marktwert unter den sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenständen oder den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Veränderungen der Marktwerte werden in den Konzern-Gewinn- und Verlust-Rechnungen oder als Änderung im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, ausgewiesen, in Abhängigkeit davon, ob das Finanzinstrument Teil eines Sicherungsgeschäfts ist, und gemäß der Art des Sicherungsgeschäfts. Die Anwendung des SFAS Nr. 133 sowie dessen Erweiterungen hatten keinen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente und anderer Finanzinstrumente wird in Anhang Nr. 29 erläutert.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse werden abzüglich der Rabatte und Nachlässe aus Preissicherungsklauseln ausgewiesen, sobald die Lieferungen oder Leistungen erbracht sind und der Gefahrenübergang erfolgt ist.

Die US Security and Exchange Commission („SEC“) hat das Staff Accounting Bulletin („SAB“) Nr. 101 „Umsatzrealisation in Abschlüssen“ veröffentlicht. SAB Nr. 101 regelt Realisierung, Ausweis und Erläuterungen zu Umsatzerlösen in Abschlüssen, die bei der SEC einzureichen sind. Seit 1. Juli 2001 wendet Infineon SAB Nr. 101 an. Die Anwendung hatte keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Umsatzrealisierung – Lizenzen und Know-how-Überlassung

Lizenzgebühren und Erträge aus der Know-how-Überlassung werden realisiert, sofern der Zahlungseingang erfolgt und die Leistung erbracht ist. Einmalzahlungen werden abgegrenzt und über den Zeitraum der Leistungserbringung vereinnahmt. Vereinbarungen über eine Leistung aus mehreren Bestandteilen, für die separate Marktpreise nicht existieren, werden in zusammengefasster Form über die entsprechenden Perioden realisiert. Stücklizenzgebühren werden zum Zahlungszeitpunkt erfolgswirksam vereinnahmt.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Fördergelder für Investitionen wie Investitionszuschüsse und steuerfreie Investitionszulagen werden erfolgswirksam über die Nutzungsdauer (als Reduzierung der Abschreibungen) der geförderten Sachanlagen vereinnahmt. Der Anspruch auf Fördermittel wird dann bilanziert, wenn die begünstigten Investitionen getätigt wurden. Investitionszulagen werden über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten periodengerecht abgegrenzt (Anhang Nr. 17), während Investitionszuschüsse die Anschaffungs- und Herstellungskosten reduzieren (Anhang Nr. 22).

Sonstige zu versteuernde Zuschüsse werden aufwandsmindernd erfasst (siehe Anhang Nr. 17 und 22).

Produktbezogene Aufwendungen

Ausgaben für Produktmarketing und Werbung sowie für sonstige vertriebsbezogene Maßnahmen werden zum Zeitpunkt des Anfalls als Aufwand erfasst. Gewährleistungsrückstellungen werden ab dem Zeitpunkt der Umsatzrealisierung gebildet. Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei Anfall in voller Höhe als Aufwand gebucht.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden nach der Verbindlichkeiten-Methode ermittelt. Aktive und passive latente Steuern werden als sonstige Vermögensgegenstände bzw. als Rückstellungen bilanziert, um die künftige steuerliche Wirkung aus zeitlichen Unterschieden zwischen dem bilanziellen Wertansatz von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten und dem steuerlich beizulegenden Wert zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der aktiven und passiven latenten Steuern wird von den erwarteten Steuersätzen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Realisierung ausgegangen. Wirkungen aus den Änderungen von Steuersätzen werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung berücksichtigt.

Aktionsoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert Vergütungen in Form von Aktienoptionen auf der Grundlage der Inneren-Wert-Methode entsprechend der Accounting Principles Board („APB“) Opinion 25, „Bilanzierung an Mitarbeiter ausgegebener Aktien“, und hat das Wahlrecht, nur die Erläuterung dieser Aktionsoptionspläne gemäß SFAS Nr. 123, „Bilanzierung für Aktionsoptionspläne“, anzugeben, wahrgenommen.

Kapitalerhöhungen von Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen

Gewinne oder Verluste aus der Durchführung von Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen führen entsprechend der Veränderung der Anteilshöhe zu sonstigen Erträgen oder Aufwendungen entsprechend der Regelungen des SAB Topic 5:H „Bilanzierung bei Anteilsverkäufen von Tochtergesellschaften“ (siehe Anhang Nr. 12).

Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert Schätzungen und Annahmen des Managements. Diese haben Einfluss auf den Ausweis von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. Die tatsächlichen Beträge können wesentlich von den Schätzungen des Managements abweichen.

Aktuelle Verlautbarungen zur Bilanzierung

Im Juni 2001 gab das Financial Accounting Standards Board das SFAS Nr. 143 „Bilanzierung von Verpflichtungen aus der Stilllegung von Vermögensgegenständen“ heraus, welches sich auf die Rechnungslegung für Verpflichtungen aus Stilllegungen von langlebigen Vermögensgegenständen und den zugehörigen Stilllegungskosten bezieht. Dieser Standard ist anwendbar auf die Verpflichtungen aus der Stilllegung von langlebigen Vermögensgegenständen, die aus Kauf, Konstruktion, Entwicklung und/oder normaler Benutzung des Vermögensgegenstands resultieren. SFAS Nr. 143 verlangt, dass die Stilllegungs-Verpflichtung in dem Berichtszeitraum erfasst wird, in dem sie entsteht, sofern eine angemessene Beurteilung des Marktwerts möglich ist. Der Marktwert der Verpflichtung wird zum Buchwert des entsprechenden Vermögensgegenstands addiert, und der zusätzliche Buchwert aus dieser Verpflichtung wird über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands abgeschrieben. Die Verpflichtung wird am Ende jeder Periode zu Lasten der Betriebsaufwendungen angepasst. Falls die Verpflichtung zu einem anderen als dem Buchwert abgerechnet wird, resultiert daraus ein Abrechnungsgewinn oder -verlust. Infineon wird das SFAS Nr. 143 zum 1. Oktober 2002 einführen. Um dies zu erreichen, muss die Gesellschaft alle eventuellen Verpflichtungen identifizieren und deren Marktwerte zum Zeitpunkt der Erstanwendung des Standards bestimmen. Die Wertbestimmung ist komplex und erfordert die Erhebung von Marktdaten und die Entwicklung von Cash-Flow-Modellen. Zusätzlich müssen Prozesse entwickelt werden, um diese Verpflichtungen zukünftig zu identifizieren und zu verfolgen. Die Anwendung von SFAS Nr. 143 wird voraussichtlich keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Im August 2001 veröffentlichte das FASB das SFAS Nr. 144 „Bilanzierung von Wertberichtigungen oder von Veräußerungen von Anlagegütern“. SFAS Nr. 144 hält an der bestehenden Regelung fest, nur dann Wertberichtigungen vorzunehmen, wenn die zukünftigen, nicht diskontierten Einnahmeüberschüsse den Restbuchwert der Anlagegüter nicht abdecken. Geschäfts- und Firmenwerte werden in diese Betrachtung nicht einbezogen. Für den Fall, dass Anlagegüter aufgegeben, ausgetauscht oder im Verlauf einer Ausgründung an die Eigentümer abgegeben werden sollen, fordert SFAS Nr. 144, dass ein derartiges Anlagegut so lange zum Anlagevermögen gehört, bis das Anlagegut tatsächlich aus dem Betrieb ausscheidet. Die Nutzungsdauer eines Anlageguts, das aufgegeben werden soll, muss jedoch angepasst werden. SFAS Nr. 144 fordert, dass alle Anlagegüter, die verkauft werden sollen, zum Restbuchwert oder zum niedrigeren Marktwert abzüglich Veräußerungskosten und noch zu berücksichtigender Abschreibungen ausgewiesen werden. Deshalb werden nicht mehr fortgeführte Aktivitäten nicht länger auf Basis des zu erzielenden Marktwerts bemessen, und zukünftige Verluste werden erst dann ausgewiesen, wenn sie eintreten. Die Gesellschaft muss SFAS Nr. 144 ab dem 1. Oktober 2002 anwenden. Die Anwendung von SFAS Nr. 144 wird voraussichtlich keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Im Juni 2002 gab das FASB das SFAS Nr. 146 „Die Buchung von Kosten im Zusammenhang mit der Aufgabe und der Veräußerung von Geschäftsaktivitäten“ heraus, welches die buchhalterische Erfassung und Bilanzierung von Kosten, die bei Veräußerungen von Unternehmensteilen anfallen, zum Inhalt hat und die Regelung des Emerging Issues Task Force („EITF“) Issue Nr. 94-3 „Die Erfassung von Verbindlichkeiten bei bestimmten Personalabbaumaßnahmen und anderen Kosten im Zusammenhang mit der Aufgabe eines Geschäfts (einschließlich bestimmter Kosten bei Restrukturierungen)“ aufhebt. SFAS Nr. 146 fordert, dass eine Verbindlichkeit für Kosten im Zusammenhang mit der Aufgabe oder der Veräußerung von Unternehmensteilen erst dann angesetzt und mit dem Marktwert bewertet wird, wenn die Verbindlichkeit entstanden ist. Gemäß der Vorgabe der EITF Nr. 94-3 konnte eine Verbindlichkeit für Austrittskosten bereits zu dem Zeitpunkt erfasst werden, zu dem sich die Gesellschaft verpflichtet hatte. SFAS 146 findet bei der Aufgabe oder der Veräußerung von Unternehmensteilen Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2002 eingeleitet wird. Dementsprechend erwartet die Gesellschaft aus der Anwendung von SFAS Nr. 146 voraussichtlich keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

(3) Akquisitionen

Am 9. September 2002 erwarb Infineon alle Aktien der Ericsson Microelectronics AB („MIC“). MIC, mit Hauptsitz in Schweden, ist ein Hersteller von Hochfrequenz-Mikroelektronikbauteilen für Mobilfunkapplikationen, High-End-Leistungsverstärker, Bluetooth-Bauteile und Breitband-Kommunikationsprodukte. MIC stellt einen strategischen Zulieferer für Ericsson, einen Marktführer bei Basisstationen für Bluetooth-Lösungen und Hochfrequenz-Bauteile für Mobiltelefone und drahtlose Infrastruktur dar. Ferner traf die Gesellschaft eine strategische Liefervereinbarung mit Ericsson über bestimmte Mobilfunklösungen, etwa auf den Gebieten aktueller und zukünftiger Mobiltelefontechnologien (allgemein als 2,5G und 3G bezeichnet), über eine Laufzeit von zwei Jahren. Durch diese Akquisition wird die Gesellschaft ihre Kompetenz in den Bereichen Bluetooth-Lösungen und Hochfrequenz-Komponenten für Mobiltelefone sowie in der mobilen Infrastruktur weiter ausbauen können. Sollte Ericsson bestimmte Abnahmeschwellen bis Dezember 2002 erreichen, wird Infineon zusätzlich € 50 an Ericsson zahlen, die zum 30. September 2002 als Verbindlichkeit erfasst sind. Sollte Ericsson diese Schwelle nicht erreichen, wird Ericsson der Gesellschaft € 130 zahlen. Nachdem die Abnahmeschwellen mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden, wurden die € 50 ab dem Erwerbszeitpunkt als Geschäfts- und Firmenwert erfasst. Zum 30. September 2002 war die Verrechnung des Kaufpreises für MIC noch nicht abgeschlossen. Darum wurde die Kaufpreisaufteilung auf einer vorläufigen Basis im vorliegenden Bilanzausweis abgebildet.

Im August 2001 erwarb die Gesellschaft alle Aktien der Catamaran Communications Inc. („Catamaran“). Catamaran, mit Sitz in San José, ist ein Entwickler von Halbleitern für den Einsatz im Kommunikationsbereich ohne eigene Herstellungskapazität, der sich auf integrierte Schaltungen (ICs) für die optische Datenübertragung konzentriert.

Im April 2001 schloss die Gesellschaft den Erwerb aller Aktien der Ardent Technologies Inc. („Ardent“) ab. Ardent ist ein Zulieferer von ICs mit hoher Bandbreite für internetbasierte Schaltsysteme im lokalen Netzwerkbereich (LAN). Auf Grund deutlicher Veränderungen im Wirtschaftsklima der internetbezogenen Anwendungen, einschließlich des Marktes für LAN-Schaltssysteme, hat die Gesellschaft im Rahmen ihres Umstrukturierungsprogramms von 2001 (siehe Anhang Nr. 24) eine große Anzahl der Mitarbeiter bei Ardent freigestellt, bestimmte erworbene Technologien nicht weiterverfolgt und die zukünftigen Forschungsaufwendungen bei Ardent deutlich reduziert. Auf Grund einer Rückstufung der erwarteten zukünftigen Überschüsse und verschiedener unabhängiger Bewertungen der verbleibenden immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum 30. September 2001 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von € 14 vorgenommen. Zum 30. September 2002 löste die Gesellschaft die verbleibenden Geschäftsfelder von Ardent auf und verzeichnete außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von € 3 für den Restwert der verbliebenen Patente und Technologien.

Am 24. Oktober 2000 hat die Gesellschaft ihre Option zum Erwerb des restlichen Anteils von Motorola an der Semiconductor 300 GmbH & Co. KG, Dresden („SC 300“), ausgeübt. SC 300 wurde von diesem Zeitpunkt an voll konsolidiert. Vor dem Erwerb der Anteile von Motorola wurde der von Infineon gehaltene Anteil nach der Equity-Methode bilanziert, da Infineon nicht die Kontrolle über die SC 300 hatte.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Akquisitionen der Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2001 und 2002 zusammen:

	2001			2002
	SC 300	Ardent	Catamaran	MIC
Erwerbszeitpunkt	Oktober 2000	April 2001	August 2001	September 2002
Geschäftsbereich	Speicherprodukte	Drahtgebundene Kommunikation	Drahtgebundene Kommunikation	Mobile Kommunikation
Barmittel	–	–	–	50
Sonstiges Umlaufvermögen	80	1	1	62
Sachanlagen	94	1	5	60
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Aktuelle Produkttechnologie	–	–	–	17
Basistechnologie	–	9	9	49
Patente	–	14	–	28
Laufende F&E	–	12	57	37
Geschäfts- und Firmenwert	–	3	179	70
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	–	–	–	66
Gesamte erworbene Vermögensgegenstände	174	40	251	439
Kurzfristige Verbindlichkeiten	–166	–5	–23	–86
Langfristige Verbindlichkeiten	–	–9	–13	–26
Gesamte übernommene Verbindlichkeiten	–166	–14	–36	–112
Erworbenes Nettovermögen	8	26	215	327
Abgegrenzte Vergütung	–	13	31	–
Kaufpreis	8	39	246	327
Barzahlung	8	–	–	–
Ausgegebene Aktien (in Stück)	–	706.714	5.730.886	27.500.000
Anteilige Zahlung in Aktien (in Stück)	–	–	642.569	–

Die oben aufgeführten Akquisitionen wurden nach der Erwerbsmethode bilanziert. Dementsprechend enthält das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit die Ergebnisse der erworbenen Gesellschaften ab dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt. Der Wert der zur teilweisen Kaufpreisbegleichung ausgegebenen Aktien wurde auf Grund der durchschnittlichen Marktpreise der Aktien der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwei Tagen vor und nach dem Tag, an dem die Anzahl der ausgegebenen Aktien festgelegt wurde, ermittelt.

Aktien, die emittiert und für Mitarbeiter als Anreiz für die Fortdauer der Beschäftigung und die Erreichung bestimmter Leistungsziele hinterlegt wurden, werden als abgegrenzte Vergütung mit ihrem inneren Wert bilanziert. Die abgegrenzte Vergütung wird als Minderung der Kapitalrücklage in der Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt und linear über die entsprechenden Beschäftigungs- oder Leistungszielzeiträume abgeschrieben, die zwischen zwei und vier Jahren betragen.

Ausgegebene Aktien, die für die Aktionäre der erworbenen Gesellschaften als Anreiz zur Erreichung bestimmter Leistungsziele hinterlegt wurden, stellen eine anteilige Kaufpreiszahlung dar. Diese Aktien werden in der Eigenkapitalveränderungsrechnung nicht als emittiert und ausgegeben dargestellt. Sollten die Leistungsziele erreicht werden, wird der Kaufpreis um die Ausgabe der erworbenen Aktien, welche zum jeweiligen Marktwert am Stichtag bewertet werden, angepasst. Während des Geschäftsjahrs 2002 wurden 546.183 Aktien aus der Hinterlegung freigegeben, da die Leistungsziele erreicht wurden (siehe Anhang Nr.5), was zu einer Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts von Catamaran in Höhe von € 9 führte.

Bei jeder Akquisition wurde ein unabhängiger Dritter zur Bewertung des erworbenen Nettovermögens hinzugezogen. Als Folge dieser Bewertungen wurden in den Geschäftsjahren 2001 und 2002 Beträge von € 69 bzw. € 37 als erworbene, noch nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen den F&E-Aufwendungen zugerechnet, da keine technologische Anwendung der Entwicklungen erkennbar war und keine zukünftige Alternativnutzung existierte. Die Beträge, die den erworbenen, noch nicht abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen zugerechnet wurden, wurden durch anerkannte Bewertungspraktiken für den Hochtechnologie-Kommunikationssektor und zugehörige Richtlinien der SEC ermittelt.

Basistechnologien und Patente werden über ihre erwartete Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben, aktuelle Produkttechnologie wird über ihre erwartete Nutzungsdauer von zwei Jahren abgeschrieben.

Der Geschäfts- und Firmenwert, der den Betrag darstellt, um den der Kaufpreis das erworbene Nettovermögen übersteigt, wird gemäß SFAS Nr. 141 für Akquisitionen nach dem 1. Juli 2001 nicht abgeschrieben. Die im Rahmen der Akquisitionen Catamaran und MIC entstandenen Geschäfts- und Firmenwerte werden entsprechend nicht abgeschrieben. Wären die Geschäfts- und Firmenwerte abgeschrieben worden, hätten sich die Aufwendungen in den Jahren 2001 und 2002 um € 3 bzw. € 37 erhöht. Keiner der Geschäfts- und Firmenwerte ist steuerlich abzugsfähig.

Auf die Aufstellung von Pro-forma-Finanzdaten wurde verzichtet, da die Akquisitionen keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Im April 2000 erwarb die Gesellschaft Savan Communications Ltd., eine Gesellschaft, die VDSL-Technologie produziert, für € 75 in Barmitteln und schloss einen Vertrag über abzugrenzende Vergütungen in Höhe von € 56 ab. Nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Höhe von € 26 wurden im Geschäftsjahr 2000 im Zusammenhang mit dieser Akquisition als Aufwand gebucht.

(4) Geschäftsanteilsveräußerungen

Am 1. Juli 2002 vollendete die Gesellschaft den Verkauf ihres Gallium-Arsenid-Geschäfts, das zum Bereich Mobile Kommunikation gehörte, einschließlich bestimmter, nicht fertigungsrelevanter materieller und immaterieller Vermögensgegenstände sowie spezifizierter Kundenverträge und -verbindlichkeiten. Die Gesellschaft erhielt vorläufige Barerlöse in Höhe von € 50. Eventuelle Kaufpreisanpassungen hängen von der Höhe der Umsätze an Gallium-Arsenid-Produkten, die vom Käufer bis zum 30. September 2004 realisiert werden, und weiteren Bereinigungen ab. Die Berücksichtigung dieser Anpassungen, die sich zwischen einer Zahlung von € 5 und Erlösen von € 74 bewegen, erfolgt, wenn der Berücksichtigungszeitraum vorbei und der Betrag realisierbar ist. Bis einschließlich Juni 2003 ist die Gesellschaft verpflichtet, den Käufer mit einer Mindestmenge an Gallium-Arsenid-Produkten deutlich unter Marktpreisen zu beliefern. € 44 der Erlöse wurden dementsprechend abgegrenzt und werden im Laufe der Liefervereinbarung, wenn die Produkte verkauft werden, realisiert. Die Veräußerung führte zu einem Vorsteuerertrag von € 2, der als sonstiger Ertrag im Geschäftsjahr 2002 bilanziert wird. Die Umsatzerlöse des veräußerten Gallium-Arsenid-Geschäfts betragen in den Geschäftsjahren 2001 und 2002 (bis zum Veräußerungszeitpunkt) € 36 bzw. € 24, das Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschaften entfallender Ergebnisanteile und Steuern („EBIT“) € -44 bzw. € -18.

Am 31. Dezember 2001 veräußerte die Gesellschaft ihren verbleibenden 81%igen Anteil an der Infineon Technologies Krubong Sdn. Bhd., welche zu dem Geschäftsfeld Infrarotkomponenten gehörte und vorher unter den Sonstigen Geschäftsbereichen ausgewiesen wurde. Die ersten 19% waren im Juli 2001 verkauft worden. Dieses Geschäft generierte im Geschäftsjahr 2000 Umsatzerlöse in Höhe von € 137, im Geschäftsjahr 2001 in Höhe von € 110 und im Geschäftsjahr 2002 bis zum Veräußerungszeitpunkt in Höhe von € 11. Das EBIT belief sich auf € 16, € -22 und € -7 in den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 (bis zum Veräußerungszeitpunkt). Die Gesellschaft erzielte aus dem Verkauf Nettogewinne vor Steuern in Höhe von € 26 bzw. € 39, welche in den Abschlüssen zum 30. September 2001 bzw. 2002 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen dargestellt werden.

Am 14. August 2001 hat die Gesellschaft vertraglich den Verkauf des von ihr gehaltenen Anteils von 49% an dem Gemeinschaftsunternehmen OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG („OSRAM Opto“) mit der OSRAM GmbH („OSRAM“) für € 565 vereinbart. OSRAM ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Siemens. Nach der Rechnungslegungsinterpretation 39 des Accounting Principles Board (APB) Opinion 16 „Transfers und Übertragungen zwischen Gesellschaften unter gemeinsamer Kontrolle“ müssen langlebige Vermögensgegenstände zwischen zwei Tochterunternehmen, die unter gemeinsamer Führung stehen, zu historischen Kosten transferiert werden. Der den Buchwert übersteigende Kaufpreis ist demnach als Kapitaleinlage auszuweisen. Der Kaufpreisüberschuss nach Steuern von € 392 wurde entsprechend als direkte Kapitaleinlage zum 30. September 2001 bilanziert. Infineon hat Gewinnanteile aus der Beteiligung an OSRAM Opto im Jahr 2000 in Höhe von € 9 und in 2001 in Höhe von € 4 ausgewiesen.

Am 19. Dezember 2000 verkaufte die Gesellschaft das Geschäftsfeld Image & Video, welches Teil des Geschäftsbereichs Drahtgebundene Kommunikation war. Das Geschäftsfeld generierte in den Geschäftsjahren 2000 und 2001 (bis zum Veräußerungszeitpunkt) Umsatzerlöse in Höhe von € 139 und € 38 und ein EBIT in Höhe von € 16 bzw. € 10. Die Veräußerung dieses Geschäftsfelds brachte einen Nettogewinn vor Steuern in Höhe von € 202 und wird im Abschluss zum 30. September 2001 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

(5) Grundkapital

Am 30. September 2002 hatte Infineon 720.880.604 Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,00 Euro ausgegeben. In der Bilanz zum 30. September 2002 wurden 96.386 ausgegebene Aktien, die als bedingte Kaufpreiskomponenten im Zusammenhang mit der Akquisition von Catamaran (siehe Anhang Nr.3) durch einen Treuhänder verwahrt wurden, nicht als ausstehend klassifiziert. Ohne Berücksichtigung der hinterlegten Aktien sind zum 30. September 2002 folglich 720.784.218 Namensaktien ausstehend.

Genehmigtes und Bedingtes Kapital

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Vorstand, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Anteile zu erhöhen. Zum Stichtag 30. September 2002 kann der Vorstand folgende genehmigte Kapitalien zur Ausgabe neuer Aktien ausüben:

- Das Genehmigte Kapital I/2002 ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 21. Januar 2007 um bis zu € 295, um junge Aktien gegen Bareinlagen auszugeben, wobei das Bezugsrecht teilweise ausgeschlossen werden kann, oder im Zusammenhang mit Geschäftszusammenschlüssen (jegliche Einbringung), wobei das Bezugsrecht für alle Aktien ausgeschlossen werden kann.
- Das Genehmigte Kapital II ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 31. März 2004 um bis zu € 119, um Aktien an Mitarbeiter auszugeben (wobei die Bezugsrechte bestehender Aktionäre ausgeschlossen sind).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 96 („Bedingtes Kapital I“) bzw. um bis zu € 29 („Bedingtes Kapital III“) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 62,5 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung jeweils ab dem Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe und nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten unter diesem Aktienoptionsplan von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen (siehe Anhang Nr. 28). Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 50 durch Ausgabe von bis zu 25 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die im Februar 2002 begeben wurden und bis zum 23. Januar 2007 umgewandelt werden können (siehe Anhang Nr. 18). Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 350 durch Ausgabe von bis zu 175 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 21. Januar 2007 begeben werden können. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil.

Das Genehmigte Kapital III ermächtigte den Vorstand zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 22. Januar 2002 zur Finanzierung von Unternehmensakquisitionen, wobei die Bezugsrechte bestehender Aktionäre ausgeschlossen waren.

Kapitalmaßnahmen

Nach der Gründung wurde Infineon durch die Ausgabe von 600.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem gesamten Nennkapital von € 1.200 ausgestattet. Am 13. März 2000 erfolgte Infineons Börsengang mit 16.700.000 auf den Namen lautenden Stückaktien, die an der Frankfurter Börse, bzw. entsprechenden American Depository Shares, die an der New Yorker Börse gehandelt werden. Der Kapitalzufluss nach Abzug von Emissionskosten daraus betrug € 562.

Im März 2000 hat die Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung 7.592.430 auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben und daraus € 259 Erlöst.

Infineon hat am 25. April 2000 den Geschäftsbetrieb von Savan Communications Ltd. gegen Gewährung von 1.209.077 Aktien aus dem Genehmigten Kapital III erworben (siehe Anhang Nr. 3).

Im März 2001 hat Infineon 443.488 Namensaktien aus dem Genehmigten Kapital III zur teilweisen Bezahlung einer Beteiligung an Ramtron International Corp. ausgegeben (siehe Anhang Nr. 12).

Infineon hat im April 2001 den Geschäftsbetrieb von Ardent Technologies Inc. gegen Gewährung von 706.714 Namensaktien aus dem Genehmigten Kapital III erworben (siehe Anhang Nr. 3).

Bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Juli 2001 hat Infineon weitere 60.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien an der Börse platziert und daraus € 1.475 nach Abzug der Emissionskosten erlöst.

Im August 2001 gab Infineon 6.373.435 Aktien des Genehmigten Kapitals III aus, um Catamaran Communications Inc. zu erwerben (siehe Anhang Nr. 3).

Im September 2002 gab Infineon 27.500.000 Aktien des Genehmigten Kapital I/2002 aus, um MIC zu erwerben (siehe Anhang Nr. 3).

Im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms emittierte Infineon im Geschäftsjahr 2002 355.460 Aktien aus dem Genehmigten Kapital II (siehe Anhang Nr. 28).

Nach dem deutschen Aktiengesetz beruht der Betrag, der zur Dividendenzahlung an die Aktionäre zur Verfügung steht, auf dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft Infineon Technologies AG, der nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs ermittelt wird. Alle Dividendenzahlungen müssen von der Hauptversammlung beschlossen werden. Auf der Hauptversammlung am 6. April 2001 haben die Aktionäre eine Dividende von € 406 für das Geschäftsjahr 2000 beschlossen, die von Infineon Technologies AG ausbezahlt wurde. Auf der Hauptversammlung im Januar 2002 wurde beschlossen, keine Dividende auszuzahlen. Ebenso wird für das Geschäftsjahr 2002 vom Vorstand vorgeschlagen, keine Dividende auszuschütten, da die Muttergesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzverlust auswies.

Aus der am 13. Oktober 1999 von der Infineon-Beteiligungsgesellschaft ProMOS Technologies Inc. durchgeführten Platzierung von 150.000.000 jungen Aktien an der Börse in Taiwan ergab sich ein Verwässerungseffekt für Infineon. Der Anteil von Infineon am Grundkapital verringerte sich, wohingegen Infineons wertmäßiger Anteil am Eigenkapital um € 51 stieg. Gemäß SEC Staff Accounting Bulletin („SAB“) Topic 5:H, „Bilanzierung von Aktienverkäufen durch Tochtergesellschaften“, hat Infineon den Betrag direkt in das Eigenkapital eingestellt, da zu diesem Zeitpunkt die Realisierung dieses Gewinns noch nicht hinreichend gesichert erschien.

(6) Ergebnis je Aktie

Das Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Ergebnis, geteilt durch den gewogenen Mittelwert der während des Jahres ausstehenden Aktien. Bei dem verwässerten Ergebnis je Aktie wird der gewogene Mittelwert der ausstehenden Aktien um die Anzahl der zusätzlichen Stückaktien erhöht, die ausstünden, wenn potenziell verwässernde Stückaktien ausgegeben worden wären.

Ermittlung des Ergebnisses je Aktie sowie des verwässerten Ergebnisses je Aktie für die Jahre 2000, 2001 und 2002:

	2000	2001	2002
Zähler			
Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag)	1.126	-591	-1.021
Nenner			
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – unverwässert	613.862.876	640.566.801	694.729.462
Verwässerungseffekt durch Aktienoptionen	1.258.310	-	-
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – verwässert	615.121.186	640.566.801	694.729.462
Gewinn (Verlust) je Aktie (in Euro)			
Unverwässert und Verwässert	1,83	-0,92	-1,47

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben.)

(7) Wertpapiere

Die Wertpapiere setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	30. September 2001				30. September 2002			
	An-schaffungs-kosten	Markt-wert	Un-realisierte Gewinne	Un-realisierte Verluste	An-schaffungs-kosten	Markt-wert	Un-realisierte Gewinne	Un-realisierte Verluste
Deutsche Staatsanleihen	5	5	-	-	-	-	-	-
Ausländische Staatsanleihen	25	25	-	-	10	10	-	-
Variabel verzinsliche Anleihen	55	57	2	-	299	299	2	-2
Sonstige Gläubigerpapiere	3	3	-	-	23	21	-	-2
Summe Gläubigerpapiere	88	90	2	-	332	330	2	-4
Anteils-papiere	19	14	-	-5	9	7	-	-2
Festgeldanlagen	-	-	-	-	413	413	-	-
Summe Wertpapiere	107	104	2	-5	754	750	2	-6
Ausgewiesen als:								
Wertpapiere des Umlaufvermögens	96	93	2	-5	742	738	2	-6
Wertpapiere des Anlagevermögens (Anhang Nr. 13)	11	11	-	-	12	12	-	-
Summe Wertpapiere	107	104	2	-5	754	750	2	-6

Die realisierten Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren betragen zum 30. September 2000, 2001 und 2002 € 20, € 1 und € -3 und sind als Saldogröße unter den sonstigen Erträgen (Aufwendungen) in den jeweiligen Gewinn-und-Verlust-Rechnungen ausgewiesen.

Die Gläubigerpapiere zum 30. September 2002 werden vertragsgemäß wie folgt fällig:

	Anschaffungs-kosten	Marktwert
Innerhalb eines Jahres	88	86
Zwischen ein und fünf Jahren	203	203
Nach fünf Jahren	41	41
Summe Gläubigerpapiere	332	330

Die tatsächlichen Fälligkeiten können auf Grund von Veräußerungs- oder Rückzahlungsrechten abweichen.

(8) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritte	530	696
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (Anhang Nr. 19)	132	97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (Anhang Nr. 19)	12	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto	674	801
Wertberichtigungen	-48	-43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	626	758

Die Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:

	2001	2002
Wertberichtigungen zu Beginn des Geschäftsjahrs	32	48
Zuführung zu Wertberichtigungen (Wiederaufholung), Saldo	19	-5
Verbrauch von Wertberichtigungen	-1	-
Fremdwährungseffekte	-2	-
Wertberichtigungen zum Ende des Geschäftsjahrs	48	43

(9) Vorräte

Die Vorräte setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126	105
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	459	463
Fertige Erzeugnisse und Waren	297	323
Summe Vorräte	882	891

In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 wurden den Wertberichtigungen auf Vorräte in Höhe von € 40, € 358 sowie € 0 zugeführt.

(10) Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände

Das sonstige Umlaufvermögen setzt sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Steuerforderungen	136	54
Sonstige Vermögensgegenstände	89	116
Derivative Finanzinstrumente (Anhang Nr. 29)	133	140
Fördermittel	6	100
Finanzforderungen und Sonstige gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (Anhang Nr. 19)	25	23
Finanzforderungen und Sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (Anhang Nr. 19)	38	28
Forderungen gegen Arbeitnehmer	6	8
Sonstige	46	54
Summe Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	479	523

(11) Sachanlagen

Eine Zusammenfassung der Sachanlagen sowie der Zu- und Abgänge zum 30. September 2002 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
Anschaffungskosten 30. September 2001	1.052	5.679	1.929	752	9.412
Zugänge	-	332	162	149	643
Abgänge	-1	-83	-69	-4	-157
Konsolidierungen	-5	13	-1	-1	6
Umbuchungen	29	405	84	-518	-
Fremdwährungseffekte	-20	-92	-28	-14	-154
30. September 2002	1.055	6.254	2.077	364	9.750
Kumulierte Abschreibungen 30. September 2001	-352	-2.625	-1.202	-	-4.179
Zugänge	-72	-898	-350	-	-1.320
Abgänge	-	67	62	-	129
Konsolidierungen	-	14	7	-	21
Umbuchungen	-	8	-8	-	-
Fremdwährungseffekte	6	62	22	-	90
30. September 2002	-418	-3.372	-1.469	-	-5.259
Buchwert 30. September 2001	700	3.054	727	752	5.233
Buchwert 30. September 2002	637	2.882	608	364	4.491

Die Gesellschaft ist Leasinggeber von technischen Anlagen und Maschinen (siehe Anhang Nr. 19). Deren Anschaffungskosten betragen zum 30. September 2001 und 2002 jeweils € 217 und € 215 bei korrespondierenden kumulierten Abschreibungen in Höhe von € 162 und € 183.

Zum 30. September 2002 enthalten die Anlagen im Bau € 204, die im Zusammenhang mit dem Bau einer 300-Millimeter-Fertigungsanlage in Richmond, Virginia, USA, anfielen, der momentan ausgesetzt ist und nicht abgeschrieben wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Bau abhängig von der Marktentwicklung im Geschäftsjahr 2003 fortgesetzt wird.

(12) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen haben sich in dem am 30. September 2002 endenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Assoziierte Unternehmen	Beteiligungen	Gesamt
Stand 30. September 2001	512	143	655
Zugänge	163	15	178
Abgänge	–	–2	–2
Außerplanmäßige Abschreibungen	–9	–30	–39
Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen	–47	–	–47
Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhungen	18	–	18
Fremdwährungseffekte	–54	–1	–55
Stand 30. September 2002	583	125	708

Investitionen in Beteiligungen erfolgen überwiegend mit dem Ziel, das Zukunftspotenzial von Infineon bei geistigen Eigentumsrechten zu stärken.

Die folgenden assoziierten Unternehmen wurden zum 30. September 2002 nach der Equity-Methode bilanziert.

Namen der assoziierten Unternehmen**Anteile in %**

■ Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG, Dresden („AMTC“)	33,3%
■ ALTIS Semiconductor, Essonnes, Frankreich („ALTIS“)	50,1%
■ Aristos Logic Corp., Anaheim Hills, Kalifornien, USA („Aristos“)	23,6%
■ Cryptomathic Holding ApS, Arhus, Dänemark („Cryptomathic“)	25,4%
■ Enhanced Memory Systems Inc., Wilmington, Delaware, USA („EMS“)	20,0%
■ Maskhouse Building Administration GmbH & Co. KG, Dresden („BAC“)	33,3%
■ MICRAM Microelectronic GmbH, Bochum („MICRAM“)	25,1%
■ Newlogic Technologies AG, Lustenau, Österreich („Newlogic“)	24,9%
■ ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan („ProMOS“)	29,9%
■ Ramtron International Corp., Colorado Springs, Colorado, USA („Ramtron“)	20,1%
■ UMCi Pte. Ltd., Singapur („UMCi“)	31,7%

Infineon hat diese Beteiligungen nach der Equity-Methode bilanziert, da keine mehrheitliche Leitung von Infineon ausgeübt worden ist (siehe Anhang Nr. 2). Die oben aufgeführten Gesellschaften sind vorwiegend mit Forschung, Entwicklung, Entwurf und Fertigung von Halbleiterprodukten, integrierten Schaltungen und damit in Zusammenhang stehenden Produkten befasst.

Am 16. Mai 2002 ging die Gesellschaft mit den Partnern Advanced Micro Devices Inc. (AMD), USA, und DuPont Photomasks Inc. („DuPont“), USA, ein Joint Venture mit dem Ziel ein, gemeinsam fortschrittliche Fotomasken zu entwickeln und herzustellen. Durch eine Kapitaleinlage von je € 6 im Zuge der Gründung ist jeder Partner mit einem Drittel an den neu gegründeten Gesellschaften AMTC und BAC beteiligt.

ALTIS ist ein Joint Venture von Infineon und IBM, in welchem beide Partner gleiches Stimmrecht haben.

Am 20. Juli 2000 erwarb die Gesellschaft für einen Betrag von € 5 Anteile an Aristos. Am 26. März 2001 übte die Gesellschaft die Option aus, einen Kredit in Höhe von € 5 in Eigenkapital umzuwandeln. Im Geschäftsjahr 2001 wurden die Investition und die Finanzforderung der Gesellschaft an Aristos abgeschlossen.

Zum 1. Juli 2001 erwarb die Gesellschaft für € 10 einen Anteil von 25,4% an Cryptomathic.

Am 12. Januar 2001 erwarb die Gesellschaft 25,1% der Anteile an MICRAM. MICRAM entwickelt Hochgeschwindigkeits-ICs mit mehr als 40 Gigabit/s.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2001 erwarb die Gesellschaft einen Gesamtanteil von 24,9% an Newlogic für ein Gesamtentgelt in Höhe von € 21.

ProMOS, eine taiwanische börsennotierte Gesellschaft, ist im Mehrheitsbesitz von Mosel Vitelic Inc. („MVI“) und Infineon. Diese Beteiligung wird abzüglich abgegrenzter Erträge aus Lizenzen und Know-how-Überlassungsverträgen bilanziert (siehe Anhang Nr. 23). Am 22. Mai 2000 genehmigten die Aktionäre von ProMOS Mitarbeitergratifikationen in Form von Aktien, wodurch der Anteil von Infineon auf 33,0% verwässert und der wertmäßige Anteil am Eigenkapital um € 53 erhöht wurde. Am 14. Mai 2001 genehmigten die Aktionäre von ProMOS wiederum Mitarbeitergratifikationen in Form von Aktien, was Infineons Anteil am Grundkapital auf 32,5% weiter verwässerte, während der wertmäßige Anteil am Eigenkapital um € 11 stieg. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung emittierte ProMOS am 23. Mai 2002 300 Mio. junge Aktien. Durch diese Kapitalerhöhung wurde Infineons Anteil am Grundkapital auf 29,9% verwässert, während sich der wertmäßige Anteil am Eigenkapital von ProMOS um € 18 erhöhte.

Im März 2001 erwarb die Gesellschaft für einen Betrag von € 31, der sich aus 443.488 Aktien und Barmitteln in Höhe von € 11 zusammensetzt, einen Anteil von 20,1% an Ramtron. Ramtron ist ein führender Entwickler von speziellen Halbleitern für Speicherprodukte mit Sitz in Colorado Springs, Colorado, USA, und ist unter dem Symbol RMTR an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq notiert. Auf Grund einer voraussichtlich dauernden Minderung des Marktwerts von Ramtron führte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2002 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 9 durch.

Am 30. März 2000 hat die Gesellschaft eine Vereinbarung mit United Microelectronics Corporation („UMC“) zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens UMCi abgeschlossen, um eine 300-Millimeter-Fertigungsstätte zu errichten und zu betreiben. Für eine Einlage in Höhe von € 66 erhielt Infineon einen Anteil von 27,3%. Am 1. Oktober 2001 brachte die Gesellschaft Barmittel in Höhe von USD 59 Mio. und eine zusätzliche Lizenzübertragung ein, was einen Anstieg der Anteile der Gesellschaft auf 31,7% zur Folge hatte.

In den Finanzanlagen sind für diese Beteiligungen zum 30. September 2002 Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von € 35 enthalten.

Die zusammengefassten Finanzdaten der assoziierten Unternehmen für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002 stellen sich wie folgt dar:

	2000 ¹	2001 ²	2002
Umsatzerlöse	1.684	1.534	922
Bruttoergebnis vom Umsatz	515	275	14
Jahresüberschuss	291	86	-174
		2001	2002
Umlaufvermögen		1.188	1.045
Anlagevermögen		2.239	1.992
Kurzfristige Verbindlichkeiten		-992	-841
Langfristige Verbindlichkeiten		-472	-497
Eigenkapital		1.963	1.699

¹ Einschließlich Umsatzerlöse, Bruttoergebnis vom Umsatz und Jahresüberschuss von OSRAM Opto in Höhe von € 480, € 70 und € 19.

² Einschließlich Umsatzerlöse, Bruttoergebnis vom Umsatz und Jahresüberschuss von OSRAM Opto in Höhe von € 415, € 59 und € 9.

(13) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Immaterielle Vermögensgegenstände	437	554
Wechselforderungen	13	9
Finanzforderungen und Sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 19)	15	92
Forderungen gegen Arbeitnehmer	4	2
Wertpapiere des Anlagevermögens (siehe Anhang Nr. 7)	11	12
Sonstige	1	2
Summe Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	481	671

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2002 wie folgt zusammen:

	Firmenwerte	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt
Anschaffungskosten 30. September 2001	328	347	675
Zugänge	9	46	55
Außerplanmäßige Abschreibungen	-5	-6	-11
Abgänge	-	-224	-224
Konsolidierungen	70	140	210
Übertragungen	2	-2	-
Fremdwährungseffekte	-17	-	-17
30. September 2002	387	301	688
Kumulierte Abschreibungen 30. September 2001	-32	-206	-238
Zugänge	-	-51	-51
Laufende F&E	-	-37	-37
Abgänge	-	197	197
Konsolidierungen	-	-6	-6
Fremdwährungseffekte	1	-	1
30. September 2002	-31	-103	-134
Buchwert 30. September 2001	296	141	437
Buchwert 30. September 2002	356	198	554

Die geschätzten Abschreibungen der Sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände weisen für die nächsten fünf Folgejahre die folgenden Werte auf: 2003 € 67, 2004 € 57, 2005 € 33, 2006 € 23 und 2007 € 18.

(14) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	956	837
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 19)	137	154
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 19)	98	206
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.191	1.197

(15) Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	158	187
Rückstellungen für Restrukturierungsaufwendungen (siehe Anhang Nr. 24)	81	35
Steuern	66	93
Gewährleistungen und Lizenzen	83	103
Sonstige	38	90
Summe Rückstellungen	426	508

(16) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	174	162
Abgegrenzte Erträge	75	126
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten	11	5
Steuerverbindlichkeiten	89	108
Finanzverbindlichkeiten und Sonstige gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 19)	2	-
Finanzverbindlichkeiten und Sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 19)	2	62
Sonstige	95	74
Summe Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	448	537

Die abgegrenzten Erträge enthalten Erträge aus Lizenz- und Technologieübertragungen (siehe Anhang Nr. 23), Geschäftsfeldveräußerungen (siehe Anhang Nr. 4) und Zuwendungen der öffentlichen Hand (siehe Anhang Nr. 22).

(17) Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Pensionsrückstellungen (siehe Anhang Nr. 21)	37	71
Abgegrenzte Investitionszulagen	37	230
Abgegrenzte Erträge aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen (siehe Anhang Nr. 23)	16	39
Rückgewährbare Einlagen	196	218
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Kapitalanteile	18	12
Sonstige	34	39
Summe Sonstige Langfristige Verbindlichkeiten	338	609

Nach den Verträgen der Gesellschaft mit anderen Investoren am Gemeinschaftsunternehmen SC300 hat jeder von ihnen das Recht, seinen Anteil an SC300 am 30. September 2005 und jedes dritte Folgejahr zum gleichen Datum an Infineon zurückzukaufen. Die Gesellschaft hat wiederkehrend alle drei Jahre, das erste Mal am 31. März 2004, das Recht, die Anteile der Investoren zu erwerben. Darüber hinaus hat jeder Investor das Recht, seinen Anteil unter bestimmten Umständen an die Gesellschaft zu veräußern. Der Buchwert dieser Verbindlichkeit besteht aus der Kapitaleinlage der Investoren und wird um aufgelaufene Zinsen erhöht, die bei Rücknahme fällig wären, so dass er dem jeweiligen Rücknahmebetrag zum jeweiligen Rücknahmzeitpunkt entspricht.

(18) Finanzverbindlichkeiten

Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Durchschnittzinssatz 3,0%	95	96
Kurzfristige Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	21	23
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3	1
Summe Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	119	120
Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 4,25%, fällig 2007	–	981
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Unbesicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittzinssatz 3,6%, fällig 2002–2008	112	595
Zinslose Darlehen, fällig 2004	43	51
Besicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittzinssatz 5,1%, fällig 2007	1	2
Verbindlichkeiten, Durchschnittzinssatz 4,0%, fällig 2004	7	6
Sonstige Darlehen, Durchschnittzinssatz 4,0%, fällig 2003	11	–
Darlehen der öffentlichen Hand, Zinssatz 1,4%, fällig 2027–2031	74	70
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	1	5
Summe Langfristige Finanzverbindlichkeiten	249	1.710

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen hauptsächlich aus Kreditaufnahmen im Rahmen von kurzfristigen Darlehensvereinbarungen.

Am 6. Februar 2002 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von € 1.000 im Rahmen eines garantierten Angebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese auf Anforderung in Aktien von Infineon umwandeln, wobei der Wandelpreis 35,43 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann Infineon statt einem Teil oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 4,25% und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Schuldverschreibung ist unbesichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger das Recht auf Rückzahlung der gesamten oder eines Teils der Schuldverschreibung zum Nennbetrag zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bei einem Kontrollwechsel der Gesellschaft. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Infineon AG 115% des Wandlungspreises für einen Zeitraum von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Zum 30. September betragen die nicht amortisierten Ausgabekosten dieser Anleihe € 16.

Das zinslose Darlehen, fällig in 2004, besteht aus Krediten, bei denen die öffentliche Hand die gesamte Zinslast trägt. Darüber hinaus übernimmt die öffentliche Hand 75% der Darlehensrückzahlungen, falls Infineon bestimmte Bedingungen erfüllt. Infineon wird dieses Darlehen bis zum Eintritt der auflösenden Bedingungen voll passivieren. Bei Erfüllung der Bedingungen wird das Darlehen um den Beitrag der öffentlichen Hand reduziert.

Zum 30. September 2002 hatte die Gesellschaft eine unbesicherte Anleihe in Höhe von € 70 im Zusammenhang mit dem Bau der Fertigungsstätte in Richmond begeben.

Zum 30. September 2002 verfügt die Gesellschaft über eine Kreditlinie in Höhe von € 450 für den Ausbau der Fertigungsstätte am Standort Dresden. Diese Kreditlinie ist teilweise von der Bundesrepublik Deutschland und einer anderen öffentlichen Körperschaft gesichert. Die Kreditlinie enthält bestimmte Restriktionen bezüglich der Bilanzrelationen, sieht jährliche Zinszahlungen vor und ist am 30. September 2005 rückzahlbar. Zum 30. September 2002 war die Kreditlinie vollständig in Anspruch genommen.

Am 30. September vereinbarte die Gesellschaft mit einem Bankenkonsortium eine revolvingende Mehrwährungskreditlinie über € 750. Die Kreditlinie ist in zwei Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche über € 375 läuft bis September 2003. Die zweite Tranche über € 375 läuft bis September 2005. Die Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung von branchenüblichen Finanzkennzahlen. Diese Kreditlinie ersetzt den bestehenden revolvingenden Mehrwährungskredit über € 622 mit gleicher Laufzeit. Zum 30. September 2002 wurde die Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft hat voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzierungsbedarf vereinbart. Diese Kreditlinien (inklusive der revolvingenden Mehrwährungskreditlinie über € 750 und der Kreditlinie über € 450 und exklusive des Finanzierungsleasings und der nachrangigen Wandelschuldverschreibung) betragen € 2.183. Davon waren € 1.340 zum 30. September 2002 verfügbar und bestehen aus den folgenden vier Gruppen: Die erste Gruppe besteht aus zugesicherten kurzfristigen Kreditlinien von Kreditinstituten zur Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens, Garantien und dem Cash-Pooling in Höhe von € 911, von denen € 815 am 30. September 2002 ungenutzt zur Verfügung standen. Die zweite Gruppe von Kreditlinien beinhaltet nicht verbindlich zugesagte kurzfristige Kreditlinien in Höhe von € 152, die zum 30. September 2002 zur Betriebsmittelfinanzierung zur Verfügung standen. Die dritte Gruppe beinhaltet langfristige, verbindlich zugesagte Kreditlinien von Finanzinstituten zur Finanzierung des Netto-Umlaufvermögens in Höhe von € 384. Zum 30. September 2002 waren hiervon noch € 373 verfügbar. Die vierte Gruppe, bestehend aus langfristigen, verbindlich zugesagten Kreditlinien von Finanzinstituten zur Projektfinanzierung, beläuft sich (einschließlich der kurzfristig fälligen Kredite) auf € 736 und war zum 30. September 2002 voll ausgeschöpft.

Zum 30. September 2002 hatte die Gesellschaft alle Besicherungsaufgaben zu den entsprechenden Krediten erfüllt.

Zinsaufwendungen beliefen sich auf € 0, € 42 und € 89 in den Geschäftsjahren 2000, 2001 bzw. 2002.

Von den als langfristig aufgenommenen Finanzverbindlichkeiten und Finanzierungsleasing-Verpflichtungen werden in den nächsten Jahren folgende Beträge fällig:

Geschäftsjahr	Betrag
2004	94
2005	499
2006	47
2007	1.000
Folgende Jahre	70
Summe	1.710

(19) Verbundene Unternehmen

Infineon unterhält übliche Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen des Siemens-Konzerns und zu den sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (im Folgenden als „verbundene Unternehmen“ bezeichnet). Infineon bezieht bestimmte Vorprodukte, insbesondere Chip-Sätze, von verbundenen Unternehmen. Zugleich verkauft Infineon auch einen Teil der Produktion an verbundene Unternehmen. Diese Käufe und Verkäufe an verbundene Unternehmen orientieren sich grundsätzlich an Marktpreisen oder an Herstellungskosten zzgl. einer Gewinnmarge.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Arbeitnehmer setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Kurzfristig		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	132	97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	12	8
Finanzforderungen und Sonstige gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	25	23
Finanzforderungen und Sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	38	28
Forderungen gegen Arbeitnehmer	6	8
	213	164
Langfristig		
Finanzforderungen und Sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	15	92
Forderungen gegen Arbeitnehmer	4	2
	19	94
Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen	232	258

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns	137	154
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	98	206
Finanzverbindlichkeiten und Sonstige gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns	2	-
Finanzverbindlichkeiten und Sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	2	62
Summe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	239	422

Bei den Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wird wie folgt unterschieden: (1) Positionen, bei denen entweder von oder an Siemens-Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, an denen Infineon Geschäftsanteile hält, geschuldet wird, und (2) nach dem zu Grunde liegenden Geschäftsvorfall. Die als Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Beträge resultieren aus dem Kauf bzw. Verkauf von Produkten. Finanzforderungen und -verbindlichkeiten beinhalten die geschuldeten Beträge aus Darlehen sowie die zu Interbankensätzen aufgelaufenen Zinsen.

Darstellung des Geschäftsverkehrs mit verbundenen Unternehmen für die zum 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre:

	2000	2001	2002
Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	1.089	901	761
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	122	147	170
Bezüge von verbundenen Unternehmen			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	424	417	681
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	1.183	1.040	686
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	14	9	5
Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen	21	10	2

Die Umsätze mit Unternehmen des Siemens-Konzerns beinhalten Verkäufe an Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Dritte, die sich in den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 auf jeweils € 326, € 89 und € 77 beliefen. Im Januar 2001 hat Infineon die Neuverhandlungen bezüglich der Kompensationsvereinbarungen mit den Vertriebsorganisationen des Siemens-Konzerns abgeschlossen. Damit ist die Praxis, dass Siemens einen Rabatt für den Wiederverkauf an Dritte erhält, beendet. Solche Rabatte lagen innerhalb einer Spanne von 5% bis 8% und wurden als Verringerung der Umsatzerlöse bilanziert. Grundsätzlich wird der Verkauf an Dritte über die eigenen Vertriebsorganisationen der Gesellschaften abgewickelt. In bestimmten Ländern, in denen die Gesellschaft keine eigene Vertriebsorganisation unterhält, unterstützen die Vertriebsgesellschaften des Siemens-Konzerns den direkten Verkauf an Dritte und erhalten hierfür eine Kommission.

Die Käufe von Gesellschaften des Siemens-Konzerns bestehen hauptsächlich aus Vorräten, IT-Dienstleistungen und Verwaltungsdienstleistungen.

Infineon verleast technische Anlagen und Maschinen an das Gemeinschaftsunternehmen ALTIS (siehe Anhang Nr. 11). Aus den unkündbaren Leasingverträgen erwartet die Gesellschaft Leasingzahlungen zum 30. September 2002 für die Geschäftsjahre 2003 von € 23 und für 2004 von € 15.

Am 21. Dezember 2001 refinanzierte das Gemeinschaftsunternehmen ALTIS einen Teil seines Zwischenkredits in Höhe von € 110 durch einen revolvingierenden Konsortialkredit. Der Kredit ist nicht durch ALTIS' Anteilseigner, Infineon und IBM, garantiert. Im Zusammenhang mit dieser Refinanzierung verlängerten sowohl Infineon als auch IBM jeweils einen befristeten Kredit an ALTIS, der nachrangig gegenüber dem revolvingierenden Konsortialkredit steht. Zum 30. September 2002 wird der Kredit in Höhe von € 76 in der Position „langfristige Finanzforderungen“ und „Sonstige gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ ausgewiesen.

Am 30. September 2002 enthielten die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten und Sonstige gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen ein Darlehen von UMCi in Höhe von USD 55 Mio., welches marktüblich verzinst und am 27. Dezember 2002 fällig ist.

Siemens hat am 10. August 2000 eine garantierte Wandelanleihe (Exchangeable Note) auf 4% der Infineon-Aktien ausgegeben. Die Anleihe mit einem Nominalvolumen von € 2.500 (was 4% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht) ist in Teilschuldverschreibungen zu je € 0,1 geteilt. Die mit 1% p.a. verzinsten Wertpapiere haben eine Laufzeit bis zum 10. August 2005. Jeder Inhaber einer Teilschuldverschreibung hat bei Eintritt bestimmter Bedingungen das Recht, diese Teilschuldverschreibung bis zum 10. August 2005 in 1.000 Infineon-Aktien umzutauschen.

Am 5. Dezember 2001 übertrug Siemens in einem Treuhandabkommen 200 Mio. Aktien der Infineon Technologies AG bzw. ca. 28,9% von Infineons zu diesem Zeitpunkt ausstehendem Grundkapital unwiderruflich an eine nicht stimmberechtigte Treuhandgesellschaft, die nicht mit dem Siemens-Konzern in Beziehung steht. Der Treuhänder hat einen Rechtsanspruch auf die im Treuhandvermögen gebundenen Aktien, Siemens hat unwiderruflich alle Stimmrechte daraus aufgegeben. Der Treuhänder ist jedoch nicht berechtigt, das Stimmrecht der mit diesem Treuhandvertrag übertragenen Aktien auszuüben. Siemens ist weiterhin berechtigt, den wirtschaftlichen Nutzen aus den in Treuhandverwahrung befindlichen Aktien zu ziehen, einschließlich des Rechts auf Dividendenzahlung oder Erlöse aus einem erlaubten Verkauf der Infineon-Aktien aus der Treuhandverwahrung. Gemäß dem Treuhandvertrag hält der Treuhänder die Aktien zum Nutzen der Begünstigten, die sowohl Siemens als Treuhandgeber als auch Dritte umfassen. Das Treuhandverhältnis erlischt, wenn der Siemens-Konzern direkt oder indirekt weniger als 50% des stimmberechtigten Grundkapitals von Infineon über einen Zeitraum von zwei Jahren hält oder gehalten hat. Gewisse Bestimmungen des Treuhandvertrags, einschließlich derjenigen, die sich auf die Stimmrechte und die Übertragung der treuhänderisch gehaltenen Aktien beziehen, dürfen nicht ohne Zustimmung von Aktionären von Infineon geändert werden.

Die unwiderrufliche Übertragung von Infineon-Aktien an einen nicht stimmberechtigten Treuhänder durch Siemens am 5. Dezember 2001 verringerte die durch Siemens gehaltenen stimmberechtigten Anteile an Infineon um den der Anzahl der übertragenen Aktien entsprechenden Stimmrechtsanteil. Entsprechend hält Siemens am 31. Dezember 2001 18,2% der Stimmrechte bei einem Anteilsbesitz von 47,1%. Zusammen mit dem Siemens Pension-Trust e.V. mit einem Stimmrechtsanteil von 13,2% kontrollierte der Siemens-Konzern zum 31. Dezember 2001 31,4% der Stimmrechte an Infineon. Da andere Aktionäre als Siemens und der Siemens Pension-Trust e.V. etwa 39,7% des Grundkapitals von Infineon besitzen, können sie die Mehrheit der Stimmrechte auf einer Hauptversammlung innehaben. Die Auswirkung der Übertragung von Infineon-Aktien an den nicht stimmberechtigten Treuhänder ist also, dass alle anderen Aktionäre einen nicht im Verhältnis zum Anteilsbesitz stehenden Stimmrechtsanteil innehaben.

Nachdem die Gesellschaft nicht länger eine im mehrheitlichen Besitz befindliche Tochter von Siemens ist, verlor sie eine Anzahl bestimmter Rechte aus gegenseitigen Patentlizenzierungen, die ursprünglich zwischen Siemens und Dritten abgeschlossen worden waren. In Vorwegnahme dieses Tatbestands ging die Gesellschaft verschiedene wechselseitige Patentlizenzierungen mit einer großen Anzahl dieser dritten Gesellschaften ein, welche die für Infineon relevanten wechselseitigen Lizenzierungen ausweiten oder auf die Gesellschaft übertragen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft neue Lizenzverträge abgeschlossen und steht in ständigen Verhandlungen mit einigen größeren Mitbewerbern.

Am 8. Januar 2002 veräußerte Siemens 40 Mio. Infineon-Aktien in einem Blockverkauf, wodurch sich die vereinten Stimmrechte von Siemens und dem Siemens Pension-Trust e.V. an der Gesellschaft ab diesem Zeitpunkt auf 25,6% verringerten.

(20) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Gewinn (Verlust) vor Steuern und vor Abzug der auf die Minderheitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile verteilt sich in den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 wie folgt auf die Regionen:

	2000	2001	2002
Deutschland	1.298	-1.184	-1.403
Ausland	446	159	236
	1.744	-1.025	-1.167

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ermitteln sich für die zum 30. September 2000, 2001 und 2002 endenden Geschäftsjahre wie folgt:

	2000	2001	2002
Laufender Steueraufwand			
Deutschland	448	23	15
Ausland	73	43	124
	521	66	139
Latente Steuern			
Deutschland	110	-490	-232
Ausland	-19	-4	-46
	91	-494	-278
Aufwand (Ertrag) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	612	-428	-139

Im Oktober 2000 hat die Bundesregierung neue Steuergesetze verabschiedet, welche den Körperschaftsteuersatz auf einheitlich 25% reduzieren. Für Infineon wurde die Gesetzesänderung in dem am 30. September 2002 endenden Geschäftsjahr wirksam. Zusätzlich wird ein Solidaritätszuschlag von 5,5% und Gewerbesteuer in Höhe von 13% erhoben, was einer Gesamtsteuerbelastung von 39% entspricht. Vor dem 1. Oktober 2001 war eine geteilte Regelung gültig, die 40% Körperschaftsteuer für einbehaltene Gewinne und 30% Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne vorsah und zu einer Gesamtsteuerbelastung von 52% führte. Die Berücksichtigung der reduzierten Steuersätze ergab eine Reduzierung der aktiven und passiven latenten Steuern in Höhe von € 28 im Geschäftsjahr 2001.

Am 19. September 2002 verabschiedete die Bundesregierung eine Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes von 25% auf 26,5%. Das Gesetz dient der Unterstützung der Opfer der Flutkatastrophe und wird nur im Geschäftsjahr 2003 wirksam sein. Die Auswirkungen dieses Ein-Jahres-Effekts werden als Steuerertrag in Höhe von € 2 im Geschäftsjahr 2002 ausgewiesen, der die Auswirkungen von zeitlichen Unterschieden erfasst, die sich im Folgejahr erwartungsgemäß wieder aufheben.

Die nachfolgende Abstimmung der Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zum 30. September 2000, 2001 und 2002 erfolgte unter Zugrundelegung einer Gesamtsteuerbelastung der deutschen Körperschaftsteuerquote zuzüglich Gewerbesteuer für 2000 und 2001 in Höhe von 52% sowie für 2002 in Höhe von 39%:

	2000	2001	2002
Erwarteter Aufwand (Ertrag)			
aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	907	-533	-455
Herstellung der Ausschüttungsbelastung	-58	-	-
Steuerfreies Einkommen	-79	-16	-39
Differenz aus abweichenden Steuersätzen im Ausland	-150	-91	-16
Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen und sonstige Rückstellungen	1	41	99
Änderung der Steuerrate in Folge der deutschen Steuerreform – Auswirkung auf die Eröffnungsbilanz	-	-28	-
Änderung der Steuerrate in Folge der deutschen Steuerreform – Auswirkung im laufenden Geschäftsjahr	-	154	-2
Veränderung der Wertberichtigung	-28	18	275
Nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	-	29	10
Sonstige	19	-2	-11
Tatsächlicher Aufwand (Ertrag)			
aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	612	-428	-139

Die aktiven und passiven latenten Steuern setzen sich zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2001	2002
Vermögensgegenstände		
Immaterielle Vermögensgegenstände	65	232
Beteiligungen	35	10
Vorräte	30	27
Passive Rechnungsabgrenzung	84	148
Verlustvortrag und Steuervergünstigungen	441	804
Sonstiges	123	160
Bruttobetrag der aktiven latenten Steuern	778	1.381
Wertberichtigungen	-19	-294
Aktive latente Steuern	759	1.087
Verbindlichkeiten		
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	59
Sachanlagen	319	190
Rückstellungen	9	8
Sonstiges	37	40
Passive latente Steuern	380	297
Summe latente Steuern, Saldo	379	790

Die aktiven und passiven latenten Steuern werden in den Konzernbilanzen zum 30. September 2001 und 2002 wie folgt ausgewiesen:

	2001	2002
Aktive latente Steuern		
Kurzfristig fällig	39	82
Langfristig fällig	412	787
Passive latente Steuern		
Kurzfristig fällig	-19	-21
Langfristig fällig	-53	-58
Summe latente Steuern, Saldo	379	790

Zum 30. September 2002 hatten Infineon und ihre Tochtergesellschaften steuerliche Verlustvorträge (bezüglich Gewerbe- und Körperschaftsteuer) in Höhe von € 1.667 sowie Vorträge von Steuervergünstigungen in Höhe von netto € 65. Diese steuerlichen Verlustvorträge und Steuervergünstigungen resultieren hauptsächlich aus der Geschäftstätigkeit in Deutschland und sind grundsätzlich insoweit nur durch die Gesellschaft nutzbar, bei der die steuerlichen Verluste oder die Steuerforderungen entstanden sind, und nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung zeitlich unbeschränkt nutzbar mit der Ausnahme von steuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von € 91 bei ausländischen Gesellschaften, die in den Jahren 2020 und 2021 verfallen.

Entsprechend dem SFAS Nr. 109 hat die Gesellschaft die aktivierten latenten Steuern auf die Notwendigkeit einer Wertberichtigung überprüft. Dazu ist eine Beurteilung erforderlich, ob es wahrscheinlich ist, dass Teile oder der Gesamtbetrag der aktiven latenten Steuern nicht realisierbar sein könnten. Die Überprüfung verlangt vom Management unter anderem eine Beurteilung von Erträgen aus verfügbaren Steuerstrategien und künftigem zu versteuerndem Einkommen sowie positiven oder negativen Faktoren. Die tatsächliche Realisierung von aktivierten latenten Steuern hängt von der Möglichkeit der Gesellschaft ab, entsprechendes zu versteuerndes zukünftiges Einkommen zu generieren, um Verlustvorträge oder Steuervergünstigungen vor ihrem Verfall nutzen zu können. Da die Gesellschaft in bestimmten Steuergebieten zum 30. September 2002 über einen Dreijahreszeitraum einen kumulativen Verlust ausgewiesen hat, wird der Einfluss von geplantem zu versteuerndem Einkommen nach den Vorschriften des SFAS Nr. 109 für diese Bewertung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt für diese Steuerländer dementsprechend nur auf Grund der Erträge, die durch verfügbare Steuerstrategien und die Umkehr von zeitlichen Unterschieden in zukünftigen Perioden erlöst werden können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Überprüfung hat Infineon zum 30. September 2002 die Wertberichtigung auf die aktivierten latenten Steuern um € 275 erhöht und damit auf einen Betrag gebracht, der wahrscheinlich in Zukunft realisiert werden kann. Während des Geschäftsjahrs 2001 wurden Wertberichtigungen auf Verlustvorträge, die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Malaysia angefallen waren, in Höhe von € 19 gebildet, da die vollständige Ausnutzung dieser Verlustvorträge auf Grund der Existenz von Vorträgen von Steuervergünstigungen nicht wahrscheinlich erschien.

Infineon hat zum 30. September 2002 auf kumulierte einbehaltene Gewinne ausländischer Gesellschaften keine zusätzlichen Ertrag- oder Quellensteuern berechnet, da diese Gewinne in den Auslandsgesellschaften unbegrenzt reinvestiert bleiben sollen. Eine betragsmäßige Schätzung der nicht berücksichtigten passiven latenten Steuern auf diese einbehaltenen Gewinne ist nicht zweckmäßig.

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002 wurden im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und in den Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, erfasst. Die direkt im Eigenkapital erfassten Beträge für unrealisierte Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren und Pensionsverpflichtungen beliefen sich in den Jahren 2000, 2001 und 2002 auf € 9, € -15 und € -6.

(21) Pensionsverpflichtungen

Infineon hat einem bedeutenden Anteil ihrer Mitarbeiter Pensionszusagen gewährt. Die Pensionszusagen richten sich im Wesentlichen nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ein Teil der Altersversorgungspläne bezieht sich auf das Einkommen im letzten oder in den letzten fünf Jahren der Betriebszugehörigkeit, andere feste Versorgungspläne sind vom durchschnittlichen Einkommen und der Position abhängig.

Die Daten zu Infineons Pensionsplänen sind für die deutschen Versorgungspläne („Inland“) und die ausländischen Versorgungspläne („Ausland“) zum 30. September 2000, 2001 und 2002 in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2000		2001		2002	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Entwicklung der Anwartschaftsbarwerte (PBO)						
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Beginn des Geschäftsjahres	-148	-16	-170	-31	-197	-30
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	-10	-5	-12	-1	-13	-4
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	-9	-3	-11	-2	-12	-2
Versicherungstechnische Gewinne (Verluste)	-4	-1	-6	-4	-	2
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	-1	-	-	-	-7
Akquisitionsbedingte Abgänge	-	-	-	-	1	-
Neu geschaffener Plan	-	-	-	-	-1	-2
Planänderung	-	-	-	4	-	-
Übertragung von Pensionsverpflichtungen	-	-	-	1	-	-
Gezahlte Versorgungsleistungen	1	-	2	-	2	-
Kürzungen	-	-	-	-	2	-
Fremdwährungseffekte	-	-5	-	3	-	2
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Ende des Geschäftsjahres	-170	-31	-197	-30	-218	-41
Entwicklung des Zeitwertes des Planvermögens						
Zeitwert zu Beginn des Geschäftsjahres	-	5	155	9	133	24
Einlagen und Übertragungen	155	-	-	15	12	1
Tatsächliche Rendite auf das Planvermögen	-	2	-22	1	-13	1
Gezahlte Versorgungsleistungen	-	-	-	-	-2	-
Neu geschaffener Plan	-	-	-	-	-	2
Fremdwährungseffekte	-	2	-	-1	-	-2
Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres	155	9	133	24	130	26
Finanzierungsstatus des Planvermögens	-15	-22	-64	-6	-88	-15
Noch nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasster versicherungsmathematischer Verlust	9	7	52	4	68	3
Noch nicht bilanzierte Verpflichtungen bei Übergang auf SFAS Nr.87	3	-	2	-	-	-
Pensionsverpflichtungen	-3	-15	-10	-2	-20	-12

Die in der Bilanz zum 30. September ausgewiesenen Verpflichtungen setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	2000		2001		2002	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen	4	–	–	–	–	–
Als Sicherheitsleistung hinterlegte Zahlungsmittel	14	–	–	–	–	–
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	–	–	19	–	33	–
Pensionsverbindlichkeiten	–21	–15	–29	–2	–53	–12
Pensionsverpflichtungen, Saldo	–3	–15	–10	–2	–20	–12

Der Ermittlung der versicherungsmathematischen Werte der wesentlichen Versorgungspläne lagen folgende Annahmen zu Grunde:

	2000		2001		2002	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Abzinsungsfaktor	6,5%	7,8%	6,0%	7,5%	6,0%	5,5%–7,0%
Personalkostensteigerungsrate	3,5%–3,8%	5,0%	3,0%	4,5%	3,0%	3,0%–4,5%
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	–	8,5%	10,0%	8,0%	5,4%	6,0%–7,0%

Die Abzinsungsfaktoren werden auf der Basis hochwertiger Rentenpapiere gebildet, die, falls die Pensionsanswartschaften zum Stichtag glattgestellt würden, bis zum Fälligkeitszeitpunkt die benötigten zukünftigen Einzahlungen bereitstellen würden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass kurzfristige Schwankungen der Zinssätze keinen Einfluss auf ihre langfristigen Verpflichtungen haben.

Die Pensionsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 beinhalten:

	2000		2001		2002	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	–10	–5	–12	–1	–13	–4
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	–9	–3	–11	–2	–12	–2
Erwarteter Ertrag aus Planvermögen	–	1	15	1	7	1
Amortisation von noch nicht realisierten Verlusten	–	–	–	–	–2	–
Amortisation des Unterschiedsbetrags bei Übergang auf SFAS Nr. 87	–2	–	–2	–	–2	–
Aufwendungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	–21	–7	–10	–2	–22	–5

Am 25. September 2000 gründete die Gesellschaft den Infineon Technologies Pension Trust („Pension Trust“) zum Zwecke der Finanzierung zukünftiger Pensionszahlungen für Mitarbeiter in Deutschland. Die Gesellschaft leistete eine Einlage in Höhe von € 155 in Form von Zahlungsmitteln und Wertpapieren, die Gläubiger- bzw. Eigentümerrechte verbriefen. Die Einlage fällt als Planvermögen des Pension Trust zur Finanzierung dieser Pensionsverpflichtungen unter die Bestimmungen von SFAS Nr. 87 und reduziert insoweit die Pensionsrückstellungen der Gesellschaft.

Die Auswirkungen der Mitarbeiterentlassungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 24) auf die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft werden auf Grund der Anwendung von SFAS Nr. 88 „Bilanzierung für Abgeltung und Kürzungen von Pensionsverpflichtungen und Abfindungen“ als Kürzung dargestellt.

Im Geschäftsjahr 2002 brachte die Gesellschaft Einlagen in Höhe von € 10 in ihren deutschen Pensionsplan ein.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 legte die Gesellschaft ein Programm zur betrieblichen Altersvorsorge für deutsche Mitarbeiter auf, wobei die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einen Teil des Gehalts für eine Rentenzahlung inklusive aufgelaufener Zinsen zum Renteneintritt umzuwandeln. Die Verbindlichkeit für zukünftige Zahlungen ist versicherungsmathematisch bestimmt und auf der gleichen Basis wie andere Pensionspläne der Gesellschaft berechnet worden.

Nach der Ausgründung von Siemens gründete die Gesellschaft einen Pensionsplan für seine amerikanischen Mitarbeiter gesondert von dem Siemens-US-Pensionsplan. Zum Zeitpunkt der Ausgründung wurde der eingezahlte Bestand des der Gesellschaft zuzurechnenden Teils des Siemens-US-Pensionsplans im Verhältnis zu den übertragenen Mitarbeitern als Pensionsrückstellung erfasst. Nachträglich transferierte Siemens, basierend auf einer versicherungsmathematischen Ermittlung, Vermögensgegenstände, um diese Rückstellung finanziell zu unterlegen. Die Differenz zwischen der versicherungsmathematischen Bewertung am Tag der Unterlegung und der ursprünglich verrechneten Rückstellung in Höhe von € 10 wurde als Eigenkapitalübertragung im Geschäftsjahr 2002 ausgewiesen.

Die Gesellschaft unterstützt bestimmte Mitarbeiter in den USA nach ihrem Ausscheiden mit Krankenversicherungsleistungen. Der Gesellschaft entstanden hierfür Kosten in Höhe von € 1 für das Geschäftsjahr 2000, € 1 für das Geschäftsjahr 2001 und € 0 für das Geschäftsjahr 2002. Die Netto-Verbindlichkeit betrug in den Bilanzen der Geschäftsjahre 2001 und 2002 jeweils € 6.

(22) Zuwendungen der öffentlichen Hand

Infineon hat im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderungsprogramme von verschiedenen öffentlichen Stellen Fördermittel u. a. für die Errichtung von Fertigungsstätten, für Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildungsmaßnahmen und Zinszuschüsse erhalten. Die in den vorliegenden Konzernabschlüssen enthaltenen Zuwendungen setzen sich zum 30. September 2000, 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2000	2001	2002
In der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung sind enthalten:			
Zinszuschüsse	63	–	–
Forschungs- und Entwicklungszuschüsse	41	71	59
Sonstige Zuwendungen	11	10	34
	115	81	93
Investitionszuschüsse, die von den Anschaffungskosten der Sachanlagen abgesetzt wurden	–	11	83

(23) Lizenzen und Know-how-Überlassungsverträge

In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 weist Infineon Umsätze aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen in Höhe von jeweils € 176, € 88 und € 147 in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen aus. Nach dem SEC SAB 101 wurden bereits erhaltene, jedoch abgegrenzte Lizenzeneinnahmen in einer Höhe von € 85 im abgelaufenen Geschäftsjahr als Umsatz gebucht, da die Gesellschaft ihre Verpflichtungen erfüllt und diese Beträge realisiert hatte. Zum 30. September 2002 wurden von ProMOS erhaltene Lizenzeneinnahmen in Höhe von € 60 nach dem SEC Staff Accounting Bulletin Nr. 5:H als abgegrenztes Einkommen mit dem Beteiligungsbuchwert von ProMOS verrechnet (siehe Anhang Nr. 12).

Im März 2000 schloss Infineon einen neuen Lizenzvertrag mit ProMOS und passte den bestehenden Vertrag mit MVI an. Im Rahmen dieser Verträge wurden Lizenzgebühren von USD 108 Mio. neu terminiert, die über die Laufzeit der neuen Verträge realisiert werden. In Verbindung mit den veränderten vertraglichen Regelungen wurden in der Vergangenheit zugeflossene und abgegrenzte Lizenzgebühren in Höhe von € 138 als Umsatzerlöse zum 30. September 2000 ausgewiesen, da Infineon alle Verpflichtungen erfüllt hatte und diese Beträge realisiert waren.

Im März 2002 modifizierte die Gesellschaft ihre Kapazitätsabnahmevereinbarung mit ProMOS (siehe Anhang Nr. 31) und passte die Zahlungsbedingungen der bestehenden Lizenz-Vereinbarung mit MVI entsprechend an. Die Vereinbarung verlängert die Fälligkeiten der ausstehenden Lizenzgebühren von USD 54 Mio. bis zum Januar 2004 (welche im Zeitpunkt der Barzahlung erfolgswirksam vereinnahmt werden) und verlängerte die Fristigkeit weiterer Beträge, die der Gesellschaft zustehen. Im Gegenzug zu diesen Vereinbarungen hinterlegte MVI 56.330.000 Aktien von ProMOS zur Besicherung bezüglich im Rahmen dieser Vereinbarung noch ausstehender Lizenzgebühren für den Fall der Zahlungsunfähigkeit.

(24) Umstrukturierungsmaßnahmen

Als Reaktion auf die weltweit anhaltende Schwäche des Technologiesektors hat die Gesellschaft im letzten Quartal des Berichtsjahrs 2001 einen Plan zur Restrukturierung der Organisation und zur Kostensenkung verabschiedet. Infineon will den Einkauf und die Logistikprozesse rationalisieren und die Kosten der Produktion und Informationstechnologie reduzieren. Hierdurch soll die Produktivität, der gesamte Beschaffungsprozess und der Auftragsabwicklungsprozess verbessert werden. Die Gesellschaft plante hierbei die Reduzierung der Belegschaft um circa 5.000 Mitarbeiter. Bis zum 30. September 2002 hat die Gesellschaft diese Anpassung der Mitarbeiteranzahl abgeschlossen und die entsprechenden Mitarbeiter freigesetzt bzw. Aufhebungsverträge mit ihnen geschlossen.

Bis zum 30. September 2001 sind Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von € 117 angefallen. Diese Aufwendungen enthalten € 57 für Kündigungen und € 44 auf Grund der Unterbrechung eines weltweiten IT-Projekts, die sich aus bereits aktivierten Investitionsaufwendungen (€ 27) und ähnlichen Ausstiegskosten (€ 17) zusammensetzen, sowie € 16 infolge anderer Ausstiegskosten.

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 fielen im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen Aufwendungen in Höhe von € 16 durch unkündbare Verpflichtungen an.

Die Komponenten der Restrukturierungsaufwendungen setzen sich zum 30. September 2002 wie folgt zusammen:

	30. September 2001			30. September 2002
	Rückstellungen	Zahlungen	Restrukturierungs- aufwendungen	Rückstellungen
Abfindungen	53	-47	-	6
Andere Ausstiegskosten	28	-15	16	29
	81	-62	16	35

(25) Zusätzliche Angaben zu betrieblichen Aufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2000	2001	2002
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.047	2.045	1.689
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022	1.357	926
Summe Materialaufwendungen	3.069	3.402	2.615

Die Personalaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002 wie folgt zusammen:

	2000	2001	2002
Löhne und Gehälter	1.263	1.510	1.422
Soziale Abgaben	184	240	267
Aufwendungen für Altersversorgung	29	13	27
Summe Personalaufwendungen	1.476	1.763	1.716

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach Regionen für die Geschäftsjahre zum 30. September ist in folgender Übersicht dargestellt:

	2000	2001	2002
Deutschland	13.718	16.279	15.773
Übriges Europa	3.161	4.921	4.376
USA	2.747	3.101	2.818
Asien/Pazifik	8.064	9.095	7.189
Übrige	-	7	24
Summe Mitarbeiter	27.690	33.403	30.180

Im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan von 2001 (siehe Anhang Nr. 24) reduzierte die Gesellschaft seit dem 30. Juni 2001 ihre Belegschaft um etwa 5.000 Mitarbeiter, was durch die Akquisition von MIC im September 2002 (siehe Anhang Nr. 3) teilweise ausgeglichen wurde.

(26) Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung

	2000	2001	2002
Auszahlungen für			
Zinsen	53	52	55
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211	282	46
Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungsaktivitäten			
Einlagen von (an) Siemens	12	-11	10

Der Mittelzufluss aus dem Verkauf der Beteiligung an OSRAM Opto im Geschäftsjahr 2001 wird unter „Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit“ als Kapitaleinlage gezeigt. Der den Buchwert übersteigende Verkaufspreis von € 392 ist um latente Steuern von € 141 gekürzt.

(27) Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren

Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, haben sich für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002 wie folgt entwickelt:

	2000			2001			2002		
	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern
Unrealisierte Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren									
Unrealisierte Gewinne (Verluste) aus gehaltenen Wertpapieren	13	-7	6	-3	1	-2	-4	2	-2
Umgliederung von im Periodenergebnis enthaltenen (Gewinnen) Verlusten	4	-2	2	-13	7	-6	3	-1	2
Nicht realisierte Gewinne (Verluste)	17	-9	8	-16	8	-8	-1	1	-
Zusätzliche Mindestpensionsverbindlichkeit	-	-	-	-19	7	-12	-13	5	-8
Unterschiede aus Fremdwährungsumrechnung	105	-	105	-19	-	-19	-92	-	-92
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	122	-9	113	-54	15	-39	-106	6	-100
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren – zu Beginn des Geschäftsjahres	-3	2	-1	119	-7	112	65	8	73
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren – am Ende des Geschäftsjahres	119	-7	112	65	8	73	-41	14	-27

(28) Aktienoptionspläne

Aktienoptionsplan mit fester Ausübungshürde

Im Herbst 1999 verabschiedete die Hauptversammlung einen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan), wonach nicht übertragbare Rechte zum künftigen Erwerb von Aktien gewährt werden. Entsprechend dieses Plans können über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 48 Mio. Aktienoptionen ausgegeben werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 120% des durchschnittlichen Aktienpreises während der fünf Handelstage vor dem Ausgabebetrag der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwei Jahre vergangen sind und der Aktienkurs im Xetra-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an mindestens einem Handelstag während der jeweiligen Laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat.

Am 6. April 2001 stimmten die Aktionäre einem internationalen Aktienoptionsplan zu, der den 1999 beschlossenen Aktienoptionsplan ablöst. Optionen, die auf Grundlage des bisherigen Planes ausgegeben wurden, behalten ihre Wirksamkeit zu den damaligen Ausgabekonditionen. Entsprechend den Bedingungen des neuen Planes können insgesamt bis zu 51,5 Mio. Optionen innerhalb einer Fünfjahresfrist gewährt werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 105% des durchschnittlichen Aktienkurses während der fünf Handelstage vor Gewährung der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren ausgeübt werden, sofern seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwei Jahre vergangen sind.

Nach den Regelungen des Aktienoptionsplans von 2001 entscheidet der Aufsichtsrat jährlich innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Konzernabschlusses über die Zahl der dem Vorstand zu gewährenden Optionen. Der Vorstand wird im gleichen Zeitraum die Zahl der den Mitarbeitern zu gewährenden Optionen festlegen.

Die Aktienoptionspläne von 1999 und 2001 sowie ihre Veränderungen innerhalb der letzten drei Jahre stellen sich wie folgt dar:

	2000		2001		2002	
	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis
Ausstehende Optionen zu Beginn des Geschäftsjahrs	-	-	5.469.468	€ 42,15	11.267.878	€ 48,56
Gewährte Optionen	5.556.268	€ 42,15	6.013.060	€ 54,15	9.393.030	€ 21,74
Ausgeübte Optionen	-	-	-	-	-	-
Verfallene Optionen	-86.800	€ 42,00	-214.650	€ 43,82	-777.698	€ 45,90
Ausstehende Optionen zum Ende des Geschäftsjahrs	5.469.468	€ 42,15	11.267.878	€ 48,56	19.883.210	€ 35,96
Ausübbar zum Ende des Geschäftsjahrs	-	-	-	-	5.060.460	€ 42,00

Die folgende Tabelle fasst Informationen über die ausstehenden Aktienoptionen zum 30. September 2002 zusammen:

Spanne der Ausübungspreise	Ausstehend			Ausübbar	
	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen (in Stück)	Durchschnittlicher Ausübungspreis
€ 10–€ 15	1.524.000	6,90	€ 12,57	–	–
€ 15–€ 20	206.750	6,82	€ 16,08	–	–
€ 20–€ 25	7.516.940	6,18	€ 23,70	–	–
€ 25–€ 30	163.950	5,99	€ 27,45	–	–
€ 40–€ 45	5.144.960	4,47	€ 42,05	5.060.460	€ 42,00
€ 50–€ 55	196.700	5,51	€ 53,26	–	–
€ 55–€ 60	5.129.910	5,17	€ 55,19	–	–
	19.883.210	5,53	€ 35,96	5.060.460	€ 42,00

Wie in Anhang Nr. 2 erläutert, bilanziert die Gesellschaft Aktienoptionspläne gemäß APB Opinion 25 „Bilanzierung von Aktienoptionen für Mitarbeiter“ und den entsprechenden Regelungen zur Bilanzierung von Aktienoptionsplänen. Daher wurden im Zusammenhang mit den Aktienoptionsplänen von 1999 und 2001 keine Aufwendungen für Mitarbeitervergütung erfasst, da die Laufzeiten und die Ausübungspreise der Optionen fest vorgegeben sind und die Ausübungspreise den Marktwert der zu Grunde liegenden Aktie zum Gewährungszeitpunkt überschreiten.

SFAS Nr. 123 gibt eine alternative Möglichkeit zur Bewertung des Aufwands für Mitarbeitervergütung vor, indem der Marktwert der Optionen zum Gewährungszeitpunkt durch Optionspreismodelle bestimmt wird. Optionspreismodelle wurden entwickelt, um den Marktwert von frei handelbaren, fungiblen Optionen ohne Mindesthaltedauer zu bestimmen, die sich jedoch deutlich von den Optionen mit Ausübungsrestriktionen unterscheiden, die die Gesellschaft ihren Mitarbeitern gewährt. Diese Modelle benötigen weiterhin subjektive Annahmen, wie die zukünftige Volatilität des Aktienkurses und den erwarteten Zeitraum bis zur Ausübung, die den festgestellten Optionspreis erheblich beeinflussen. Die Gesellschaft bewertete den Marktwert einer gewährten Option zum Ausgabezeitpunkt mittels des Black-Scholes-Optionspreismodells, das von einer Einzelbewertung der Optionen ausgeht und den Verfallszeitpunkt zu dem Zeitpunkt annimmt, zu dem die Optionen auslaufen. In der folgenden Tabelle sind die durchschnittlichen Annahmen zur Optionspreisbewertung in den einzelnen Geschäftsjahren dargestellt.

	2000	2001	2002
Durchschnittliche Annahmen			
Risikofreier Zinssatz	5,46%	5,35%	4,19%
Erwartete Volatilität	45%	50%	52%
Dividendenertrag	0%	0%	0%
Erwartete Laufzeit in Jahren	4,50	4,50	4,50
Durchschnittlicher Marktwert pro Option zum Gewährungszeitpunkt in Euro	14,81	24,18	9,09

Wären Personalaufwendungen auf der Grundlage des Marktwerts nach SFAS Nr. 123 bilanziert worden, wodurch sich ein Aufwand für Mitarbeitervergütung auf Grundlage oben dargestellter Marktwerte ergeben hätte, so hätte sich der Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag) und das Ergebnis je Aktie wie in den folgenden Pro-forma-Angaben verringert:

	2000	2001	2002
Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag)			
Ist	1.126	-591	-1.021
Pro forma	1.116	-638	-1.090
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie			
Ist	€ 1,83	€ -0,92	€ -1,47
Pro forma	€ 1,81	€ -1,00	€ -1,57

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Zur Börseneinführung konnten Mitarbeiter Aktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms bevorrechtigt erwerben. Von Mitarbeitern wurden 7.540.448 Aktien mit einem durchschnittlichen Abschlag von 5% gegenüber dem Ausgabekurs erworben. In diesem Zusammenhang sind im Geschäftsjahr 2000 Personalaufwendungen in Höhe von € 3 entstanden.

Die Gesellschaft hat ein weltweites Programm zum Aktienwerb durch Mitarbeiter, das den Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, Aktien der Gesellschaft mit einem Abschlag von 15% zu erwerben, solange eine bestimmte Obergrenze pro Mitarbeiter nicht überschritten und eine Mindesthaltedauer von einem Jahr eingehalten wird. Im Rahmen und unter den Bedingungen dieses Planes erwarben Mitarbeiter im abgelaufenen Geschäftsjahr 355.460 Aktien.

(29) Derivative Finanzinstrumente

Infineon schließt Geschäfte über Derivate einschließlich Fremdwährungstermin- und -optionsgeschäften ab. Ziel dieser Transaktionen ist die Verringerung der Marktrisiken aus Veränderungen von Währungsrelationen für die in Fremdwährung lautenden Zahlungsströme. Derivative Finanzinstrumente werden bei Infineon nicht zu Handels- oder spekulativen Zwecken eingesetzt.

Die Nominal- und Marktwerte der von Infineon zum 30. September 2001 und 2002 erworbenen bzw. veräußerten Derivate in Mio. Euro sind im Folgenden dargestellt:

	2001		2002	
	Nominalwert	Marktwert	Nominalwert	Marktwert
Forward Verträge Verkauf				
US-Dollar	1.377	62	313	6
Japanische Yen	136	7	-	-
Britisches Pfund	7	-	-	-
Forward Verträge Kauf				
US-Dollar	261	-8	148	-
Japanische Yen	44	-1	75	-2
Singapur-Dollar	26	-	33	-1
Britisches Pfund	7	-	7	-
Sonstige Währungen	64	-1	52	-
Währungsübergreifender Zinsswap				
US-Dollar	616	59	616	106
Zinsswap	-	-	500	26
Termingeschäft	-	-	150	-

Zum 30. September 2001 und 2002 wurden die Derivate zu ihren Marktwerten bilanziert.

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben.)

Die Gewinne aus Fremdwährungen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften betragen in den Geschäftsjahren 2000 € 184 und 2001 € 34, im Geschäftsjahr 2002 wurden mit Fremdwährungen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften Verluste in Höhe von € 16 erzielt. Gewinne und Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten sind in den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen enthalten. Gewinne oder Verluste, die dem operativen Geschäft zuordenbar sind, werden überwiegend in den Umsatzkosten, und solche, die im Zusammenhang mit Finanztransaktionen entstanden, werden in den sonstigen Erträgen oder Aufwendungen gezeigt.

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen oder der DCF-Methode ermittelt. Der Marktwert der unbesicherten Darlehen und der verzinslichen Bankverbindlichkeiten entspricht annähernd dem Buchwert, da die Verzinsung den derzeit marktüblichen Zinsen entspricht. Der Marktwert des zinslosen Darlehens ist nicht aussagefähig, da dessen Übertragbarkeit beschränkt ist. Zum 30. September 2002 wurde die Wandelanleihe an der Börse in Luxemburg mit einem Abschlag von 42,3% gegenüber dem Nominalwert gehandelt. Die Marktwerte der Zahlungsmittel, Forderungen gegen Dritte, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie der übrigen derivativen Finanzinstrumente entsprechen auf Grund ihrer kurzfristigen Fälligkeiten annähernd deren Buchwerten. Die Marktwerte der Wertpapiere des Umlaufvermögens werden in Anhang Nr. 7 gezeigt.

(30) Risiken

Die Finanzrisiken von Infineon resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften. Das Kreditrisiko bei Forderungen ist auf Grund der großen Anzahl sowie wegen der regionalen Verteilung der Kunden begrenzt. Ferner bestehen Richtlinien zur Kreditgewährung und -überwachung. Ein wesentlicher Teil der Forderungen und Umsätze aus Lieferungen und Leistungen wird mit verbundenen Unternehmen realisiert. Das Kreditrisiko ist in Bezug auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Fremdwährungs-Derivate durch Transaktionen mit verschiedenen Banken auf vorgegebene Obergrenzen beschränkt.

Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit hat Infineon anhaltend hohe Aufwendungen für Prozesstechnologien sowie für Forschung und Entwicklung. Falls die Ergebnisse aus diesen Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Markt keine Akzeptanz finden oder die Marktbedingungen sich wesentlich verschlechtern, könnten Teile der erwarteten Rückflüsse aus diesen Investitionen ausbleiben.

(31) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Am 7. und 8. August 2000 hat Rambus Inc. („Rambus“) Klagen gegen die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und in Deutschland erhoben. Der Kläger behauptet, dass die Gesellschaft gegen Patentrechte des Klägers in Verbindung mit den SDRAM- und DDR DRAM-Produkten verstoßen hat. SDRAM-Produkte sind für das Infineon-Speichergeschäft von erheblicher Bedeutung. Ein Fertigungsverbot von SDRAM- und DDR DRAM-Produkten würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage insbesondere des Unternehmensbereichs Speicherprodukte negativ beeinflussen, da die Produktlinien SDRAM und DDR RAM, die wesentlich zum Speichergeschäft beitragen, aufgegeben werden oder Lizenzabkommen mit Rambus geschlossen werden müssten, die erhebliche Lizenzzahlungen für produzierte und künftig zu produzierende Produkte auslösen würden. Die betroffenen Produkte sind im Wesentlichen alle Produkte des Geschäftsbereichs Speicherprodukte. Am 4. und 9. Mai 2001 hat ein Bezirksgericht in Virginia, USA, alle Klagen von Rambus gegen die Gesellschaft abgewiesen. Zusätzlich attestierte das Gericht Rambus arglistige Täuschung im Verhalten gegenüber der JEDEC-Standardisierungs-Organisation und erkannte Infineon Schadenersatz zu. Nachdem Rambus nunmehr Berufung eingelegt hat, kann die Wahrscheinlichkeit des endgültigen Erfolgs noch nicht vorhergesagt werden.

Die erste Anhörung der Klage in Deutschland begann im Mai 2001. In ihrem Schriftsatz vom 9. Februar 2001 veränderte Rambus die ursprünglich verfolgte Unterlassungsklage und nahm zusätzlich einen Antrag auf Schadenersatzzahlung wegen Patentverletzung auf. Die Höhe der Schadenersatzforderung ist noch nicht bekannt. In der ersten Anhörung am 18. Mai 2001 erwähnte das Gericht besonders die Entscheidungen der parallelen Klage in den USA. Das Gericht hat einen technischen Experten bestimmt, der die Frage der Verletzung beurteilen soll. Das Gutachten wurde zwischenzeitlich vorgelegt, aber das Gericht hat sich dazu noch nicht geäußert. Die Gesellschaft glaubt, eine gute Verteidigungsposition zu haben, und beabsichtigt, sich in dieser Angelegenheit energisch zu wehren.

Im Oktober 1999 unterrichtete die Deutsche Telekom AG („DT“) Infineon über eine mögliche vertragliche Inanspruchnahme aus Gewährleistungsverpflichtungen in Bezug auf Chiplieferungen für Telefonkarten. Der Anspruch bezieht sich auf einen von der DT vermeintlich erlittenen Schaden, der bei unrechtmäßigen Versuchen entstand, bereits benutzte Telefonkarten wieder aufzuladen. Die DT machte ursprünglich einen Verlust von circa € 90 geltend, welcher den erlittenen Schaden ebenso wie die Aufwendungen für Abwehrmaßnahmen umfasst, und verlangte Schadenersatz von Siemens und Infineon. Im November 2001 hat die DT aber nur gegen Siemens Klage eingereicht und die Schadenersatzforderung auf rund

€ 125 erhöht. Siemens hat die Gesellschaft offiziell darüber informiert, und Infineon ist jetzt für weitere Verhandlungen an die Seite von Siemens gestellt. Die erste Anhörung ist für den 28. Januar 2003 vorgesehen. Sollte Siemens haftbar gemacht werden, könnte Infineon im Rahmen bestimmter Garantien, die bei der Gründung von Infineon gegenüber Siemens abgegeben wurden, für den Schaden einstehen müssen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Ansprüche unbegründet sind. Infineon geht davon aus, dass in diesem Zusammenhang kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entstehen wird.

Im Juni 2002 erhielten die Infineon Technologies North America Corp., die Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG in den USA, sowie weitere Speicherhersteller eine Vorladung einer Grand Jury eines kalifornischen Bezirksgerichts im Zusammenhang mit einer Ermittlung über mögliche Verletzungen US-amerikanischer Kartellgesetze bei der Preisfestsetzung für DRAM-Speicherprodukte. Die Gesellschaft wurde aufgefordert, der Grand Jury im Zusammenhang mit der Untersuchung Informationen zu übermitteln. Infineon will alle Anforderungen von offizieller Seite im Zusammenhang mit dieser Ermittlung erfüllen. Im Zusammenhang mit dieser Ermittlung erhoben direkte und indirekte DRAM-Käufer mehrere Gemeinschaftsklagen gegen die Infineon Technologies AG und die Infineon Technologies North America Corp. Diese Klagen beschuldigen Infineon und andere Wettbewerber der Preisabsprache bei DRAM-Produkten. Momentan prüft die Gesellschaft diese Beschuldigungen. Die Gesellschaft ist nicht in der Lage, eine Aussage über den Ausgang dieser Klagen zu treffen.

Gegen die Gesellschaft laufen verschiedene andere Rechtsstreite und Verfahren im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit. Diese betreffen Produkte, Leistungen, Patente und andere Sachverhalte. Hierfür werden Rückstellungen gebildet, sobald die mögliche Verpflichtung dem Grunde nach wahrscheinlich und in der Höhe hinreichend genau bestimmbar ist. Das Management der Gesellschaft ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Auffassung, dass aus dem Ausgang der anhängigen Verfahren kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögenslage zu erwarten ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Zukunft liegenden Verfahrensabschlüsse die Finanz- und Ertragslage wesentlich negativ beeinflussen können.

Im Rahmen der Gründung von Infineon verblieben bei Siemens bestimmte Betriebsstätten in den USA sowie die damit zusammenhängenden Umweltaltlasten. Für das von Siemens bei der Gründung von Infineon eingebrachte Geschäft wurden in der Vergangenheit einige dieser Betriebsstätten genutzt. Auf Grund der US-amerikanischen Rechtsprechung könnte Infineon für die Beseitigung von Umweltaltlasten in Anspruch genommen werden, obwohl diese Betriebsstätten bei Siemens verblieben sind. Siemens hat gegenüber bestimmten, nicht zum Konzern gehörigen Gesellschaften sowie Behörden Garantien abgegeben. Alle beteiligten Parteien sehen die Verantwortung für die betreffenden Standorte bei Siemens. Bislang wurden keine Ansprüche gegen Infineon geltend gemacht. Die Höhe eventueller Ansprüche aus der Beseitigung von Altlasten, sofern solche bestehen, wurde nicht ermittelt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihr Risiko zur Entsorgung der Altlasten der bei Siemens verbliebenen Betriebsstätten in den USA begrenzt ist.

Im Zuge der Gründung hat die Gesellschaft Siemens für Garantien, die Siemens für Finanzierungen von Infineon-Gesellschaften gegeben hatte, Rückbürgschaften gewährt. Am 30. September 2002 war Infineon unter anderem folgende wesentliche Verpflichtungen eingegangen:

- eine Zahlungsgarantie in Höhe von € 313 zu Gunsten von Kreditinstituten im Zuge einer Rückhaftungserklärung im Zusammenhang mit gewährten Zuschüssen für die Fertigungsstätte in Dresden;
- eine Zahlungsgarantie für Schulden von ProMOS in Höhe von USD 61 Mio. Die Verschuldung ist an Bedingungen der Einhaltung einer anderen Kreditvereinbarung geknüpft.

Die Gesellschaft hat Zuwendungen der öffentlichen Hand für den Bau und die Finanzierung von bestimmten Produktionsstätten erhalten. Diese Beträge werden bei Erreichen definierter Meilensteine vereinbart sowie in den Fällen, in denen die Erfüllung der Anforderungen nach geplanten und zugesagten Investitionen, geschaffenen Arbeitsplätzen sowie anderen Faktoren hinreichend sichergestellt werden kann. Infineon ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen. Sollten jedoch die Anforderungen an ein Gesamtprojekt nicht erfüllt werden, können zum Stichtag 30. September 2002 bis zu € 374 der Zuwendungen zurückgefordert werden.

Infineon ist mit verschiedenen Zulieferern Vereinbarungen eingegangen, die der Gesellschaft Kapazitäten zur Produktion und zum Testen von Halbleiterprodukten garantieren. Diese verlängerbaren Vereinbarungen besitzen grundsätzlich eine Vertragslaufzeit von ein oder zwei Jahren und beinhalten jeweils Mindestabnahmemengen und Preiszusagen.

Gegenüber ProMOS hat sich Infineon vertraglich verpflichtet, 48% (auf Nettobasis) der Jahresproduktion, die auf Infineons lizenzierter Technologie basiert, abzüglich des an MVI verkauften Anteils, zu von Marktwerten abgeleiteten Preisen abzunehmen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit ALTIS die Abnahme von 50% von deren Jahresproduktion zu Marktpreisen vereinbart (siehe Anhang Nr. 32).

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben.)

Bezüge aus diesen Vereinbarungen werden entsprechend dem üblichen Geschäftsverlauf als Aufwendungen erfasst. Um der Nachfrage seitens ihrer Kunden nach ihren Produkten entsprechen zu können, überprüft Infineon regelmäßig den voraussichtlichen Einkaufsbedarf. Die Einkaufsverträge werden regelmäßig auf drohende Verluste überprüft, die eintreten können, falls die voraussichtlichen Bedarfsmengen unter die Bestellmengen bzw. die Marktpreise unter die Vertragspreise fallen. ALTIS und ProMOS bilden einen wichtigen Teil im Produktbeschaffungsprozess der Gesellschaft.

Im Mai 2002 schloss die Gesellschaft mit Winbond Electronics Corp. („Winbond“) eine Lizenz- und Produktabnahmevereinbarung. Gemäß den Bedingungen der Lizenzvereinbarung wird die Gesellschaft Know-how über spezielle DRAM-Technologien an Winbond übertragen. Die Lizenzvereinbarung sieht innerhalb ihrer Laufzeit von fünf Jahren auch die Zahlung von Lizenzgebühren für bestimmte Produkte vor, die seitens Winbond an Dritte verkauft werden. Die Lizenzgebühren werden abgegrenzt und über die Laufzeit des Produktabnahmevertrags linear erfolgswirksam vereinnahmt. Nach den Bedingungen des Produktabnahmevertrags wird die Gesellschaft bestimmte Mengen von DRAM-Produkten zu Preisen, welche teilweise auf Marktpreisen basieren, abnehmen. Zusätzlich wird die Gesellschaft über die Laufzeit der Vereinbarung die Verantwortung für die Belieferung eines wesentlichen Kunden von Winbond mit DRAM-Produkten übernehmen.

Im Zuge der Gründung des UMCi-Gemeinschaftsunternehmens („UMCi“) hat die Gesellschaft zugestimmt, in den Geschäftsjahren nach dem 30. September 2002 spezielle Technologie- und Bareinlagen im Wert von insgesamt USD 405 Mio. einzubringen. Zusätzlich hat die Gesellschaft eine Abnahmevereinbarung mit dem Gemeinschaftsunternehmen abgeschlossen, die eine Mindestabnahmeverpflichtung enthält, welche etwa 30% der Produktionskapazität des Werkes darstellt.

Im Mai 2002 gründeten die Gesellschaft, AMD und DuPont ein Joint Venture, um ein Werk zur Herstellung von Fotomaschinen in Dresden zu errichten und zu betreiben. Es ist absehbar, dass in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2003 der Bau der Anlage beendet und der Betrieb aufgenommen wird. Im Zusammenhang mit diesem Abkommen traf die Gesellschaft ein Zehnjahres-Lieferabkommen mit DuPont, das das Produktionsvolumen aus dem Dresden Werk einschließt. Der Vertrag enthält jährliche Mindestabnahmemengen und ist nicht kündbar.

Die gesamten Aufwendungen für Operating-Lease-Verträge betragen in den Geschäftsjahren 2000 € 131, 2001 € 181 und 2002 € 193. Die zukünftigen Mindestleasingraten für unkündbare Operating-Lease-Verträge mit Laufzeiten oder Restlaufzeiten von über einem Jahr betragen zum 30. September 2002 jeweils: 2003 € 83; 2004 € 78; 2005 € 67; 2006 € 46; 2007 € 18 und für die Folgejahre € 84.

(32) Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach der notwendigen Zustimmung der Kartellbehörden gründeten Infineon, Agere Systems Inc. und Motorola Inc. am 1. Oktober 2002 das Joint Venture StarCore LLC. StarCore wird Basistechnologien für Digital-Signal-Prozessoren (DSP) entwickeln, vereinheitlichen und vermarkten. Die Gesellschaft wird geistiges Eigentum, ihr Entwicklungszentrum in Tel Aviv sowie Bargeld im Gesamtwert von € 25 in die Gründung von StarCore einbringen.

Am 4. Oktober 2002 gab die Gesellschaft bekannt, dass sie den Aktionärsvertrag mit MVI über ihr Gemeinschaftsunternehmen ProMOS auf Grund schwer wiegender Verletzungen des Aktionärsvertrags durch MVI zum 1. Januar 2003 gekündigt hat. Die Gesellschaft hat weder das im Aktionärsvertrag vereinbarte Recht zur Ausübung einer Call-Option zum Kauf der von MVI gehaltenen ProMOS-Aktien noch das einer Put-Option, die MVI verpflichtet, die von Infineon gehaltenen Anteile an ProMOS zu erwerben, in Anspruch genommen. Die Kapazitäts- und Liefervereinbarung, die sowohl das Recht als auch die Pflicht zur Abnahme von Produkten von ProMOS für beide Anteilseigner beinhaltet, erlischt mit der Beendigung des Aktionärsvertrags. Die Gesellschaft überprüft verschiedene Handlungsalternativen, darunter die Verhandlung einer neuen Liefervereinbarung mit ProMOS, welche gemäß dem Gesellschaftervertrag von ProMOS für die Genehmigung eine Dreiviertelmehrheit im Aufsichtsrat und damit die Zustimmung der Vertreter von MVI benötigt. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eine solche Vereinbarung getroffen oder vom ProMOS-Aufsichtsrat genehmigt wird. Die Materialbezüge von ProMOS für die Geschäftsjahre 2001 und 2002 beliefen sich auf € 137 bzw. € 182 (siehe Anhang Nr.31). Die Gesellschaft wies im Geschäftsjahr 2002 Lizenzeinnahmen in Höhe von € 95 aus. Am 30. September 2002 war die Beteiligung an ProMOS mit € 196 (inklusive abgegrenzter Lizenzeinnahmen) unter Finanzanlagen bilanziert. Die Forderungen gegenüber MVI waren alle kurzfristig und betragen zum 30. September 2002 € 87.

Die Gesellschaft entschied die Zusammenlegung der Geschäftsbereiche Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs zu einem Geschäftsbereich unter dem Namen Sichere Mobile Lösungen und wird die Zusammenlegung als solche mit Wirkung vom 1. Oktober 2002 berichten.

Am 13. November 2002 schlossen Infineon und Nanya eine Reihe von Abkommen über eine strategische Kooperation zur Entwicklung von DRAM-Speicherprodukten und die Errichtung und den Betrieb einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Taiwan.

Gemäß den Vereinbarungen werden Nanya und die Gesellschaft fortschrittliche 0,09-Mikrometer- und 0,07-Mikrometer-Technologie entwickeln. Die Gesellschaft erwartet, dass die Entwicklung bis zum 30. April 2005 abgeschlossen ist, die Kosten hierfür werden zu zwei Dritteln von Infineon und zu einem Drittel von Nanya getragen. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungstätigkeiten hat die Gesellschaft Nanya gestattet, unsere 0,11-Mikrometer-Technologie in Lizenz im Rahmen ihrer bestehenden Produktion einzusetzen. Nanya hat sich verpflichtet, der Gesellschaft – hauptsächlich im Geschäftsjahr 2003 – 95 Mio. US-Dollar zu zahlen.

Die neue 300-Millimeter-Fertigungsstätte wird die im Rahmen der oben genannten Vereinbarung entwickelte Technologie einsetzen um DRAM-Produkte herzustellen und soll in zwei Stufen errichtet werden. Die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe ist für die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2004 geplant. Die Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe wird für das Geschäftsjahr 2006 erwartet. Beide Partner an diesem Joint Venture haben sich verpflichtet, jeweils die Hälfte der Produktion dieser Fertigungsstätte zu Preisen, die teilweise auf Marktpreisen basieren, abzunehmen.

Das Finanzierungsvolumen für die Errichtung der gemeinsamen 300-Millimeter-Fertigungsstätte beträgt rund € 2.200. Von diesem Betrag wird bis zum Ende des Kalenderjahres 2005 jeder der beiden Partner € 550 einbringen, wobei die Gesellschaft erwartet, dass € 110 bis zum 30. September 2003 benötigt werden. Die verbleibenden € 1.100 plant das Joint Venture extern zu finanzieren. Der Zeitrahmen der Errichtung und die entsprechenden Kapitalaufnahmen können an die vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Das beabsichtigte Gemeinschaftsunternehmen muss durch die Kartellbehörden genehmigt werden; die Zustimmung wird bis Ende des laufenden Kalenderjahres erwartet.

(33) Segmentberichterstattung

Infineon berichtet über ihre Geschäftsbereiche und nach Regionen gemäß den Regelungen des SFAS Nr. 131 „Angaben zu den Segmenten eines Unternehmens und damit in Zusammenhang stehende Informationen“.

Infineon ist schwerpunktmäßig in fünf Geschäftsbereichen tätig, von denen vier anwendungsorientiert sind: Automobil- und Industrieelektronik, Drahtgebundene Kommunikation, Mobile Kommunikation und Sicherheits- und Chipkarten-ICs sowie der Geschäftsbereich Speicherprodukte, der produktorientiert ist. Ferner entsprechen die verbleibenden Aktivitäten aus verkauften Geschäften und neuen Geschäftsaktivitäten der Definition gemäß SFAS Nr. 131 für ein Segment, erreichen aber nicht die Berichterstattungskriterien gemäß SFAS Nr. 131. Deshalb wurden für Berichterstattungszwecke diese Bereiche unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ zusammengefasst.

Jedes dieser Segmente wird von einem Bereichsleiter geführt, der direkt dem Chief Operating Officer und dem Finanzvorstand berichtet. Diese als Chief Operating Decision Makers („CODM“) Bezeichneten tragen gemeinsam die Entscheidungsverantwortung für das laufende Geschäft. Sie entscheiden gemeinsam über die Ressourcenzuordnung auf die Geschäftsbereiche und beurteilen deren Erfolg anhand der Kennzahlen, Umsatzerlöse sowie EBIT. Die Aktiva von Infineon werden den Geschäftsbereichen nicht in einer regelmäßigen Berichterstattung zugerechnet, mit Ausnahme von bestimmten Vorratsinformationen, die den CODM regelmäßig auf Segmentbasis berichtet werden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für die Geschäftsbereiche entsprechen grundsätzlich den bereits erläuterten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen von Infineon (siehe Anhang Nr. 2). Das Anlagevermögen wird für Management-Berichterstattungszwecke in den einzelnen Geschäftsbereichen nicht im Einzelnen identifiziert und diesen demzufolge nicht zugerechnet. Infineon ordnet den einzelnen Geschäftsbereichen die Abschreibungen nach Maßgabe des Produktionsvolumens und der erzeugten Produkte auf Basis von Standardkosten zu, so dass das EBIT je Geschäftsbereich ermittelt werden kann.

Informationen zu den Geschäftsbereichen:

Drahtgebundene Kommunikation

Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Glasfaserbauteile für ein breites Anwendungsspektrum von Breitband-Kommunikationsanwendungen und Anwendungen mit geringen Übertragungsraten in den Bereichen WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) und Corner Access.

Mobile Kommunikation

Der Geschäftsbereich Mobile Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und komplette Systemlösungen für ein breites Spektrum von drahtlosen Anwendungen, darunter Mobilfunk-Telefonsysteme, schnurlose Telefone, Bluetooth-Anwendungen und Anwendungen, die im Rahmen von globalen Ortungssystemen („GPS“) eingesetzt werden.

Sicherheits- und Chipkarten-ICs

Der Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs entwickelt, fertigt und vertreibt Sicherheitskontrollbausteine, Sicherheitsspeicherbausteine sowie andere Halbleiter und Systemlösungen für Einsatzgebiete mit speziellen Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Banken, in der Telekommunikation, für Zugangskontrollsysteme und Identifizierungssysteme sowie andere sicherheitssensible Anwendungen.

Automobil- und Industrieelektronik

Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen zur Verwendung in der Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen.

Speicherprodukte

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiter-Speicherprodukte in verschiedenen Gehäusen und Konfigurationen, Architekturen und mit verschiedenen Leistungsparametern für den Einsatz in Standard- und speziellen Speicheranwendungen.

Sonstige Geschäftsbereiche

Bestimmte verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften und neuen sonstigen Geschäftsaktivitäten sowie die Umsätze mit optoelektronischen Produkten sind in „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten.

Zum 1. Oktober 2001 organisierte die Gesellschaft einige ihrer Geschäftsbereiche neu, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Die Bereichsergebnisse der Jahre 2000 und 2001 wurden entsprechend umgestellt, so dass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahrs entsprechen, und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen zu ermöglichen.

Die folgende Darstellung zeigt ausgewählte Segmentdaten für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002:

	2000	2001	2002
Umsatzerlöse			
Drahtgebundene Kommunikation	661	766	386
Mobile Kommunikation	1.191	960	874
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	375	588	421
Automobil- und Industrieelektronik	923	1.153	1.201
Speicherprodukte	3.473	1.588	1.844
Sonstige Geschäftsbereiche	570	560	434
Konzernfunktionen	90	56	47
Summe Umsatzerlöse	7.283	5.671	5.207
EBIT			
Drahtgebundene Kommunikation	48	-93	-245
Mobile Kommunikation	258	-178	-82
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	49	27	-52
Automobil- und Industrieelektronik	71	143	111
Speicherprodukte	1.336	-931	-616
Sonstige Geschäftsbereiche	28	188	6
Konzernfunktionen	-120	-180	-264
Summe EBIT	1.670	-1.024	-1.142
Abschreibungen			
Drahtgebundene Kommunikation	61	98	97
Mobile Kommunikation	117	145	205
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	52	81	99
Automobil- und Industrieelektronik	143	186	226
Speicherprodukte	389	589	709
Sonstige Geschäftsbereiche	72	23	35
Konzernfunktionen	-	-	-
Summe Abschreibungen	834	1.122	1.371

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben.)

	2000	2001	2002
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften			
Drahtgebundene Kommunikation	-	-	-
Mobile Kommunikation	-	-	-
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	-	-	-
Automobil- und Industrieelektronik	-	-	-
Speicherprodukte	82	12	-56
Sonstige Geschäftsbereiche	9	1	-1
Konzernfunktionen	10	12	10
Summe Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften	101	25	-47
Vorräte			
Drahtgebundene Kommunikation	55	101	62
Mobile Kommunikation	107	111	137
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	36	70	54
Automobil- und Industrieelektronik	141	181	168
Speicherprodukte	359	268	357
Sonstige Geschäftsbereiche	35	49	21
Konzernfunktionen	108	102	92
Summe Vorräte	841	882	891

Zum 30. September 2002 verteilte sich der Geschäfts- und Firmenwert wie folgt auf die einzelnen Geschäftsbereiche:

	2002
Geschäfts- und Firmenwert	
Drahtgebundene Kommunikation	190
Mobile Kommunikation	73
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	-
Automobil- und Industrieelektronik	-
Speicherprodukte	88
Sonstige Geschäftsbereiche	5
Konzernfunktionen	-
Summe Geschäfts- und Firmenwert	356

Zwischen den Geschäftsbereichen werden auf Grund ihrer spezifischen Anwendungen und der produktbezogenen Eigenarten keine Umsätze getätigt. Dementsprechend resultieren die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche aus Umsätzen mit Dritten.

Die Vorprodukte und unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Logik-Front-End-Fabriken sowie die unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Back-End-Fabriken stehen nicht unter der Kontrolle und Verantwortung der zuständigen Bereichsleiter, sondern unter der des Standortmanagements, welches für die Umsetzung des Produktionsplans nach Mengen und Einheiten verantwortlich ist. Deshalb werden diese Vorräte in der Zeile „Konzernfunktionen“ ausgewiesen und nicht unter den einzelnen Geschäftsbereichen. Lediglich die Rohstoffe der Back-End-Fabriken (Chip-Bestände) und Fertigprodukte sind den Geschäftsbereichen zugeordnet und in den Segmentinformationen, welche an die verantwortlichen CODM berichtet werden, enthalten.

Infineon hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2000 die Berichterstattung der Leerkosten für Segmente überarbeitet. In der Vergangenheit wurden Leerkosten, sofern welche aufgetreten sind, den Segmenten zugerechnet, basierend auf der Differenz von geplanten und tatsächlichen Einkäufen. Die Gesellschaft ist bei der Leerkostenzuordnung auf das Fremdfertigermodell übergegangen, wobei die Vorlaufzeit der Auftragsstornierung oder -änderung bei der Leerkostenzuordnung berücksichtigt wird. Alle nicht verrechneten Leerkosten werden in Konzernfunktionen gezeigt. Die Vorjahre werden von dieser Änderung nicht berührt. Die Gesellschaft ist der Meinung, dass diese Methode die Verantwortlichkeiten des Segmentmanagements besser abbildet, im Einklang mit der von unabhängigen Fremdfertigern angewendeten Methoden ist und somit zu einer adäquateren Berichterstattung der Segmentergebnisse führt.

Bestimmte Posten sind in den Konzernfunktionen enthalten und werden nicht auf die Segmente umgelegt. Dies gilt für Kosten der Konzernzentrale, bestimmte Inkubatorkosten und Aufwendungen für Grundlagenforschung, Einmalgewinne und spezielle strategische Technologieaktivitäten. Rechtskosten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum werden bei den Segmenten zum Zeitpunkt der Ausgabewirksamkeit gezeigt. Dies kann sich unterscheiden vom Zeitpunkt des Aufwands, der in den Konzernfunktionen gezeigt wird. Im Geschäftsjahr 2002 beinhalten die Konzernfunktionen nicht zugeordnete Leerkosten in Höhe von € 211 (2001: € 27), Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von € 16 (2001: € 117) und zentrale IT-Kosten in Höhe von € 36 (2001: € 71).

Es folgt eine Übersicht zu der Geschäftstätigkeit nach Regionen für die Geschäftsjahre 2000, 2001 und 2002:

	2000	2001	2002
Umsatzerlöse			
Deutschland	1.612	1.745	1.372
Übriges Europa	1.647	1.260	1.023
USA	1.814	1.262	1.211
Asien/Pazifik	2.100	1.309	1.512
Andere	110	95	89
Summe Umsatzerlöse	7.283	5.671	5.207
Langfristig gebundenes Vermögen			
Deutschland	2.297	3.454	3.113
Übriges Europa	790	1.006	1.172
USA	1.312	1.551	1.211
Asien/Pazifik	310	350	374
Andere	11	8	-
Summe Langfristig gebundenes Vermögen	4.720	6.369	5.870

Der Ausweis des Umsatzes (mit Dritten) richtet sich nach dem Sitz des Rechnungsempfängers. Zwischen den Geschäftsbereichen entstehen keine Umsätze. Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind den Regionen zugeordnet, in denen sie sich befinden.

Mit Ausnahme von Verkäufen an Siemens, die in Anhang Nr. 19 erläutert sind, entfielen in den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 auf keinen Einzelkunden mehr als 10% der Gesamtumsatzerlöse. Die Umsatzerlöse mit Siemens resultieren insbesondere aus den Geschäftsbereichen Mobile Kommunikation und Automobil- und Industrieelektronik.

Ergänzende Erläuterungen für den nach US-GAAP aufgestellten Anhang zum Konzernabschluss entsprechend den Anforderungen nach § 292a HGB

Die Gesellschaft hat für das zum 30. September 2002 beendete Geschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsgesetzbuch aufgestellt. Sie hat sich dabei gemäß den handelsrechtlichen Regelungen dafür entschieden, über den Konzernabschluss auf der Grundlage der international anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze („US-GAAP“) zu berichten. Die Berichterstattung nach dem deutschen Handelsrecht umfasst neben dem Konzernabschluss nach US-GAAP zusätzliche Angaben sowie den Konzernlagebericht.

Hinweis für den Geschäftsbericht:

Der Konzernabschluss nach deutschem Handelsrecht und der Konzernlagebericht unterliegen deutschen Prüfungsvorschriften. Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat hierzu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 126492 hinterlegt oder kann in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.

Wesentliche Unterschiede zwischen deutscher und US-Rechnungslegung

Vorbemerkung

Die Infineon Technologies AG muss als deutsches Mutterunternehmen grundsätzlich einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufstellen. § 292a HGB befreit jedoch von dieser Pflicht, wenn ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt und offen gelegt wird (wie z. B. US-GAAP). Die Infineon Technologies AG stellt den Konzernabschluss nach US-GAAP auf. Im Folgenden werden die von den deutschen Rechnungslegungsvorschriften abweichenden Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden erläutert.

Grundsätzliche Unterschiede

Die Rechnungslegung nach US-GAAP unterscheidet sich von der nach dem deutschen HGB hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Während US-GAAP den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen für die Investoren legt, ist die HGB-Rechnungslegung von einer stärkeren Betonung des Gläubigerschutzes und Vorsichtsprinzips geprägt. Weiterhin sind Gesellschaften mit einer Börsennotierung in den USA verpflichtet, den Bilanzierungs- und Berichterstattungsanforderungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) zu entsprechen.

Gliederungsvorschriften

Die Bilanzgliederung nach US-GAAP orientiert sich an der geplanten Liquidation der Vermögensgegenstände und der Fristigkeit der Schulden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Bilanzgliederung für deutsche handelsrechtliche Zwecke ist für Kapitalgesellschaften grundsätzlich in § 266 HGB definiert. Die Gliederung orientiert sich hier an der geplanten Verweildauer von Vermögensgegenständen bzw. Finanzierungsquellen wie Schulden und Eigenkapital im Unternehmen.

Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erfolgt nach HGB und US-GAAP grundsätzlich nach gleichen Grundsätzen, sofern die Leistung erbracht und die Einzahlung erfolgt ist. Unterschiede können bezüglich des Zeitpunkts der Vereinnahmung auftreten, wenn die leistende Gesellschaft weitere finanzielle, operative oder leistungsbezogene Verpflichtungen gegenüber der leistungsempfangenden Gesellschaft übernommen hat oder die vereinbarten Beträge nicht hinreichend objektivierbar sind.

Marktgängige Wertpapiere

Marktgängige Wertpapiere, die Anteils- oder Gläubigerrechte verbriefen, sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die von Infineon gehaltenen Wertpapiere sind nach US-GAAP als Available-for-Sale-Securities zu klassifizieren und zum Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die Wertsteigerungen oder Wertminderungen dieser Wertpapiere werden, nach Berücksichtigung latenter Steuern, ergebnisneutral im Eigenkapital unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst.

Vorräte

Die Vorräte sind nach HGB ebenso wie nach US-GAAP mit den Herstellungskosten zu bewerten. Die Herstellungskosten nach US-GAAP werden als produktionsbezogene Vollkosten definiert, bei denen neben den Material- und Lohneinzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung die Material- und Fertigungsgemeinkosten einzubeziehen sind. Zudem sind Verwaltungskosten zu berücksichtigen, sofern sie in eindeutigem Zusammenhang mit der Erzeugung der zu bewertenden Produkte stehen. Nach HGB brauchen von den oben genannten Kosten Teile der indirekten Kosten wie z. B. Verwaltungskosten nicht in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen zu werden.

Geschäfts- oder Firmenwert

Unter US-GAAP ist gemäß dem SFAS Nr. 141 „Kapitalkonsolidierung“ in Verbindung mit dem SFAS Nr. 142 „Geschäfts- und Firmenwerte und andere immaterielle Vermögensgegenstände“ der Geschäfts- und Firmenwert bei Kapitalkonsolidierungen unter Anwendung der Erwerbsmethode nach dem 30. Juni 2001 nicht mehr länger abzuschreiben, sondern jährlich auf Werthaltigkeit zu überprüfen. Unter HGB ist der Firmen- und Geschäftswert über den Zeitraum der zu erwartenden Lebensdauer abzuschreiben.

Nicht abgeschlossene Entwicklungen geistiger Eigentumsrechte bei Beteiligungserwerben

Aufwendungen, die bei erworbenen Unternehmen für nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte entstanden sind, werden nach HGB nicht separat ermittelt, sondern als Bestandteil des Geschäfts- und Firmenwerts ausgewiesen. Nach US-GAAP werden diese Kosten zum Anschaffungszeitpunkt gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Nach HGB werden derivative Finanzinstrumente grundsätzlich nicht bilanziert. Dies bedeutet, dass Wertsteigerungen nicht zu berücksichtigen sind. Für Wertminderungen, die nicht realisierte Verluste darstellen, sind dagegen Rückstellungen zu bilden. Nach US-GAAP sind derivative Finanzinstrumente in der Bilanz mit ihrem Marktwert anzusetzen. Die Marktwertänderungen werden in der Gewinn- und Verlust-Rechnung oder unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst. Dies ist einerseits abhängig davon, ob die derivativen Finanzinstrumente Bestandteil eines Sicherungsgeschäfts sind, und andererseits von der Art des Sicherungsgeschäfts.

Latente Steuern

Der wesentlichste Unterschied in der Bilanzierung latenter Steuern zwischen HGB und US-GAAP ist, dass bislang nach den Vorschriften des HGB keine latenten Steuern auf Verluste bilanziert werden. Nach US-GAAP sind latente Steuern auf Verluste (inklusive Verlustvorträge) zu berücksichtigen. Auf aktive latente Steuern, deren Realisierung eher unwahrscheinlich ist, sind Wertberichtigungen vorzunehmen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Nach US-GAAP sind Pensionsrückstellungen unter Berücksichtigung für die Zukunft zu erwartender Entgeltentwicklungen nach dem Anwartschaftsbarwert-Verfahren zu bewerten. Diese Methode ist auch nach dem HGB zulässig. Auf Grund der Übertragung der treuhänderischen Verwaltung von Pensionsfondsanteilen an einen Pension Trust-Verein wurden nach US-GAAP die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen nicht mehr bei Infineon bilanziert. Nach HGB sind die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen trotz der Übertragung auf den Pension Trust-Verein weiterhin bei Infineon zu bilanzieren.

Aktienoptionsprogramm

Für die gewährten Aktienoptionen werden nach HGB Rückstellungen gebildet, sofern der Marktwert zum Bilanzstichtag über dem Ausübungspreis für die Optionsrechte liegt. Nach US-GAAP bilanziert Infineon die gewährten Aktienoptionen nach der Inneren-Wert-Methode entsprechend APB Opinion 25 „Bilanzierung von Aktienoptionen für Mitarbeiter“, die nicht zu einer Aufwandserfassung führt, sofern der Marktwert der Aktie im Zeitpunkt der Ausgabe der Option nicht deren Ausübungspreis übersteigt.

Kosten für Kapitalerhöhungen

Nach HGB wurden Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit dem Börsengang als Aufwendungen erfasst. Nach US-GAAP wurden diese Aufwendungen mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Rückstellungen

Nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften dürfen Aufwandsrückstellungen in bestimmten Fällen auch ohne Verpflichtung gegenüber Dritten gebildet werden. Nach US-GAAP sind Rückstellungen nur bei gegenüber Dritten bestehenden Verpflichtungen und darüber hinaus nur für eng eingegrenzte Tatbestände zu bilden.

Fremdwährungsumrechnung

Nach HGB werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit dem Währungskurs im Zeitpunkt der Erfassung des Geschäftsvorfalles bzw. jeweils zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet, wobei hieraus resultierende nicht realisierte Verluste in der Gewinn- und Verlust-Rechnung erfasst werden. Nach US-GAAP erfolgt die Bewertung der Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten zum Fremdwährungskurs des Bilanzstichtags, wobei die daraus ermittelten, nicht realisierten Gewinne und Verluste in der Gewinn- und Verlust-Rechnung erfasst werden.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Nach HGB dürfen Investitionszulagen und Zinszuschüsse im Geschäftsjahr des Zuflusses erfolgswirksam vereinnahmt werden. Nach US-GAAP wurden diese Zuwendungen abgegrenzt und über den Zeitraum der Verrechnung der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen erfolgswirksam vereinnahmt.

Anteiliges Jahresergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Nach HGB dürfen die anteiligen Ergebnisse der assoziierten Unternehmen basierend auf den nach den jeweiligen landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Ergebnissen vereinnahmt werden. Unter US-GAAP werden die nach US-GAAP ermittelten Ergebnisse der assoziierten Unternehmen anteilig vereinnahmt.

Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen

Nach HGB dürfen Wertsteigerungen des anteiligen Eigenkapitals durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen erfolgswirksam erfasst werden. Nach US-GAAP und SEC-Rechnungslegungsvorschriften hängt eine solche erfolgswirksame Vereinnahmung von der Erfüllung weiterer Kriterien neben der Durchführung der Kapitalerhöhung ab. Sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, ist die Werterhöhung des anteiligen Eigenkapitals erfolgsneutral in die Kapitalrücklage einzustellen.

Anwendung von Befreiungsvorschriften

Nach § 264a HGB haben offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen keiner der Gesellschafter eine natürliche Person oder eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesellschafter ist, einen Jahresabschluss nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Infineon Technologies AG hat die in §264b HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

- COMNEON GmbH & Co. OHG, Nürnberg
- Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden
- Infineon Technologies Immobilien Regensburg GmbH & Co. KG, Regensburg
- Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG, Dresden
- Infineon Ventures GmbH, München
- Ingentix GmbH & Co. KG, München

in Anspruch genommen, da diese Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen sind.

Die Infineon Ventures GmbH, München, hat mit der Infineon Technologies AG einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen und wird die Befreiungsmöglichkeit nach § 264 Abs. 3 HGB zur Aufstellung eines Jahresabschlusses ebenfalls in Anspruch nehmen.

Angabe gemäß §160 Nr.8 AktG

Die Siemens Nederland N.V., Den Haag, Niederlande, hat der Gesellschaft am 5. Dezember 2001 mitgeteilt, dass sie am 29. November 2001 die Schwelle von 25% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe des Stimmrechtsanteils betrage 20,4%. Dies entspreche 141.399.775 Stimmen.

Die First Union Trust Company, National Association, Wilmington, Delaware, USA, hat der Gesellschaft am 7. Dezember 2001 mitgeteilt, dass sie am 5. Dezember 2001 die Schwelle von 5%, 10% und 25% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG überschritten habe. Die Höhe des Stimmrechtsanteils betrage 28,86%. Dies entspreche zweihundert Millionen Stimmen.

Am 5. April 2002 hat die Siemens AG, Berlin und München, der Gesellschaft mitgeteilt, dass ihr zum 1. April 2002 25,63% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG zuständen. Dies entspreche 177.625.000 Stimmen. Dieser Anteil enthalte 86.299.775 Stimmrechte (entspreche 12,45%), die der Siemens AG gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Siemens Nederland N.V., und 91.325.225 Stimmrechte (entspreche 13,18%), die der Siemens AG gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG über den Siemens Pension-Trust e.V., München, zugerechnet würden.

Die Siemens AG teilte der Gesellschaft am 5. April 2002 gem. § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass sie am 5. Dezember 2001 die Schwelle von 50% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe des Stimmrechtsanteils betrage am 5. Dezember 2001 33,94%. Dies entspreche 235.225.000 Stimmen. Dieser Anteil enthalte 141.399.775 Stimmrechte (entspreche 20,4%), die der Siemens AG nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Siemens Nederland N.V., und 93.825.225 Stimmrechte (entspreche 13,54%), die der Siemens AG gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG über den Siemens Pension-Trust e.V., München, zugerechnet werden.

Die Siemens AG hat der Gesellschaft außerdem am 30. Juli 2002 gem. § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sie am 30. Juli 2002 die Schwelle von 25% der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Die Höhe ihres Stimmrechtsanteils betrage nunmehr 24,99998%. Dies entspreche 173.344.995 Stimmen. Dieser Anteil enthalte 86.292.363 Stimmrechte (entspreche 12,44517%), die der Siemens AG gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Siemens Nederland N. V., und 87.052.632 Stimmrechte (entspreche 12,55481%), die der Siemens AG gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG über den Siemens Pension-Trust e. V., München, zugerechnet würden.

Vorstand und Aufsichtsrat

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2002 0,5 Mio. Euro (fixe Bestandteile 0,5 Mio. Euro, variable Bestandteile 0 Euro und Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen 0 Euro). Darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 1.500 Wertsteigerungsrechte. Der Vorstand hat im Geschäftsjahr feste Gehaltsbestandteile in Höhe von 1,6 Mio. Euro bezogen und 290.000 Aktienoptionen erhalten. Die Aktienoptionen des Vorstands sowie die Wertsteigerungsrechte des Aufsichtsrats wurden im Geschäftsjahr 2001 nach den Regelungen des Long Term Incentive Plans 2001 ausgegeben. Für variable Bezüge des Vorstands wurden im Geschäftsjahr 2002 3,2 Mio. Euro Rückstellungen gebildet. Der Wert pro Option bzw. Wertsteigerungsrecht, wenn nach den gleichen Grundsätzen wie Aktienoptionen bewertet, betrug zum Ausgabezeitpunkt 9,63 Euro.

Als Vorstand und Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG waren im Geschäftsjahr folgende Damen und Herren bestellt:

Der Vorstand der Infineon Technologies AG	Alter	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30.9.2002)
Dr. Ulrich Schumacher	44	Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats I Deutsche Bahn AG, Berlin Konzernmandate: Vorsitzender des Board of Directors I Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur I Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan I Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA Vorsitzender des Aufsichtsrats I Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich
Peter Bauer	42	Mitglied des Vorstands und Chief Sales and Marketing Officer Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats I Siemens VDO Automotive AG, München Konzernmandate: Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors I Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan Mitglied des Board of Directors I Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur I Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA I Infineon Technologies Savan Ltd., Netanya, Israel
Peter J. Fischl	56	Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer Konzernmandate: Mitglied des Board of Directors I Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur I Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA Mitglied des Aufsichtsrats I Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich

Dr. Sönke Mehrgardt	54	Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer
		Externe Mandate:
		Mitglied des Aufsichtsrats
		■ Loewe AG, Kronach
		■ Loewe Opta GmbH, Kronach
		Konzernmandate:
		Vorsitzender der Gesellschafterdelegation
		■ Infineon Technologies Orion GmbH, München
Dr. Andreas von Zitzewitz	42	Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer
		Externe Mandate:
		Mitglied des Aufsichtsrats
		■ Steag Hamatech AG, Sternenfels
		Konzernmandate:
		Mitglied des Board of Directors
		■ Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur
		■ Infineon Technologies-Fabrico de Semicondutores
		Portugal S.A., Vila do Condo, Portugal
		■ Infineon Technologies Richmond Limited Partnership,
		Wilmington, Delaware, USA
		Vorsitzender der Gesellschafterdelegationen
		■ Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG,
		Dresden
		■ Eupec GmbH, Warstein-Belecke
		Präsident (in Vertretung der Infineon Technologies AG)
		■ Infineon Technologies France S.A.S., Saint Denis,
		Frankreich
		■ Infineon Technologies Holding France S.A.S., Saint Denis,
		Frankreich

Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG	Alter	Ende der Amts- zeit	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30.9.2002)
Max Dietrich Kley ^{1,2,3,4} Vorsitzender (seit 28. August 2002)	62	2005	<p>Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der BASF AG</p> <p>Externe Mandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München ■ Gerling NCM Credit and Finance AG, Köln ■ RWE Plus AG, Essen <p>Vergleichbare Mandate</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Basell N.V., Hoofddorp, Niederlande ■ Cazenove Group Plc., London, Großbritannien ■ Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz (Verwaltungsrat) <p>Konzernmandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BASF Coatings AG, Münster (Vorsitzender) ■ Wintershall AG, Kassel (Vorsitzender) <p>Vergleichbare Mandate</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BASFIN Corporation, Mt. Olive, USA (Board of Directors) ■ BASF Innovationsfonds GmbH, Ludwigshafen (Vorsitzender des Beirats) ■ WIEH GmbH, Berlin (Beirat) ■ WINGAS GmbH, Kassel (Beirat)
Dr.-Ing. E.h. Peter Mihatsch ^{1,2,3} Vorsitzender (vom 22. Januar bis 31. Juli 2002)	61	–	<p>Mitglied der Geschäftsführung der Taurus Holding GmbH & Co. KG (bis 31. März 2002)</p> <p>Externe Mandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Giesecke & Devrient GmbH, München (Vorsitzender) ■ Arcor AG, Eschborn ■ DaimlerChrysler Services AG, Berlin ■ Vodafone D2 AG, Düsseldorf ■ Vodafone AG, Düsseldorf ■ Vodafone GmbH, Düsseldorf <p>Mitglied des Verwaltungsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BT&T AG, St. Gallen/Zürich, Schweiz (bis 30. April 2002) ■ Alcatel S.A., Paris, Frankreich (seit Februar 2002) <p>Konzernmandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KirchPayTV GmbH & Co. KGaA, München (Vorsitzender) (Januar bis Juli 2002)

Dr. Eng. h.c. Volker Jung ^{1,2,3} Vorsitzender (bis zum 22. Januar 2002)	63	-	Mitglied des Vorstands der Siemens AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ DAB bank AG, München ■ MAN AG, München (Vorsitzender) ■ Messe München GmbH, München
			Konzernmandate: Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens A.E., Athen, Griechenland (Vorsitzender des Verwaltungsrats) ■ Siemens Ltd., Johannesburg, Südafrika (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
Alfred Eibl ^{*1,2,3} Stellvertretender Vorsitzender	53	2004**	Mitglied des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße
Dr. h.c. Martin Kohlhaussen ¹ Stellvertretender Vorsitzender	66	2005	Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Bayer AG, Leverkusen ■ Heraeus Holding GmbH, Hanau ■ HOCHTIEF AG, Essen ■ KarstadtQuelle AG, Essen ■ Linde AG, Wiesbaden ■ Schering AG, Berlin ■ ThyssenKrupp AG, Düsseldorf ■ Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart
Ender Beyhan*	34	2004**	Mitglied des Gesamtbetriebsrats; Mitglied des Betriebsrats München-Perlach
Johann Dechant*	37	2004**	Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West

Dr. Joachim Faber	52	2005	<p>Mitglied des Vorstands der Allianz AG</p> <p>Externe Mandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Berlinwasser Holding AG, Berlin <p>Vergleichbare Mandate</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Societa Metallurgica Italiana S.p.A., Florenz, Italien <p>Konzernmandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allianz Capital Partners GmbH, München <p>Vergleichbare Mandate</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allianz Risk Transfer, Zürich, Schweiz (Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats) ■ RASBANK S.p.A., Mailand, Italien (Verwaltungsrat)
Heinz Hawreliuk*	55	2004**	<p>Leiter des Ressorts Unternehmensmitbestimmung der IG Metall</p> <p>Externe Mandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Astrium GmbH, Ottobrunn bei München ■ DaimlerChrysler Aerospace AG, München ■ DaimlerChrysler Luft- und Raumfahrt Holding AG, München ■ Eurocopter Deutschland GmbH, Donauwörth ■ Siemens AG, Berlin und München
Dr. Stefan Jentsch (seit 22. Januar 2002)	41	2005	<p>Mitglied des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG</p> <p>Externe Mandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deutsche Börse AG, Frankfurt <p>Konzernmandate:</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ HVB Systems GmbH, München (Vorsitzender) ■ HVB Info GmbH, München (Vorsitzender) ■ DAB bank AG, München (Stellvertretender Vorsitzender) ■ INDEXCHANGE Investment AG, München (Vorsitzender) ■ Vereins- und Westbank AG, Hamburg (Stellvertretender Vorsitzender) <p>Vergleichbare Mandate</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bank Austria Creditanstalt AG, Wien, Österreich ■ HVB Asset Management GmbH, München (Vorsitzender des Verwaltungsrats) ■ HVB Private Clients GmbH, München (Vorsitzender des Verwaltungsrats) ■ Bank von Ernst & Cie. AG, Bern, Schweiz (Verwaltungsrat)

Klaus Luschtinetz*	59	2004**	Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats; Vorsitzender des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße
			Externe Mandate: Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Betriebskrankenkasse, München (Verwaltungsrat)
Karl Heinz Midunsky ^{2,3} (seit 22. Januar 2002)	58	2005	Corporate Vice President und Treasurer der Siemens AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Gerling-Konzern Spezialreife Kreditversicherungs-AG, Köln ■ Hannover Rückversicherungs-AG, Hannover Konzernmandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Krauss-Maffei Wegmann Verwaltungs-GmbH, München (Vorsitzender) ■ Risicom Rückversicherung AG, Grünwald bei München (Stellvertretender Vorsitzender) ■ Siemens Dematic AG, München (Stellvertretender Vorsitzender) ■ Siemens VDO Automotive AG, München (Stellvertretender Vorsitzender) ■ BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München ■ OSRAM GmbH, München Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Fujitsu Siemens Computers (Holding) B.V., Amsterdam, Niederlande (Member of the Board) ■ Siemens Building Technologies AG, Zürich, Schweiz (Verwaltungsrat)
Wolfgang Müller ⁴ (seit 1. Juli 2002)	54	2004**	Gewerkschaftssekretär; IG Metall – Bezirksleitung Bayern
Heinz-Joachim Neubürger ^{2,3} (bis 22. Januar 2002)	49	–	Mitglied des Vorstands der Siemens AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Allianz Versicherungs AG, München ■ Bayerische Börse AG, München ■ HVB Real Estate Bank AG, München Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Merrill Lynch & Co. Inc., New York, USA (Mitglied des Board of Directors) ■ Münchener Handelsverein Holding GmbH & Co. KG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Beirats) Konzernmandate: Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Corporation, New York, USA (Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors)

Dr. Eberhard Rauch (bis 31. Dezember 2001)	54	–	bis zum 31. Dezember 2001 Mitglied des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Inveos AG, Hamburg (Vorsitzender) ■ Bionorica AG, Neumarkt ■ DaimlerChrysler Bank AG, Stuttgart ■ Kennametal Hertel AG, Fürth (Vorsitzender)
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge	67	2005	Professor an der Technischen Universität München
Michael Ruth*	42	2004**	Kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs Mobile Kommunikation Vertreter der Leitenden Angestellten
			Konzernmandate: Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Comneon GmbH & Co. OHG, Nürnberg, (Mitglied der Gesellschafterdelegation) ■ Comneon electronic technology GmbH & Co. OHG, Linz, (Mitglied des Beirats) ■ DICE Danube Integrated Circuit Engineering GmbH & Co. KG, Linz (Mitglied der Gesellschafterdelegation) ■ Infineon Technologies Wireless Design Denmark A/S, Aalborg (Mitglied des Board of Directors)
Gerd Schmidt* ²	48	2004**	Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West
Sibylle Wankel* (bis 31. Mai 2002)	38	–	Bezirkssekretärin der IG Metall Bayern
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Vaillant GmbH, Remscheid ■ ZEPPELIN GmbH, Garching bei München
Prof. Dr. Claus Weyrich (bis 22. Januar 2002)	58	–	Mitglied des Vorstands der Siemens AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Heraeus Holding GmbH, Hanau
			Konzernmandate: Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ Siemens Corporate Research, Princeton, USA (Vorsitzender des Board)
Dr. rer. nat. Martin Winterkorn (seit 22. Januar 2002)	55	2005	Vorsitzender des Vorstands der Audi AG Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG
			Externe Mandate: Mitglied des Aufsichtsrats <ul style="list-style-type: none"> ■ Salzgitter AG, Salzgitter
			Konzernmandate: Vergleichbare Mandate <ul style="list-style-type: none"> ■ SEAT S.A., Barcelona, Spanien ■ Lamborghini Holding S.p.A., Italien

Dr.-Ing. Klaus Wucherer	58	2005	Mitglied des Vorstands der Siemens AG
			Externe Mandate:
			Mitglied des Aufsichtsrats
			■ Deutsche Messe AG, Hannover
			Konzernmandate:
			Mitglied des Aufsichtsrats
			■ BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München
			Vergleichbare Mandate
			■ Siemens Ltd., Peking, China (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
			■ Siemens E&A, Atlanta, USA (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
			■ Siemens K.K., Tokio, Japan (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
			■ Yaskawa Siemens Automation & Drives, YSAD, Tokio, Japan (Vorsitzender des Verwaltungsrats) (bis Juni 2002)
			■ Eviop-Tempo, Athen, Griechenland (Verwaltungsrat)
			■ Siemens Building Technologies AG, Zürich, Schweiz (Verwaltungsrat)
			■ Siemens Ltd., Mumbai, Indien (Verwaltungsrat)

Anmerkungen

¹ Mitglied des Präsidialausschusses

² Mitglied des Vermittlungsausschusses

³ Mitglied des Investitions- und Finanzausschusses

⁴ Herr Müller wurde gerichtlich bestellt und ersetzt Sibylle Wankel nach deren Ausscheiden.

Herr Kley wurde durch Beschluss vom 16. August 2002 gerichtlich bestellt für den ausgeschiedenen Herrn Dr. Mihatsch.

* Arbeitnehmervertreter

** Wenn nicht vorher durch ein gewähltes Mitglied ersetzt.

**Wesentliche Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen
für das zum 30. September 2002 endende Geschäftsjahr**

Name und Sitz der Gesellschaft	
EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke	100%
Guardeon Solutions AG, München	100%
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden	100%
Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. KG, Dresden	87%
Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich	100%
Infineon Technologies-Fabrico de Semicondutores, Portugal S.A., Vila do Conde, Portugal	100%
Infineon Technologies France S.A.S., Saint Denis, Frankreich	100%
Infineon Technologies Holding B.V. Rotterdam, Niederlande	100%
Infineon Technologies Trutnov s.r.o., Trutnov, Tschechische Republik	100%
Infineon Technologies Wireless Solutions Sweden AB, Stockholm, Schweden	100%
Infineon Technologies Catamaran Inc., Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Holding North America Inc., Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Richmond LP, Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur	100%
Infineon Technologies (Advanced Logic) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies (Integrated Circuit) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan	100%
ALTIS Semiconductor S.N.C, Essonnes, Frankreich	50,1%
ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan	29,9%
UMCi Pte. Ltd., Singapur	31,7%

Die erweiterte Anteilsbesitzliste wird beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 126492 hinterlegt.

Infineon Technologies AG – Einzelabschluss* – Kurzfassung (Euro in Mio.)

Gewinn- und Verlustrechnungen*	2001	2002	Bilanzen* zum 30.09.	2001	2002
Umsatz	6.697	6.765	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.010	991
Umsatzkosten	-6.515	-6.669	Finanzanlagen	5.388	5.874
Bruttoergebnis	182	96	Anlagevermögen	6.398	6.865
Aufwendungen der übrigen Funktionsbereiche	-1.529	-1.358	Vorräte	338	340
Übrige Aufwendungen und Erträge	860	580	Forderungen und Sonstiges	2.184	2.009
Ergebnis vor Ertragssteuer	-487	-682	Wertpapiere, Flüssige Mittel	8	1.803
Ertragssteuern	52	65	Summe Aktiva	8.928	11.017
Jahresfehlbetrag	-435	-617	Eigenkapital	7.259	7.061
Verlustvortrag aus Vorjahr	-	-435	Rückstellungen	619	631
Bilanzverlust	-435	-1.052	Verbindlichkeiten und Sonstiges	1.050	3.325
			Summe Passiva	8.928	11.017

* Erstellt nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB)
Ist nicht Teil des Anhang zum Konzernabschluss

Mehrjahres-Übersicht 1998–2002

Ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG (in Mio. Euro)

Zum Ende des Geschäftsjahres per 30. September	1998	1999	2000	2001	2002
Daten der Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnungen					
Umsatzerlöse	3.175	4.237	7.283	5.671	5.207
nach Regionen:					
Deutschland	1.078	1.241	1.612	1.745	1.372
Übriges Europa	783	1.203	1.647	1.260	1.023
USA	626	827	1.814	1.262	1.211
Asien/Pazifik	649	899	2.100	1.309	1.512
Andere	39	67	110	95	89
nach Geschäftsbereichen ¹ :					
Drahtgebundene Kommunikation	n/a	n/a	661	766	386
Sichere Mobile Lösungen ² , davon	n/a	n/a	1.566	1548	1.295
Mobile Kommunikation	n/a	n/a	1.191	960	874
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	n/a	n/a	375	588	421
Automobil- und Industrieelektronik	n/a	n/a	923	1.153	1.201
Speicherprodukte	n/a	n/a	3.473	1.588	1.844
Sonstige und Konzernfunktionen	n/a	n/a	660	616	481
Umsatzkosten	-2.727	-3.010	-4.111	-4.904	-4.606
Bruttoergebnis vom Umsatz	448	1.227	3.172	767	601
Forschungs- und Entwicklungskosten	-637	-739	-1.025	-1.189	-1.060
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-481	-551	-670	-786	-643
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-817	-	-	-117	-16
Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), (Saldo)	-9	-1	2	200	46
Betriebsergebnis	-1.496	-64	1.479	-1.125	-1.072
Zinsergebnis, saldiert mit Zuschüssen	-35	43	75	-1	-25
Anteiliger Periodenüberschuss/-fehlbetrag					
von nach der Equity-Methode konsolidierten Unternehmen	-151	34	101	25	-47
Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen					
durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	-	-	53	11	18
Sonstige Erträge, (Saldo)	1	18	36	65	-41
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	-1	-	-6	6	7
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.682	31	1.738	-1.019	-1.160
Erträge (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	907	30	-612	428	139
Konzernperiodenüberschuss/-fehlbetrag	-775	61	1.126	-591	-1.021
Konzernperiodenüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie in Euro – unverwässert und verwässert	-1,29	0,10	1,83	-0,92	-1,47
EBIT	-1.646	-12	1.670	-1.024	-1.142
nach Geschäftsbereichen ¹ :					
Drahtgebundene Kommunikation	n/a	n/a	48	-93	-245
Sichere Mobile Lösungen ² , davon	n/a	n/a	307	-151	-134
Mobile Kommunikation	n/a	n/a	258	-178	-82
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	n/a	n/a	49	27	-52
Automobil- und Industrieelektronik	n/a	n/a	71	143	111
Speicherprodukte	n/a	n/a	1.336	-931	-616
Sonstige und Konzernfunktionen	n/a	n/a	-92	8	-258

Zum Ende des Geschäftsjahres per 30. September	1998	1999	2000	2001	2002
Daten der Konzern-Bilanzen					
Zahlungsmittel	12	30	511	757	1.199
Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	498	93	738
Vorräte	583	677	841	882	891
Summe Umlaufvermögen	2.117	2.523	3.835	2.876	4.191
Sachanlagen	2.198	3.014	4.034	5.233	4.491
Finanzanlagen	28	130	432	655	708
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	–	64	132	86	70
Bilanzsumme	4.760	6.445	8.853	9.743	10.918
Kurzfristige Verbindlichkeiten sowie kurzfristiger Teil langfristiger Verbindlichkeiten	106	495	138	119	120
Langfristige Verbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	893	135	128	249	1.710
Summe Eigenkapital	2.096	3.656	5.806	6.900	6.158
Daten der Konzern-Kapitalflussrechnungen					
Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	–185	469	2.080	211	237
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	–959	–918	–2.327	–1.813	–1.244
Planmäßige Abschreibungen	578	573	834	1.122	1.371
Investitionen in Sachanlagen	–763	–653	–1.571	–2.282	–643
Börsenkennzahlen (zum 30. 9.) (Börsengang am 13.03.2000)					
Dividendenertrag pro Aktie (Euro)	n/a	–	0,65	–	–
Xetra Handelssystem (Euro)	n/a	n/a	54,88	13,50	5,61
New York Stock Exchange (NYSE) (US Dollar)	n/a	n/a	47,50	12,39	5,70
Anzahl der Aktien (Mio. Stück)	n/a	n/a	625,5	693,0	720,8
Marktkapitalisierung (Mrd. Euro)	n/a	n/a	34.327	9.356	4.044
Marktkapitalisierung (Mrd. US Dollar)	n/a	n/a	29.711	8.586	4.109
Kennzahlen					
Eigenkapitalquote	44%	57%	66%	71%	56%
Verschuldungsgrad	48%	17%	5%	5%	30%
Net Cash (am 30. 9.) ³	–987	–536	875	568	177
Mitarbeiter zum 30. 9. (absolute Zahlen soweit verfügbar)					
Gesamt	n/a	25.779	29.166	33.813	30.423
nach Regionen:					
Deutschland	n/a	12.853	14.247	16.814	15.716
Übriges Europa	n/a	2.842	3.409	5.007	4.590
USA	n/a	2.563	2.838	3.023	2.889
Asien/Pazifik	n/a	7.521	8.672	8.949	7.200
Andere	n/a	–	–	20	28
nach Funktionen:					
Produktion	n/a	n/a	20.371	23.416	20.822
Forschung und Entwicklung	n/a	n/a	4.733	5.510	5.374
Vertrieb und Marketing	n/a	n/a	2.043	2.259	2.010
Verwaltung	n/a	n/a	2.019	2.628	2.217

¹ Zum 1. Oktober 2001 haben wir einige unserer Geschäftsbereiche reorganisiert, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Die Bereichsergebnisse der Jahre 2000 und 2001 wurden entsprechend umgestellt, sodass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahres entsprechen und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen zu ermöglichen.

² Infineon hat mit Wirkung zum 1. November 2002 den neuen Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen gegründet. Dieser fasst die bisherigen Bereiche Mobile Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs zusammen.

³ Entspricht der Kalkulation: Zahlungsmittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens plus als Sicherheitsleistung hinterlegte Zahlungsmittel minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

Stichwortverzeichnis

Abhängigkeitsbericht	117f.
Abschlussprüfer (Bericht der unabhängigen)	119
AG-Abschluss (Einzelabschluss)	116ff., 179
Agenda 5-to-1	19, 24, 42, 57, 67, 78
Akquisitionen	79, 90, 101, 111, 131ff.
Aktioptionspläne	130, 134, 158ff.
Anhang zum Konzernabschluss	126ff.
Assoziierte Unternehmen	100, 103, 120ff., 137ff., 145ff., 179
Aufsichtsrat (Bericht)	78
Aufsichtsrat (Besetzung)	81, 173ff.
Ausblick	110
Automobil- und Industrieelektronik	63, 67, 70, 74, 97, 100
Bericht der Abschlussprüfer	119
Bericht des Aufsichtsrats	78ff.
Bericht des Vorstands (Lagebericht)	85ff.
Bestätigungsvermerk	119
Bilanz	121
Bilanzierung	126, 130f., 169
Brief an die Aktionäre	10
Campeon	79, 112
Cash-Flow	87, 104, 124f.
Chancen (und Risiken)	84, 113
Chronik 2002	52f.
Chronik 1952–2002	58ff.
Corporate Governance	82
Desinvestitionen	93
Dividende/Dividendenertrag	117, 135, 147, 159, 181
Drahtgebundene Kommunikation	64, 74, 96, 100
Eigenkapitalveränderungs-Rechnung	122
Einkauf (Rationalisierung)	88, 155, 163
Ereignisse nach dem 30.09.2002	109, 163
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94
Ergebnis je Aktie	87, 135, 160
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	85, 87, 94f., 103, 164ff., 180
Fertigungskapazitäten (Optimierung)	93, 99f.
Finanzanlagen	105, 116f., 121f., 139f., 181
Finanzdaten (Ausgewählte Konzern-)	180ff.
Finanzlage	104, 117, 119
Finanzverbindlichkeiten	105f., 108, 121, 142ff., 145ff., 181
Forschung und Entwicklung (Aufwendungen)	89, 101, 112, 154, 169, 180
Fremdwährungsmanagement	114
Geschäftsanteilsveräußerungen	133
Geschäftsbereiche	94, 96ff., 109f., 110ff., 163ff., 180
Geschäftstätigkeit, Gründung	126
Gewinn- und Verlust-Rechnung	120
Grundkapital	117, 121, 134
IFX Aktie	47ff.
Impact (Kostensenkungsprogramm)	78, 85, 87ff., 99, 101f., 111f.
Impressum	184

Infineon Technologies AG	84, 116ff., 126, 135, 168ff., 179
Innovationsbericht	31ff.
Investitionen	85f., 88, 92f., 108ff., 139, 181
Jahresabschluss	79, 117f., 126, 170
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	87, 95, 106, 120ff., 140, 179
Kapitalbedarf	106, 111
Kapitalerhöhung	135
Kapitalflussrechnung	124f., 157, 181
Kapitalmaßnahmen	134
Konjunktur	85, 114
Konsolidierungsgrundsätze	126
Konzern-Finanzdaten (ausgewählte)	180f.
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, -Bilanzen, -Kapitalflussrechnungen	120ff.
Konzernlagebericht	85ff.
Konzernrechnungslegung	119
Kooperationen	91f., 110f., 163
Kostensenkungsprogramm (Impact)	78, 85, 87ff., 99, 101f., 111f.
KPMG (Wirtschaftsprüfer)	79, 119, 168
Kunden	9, 21ff., 31, 63ff.
Lagebericht	85ff.
Märkte	24
Mehrjahres-Übersicht	180f.
Mission	14f., 19
Mitarbeiter	88f., 102, 112, 155f., 181
Mobile Kommunikation	66, 74, 94, 100
Pensionsverpflichtungen	151ff.
Quartalszahlen (Umsatz)	74
Risiken	84, 113ff., 129, 160
Sachanlagen	93, 121, 127, 132, 138, 150
Segmentdaten, -berichterstattung	94, 96ff., 110ff., 164ff.
Sichere Mobile Lösungen	66f., 109, 163, 180
Sicherheits- und Chipkarten-ICs	67ff., 74, 97, 100
Speicherprodukte	63, 72ff., 97, 100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	95, 103f., 120, 130, 148ff., 180
Tochtergesellschaften	106, 117, 126, 130, 144, 179
Umsatzerlöse	87, 92ff., 120, 129, 164ff., 180
Umsatzkosten	95, 99f., 120, 161, 179f.
Umweltschutz	35, 38, 43f.
Unternehmensstrategie	11f., 18ff., 24f., 32, 40f.
Vermögenslage	105f.
Vertriebskosten	95, 102, 120, 180
Verwaltungskosten (allgemeine)	95, 102, 120, 180
Vision	14f., 19, 22, 24, 32, 71
Vorstand	14f., 171f.
Weltwirtschaft	85f.
Umstrukturierung (inkl. Restrukturierung)	94f., 101f., 120, 142, 154, 180
Zinsergebnis	95, 103, 120, 180

Impressum Geschäftsbericht 2002

Herausgeber Infineon Technologies AG, München

Redaktion Corporate & Investor Communications
Accounting & Financial Reporting

Gestaltung OgilvyOne worldwide GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Satz OgilvyOne und Newway Agentur GmbH, Frankfurt am Main
Fotonachweis Günther Bauer, Frank Blümmler, Ralf Braum, Getty Images, ZEFA, The Image Bank, Corbis
Lithografie ProFab GmbH, Frankfurt am Main
Druck Kunst- und Werbedruck GmbH, Bad Oeynhausen

Gedruckt in Deutschland.

Die folgenden Bezeichnungen sind **eingetragene Namen, Markennamen und/oder Markenzeichen** der Infineon Technologies AG: Infineon und das Infineon Technologies-Logo, 10BaseS, Bidi, BlueMoon, CoolMOS, CoolSET, Infineon FingerTIP, OptiMOS, PAROLI, SMARTi, S-Gold, StarCore, TriCore.

Das **BLUETOOTH**-Markenzeichen wird von Infineon in Lizenz verwendet.

Alle anderen in diesem Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte die Rechte ihrer Inhaber verletzen kann.

Wenn Sie **zusätzliche Exemplare** dieses Geschäftsberichts in deutscher oder englischer Sprache bestellen möchten, oder wenn Sie diese Berichte und aktuelle Anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns doch im Internet unter www.infineon.com/boerse. Aktionäre und andere interessierte Anleger können kostenlose Einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der Abteilung Investor Relations anfordern.

Für interne Bestellungen

LZF Fürth-Bislohe

Per Intranet <http://c4bs.spls.de>

Per Fax +49 (0) 911 654 4271

Bestellnummer (deutsch) B192-H8086

(englisch) B192-H8086-X-X-7600

Wichtige Finanztermine 2003*

Montag, 20. Januar

Veröffentlichung des Berichts über das
1. Quartal 2003

Dienstag, 21. Januar, 10.00 Uhr

Hauptversammlung 2003 in München,
Olympiahalle

Dienstag, 22. April

Veröffentlichung des Berichts über das
2. Quartal 2003

Dienstag, 22. Juli

Veröffentlichung des Berichts über das
3. Quartal 2003

Mittwoch, 19. November

Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen
für das 4. Quartal 2003 und das
Geschäftsjahr 2003

* vorläufig

Infineon Technologies AG

Hauptsitz

St.-Martin-Straße 53
D-81669 München
Telefon +49 (0)89 234-0

Geschäftsjahr

1. Oktober bis 30. September

Abschlussprüfer

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin und
Frankfurt am Main

Kontakt für Anleger und Analysten

E-Mail: Investor.Relations@infineon.com
Telefon/Fax:
+49 (0)89 234-26655/-26155

Kontakt für Journalisten

E-Mail: Media.Relations@infineon.com
Telefon/Fax:
+49 (0)89 234-28480/-28482

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.infineon.com



Finanzglossar

ADR – American Depositary Receipts – ADRs sind in den USA gehandelte Aktienzertifikate über nicht-amerikanische Aktien, die im Verhältnis 1:1 ausgestellt werden. Sie erleichtern nicht-amerikanischen Unternehmen den Zugang zu US-amerikanischen Kapitalmärkten und bieten so US-amerikanischen Anlegern Investitionsmöglichkeiten in nicht-amerikanische Gesellschaften. Infineons ADRs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt.

Bilanz – Sie bildet die Finanzpositionen einer Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres ab und ist Teil des Konzernabschlusses. Die Bilanz zeigt die Mittelherkunft und Mittelverwendung einer Gesellschaft.

Bruttoergebnis – Umsatz abzüglich Herstellungskosten des Umsatzes.

Cash-Flow – Zahlungswirksamer Saldo aus Mittelzuflüssen und -abflüssen innerhalb eines Geschäftsjahres. Der Cash-Flow ist Teil des Konzernabschlusses und zeigt für einen Zeitraum, aus welchen Quellen sich eine Gesellschaft finanziert und wofür die Zahlungsmittel verwendet wurden, gegliedert nach laufender Geschäftstätigkeit (Mittel, die durch Verkauf von Produkten und Dienstleistungen generiert wurden), Investitionstätigkeit (Mittelabfluss einer Gesellschaft, um das zukünftige Wachstum zu sichern) und Finanzierungstätigkeit (Mittelzufluss durch die Ausgabe von Aktien und Anleihen).

Corporate Governance-Kodex – Kodex der Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance-Kodex“, der die Vorgaben und Empfehlungen guter Unternehmensleitung und -kontrolle für börsennotierte Gesellschaften in Deutschland zusammenfasst.

DAX – Deutscher Aktienindex. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten deutschen Aktiengesellschaften ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

EBIT – Earnings Before Interest and Taxes. Bei Infineon ist das EBIT definiert als „Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern“. Dies ist die Kennzahl, mit der Infineon die operative Ertragskraft seiner Geschäftsbereiche bewertet.

EBIT-Marge – Eine Kennzahl zur Bestimmung der operativen Ertragskraft, die das EBIT im Verhältnis zum Umsatz darstellt.

Eigenkapital-Bilanzierung – Verfahren zur Bilanzierung von Beteiligungsgesellschaften, wobei der Anteil an einer Gesellschaft mit dem verhältnismäßigen Anteil an deren Eigenkapital aufgenommen wird. Änderungen an diesem verhältnismäßigen Anteil werden in der Gewinn- und Verlust-Rechnung erfasst.

Eigenkapitalquote – Zeigt den Anteil des Eigenkapitals in der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft, berechnet aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

Eigenkapitalrendite – auch: Return On Equity (ROE). Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die den Jahresüberschuss im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

Ergebnisanteile, auf konzernfremde Gesellschafter entfallend – Anteile am Jahresergebnis, die nicht dem Konzern, sondern Konzernfremden, die Anteile an verbundenen Unternehmen des Konzerns halten, zugeordnet werden.

Ergebnis je Aktie bzw. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie – Das unverwässerte Konzernergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Geschäftsjahr ausstanden, dividiert wird. Das verwässerte Konzernergebnis pro Aktie wird errechnet, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Geschäftsjahr ausstanden, zuzüglich der Zahl der Aktien, die emittiert würden, falls ausstehende Aktienoptionen, zugeeilte Aktienrechte und Wandelschuldverschreibungen ausgeübt bzw. gewandelt würden, dividiert wird.

Fair Value – Der Betrag, zu dem ein Vermögenswert (oder eine Verbindlichkeit) zwischen voneinander unabhängigen Geschäftspartnern freiwillig, d.h. nicht gezwungenermaßen oder in einem Liquidationsverfahren, gekauft (oder aufgenommen) bzw. veräußert (oder getilgt) würde. Der Fair Value ist häufig identisch mit dem Marktpreis, muss es aber nicht zwangsläufig sein.

Free-Cash-Flow – Der für den Netto-Zahlungsmittelbestand relevante Saldo des Mittelzuflusses bzw. -abflusses aus laufender Geschäftstätigkeit von Infineon und des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit, bereinigt um den dort gezeigten Mittelzu- bzw. -abfluss aus kurzfristig verfügbaren Wertpapieren.

Gesamtkapitalrentabilität – auch: Return On Total Assets (ROTA). Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die das EBIT im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Gesamtkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

Gewinnrücklagen – Derjenige Teil des Eigenkapitals, der aus nicht ausgeschütteten Gewinnen gebildet wird und zur Verbesserung der Geschäftstätigkeit oder Reduzierung von Verbindlichkeiten reinvestiert wird.

Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) – Stellt den Erfolg der Geschäftstätigkeit einer Gesellschaft während eines Geschäftsjahrs dar und ist Teil des Konzernabschlusses.

Goodwill (Geschäfts- und Firmenwert) – Ein immaterieller Vermögensgegenstand, der im Rahmen einer Unternehmensakquisition entsteht. Er stellt den Betrag dar, mit dem der Kaufpreis (die Kosten) für eine erworbene Gesellschaft den angenommenen Fair Value (siehe dort) der erworbenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten übersteigt. Nach US-GAAP wird der Geschäfts- und Firmenwert nicht über eine Nutzungsdauer abgeschrieben, sondern bei einer eventuellen Wertminderung durch eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert.

Konzernjahresabschluss – Jahresabschluss der Infineon Unternehmensgruppe, der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns am Ende eines Geschäftsjahrs so darstellt, als seien die rechtlich selbstständigen Konzernunternehmen wirtschaftlich eine Einheit. Der Konzernjahresabschluss enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlust-Rechnung, den Cash-Flow, die Eigenkapital-Veränderungsrechnung sowie den Anhang.

Latente Steuern – Da die steuerliche Gesetzgebung des Öfteren von den handelsrechtlichen Vorgaben abweicht, können Unterschiede zwischen (a) dem zu versteuernden Einkommen und dem handelsrechtlichen Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und (b) der steuerlichen Bemessungsgrundlage von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten und ihren jeweiligen Buchwerten entstehen. Eine latente Steuerverbindlichkeit und der zugehörige Aufwand entstehen aus Einkommen, das bereits handelsrechtlich, jedoch nicht steuerrechtlich, erfasst ist. Umgekehrt entsteht eine latente Steuerforderung, wenn der Aufwand erst in Zukunft steuerlich abzugsfähig ist, jedoch handelsrechtlich bereits erfasst wurde.

Namensaktien – Aktien, die auf den Namen einer bestimmten Person lauten. Diese Person wird entsprechend den aktienrechtlichen Vorgaben mit einigen persönlichen Angaben sowie der Aktienanzahl in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Nur wer im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, gilt gegenüber der Gesellschaft als Aktionär und kann beispielsweise seine Rechte in der Hauptversammlung ausüben.

Risikomanagement – Systematische Vorgehensweisen, um potenzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Risikohandhabung und -verringeringung auszuwählen und im Unternehmen umzusetzen.

Segmentberichterstattung – Darstellung von Vermögens- und Ergebnisinformationen nach Geschäftsbereichen und geographischen Regionen.

US-GAAP – US-amerikanische Norm der Rechnungslegung. Infineon stellt den Konzernabschluss gemäß den Vorgaben des US-GAAP auf.

Verschuldungsgrad – Kennzahl der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft. Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

Technologieglossar

3G – Dritte Generation. Steht für die neue Netzwerktechnologie für den Mobilfunk.

ASIC – Application Specific Integrated Circuit. Logik-Schaltung, die für eine spezifische Nutzung konstruiert und in eine integrierte Schaltung implementiert wurde.

Bluetooth – Technologie zur Funkübermittlung von Sprache und Daten über kurze Strecken.

CDMA – Code Division Multiple Access. Verfahren, das in Mobilfunksystemen eingesetzt wird und mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf einen Übertragungskanal ermöglicht. Vorteil: bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite.

Chipkarte – Kunststoffkarte mit eingebautem Speicherchip oder Mikroprozessor, auch mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN) kombinierbar.

CMOS Technology – Complementary Metal Oxide Semiconductor Technology. Technologie, um Mikrochips mit geringem Energieverbrauch und hohem Integrationsgrad zu produzieren.

DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Einheitlicher europäischer Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme.

DRAM – Dynamic Random Access Memory. Aufgrund der hohen Integrationsdichte und des daraus resultierenden niedrigen Preises weit verbreitete Speicherchip-Technologie. Beispiele für DRAM-Chips sind SDRAM, DDR DRAM, RDRAM, Rambus oder in Logikschaltungen eingebettete DRAM (vgl. „RAM“).

Ethernet – Netzwerk für Hochgeschwindigkeitskommunikation für den lokal begrenzten Einsatz (Ausdehnung von einigen 10 m bis 10 km).

Flash-Memory – Eine Sorte nichtflüchtigen Speichers. Sein Inhalt bleibt erhalten, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

Flüchtiger Speicher – Speicher, der die in ihm gespeicherten Informationen verliert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

GPRS – General Packet Radio Service heißt eine neue Mobilfunkgeneration der 2.5-Generation für höhere Datenübertragungsraten (bis zu 115 Kilobit/Sekunde) in GSM-Netzen.

GPS – Global Positioning System. Funkortungsverfahren zur Positionsbestimmung anhand des direkten Empfangs von Radiosignalen.

GSM – Das Global System for Mobile Communication ist heute weltweit das am meisten genutzte digitale Mobilfunksystem.

Halbleiter – Ein kristalliner Werkstoff, der bei Erwärmung eine mit der Temperatur anwachsende elektrische Leitfähigkeit zeigt. Halbleiter sind z. B. Silizium, Germanium oder Galliumarsenid. Der Begriff wird auch verwendet für ICs aus diesem Werkstoff.

IC/ICs – Integrated Circuit/-s (integrierte Schaltung/-en). Bauelement auf Basis eines Halbleitermaterials wie Silizium, auf dem zahlreiche Komponenten wie Transistoren und Dioden integriert und miteinander verbunden sind.

ISDN – Integrated Services Digital Network. Online-Verbindungstyp, der Telekommunikationsdienste wie Telefon, Telefax oder Datenkommunikation in einem Netz integriert.

LAN – Local Area Network (Lokales Netzwerk). Datenkommunikationsnetz in einem räumlich eng begrenzten Gebiet, z. B. innerhalb eines Gebäudes.

MAN – Metropolitan Area Network. Datenkommunikationsnetzwerk in einem relativ kleinen räumlichen Gebiet, z. B. einer Stadt.

Megabit (Mbit) – Ca. eine Million Bit. Ein Bit ist eine Informations- bzw. Recheneinheit, die einen von zwei Werten annimmt, z. B. „richtig“/„falsch“ oder „0“/„1“.

Megabyte (Mbyte) – Ca. eine Million Byte. Ein Byte ist eine Maßeinheit für Informationseinheiten bei Datenverarbeitungsanlagen; sie entspricht 8 Bit.

Mikrocontroller – Mikroprozessor, der auf einem einzelnen IC mit Speicher und Schnittstellen kombiniert integriert ist und als eingebettetes System funktioniert. In einem Mikrocontroller lassen sich komplexeste logische Schaltungen realisieren und per Software kontrollieren.

Mikrometer/Mikron – Metrisches Längenmaß. Entspricht dem millionsten Teil eines Meters. Symbol: μm (Mikron). Beispiel: Durchmesser des Menschenhaares: 0,1 mm.

PDA – Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch, neuerdings auch in Kombination mit Handys verfügbar, wird mit dem PC synchronisiert.

RAM – Random Access Memory (Direktzugriffsspeicher). Auch als Haupt- oder Arbeitsspeicher bezeichneter Datenspeicher, enthält Programme und Daten von externen Speicherträgern. Er verliert seine Daten ohne Stromversorgung, Beispiele sind SRAM und SGRAM (vgl. „DRAM“).

ROM – Read Only Memory (Nur-Lese-Speicher). Digitaler, nichtflüchtiger Datenspeicher, in dem Daten auch ohne Spannungsversorgung dauerhaft gespeichert sind.

Silizium – Werkstoff mit halbleitenden Eigenschaften. In der Halbleiterindustrie wird in großem Umfang Silizium als Grundstoff verwendet (Silizium-Wafer).

Speicher – Synonym für RAM und ROM (vgl. „RAM“, „ROM“), kann sich auf jedes Gerät beziehen, das Daten in maschinenlesbarem Format speichert.

Telematik – Aus Telekommunikation und Informatik zusammengesetztes Kunstwort. Oberbegriff für die Integration von Sprach-, Daten- und Bildkommunikationstechnik.

UMTS – Das Universal Mobile Telecommunications System soll ein künftiger digitaler Weltstandard für Mobilfunk werden. UMTS ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu zwei Megabit pro Sekunde – 200-mal so viel wie heute.

Wafer – Scheibe aus einem Halbleiter-Werkstoff, z. B. Silizium, mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Bei der Produktion von ICs wird er aus einem Einkristall geschnitten und dient als Trägermaterial für integrierte Schaltkreise.

WAN – Wide Area Network. Datenkommunikationsnetzwerk, das eine große geographische Fläche abdeckt.

xDSL – x Digital Subscriber Line. Oberbegriff für verschiedene technische Konzepte zur breitbandigen, digitalen Datenübertragung über herkömmliche verdrehte Kupferdoppeladern. Je nach Konfiguration steht das „x“ für ADSL, SDSL, SHDSL oder VDSL.

Wir haben unsere Unternehmensstrategie neu ausgerichtet und in der Agenda 5-to-1 unsere langfristigen Erfolgsziele zusammengefasst:

- ▮ In den nächsten 5 Jahren wollen wir
- ▮ zu den Top 4 Halbleiterunternehmen gehören, indem wir unseren Anteil am Weltmarkt für Halbleiter auf rund 6 % verdoppeln,
- ▮ in jedem unserer Geschäftssegmente mindestens eine Top 3 Marktposition erreichen,
- ▮ bei der Ertragskraft jedes einzelnen Geschäftsbereiches eine Top 2 Position einnehmen und
- ▮ das Halbleiterunternehmen Nr. 1 im Lösungsgeschäft werden.



Never stop thinking.

